

北京芯愿景软件技术股份有限公司

Cellixsoft Corporation

北京市海淀区高里掌路1号院2号楼1层102



CELLIX
IP & Design Services

公开转让说明书

(申报稿)

声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

平安证券

地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

二〇二五年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
技术创新风险	公司所属细分行业为 IC 设计业的上游支撑领域。近年来，IC 产业下游需求不断拓展，产品及技术升级迭代速度较快，IC 制造技术不断向 7 纳米、5 纳米、3 纳米等先进工艺制程演进。全球范围内，IC 产业仍在不断革新之中。同时，公司 IC 分析业务、知识产权和资讯业务以及设计业务技术门槛高、工艺开发时间长，公司持续面临研究开发未能达到预期效果、流片验证失败、客户产品方向或市场需求发生重大变化等不确定性。 未来，如果公司不能持续紧跟行业主流技术和前沿市场需求，技术创新方向出现偏差，或现有技术被替代，将导致公司在新技术开发和应用上无法持续保持先进地位、市场竞争力下降。
市场竞争加剧风险	根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计，2024 年集成电路市场规模达 4,284.42 亿美元。未来随着行业发展，细分领域环境可能发生变化，导致存量市场中出现竞争加剧、需求下降等情形。公司所处 IC 产业细分领域发生不利变化，将有可能直接影响公司整体的经营业绩。
国际贸易摩擦风险	近年来，部分国家通过贸易保护等手段，限制对我国相关产业的进出口，试图制约中国半导体等产业的发展。截至公开转让说明书签署日，上述事项未对公司的业务开展产生重大不利影响。国际贸易摩擦虽然促使中国半导体产业链的自主可控需求提升，为本土半导体行业厂商提供了发展机遇，但是，如果未来贸易摩擦长期持续，或者贸易保护措施进一步升级，使得客户采购或供应商供货受到约束，将给公司带来一定的经营风险。
IC 分析业务、知识产权和资讯业务所涉及法律法规和政策变化风险	公司开展 IC 分析业务、知识产权和资讯业务的工序包括采用逆向工程对 IC 进行分析，所涉及知识产权领域的主要法律法规已具有较长的发展历史。目前，世界集成电路主要发达国家均已出台支持 IC 逆向分析相关法律法规，我国亦于 2001 年起通过立法和司法解释确立了逆向工程为一种促进技术进步的合法研究方法，至今未进行实质性变动，且目前集成电路作为我国重点发展行业，国家出台鼓励和促进集成电路行业的政策。如果未来我国相关法律法规或政策发生变化，将有可能对公司业务的开展造成不利影响。
潜在诉讼风险	通常情况下，公司在 IC 分析相关业务合同中约定，技术成果仅供客户学习、参考和评价使用，由于客户使用相关成果引起的所有知识产权问题，由其承担全部责任。公司开展 IC 分析相关业务时，不具有监督客户是否存在潜在侵权行为的注意义务，且有理由相信客户合法合规使用相关成果。在业务实际开展中，存在客户不当使用 IC 分析技术成果而遭受诉讼，最终导致公司被牵连成为该等诉讼被告的风险。
毛利率下降风险	报告期内，公司综合毛利率分别达到 71.66%、71.35%，整体处于较高水平。未来，随着市场竞争的加剧、技术迭代发展的不确定性及人力成本的增加，公司毛利率将可能出现下降，

	从而给公司经营业绩带来不利影响。
应收账款回收风险	公司应收账款规模较大，报告期各期末应收账款账面价值分别为 5,763.81 万元、4,506.18 万元，占资产总额的比例分别为 6.97%、5.01%，占流动资产的比例分别为 15.99%、9.24%。由于专业科研院所、行业内大型企业等客户通常具有严格的资金预算管理体系，相关款项支付需要履行严格的内部审批程序，故公司与其合作普遍会产生一定期间的账龄。未来，随着业务收入不断提高，公司应收账款规模也将持续扩大；不能排除应收账款发生坏账损失的风险，从而给公司经营业绩带来不利影响。
税收优惠政策变动风险	报告期内，公司享受的税收优惠主要为高新技术企业所得税、研发费用加计扣除和软件增值税即征即退税收优惠，优惠金额占当期利润总额的比例较低。即便如此，如未来上述税收优惠政策发生变化，或者公司不能够持续符合享受上述税收优惠政策的条件，将对公司净利润水平产生一定影响。
实际控制人控制失当风险	本次挂牌前，公司共同实际控制人为丁柯、蒋卫军、张军和丁仲，直接控制公司 94.2578%股份对应的表决权，并通过新创愿景、同创愿景间接控制公司 3.5469%股份对应的表决权，合计控制公司 97.8047%股份对应的表决权。本次股票挂牌完成后，上述四人仍为公司共同实际控制人。 如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的各种经营决策进行不当控制，侵害中小股东利益，则公司将面临实际控制人控制失当风险。
对赌协议的风险	公司实际控制人丁柯、蒋卫军、张军、丁仲与外部投资者深创投签署了股东协议，约定了关于公司实际控制人回购义务的特殊投资条款。若触发上述股份回购情形，且相关投资者要求回购义务主体回购其所持有的公司股份，则现有股东持股比例存在可能发生变化的风险。
业绩波动风险	报告期内，公司实现营业收入分别为 21,492.38 万元、23,737.49 万元；净利润分别为 7,667.28 万元和 10,144.23 万元，收入和净利润均呈增长趋势。若未来出现宏观经济形势变化、行业竞争加剧等对公司经营造成不利影响的变化，而公司未能采取有效应对措施，同时公司存在部分执行周期较长的项目，该等项目普遍存在跨年度的情形，以上因素导致公司经营业绩可能出现波动。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
目 录	4
释 义	7
第一节 基本情况	11
一、 基本信息	11
二、 股份挂牌情况	11
三、 公司股权结构	17
四、 公司股本形成概况	28
五、 报告期内的重大资产重组情况	44
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况	44
七、 公司董事、监事、高级管理人员	46
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	48
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况	49
十、 与本次挂牌有关的机构	50
第二节 公司业务	52
一、 主要业务、产品或服务	52
二、 内部组织结构及业务流程	67
三、 与业务相关的关键资源要素	73
四、 公司主营业务相关的情况	104
五、 经营合规情况	108
六、 商业模式	109
七、 创新特征	112
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况	116
九、 公司经营目标和计划	135
第三节 公司治理	137
一、 公司股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	137
二、 表决权差异安排	140

三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见	140
四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响	141
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况	142
六、 公司同业竞争情况	142
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	143
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	144
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	147
第四节 公司财务	148
一、 财务报表	148
二、 审计意见及关键审计事项	157
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准	158
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	158
五、 适用主要税收政策	180
六、 经营成果分析	181
七、 资产质量分析	204
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析	228
九、 关联方、关联关系及关联交易	237
十、 重要事项	241
十一、 股利分配	244
十二、 财务合法合规性	245
第五节 挂牌同时定向发行	247
第六节 附表	248
一、 公司主要的知识产权	248
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	261
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施	263
第七节 有关声明	272
申请挂牌公司控股股东、实际控制人声明	272
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	273

主办券商声明.....	274
律师事务所声明.....	275
审计机构声明.....	276
评估机构声明.....	277
第八节 附件	279

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
芯愿景、公司、股份公司	指	北京芯愿景软件技术股份有限公司
芯愿景有限、有限公司	指	北京芯愿景软件技术有限公司，公司前身
天津芯愿景	指	天津芯愿景软件有限公司，为公司全资子公司
保定分公司	指	北京芯愿景软件技术股份有限公司保定分公司
太原芯愿景	指	太原芯愿景微电子技术有限公司，为公司全资子公司
方芯半导体	指	北京方芯半导体有限公司，为公司全资子公司
新创愿景	指	北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东、员工持股平台
同创愿景	指	北京同创愿景企业管理咨询中心（有限合伙），公司实际控制人持股平台
芯诺诚	指	北京芯诺诚微电子技术有限责任公司，系公司实际控制人蒋卫军曾经控制的公司，于 2003 年 8 月吊销，2020 年 2 月注销
宜安投资	指	宁波梅山保税港区宜安创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东，于 2023 年 4 月退出公司
丰年君和	指	宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，为公司股东
盈富泰克	指	盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东，于 2024 年 12 月退出公司
TechInsights	指	TechInsights, Inc.，系 IC 分析服务行业知名企业
宜特	指	宜特科技股份有限公司，台湾上柜公司，股票代码：3289.TWO
闳康	指	Materials Analysis Technology Inc.，闳康科技股份有限公司，台湾上柜公司，股票代码：3587.TWO
胜科纳米	指	胜科纳米（苏州）股份有限公司，上海证券交易所科创板股票代码：688757.SH
芯原股份	指	芯原微电子（上海）股份有限公司，上海证券交易所科创板股票代码：688521.SH
国芯科技	指	苏州国芯科技股份有限公司，上海证券交易所科创板股票代码：688262.SH
创耀科技	指	创耀（苏州）通信科技股份有限公司，上海证券交易所科创板股票代码：688259.SH
华大九天	指	北京华大九天科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板股票代码：301269.SZ
概伦电子	指	上海概伦电子股份有限公司，上海证券交易所科创板股票代码：688206.SH
广立微	指	杭州广立微电子股份有限公司，深圳证券交易所创业板股票代码：301095.SZ
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
航天科技	指	中国航天科技集团有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
律师、植德律师事务所	指	北京植德律师事务所

天职国际会计师事务所、天职会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股权系统	指	全国中小企业股份转让系统
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
股东大会/股东会	指	北京芯愿景软件技术股份有限公司股东大会/股东会
董事会	指	北京芯愿景软件技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京芯愿景软件技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《挂牌指引 1 号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《公司章程》	指	公司创立大会通过的《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》及其后续章程修正案
中国、境内	指	中华人民共和国大陆境内范围，仅为本公开转让说明书出具之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元/万元/亿元	指	如无特别指明，人民币元、万元、亿元
股票	指	境内上市人民币普通股（A 股）
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
报告期	指	2023 年、2024 年
报告期各期末	指	2023 年末、2024 年末
专业释义		
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料/元件；通常分为集成电路、分立器件、光电器件、敏感器件等
芯片/集成电路/IC	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
晶圆/晶圆片/圆片/Wafer	指	指经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
晶体管	指	一种固体半导体器件，具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能
管芯/die	指	晶圆经过切割测试后没有经过封装的芯片
摩尔定律	指	集成电路行业的一种现象，即 IC 上可容纳的晶体管数目每隔约 18 个月便会增加一倍，性能也随之提升一倍
IC 分析	指	包括检测分析、电路分析等技术服务
IC 设计	指	包括电路功能设计、结构设计、电路设计及仿真、版图设计和验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
IC 生产/制造	指	利用版图制作光掩模版，即以多次光刻的方法将版图呈现于

		晶圆上，最终在晶圆表面/内部形成立体电路
IC 封装	指	将晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能等作用
IC 测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
IP	指	Intellectual Property Core，即 IP 核，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的半导体模块
EDA	指	Electronic Design Automation，即电子设计自动化，指用于集成电路辅助设计的软件工具
集成器件制造商/IDM	指	Integrated Device Manufacturer，指涵盖集成电路设计、制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，即专门负责芯片的设计、研发、应用和销售，而将 IC 生产、IC 封装和 IC 测试等环节外包给专业的晶圆制造、封装和测试企业
系统厂商	指	面向终端应用提供整机系统设备的厂商
数字集成电路	指	基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号（0/1）的集成电路
模拟集成电路	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片；模拟信号是指用电参数（电流/电压）来模拟其他自然物理量形成的连续性电信号
工艺节点/工艺制程	指	集成电路内不同电路间的距离；精度越高，同等功能的 IC 体积越小、成本越低、功耗越小；当前工艺节点已达 7 纳米级
流片	指	工程试作样片流片或量产流片。工程试作样片流片是为了验证集成电路设计是否成功，需检验从电路图到芯片每个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能；如果工程试作样片流片成功，即可开展大规模批量生产，即量产流片
仿真	指	使用数学模型来对电子电路的真实行为进行模拟的工程方法
电路网表	指	Netlist，反映 IC 电路元件相互连接关系的一种数据形式
布图/版图	指	Layout，集成电路版图，是集成电路物理外观的平面几何形状描述
层次化电路	指	基于电路网表/平面电路图进行功能模块识别和整理分析，在保证电路连接关系不变的前提下，形成的可反映原始设计架构、功能模块的电路图
人·月	指	每人在标准月（22 天*8 小时）时长内完成的工作量或标准工作量
门级	指	Gate-Level，以网表描述的电路综合级别或规模；数字电路以“等效门”为单位计算规模，模拟电路以“器件”为单位计算规模，一个门相当于四个器件
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术；传统 CMOS 指平面基体型 CMOS 工艺
FinFET	指	Fin Field-Effect Transistor 简称，即鳍式场效应晶体管，一种集成电路制造工艺，新的互补式金氧半导体晶体管
SOI	指	Silicon-On-Insulator 简称，即绝缘层覆硅技术，一种集成电路制造工艺；在顶层硅（晶体管）和背衬底之间加入绝缘体物质（埋入式氧化层），实现元器件间的介质隔离，从而减

		少寄生电容及传统 CMOS 工艺的闩锁效应、降低整体功耗
TEM	指	Transmission Electron Microscope, 即透射式电子显微镜
EMMI	指	Emission Microscope, 即微光显微镜
FIB	指	Focused Ion Beam, 即聚焦离子束, 利用高强度聚焦离子束对材料进行纳米级加工, 配合扫描电子显微镜等进行实时观察
MCU	指	Microcontroller Unit, 微控制器, 是把中央处理器的频率与规格适当缩减, 并将内存、计数器、USB 等周边接口及驱动电路等整合在单一芯片上, 形成芯片级的计算机
SoC	指	System-on-Chip, 即为芯片级系统, 是在单个芯片上集成 CPU、GPU 等整个电子系统的产品
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit, 即专用集成电路, 指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
FPGA	指	Field Programmable Gate Array, 即现场可编程逻辑门阵列, 是一种高密度可编程逻辑器件 (HDPLD)
纳米/nm	指	长度单位, 1 纳米=10 ⁻⁹ 米
PDK	指	Process Design Kits, 即工艺设计工具包, 生产厂商提供的标准单元库, 以方便客户进行电路设计、仿真以及版图设计
FullMask	指	全掩模, 即一种集成电路的流片方式, 制造流程中的全部掩模都为某个 IC 的制造服务
Datasheet	指	芯片说明书, 即电子元器件或者芯片的数据手册, 一般由厂家编写, 内容为电子元件或者芯片的一般参数/电性参数/物理参数/制造材料及使用建议等, 形式一般为说明文字/特性曲线/图表/数据表等
EDX	指	能量散射型 X 射线荧光光谱仪
Filmshop	指	显微图像采集和处理系统, 公司自主研发的 EDA 软件之一
Panovas Pro	指	显微图像实时处理系统, 公司自主研发的 EDA 软件之一
ChipLogic Family	指	集成电路分析再设计系统, 公司自主研发的 EDA 软件之一
Hierux System	指	集成电路分析验证系统, 公司自主研发的 EDA 软件之一
Bool Smart System	指	集成电路设计优化系统, 公司自主研发的 EDA 软件之一
Catalysis Series	指	高性能图像自动算法系统, 公司自主研发的 EDA 软件之一
Design Smart System	指	定制集成电路智能设计系统, 公司自主研发的 EDA 软件之一
Veri Smart System	指	版图实时验证系统, 公司自主研发的 EDA 软件之一

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	北京芯愿景软件技术股份有限公司	
统一社会信用代码	91110108738229602C	
注册资本（万元）	6,261.1670	
法定代表人	丁柯	
有限公司设立日期	2002 年 4 月 27 日	
股份公司设立日期	2019 年 10 月 24 日	
住所	北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 1 层 102	
电话	010-62901860-668	
传真	010-82893201	
邮编	100095	
电子信箱	info@cellixsoft.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	王艳红	
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	I	信息传输、软件和信息技术服务业
	65	软件和信息技术服务业
	652	集成电路设计
	6520	集成电路设计
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	17	信息技术
	1712	半导体产品与设备
	171210	半导体产品与设备
	17121011	半导体产品
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	I	信息传输、软件和信息技术服务业
	65	软件和信息技术服务业
	652	集成电路设计
	6520	集成电路设计
经营范围	软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；出租办公用房；技术进出口、货物进出口。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
主营业务	公司的主营业务是依托自主开发的电子设计自动化（EDA）软件，开展集成电路分析业务、知识产权和资讯业务以及集成电路设计业务。	

二、 股份挂牌情况

（一） 基本情况

股票简称	芯愿景
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	62,611,670

每股面值（元）	1.00
股票交易方式	集合竞价
是否有可流通股	是

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

（1）相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百六十条：“公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《挂牌规则》第六十八条：“申请挂牌公司及其控股股东、实际控制人等应当按照下列安排向全国股转公司申请限售，并在公开转让说明书中披露：申请挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前 12 个月以内申请挂牌公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的限售安排按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售安排”。

（2）公司章程的规定

《公司章程》第二十九条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

2、 股东对所持股份自愿锁定承诺

√适用 □不适用

自愿限售股东	限售期安排	限售股数（股）
同创愿景	本企业在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为本企业挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	927,837
新创愿景	本企业在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为本企业挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	718,035

注：同创愿景为公司实际控制人的持股平台，丁柯担任其执行事务合伙人；新创愿景为公司的员工持股平台，丁柯担任其执行事务合伙人。因此，同创愿景及新创愿景均比照实际控制人出具股份锁定承诺。此外，公司董事、监事及高级管理人员在同创愿景和新创愿景中间接持有的公司股份比照《公司法》第一百六十条“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”锁定。

3、 股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	是否为董事、监事及高管	是否为控股股东、实际控制人、一致行动人	是否为做市商	挂牌前12个月内受让自控股股东、实际控制人的股份数量（股）	因司法裁决、继承等原因而获得有限售条件股票的数量（股）	质押股份数量（股）	司法冻结股份数量（股）	本次可公开转让股份数量（股）
1	丁柯	24,206,558	38.66%	是	是	否	-	-	-	-	6,051,639
2	蒋卫军	17,974,426	28.71%	是	是	否	-	-	-	-	4,493,606
3	张军	14,978,361	23.92%	是	是	否	-	-	-	-	3,744,590
4	丁仲	1,857,049	2.97%	是	是	否	-	-	-	-	464,262
5	同创愿景	1,237,113	1.98%	否	否	否	-	-	-	-	309,276
6	新创愿景	983,606	1.57%	否	否	否	-	-	-	-	265,571
7	深创投	756,000	1.21%	否	否	否	-	-	-	-	756,000

8	丰年君和	618,557	0.99%	否	否	否	-	-	-	-	618,557
合计	-	62,611,670	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	16,703,501

(四) 挂牌条件适用情况

共同标准	公司治理制度	股东会议事规则	制定
		董事会议事规则	制定
		监事会议事规则	制定
		关联交易制度	制定
		投资者关系管理制度	制定
	董事会秘书或信息披露事务负责人	公司是否设立董事会秘书或信息披露事务负责人	是
		董事会秘书或信息披露事务负责人是否为公司高管	是
	合规情况	最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决,或刑事处罚未执行完毕	☐ 是 ☒ 否
		最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为	☐ 是 ☒ 否
		最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查,尚未有明确结论意见	☐ 是 ☒ 否

		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信联合惩戒对象且情形尚未消除	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施,或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员,且市场禁入措施或不适格情形尚未消除的情形	☐ 是 ☒ 否
	审计情况	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	☐ 是 ☒ 否
		最近一期每股净资产不低于 1 元/股	☒ 是 ☐ 否
		持续经营时间是否少于两个会计年度	☐ 是 ☒ 否
	股本情况	股本总额（万元）	6,261.1670

差异化标准——标准 1

☒适用 ☐不适用

标准 1	净利润指标（万元）	年度	2024 年度	2023 年度
		归属于母公司所有者的净利润	10,144.23	7,667.28
		扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	9,699.08	7,128.29

差异化标准——标准 2

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准 3

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准 4

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准 4

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准 5

☐适用 ☒不适用

分析说明及其他情况

根据《挂牌规则》第二十一条的相关规定的挂牌条件：“除本规则第二十条规定的公司外，其他申请挂牌公司最近一期末每股净资产应当不低于 1 元/股，并满足下列条件之一：（一）最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，或者最近一年净利润不低于 600 万元”。

公司 2023 年度和 2024 年度，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 7,128.29 万元和 9,699.08 万元，最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元；公司最近一期末，即 2024 年 12 月 31 日，每股净资产为 11.69 元/股，不低于 1 元/股。

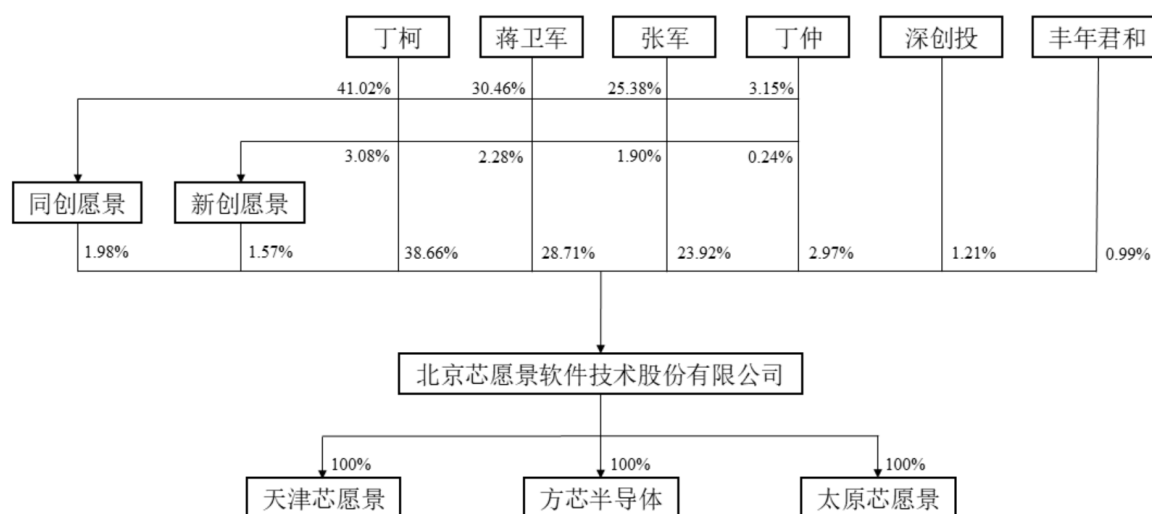
因此，公司符合挂牌条件的相关要求。

（五）进层条件适用情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

（一） 股权结构图



（二） 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

根据《公司法》第二百六十五条之（二）规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东”。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条之（五）规定：“控股股东，是指其持有的股份超过公司股本总额 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东”。

公司控股股东、实际控制人为丁柯、蒋卫军、张军及丁仲。其中丁柯与丁仲为同胞兄弟关系。

截至本公开转让说明书签署之日，丁柯为公司董事长、首席科学家；蒋卫军为公司董事、副总经理；张军为公司董事、总经理；丁仲为公司董事、研发总监。上述控股股东、实际控制人持有公司股份情况如下：

序号	姓名	持股情况	直接和间接持股比例
1	丁柯	直接持股 38.6614%	39.5202%
		通过新创愿景间接持股 0.0483%	
		通过同创愿景间接持股 0.8104%	
2	蒋卫军	直接持股 28.7078%	29.3454%

		通过新创愿景间接持股 0.0359%	
		通过同创愿景间接持股 0.6018%	
3	张军	直接持股 23.9226%	24.4540%
		通过新创愿景间接持股 0.0299%	
		通过同创愿景间接持股 0.5015%	
4	丁仲	直接持股 2.9660%	3.0319%
		通过新创愿景间接持股 0.0037%	
		通过同创愿景间接持股 0.0622%	
合计			96.3515%

由上表可见，丁柯、蒋卫军、张军及丁仲合计直接持有公司 94.2578%股份。同时，新创愿景为公司员工持股平台，直接持有公司 1.5710%股份，丁柯担任新创愿景的执行事务合伙人，能够控制新创愿景。同创愿景为公司实际控制人持股平台，直接持有公司 1.9759%股份，丁柯担任同创愿景的执行事务合伙人，能够控制同创愿景。

2020 年 3 月 25 日，丁柯、蒋卫军、张军及丁仲签署《一致行动人协议》，该协议自各方签署之日起生效，自协议任何一方不再直接或间接持有芯愿景股份之日效力终止。

丁柯、蒋卫军、张军及丁仲合计能够控制公司 97%以上股份对应的表决权，能够对股东大会/股东会、董事会决议产生重大影响，对公司生产经营、重大决策等具有实际的控制力。因此，认定丁柯、蒋卫军、张军及丁仲为公司共同控股股东、实际控制人。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

姓名	丁柯	
国家或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1975 年 2 月 6 日	
是否拥有境外居留权	否	
学历	博士研究生	
任职情况	董事长、首席科学家	
职业经历	2002 年 9 月至 2019 年 9 月，历任芯愿景有限执行董事、总经理、董事长；2019 年 10 月至今，任公司董事长、首席	

	科学家。 丁柯与蒋卫军、张军共同创立芯愿景有限，并长期从事集成电路分析技术、集成电路安全可信技术、集成电路EDA技术的前沿技术研究，丁柯规划建立了芯愿景的完整技术研发及业务体系，是公司总体技术路线的制定者。
--	---

姓名	蒋卫军
国家或地区	中国
性别	男
出生日期	1975年3月30日
是否拥有境外居留权	否
学历	硕士研究生
任职情况	董事、副总经理
职业经历	2002年4月至2019年9月，历任芯愿景有限总经理、副总经理、董事；2019年10月至今，任公司董事、副总经理。 蒋卫军一直从事集成电路研究及分析工作，并与丁柯、张军共同创立芯愿景有限，长期从事集成电路图像自动化处理技术的研究开发，是公司IC分析服务总体技术规范的制定者。

姓名	张军
国家或地区	中国
性别	男
出生日期	1974年12月5日
是否拥有境外居留权	否
学历	硕士研究生
任职情况	董事、总经理
职业经历	2002年4月至2019年9月，历任芯愿景有限监事、副总经理、董事、总经理；2019年10月至今，任公司董事、总经理。 张军与丁柯、蒋卫军共同创立芯愿景有限，长期致力于集成电路工艺分析技术、硬件安全技术、知识产权分析鉴定等研究方向，是公司知识产权和资讯业务的奠基人，工艺实验室的创始人。同时，张军长期负责公司各类业务的拓展和推广，为公司发展壮大做出了重要贡献。

姓名	丁仲
----	----

国家或地区	中国
性别	男
出生日期	1979 年 6 月 1 日
是否拥有境外居留权	否
学历	硕士研究生
任职情况	董事、研发总监
职业经历	2004 年 8 月至 2006 年 1 月,就职于北京新浪互联信息服务有限公司; 2006 年 2 月至 2008 年 6 月, 就职于美国 CA Technologies 公司中国研发中心; 2008 年 6 月至 2019 年 9 月, 历任公司研发部经理、研发总监、监事; 2019 年 10 月至今, 任公司董事、研发总监。 丁仲于硕士求学期间曾在芯愿景有限实习, 并参与了显微图像自动采集、超大规模显微图像处理等公司核心技术的研发工作; 2008 年加入公司后, 负责公司 EDA 软件整体技术发展路线和具体研发实施工作。

控股股东为其他非法人组织的, 请披露以下表格:

☐适用 ☒不适用

2、实际控制人

根据《公司法》第二百六十五条之（三）规定：“实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人”。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条之（六）规定：“实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织”。

公司实际控制人为丁柯、蒋卫军、张军及丁仲。具体情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”之“1、控股股东”。

控股股东与实际控制人不相同

☐适用 ☒不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的, 除了披露上述基本情况外, 还应披露以下情况:

☒适用 ☐不适用

一致行动关系构成的认定依据: ☒签订协议 ☐亲属关系 ☐其他

一致行动关系的时间期限: 长期, 2020 年 3 月 25 日至无

一致行动关系的其他情况：

2020年3月25日，丁柯、蒋卫军、张军及丁仲为进一步明确对公司的实际控制权并保障控制权的稳定性，保证行使实际控制权时在公司的重大决策和经营管理等方面保持一致，签署《一致行动协议》，确认并约定如下事项：

（1）确认自各方均持有公司股权之日起，已实际按本协议的约定在芯愿景的所有日常生产经营及其他重大事宜决策相关事项上采取一致行动并持有相同的意见；

（2）各方承诺自本协议签署之日起，在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，包括（但不限于）对公司股东大会、董事会审议事项在内的生产经营及其他重大决策事项依法行使时保持一致；

（3）协议各方对本协议所列公司股东大会、董事会审议事项在内的生产经营及其他重大决策事项，应尽可能达成一致意见。若各方无法就某一事项达成一致意见的，按如下方式处理：

①依照法律、法规及公司章程等应由股东大会特殊表决决议通过的事项，同意该事项的各方持有公司股份合计数不低于本协议各方持有的公司股份合计数的三分之二，则最终意见为同意；否则，最终意见为不同意；

②对其他事项，同意该事项的各方持有公司股份合计数不低于本协议各方持有的公司股份合计数的二分之一，则最终意见为同意；否则，最终意见为不同意；

协议各方应按前述表决意见在公司股东大会、董事会上投票表决；

协议各方承诺，任何一方均不得以委托、信托等方式将其直接或间接持有的公司全部或部分股份的表决权委托第三方行使；

（4）协议有效期内，本协议确定之一致行动关系不得为协议各方任何一方单方解除或撤销；本协议所述的一致行动关系的相关条款均不可撤销、不可变更、不可撤回；

（5）本协议自各方签署之日起生效，自协议任何一方不再直接或间接持有芯愿景股份之日效力终止。

3、报告期内实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

（三）前十名股东及其他持股5%以上股份或表决权股东情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	丁柯	24,206,558	38.6614%	境内自然人 股东	否

2	蒋卫军	17,974,426	28.7078%	境内自然人股东	否
3	张军	14,978,361	23.9226%	境内自然人股东	否
4	丁仲	1,857,049	2.9660%	境内自然人股东	否
5	同创愿景	1,237,113	1.9759%	境内有限合伙企业股东	否
6	新创愿景	983,606	1.5710%	境内有限合伙企业股东	否
7	深创投	756,000	1.2074%	境内法人股东	否
8	丰年君和	618,557	0.9879%	境内有限合伙企业股东	否
合计	-	62,611,670	100.0000%	-	-

☐适用 ☒不适用

（四） 股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

公司股东丁柯、丁仲系同胞兄弟关系。

公司股东新创愿景系员工持股平台。新创愿景的合伙人为丁柯、蒋卫军、张军、丁仲、熊伟、张金正、石子信、张瑞雪、王艳红、李洋，由丁柯担任执行事务合伙人。

公司股东同创愿景系实际控制人持股平台。同创愿景的合伙人为丁柯、蒋卫军、张军、丁仲，由丁柯担任执行事务合伙人。

（五） 其他情况

1、 机构股东情况

☒适用 ☐不适用

1、北京同创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	北京同创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）
成立时间	2023年3月10日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110108MACBAQ9YXP
法定代表人或执行事务合伙人	丁柯
住所或主要经营场所	北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201
经营范围	一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	丁柯	7,793,166.79	7,793,166.79	41.02%
2	蒋卫军	5,786,766.54	5,786,766.54	30.46%
3	张军	4,822,200.07	4,822,200.07	25.38%
4	丁仲	597,866.60	597,866.60	3.15%
合计	-	19,000,000.00	19,000,000.00	100.00%

2、北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）

1) 基本信息:

名称	北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）
成立时间	2018年9月4日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110108MA01EEU89U
法定代表人或执行事务合伙人	丁柯
住所或主要经营场所	北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201-142
经营范围	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	丁柯	76,900.00	76,900.00	3.08%
2	熊伟	457,500.00	457,500.00	18.30%
3	张金正	457,500.00	457,500.00	18.30%
4	石子信	457,500.00	457,500.00	18.30%
5	张瑞雪	350,000.00	350,000.00	14.00%
6	王艳红	340,000.00	340,000.00	13.60%
7	李洋	250,000.00	250,000.00	10.00%
8	蒋卫军	57,100.00	57,100.00	2.28%
9	张军	47,600.00	47,600.00	1.90%
10	丁仲	5,900.00	5,900.00	0.24%
合计	-	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%

3、深圳市创新投资集团有限公司

1) 基本信息:

名称	深圳市创新投资集团有限公司
成立时间	1999年8月25日
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300715226118E
法定代表人或执行事务合伙人	左丁
住所或主要经营场所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场5201
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；

	股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。
--	---

2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	2,819,519,943.00	2,819,519,943.00	28.20%
2	深圳市星河房地产开发有限公司	2,000,010,899.00	2,000,010,899.00	20.00%
3	深圳市资本运营集团有限公司	1,279,312,016.00	1,279,312,016.00	12.79%
4	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	1,079,962,280.00	1,079,962,280.00	10.80%
5	深圳能源集团股份有限公司	503,046,710.00	503,046,710.00	5.03%
6	七匹狼控股集团股份有限公司	489,219,653.00	489,219,653.00	4.89%
7	深圳市立业集团有限公司	489,219,653.00	489,219,653.00	4.89%
8	广东电力发展股份有限公司	367,301,375.00	367,301,375.00	3.67%
9	深圳市亿鑫投资有限公司	331,181,100.00	331,181,100.00	3.31%
10	深圳市福田投资控股有限公司	244,481,620.00	244,481,620.00	2.44%
11	深圳港集团有限公司	233,377,901.00	233,377,901.00	2.33%
12	广深铁路股份有限公司	140,027,900.00	140,027,900.00	1.40%
13	中兴通讯股份有限公司	23,338,950.00	23,338,950.00	0.23%
合计	-	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00%

4、宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016 年 10 月 27 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MA282U318N
法定代表人或执行事务合伙人	宁波丰年通达投资管理有限公司
住所或主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1331
经营范围	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	宁波梅山保税港区丰年同创投资合伙企业（有限合伙）	433,400,000.00	433,400,000.00	51.63%
2	马盼盼	100,000,000.00	100,000,000.00	11.91%
3	珠海镭聿投资管理中心（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00	5.96%
4	北海市远裕行创业投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	4.77%
5	沈磊	20,000,000.00	20,000,000.00	2.38%
6	卢语	17,500,000.00	17,500,000.00	2.08%
7	陆耀静	15,000,000.00	15,000,000.00	1.79%
8	曾挺	15,000,000.00	15,000,000.00	1.79%
9	郝金标	15,000,000.00	15,000,000.00	1.79%
10	深圳大墨龙瑞投资中心（有限合伙）	12,500,000.00	12,500,000.00	1.49%
11	杨斌	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
12	湖南光控星宸股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
13	张晓峰	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
14	周益成	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
15	阮伟祥	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
16	朱鹤松	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
17	张燕爽	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
18	邵敏舟	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
19	张华	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
20	陈永道	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19%
21	曹锐	5,000,000.00	5,000,000.00	0.60%
22	钟瑞军	5,000,000.00	5,000,000.00	0.60%
23	四川融德汇企业管理咨询有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.60%
24	中科信融联投资（北京）有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.60%
25	宁波丰年通达投资管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.12%
合计	-	839,400,000.00	839,400,000.00	100.00%

私募股东备案情况

√适用 □不适用

公司 4 名机构股东均为境内合伙企业或公司，其中双创愿景系公司员工成立的员工持股平台，同创愿景系公司实际控制人成立的持股平台，上述 2 名机构股东的投资资金均来自全体合伙人的自有或自筹资金，不存在向他人募集资金的情形，也未委托基金管理人进行管理，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金备案办法》等规定的私募基金或私

募基金管理人，无需办理相关私募投资基金备案登记手续。

深创投、丰年君和等 2 名机构股东均为私募基金，且均已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，具体备案情况如下：

序号	私募基金 股东名称	私募基金备案编号	私募基金管理人名称	私募基金管理 人登记编号
1	深创投	SD2401	深圳市创新投资集团有限公司	P1000284
2	丰年君和	SX2537	宁波丰年荣通投资管理有限公司	P1015651

注：深创投的私募基金管理人为深创投自我管理，已于 2014 年 4 月 22 日在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记。

2、特殊投资条款情况

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在作为义务或责任承担主体的对赌等特殊权利条款尚未清理的情形；尚未履行完毕的特殊权利条款的义务或责任承担主体为公司实际控制人丁柯、蒋卫军、张军及丁仲，不存在《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》规定的应当清理的情形。截至本公开转让说明书签署之日，尚未履行完毕的特殊投资条款具体情况如下：

2024 年 12 月 30 日，深创投与公司实际控制人丁柯、蒋卫军、张军及丁仲签署了《北京芯愿景软件技术股份有限公司之 2024 年股东协议》（以下简称“《2024 年股东协议》”），上述协议中有效的特殊投资条款主要内容如下：

特殊投资 条款类型	条款主要内容	合规情况说明
股份回购	1.1 发生下列情形之一（以下简称“回购触发事件”）的，投资方有权（但无义务）于知悉回购触发事件发生之日起 12 个月内随时向实际控制人发出书面通知（简称“回购通知”）要求实际控制人回购或收购该投资方所持有的公司部分或全部股权，实际控制人应根据本股东协议的约定，共同连带承担回购投资方持有的公司全部或部分股份义务： （1）截至 2028 年 12 月 31 日，公司仍未实现首次公开发行股票并在北交所、沪深证券交易所上市； （2）未经投资方书面同意，公司实际控制人发生变更； （3）实际控制人挪用、侵占公司资产或被采取强制措施、丧失民事行为能力等原因无法正常履行公司经营管理责任的； （4）可能给公司带来重大不利影响或严重损害投资方利益的其他情形。 1.2 在出现第 1.1 条约定的情形之一时，投资方有权要求实际控制人按如下方式计算的价格（以孰高原则确定）回购投资方持有的公司股份： （1）回购对价=投资金额*[1+8%*n] - 甲方从公司收	公司未作为股份回购义务的承担主体，未损害公司或公司其他股东的合法权益，符合《挂牌指引 1 号》的规定。

	到的全部现金分红（如有） 其中：n=2021年6月29日起至收到回购对价之日止的天数除以365 （2）回购价格=回购日公司账面净资产 * 投资方所持公司股份比例。 1.3 经投资方同意，实际控制人可以指定其他第三方依照本股东协议约定的条件收购投资方持有的公司股份；但，在投资方收到全部收购款前，实际控制人仍对投资方持有的全部或部分股份承担回购义务。 1.4 若投资方依据本协议1.3条的约定已将其所持公司股份部分转让给非关联第三方的，实际控制人对投资方持有的剩余股份承担回购义务。 1.5 实际控制人应在投资方发出回购通知之日起【30】天内与投资方签订回购协议或股份转让协议等相关法律文件，但投资方发出回购通知并非实际控制人履行回购义务的前提条件。	
共同出售权	投资完成后、公司上市前，未经投资方书面同意，实际控制人不得直接或间接转让其所持有的全部或部分公司股份，及进行可能导致公司控股权/实际控制人变化的质押等其它行为。 在不违反本合同有关规定的情况下，实际控制人拟转让其所持公司股份时，则投资方有权与实际控制人以相同的价格、条款和条件向意向受让方等比例（指拟转让的实际控制人与拟行使共同出售权的投资方所持公司股权的相对比例）地出售所持公司股份，且实际控制人有义务促使意向受让方购买投资方拟出售的股份。如投资方认为实际控制人对外转让股份会导致公司控股权/实际控制人变更的，则投资方有权与实际控制人以相同的价格、条款和条件向意向受让方优先出售所持公司全部股份，且实际控制人有义务促使意向受让方购买投资方的股份。若实际控制人未能促使意向受让方购买投资方的股份，则实际控制人应以相同的价格、条款和条件受让投资方的股份。若投资方依前述约定转让股份所得价款低于第1.2条约定的金额，实际控制人同意就差额部分向投资方给予补偿。	公司未作为该条款的义务或责任承担主体，未损害公司或公司其他股东的合法权益，符合《挂牌指引1号》的规定。
关联转让	投资方有权将其所持股份全部或部分转让给其受同一管理人和/或管理人控制的其他管理人所管理或控制的其他基金或企业，各方同意并放弃优先受让权；转让完成后，该受让方完整的享有投资方在本股东协议项下的相同权利。未经公司实际控制人同意，投资方不得将其所持股权全部或部分转让给主营业务为从事EDA和提供芯片反向分析服务的竞争性第三方。投资方拟将所持的全部或部分股权转让给非关联第三方时，实际控制人有权在同等条件下享有优先受让权。转让完成后，该受让方不再享有投资方在本股东协议项下的权利。	公司未作为该条款的义务或责任承担主体，未损害公司或公司其他股东的合法权益，符合《挂牌指引1号》的规定。
反稀释权	本协议有效期内且在发行上市之前，如果公司以低于36.375元/股增加注册资本或发行股份，或者实际控制人以低于36.375元/股转让其持有的公司股份，则实际	公司未作为该条款的义务或责任承担主体，未损害公司或公司其他股东的合法权

	控制人应将差价补偿给投资方，直至投资方的投资价格与该次新增加注册资本或股份转让的相同；但经批准的员工股权激励除外。	益，符合《挂牌指引 1 号》的规定。
《2024 年股东协议》中约定的特殊投资条款的义务和责任承担主体为实际控制人，前述主体资信状况良好，可通过自有资金、处置自有资产、获取股权分红等方式筹措资金，具备履约能力，相关条款不会影响公司控股股东及实际控制人对公司的控制权。针对上述股份回购条款被触发可能导致的公司实际控制人持股比例发生变化的风险，公司已在本公开转让说明书重大事项提示处披露了“对赌协议的风险”。 综上，公司不属于前述尚未履行完毕的特殊投资条款的义务或责任承担方，相关条款不属于按照《挂牌指引 1 号》的规定应予以清理的情况，不存在损害公司及公司其他股东合法权益的情形，不会对公司控制权及生产经营事项造成重大不利影响。		

3、 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为员工持股平台	具体情况
1	丁柯	是	否	境内自然人
2	蒋卫军	是	否	境内自然人
3	张军	是	否	境内自然人
4	丁仲	是	否	境内自然人
5	同创愿景	是	否	境内有限合伙企业
6	新创愿景	是	是	境内有限合伙企业
7	深创投	是	否	私募投资基金
8	丰年君和	是	否	私募投资基金

4、 其他情况说明

事项	是或否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
控股股东或实际控制人是否为境外法人或自然人	否
公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 公司设立情况

1、2002 年 4 月，芯愿景有限设立

2002 年 4 月 24 日，张军和丁仲签署《北京芯愿景软件技术有限公司章程》，对芯愿景有限的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资额、公司机构等事项进行了约定。

2002 年 4 月 24 日，张军及丁仲签署《非专利技术出资确认书》，同意本次用于出资的非专利技术“芯片图像处理系统 Filmlogic1.0”作价 40.00 万元，其中属于张军 27.50 万元，丁仲 12.50 万元；同日，张军及丁仲签署《高新技术成果说明书》，确认用于出资的“芯片图像处理系统 Filmlogic1.0”属于非专利技术，主要用于处理集成电路芯片的数字图像，有很好的市场应用前景，可以创造更好的社会效益和经济效益。

2002 年 4 月 25 日，北京方诚会计师事务所有限责任公司出具编号为“方会（C）字[2002]第 208 号”《验资报告书》。经验证，截至 2002 年 4 月 25 日，芯愿景有限注册资本 50.00 万元均已到位。

2002 年 4 月 27 日，芯愿景有限取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为 1101082379130 的《企业法人营业执照》。

设立时，芯愿景有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额		出资形式	出资比例	实际股权持有情况
1	张军	31.00	3.50	货币	62.00%	丁柯持有 44.00%股权
			27.50	非专利技术		张军持有 18.00%股权
2	丁仲	19.00	6.50	货币	38.00%	蒋卫军持有 38.00%股权
			12.50	非专利技术		
合计		50.00	50.00	-	100.00%	

注：芯愿景有限设立时，丁仲持有的 38.00%股权为代蒋卫军持有，张军所持 44.00%股权为代丁柯持有，该等股权代持已于 2003 年 3 月通过股权转让方式进行还原，具体参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（六）其他情况”之“1、股权代持及解除”。

2、2019 年 10 月，股份公司设立

2019 年 5 月 30 日，芯愿景有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意以 2019 年 5 月 31 日经审计的净资产按原持股比例折合成股份有限公司股本，共计折合股本 6,000.00 万股，每股面值 1.00 元。净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积金。由各发起人按照各自在芯愿景有限的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。

2019 年 9 月 25 日，天职国际会计师事务所出具编号为“天职业字[2019]34077 号”《北京芯愿景软件技术有限公司审计报告》。经审计，截至 2019 年 5 月 31 日，芯愿景有限经审计的净资产金额为 18,486.56 万元。

2019 年 9 月 26 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具编号为“沃克森评报字（2019）

第 1279 号”《北京芯愿景软件技术有限公司拟变更为股份有限公司涉及北京芯愿景软件技术有限公司净资产资产评估报告》。经评估，截至评估基准日 2019 年 5 月 31 日，芯愿景有限净资产评估价值为 30,710.29 万元，增值额为 12,223.73 万元，增值率为 66.12%。

2019 年 10 月 8 日，丁柯、蒋卫军、张军、丁仲及新创愿景等 5 名发起人签署《北京芯愿景软件股份有限公司发起人协议书》，约定整体变更设立股份公司的基准日为 2019 年 5 月 31 日，以芯愿景有限经审计的账面净资产之一部分折为股份公司股本，其余部分计入资本公积。股份公司注册资本为 6,000.00 万元。

2019 年 10 月 12 日，芯愿景召开创立大会，决议同意通过整体变更方式设立芯愿景相关事宜的议案。

同日，丁柯、蒋卫军、张军、丁仲及新创愿景签署《北京芯愿景软件股份有限公司章程》。

2019 年 10 月 22 日，天职国际会计师事务所出具了天职业字[2019]35384 号的验资报告：经审验，截至 2019 年 10 月 12 日，芯愿景已根据《公司法》有关规定及折股方案，将北京芯愿景软件技术有限公司截至 2019 年 5 月 31 日经审计的净资产 184,865,648.80 元折合 60,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计股本 60,000,000.00 元，大于股本部分 124,865,648.80 元转入资本公积。

2019 年 10 月 24 日，芯愿景完成整体变更设立股份有限公司的工商变更手续，并领取了统一社会信用代码为 91110108738229602C 的《营业执照》。

芯愿景设立时发起人及其持股比例如下：

单位：万股

序号	发起人姓名/名称	持股数量	持股比例（%）	出资方式
1	丁柯	2,420.6558	40.34	净资产
2	蒋卫军	1,797.4426	29.96	净资产
3	张军	1,497.8361	24.96	净资产
4	丁仲	185.7049	3.10	净资产
5	新创愿景	98.3606	1.64	净资产
合计		6,000.0000	100.00	—

（二）报告期内的股本和股东变化情况

报告期初，公司的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名/名称	持股数量	持股比例（%）
1	丁柯	2,420.66	38.20

2	蒋卫军	1,797.44	28.37
3	张军	1,497.84	23.64
4	丁仲	185.70	2.93
5	宜安投资	123.71	1.95
6	新创愿景	98.36	1.55
7	深创投	75.60	1.19
8	盈富泰克	75.60	1.19
9	丰年君和	61.86	0.98
合计		6,336.77	100.00

1、2023 年 4 月，股份公司成立后第一次股份转让

2023 年 4 月 23 日，宜安投资与同创愿景签署《股权转让协议》，约定宜安投资将其所持有的芯愿景 1.9523%股份（即 1,237,113 股）转让予同创愿景。经双方协商一致，本次股权转让价格为 15.37 元/股，转让对价为 19,018,761.00 元。本次股权转让完成后，芯愿景的股东及股权结构如下表所示：

单位：万股

序号	发起人姓名/名称	持股数量	持股比例（%）	出资方式
1	丁柯	2,420.6558	38.2002	净资产
2	蒋卫军	1,797.4426	28.3653	净资产
3	张军	1,497.8361	23.6372	净资产
4	丁仲	185.7049	2.9306	净资产
5	同创愿景	123.7113	1.9523	货币
6	新创愿景	98.3606	1.5522	净资产
7	深创投	75.6000	1.1930	货币
8	盈富泰克	75.6000	1.1930	货币
9	丰年君和	61.8557	0.9761	货币
合计		6,336.7670	100.00	—

2、2024 年 12 月，股份公司成立后第一次减资

2024 年 11 月 1 日，芯愿景召开 2024 年第一次临时股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由 6,336.7670 万股减少至 6,261.1670 万股，由公司向盈富泰克定向回购其持有的公司股份，回购完成后，盈富泰克退出公司，回购情况如下：

序号	股东名称	回购股本（股）	回购价格（元）
1	盈富泰克	756,000	34,549,125.33

2024 年 11 月 1 日，公司与盈富泰克签订了《股份收购协议》。

2024 年 11 月 1 日，公司在国家企业信用信息公示系统就上述减资事项刊登了减资公告并通过电子邮件通知主要债权人，公告期为 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 16 日，公告未接到通知书的债权人自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2024 年 12 月 17 日，公司出具《债务清偿或担保情况的说明》，承诺本公司的债务已清偿完毕，对外也无任何担保行为，如有遗留问题，由各股东按照原来的注册资本数额承担责任。

2024 年 12 月 17 日，公司取得了北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91110108738229602C 的《营业执照》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次减资情况进行了审验。

本次减资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名/名称	持股数量	持股比例（%）	出资方式
1	丁柯	2,420.6558	38.6614	净资产
2	蒋卫军	1,797.4426	28.7078	净资产
3	张军	1,497.8361	23.9226	净资产
4	丁仲	185.7049	2.9660	净资产
5	同创愿景	123.7113	1.9759	货币
6	新创愿景	98.3606	1.5710	净资产
7	深创投	75.6000	1.2074	货币
8	丰年君和	61.8557	0.9879	货币
合计		6261.1670	100.00	—

（1）本次减资的原因及定价情况

本次减资的原因系前次芯愿景主板 IPO 申请撤回后，盈富泰克出于自身资金需求及投资利益的考虑，拟退出投资，经与公司及其他股东协商沟通，最终决定进行减资回购，以顺应盈富泰克的诉求。本次回购定价基础为盈富泰克投资本金加上协商的利息。

（2）本次减资的资金来源、价款支付以及税收缴纳情况

本次减资资金来源于公司账面资金，价款支付以货币资金支付，公司减资事项不涉及公司所得税纳税义务。

（3）本次减资有关决策程序

根据《公司法（2023 年修正）》第二百二十四条规定“公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的

自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。

就本次减资事项，芯愿景履行了内部董事会及股东大会的审议程序，编制了资产负债表及财产清单，自公司股东大会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，在国家企业信用信息公示系统网站刊登了减资公告，办理市场主体变更登记等程序。对于少部分未能获取联系方式的债权人未能进行逐一通知，但公司已通过公告方式通知债权人并提供债务清偿担保，且刊登后 45 日之内并无债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人就债务清偿安排及债务清偿情况未提出任何异议，亦未实际发生纠纷或争议，不存在重大法律风险。同时，公司实际控制人丁柯、蒋卫军、张军及丁仲已出具承诺函，承诺如因前述减资程序瑕疵而使公司遭受任何损失，其本人同意无条件代公司承担，且承诺不以任何理由向公司追偿。避免给公司利益造成任何损害。

截至本公开转让说明书签署之日，公司减资时未能逐一通知债权人，并未对债权人权益造成实质性不利影响，亦未导致公司产生相关纠纷或受到处罚，该情形未对公司的经营发展造成负面影响，不会对公司本次挂牌造成实质性障碍。

（4）本次减资的真实性情况

芯愿景本次减资真实有效，不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在利益输送或其他利益安排。

自本次变更后，截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构未发生变动。

（三） 区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

☐适用 ☒不适用

（四） 在全国股转系统摘牌后重新申报情况

☐适用 ☒不适用

（五） 股权激励情况或员工持股计划

☒适用 ☐不适用

1、员工持股平台的基本情况及其人员构成

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东新创愿景为公司员工持股平台，持有公司 98.3606 万股股份，占公司总股本的比例为 1.5710%，该持股平台合伙人均为公司员工。公司不存在其他员工持股平台，亦不存在员工持股计划、已经制定或实施的股权激励及相关安排。新创愿景的基本信息及合伙人构成情况具体如下：

（1）新创愿景基本情况

企业名称	北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA01EEU89U

成立日期	2018 年 9 月 4 日		
注册资本	250.00 万元	实收资本	250.00 万元
注册地址及 主要生产经营地	北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 2 层 201-142		
企业类型	有限合伙企业		
营业期限	2018 年 9 月 4 日至 2048 年 9 月 3 日		
执行事务合伙人	丁柯		
主营业务	员工持股平台，无实际经营活动		

新创愿景最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年度
总资产	255.83
净资产	255.83
营业收入	-
净利润	-0.28

注：上述财务数据未经审计。

（2）新创愿景合伙人构成情况

丁柯为新创愿景的执行事务合伙人，具体负责管理合伙企业事务，为新创愿景的实际控制人。
根据新创愿景合伙协议书，截至本公开转让说明书签署之日，新创愿景的合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额 (万元)	合伙份额	合伙人类别	任职情况
1	丁柯	7.69	3.08%	普通合伙人	董事长、首席科学家、核心技术人员
2	熊伟	45.75	18.30%	有限合伙人	监事、核心技术人员、天津芯愿景副总经理
3	张金正	45.75	18.30%	有限合伙人	监事、核心技术人员、保定分公司总经理、太原芯愿景总经理
4	石子信	45.75	18.30%	有限合伙人	副总经理、销售总监
5	张瑞雪	35.00	14.00%	有限合伙人	财务经理
6	王艳红	34.00	13.60%	有限合伙人	财务总监、董事会秘书
7	李洋	25.00	10.00%	有限合伙人	核心技术人员、保定分公司副总经理
8	蒋卫军	5.71	2.28%	有限合伙人	董事、副总经理、核心技术人员
9	张军	4.76	1.90%	有限合伙人	董事、总经理、核心技术人员
10	丁仲	0.59	0.24%	有限合伙人	董事、研发总监、核心技术人员

合计	250.00	100.00%	-	-
----	--------	---------	---	---

2、员工持股平台的规范运作情况及备案情况

新创愿景作为公司的员工持股平台，其合伙人涵盖公司董事、监事、高级管理人员以及研发、销售、财务等多个部门的骨干人员。公司员工持股计划的规范运作情况及备案情况如下：

（1）员工持股计划的实施程序

2018年8月1日，芯愿景有限股东会作出决议，同意《北京芯愿景软件技术有限公司股权激励实施细则》（以下简称“《股权激励实施细则》”）；同意公司2018年度的员工股权激励方案及相关协议，对公司及下属子公司高级管理人员、核心技术人员、中层及骨干员工实施股权激励。

2018年9月4日，前述合伙人以货币出资方式设立新创愿景，出资额总计250万元，并于当月完成实缴。

2018年9月21日，新创愿景通过向芯愿景有限增资的方式，成为公司股东。

公司员工持股平台新创愿景对员工进行了上述股份授予，员工通过持有新创愿景的份额间接持有公司股份，参与股权激励的员工作为合伙人均签订了《合伙协议》《合伙协议之补充协议》。

（2）员工持股计划的规范运作

公司实施员工持股计划，系由公司自主决定、员工自愿参加的，不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形；参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，不存在利用知悉公司相关信息的优势，侵害其他投资者合法权益的情况；员工入股均为以货币出资，并均已按约定及时足额缴纳出资。

（3）员工持股计划的备案情况

新创愿景系公司员工成立的员工持股平台，其投资资金来自全体合伙人的自有或自筹资金，不存在向他人募集资金的情形，也未委托基金管理人进行管理，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定的私募基金或私募基金管理人。因此，新创愿景未在中国证券投资基金业协会办理私募基金或私募基金管理人的备案程序。

（4）员工持股计划人员离职的股份处理

根据《股权激励实施细则》及《合伙协议》的规定，员工持股计划人员均为公司员工，离职后应按照《股权激励实施细则》的约定将财产份额转让给公司实际控制人。

截至本公开转让说明书签署之日，新创愿景不存在合伙人变动情况。

3、员工持股平台的锁定期

除平台内任职公司董事、监事及高级管理人员的合伙人应按照法律法规的要求进行减持外，其余人员无锁定期安排。

4、设立员工持股平台对公司的影响

（1）对公司经营状况的影响

公司通过建立员工持股平台，建立健全了长效激励机制，充分调动了关键岗位员工的工作积极性，有利于公司核心团队的稳定，进一步增强公司的竞争力，有助于公司的持续稳定经营。

（2）对公司财务状况的影响

报告期内，公司因实施股权激励确认的股份支付费用分别为 65.76 万元、65.76 万元，分别占当期利润总额的 0.82%、0.60%，上述股权激励产生的股份支付费用对公司财务状况影响较小。

（3）对公司控制权变化的影响

公司员工持股平台设立后，公司控股股东、实际控制人未发生改变，公司控制权未发生变化。

（六） 其他情况

事项	是或否
公司是否曾擅自公开或者变相公开发证券	否
公司是否曾存在代持	是
公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形	否
公司是否（曾）存在非货币出资	是
公司是否曾存在出资瑕疵	是
公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制	否
公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资	是
公司是否（曾）存在红筹架构	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

√适用 □不适用

1、股权代持及解除：

（1）2002 年 4 月，第一次股权代持产生及解除情况

①本次股权代持产生的背景

2002 年初，丁柯、蒋卫军和张军协商共同投资设立芯愿景有限，从事芯片分析服务，并确定各自持股比例分别为：丁柯持有 44.00%股权、蒋卫军持有 38.00%股权、张军持有 18.00%股权。

芯愿景有限设立时，丁柯临近博士研究生毕业，且当时丁柯与蒋卫军正专注于芯片分析相关软件及技术的研发，不便分心处理工商登记及对外管理等事项；同时，丁柯和蒋卫军投资的芯诺诚当

时已经实际停止经营，出于谨慎性考虑，二人未以自身名义参与本次投资。基于上述原因，经协商，委托张军、丁仲代为持有其各自股权。

②本次股权代持的形成过程

芯愿景有限设立时注册资本 50 万元。其中，股东丁柯委托股东张军持有 22 万元出资额，占总股本 44%，股东蒋卫军委托丁仲持有 19 万元出资额，占总股本 38%，具体股权结构及代持情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例（%）	实际股权持有情况
1	张军	31.00	62.00	丁柯持有 44.00%股权
				张军持有 18.00%股权
2	丁仲	19.00	38.00	蒋卫军持有 38.00%股权
合计		50.00	100.00	-

③本次股权代持的解除过程

2003 年 3 月 19 日，经股东会审议通过，丁仲将持有的芯愿景有限的 38.00%股权转让予蒋卫军；张军将其持有的 44.00%股权转让予丁柯，由于本次股权转让实质为芯愿景设立时的股权代持还原，本次股权转让交易中，丁柯和蒋卫军未实际支付股权转让价款。

2003 年 3 月 19 日，丁柯、蒋卫军、张军及丁仲分别就上述股权转让事宜签署了《出资转让协议书》，股权转让相关情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让股权比例	转让原因
1	丁仲	蒋卫军	19.00	38.00%	解除代持
2	张军	丁柯	22.00	44.00%	解除代持

2003 年 3 月 25 日，芯愿景有限完成本次股权转让的工商变更手续，并领取了注册号为 1101082379130 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，芯愿景有限设立的股权代持情况已完成解除，具体的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例（%）
1	丁柯	22.00	44.00
2	蒋卫军	19.00	38.00
3	张军	9.00	18.00
合计		50.00	100.00

（2）2006 年 4 月，第二次股权代持产生及解除情况

①本次股权代持产生的背景

2006年4月，因业务发展需要，丁柯、蒋卫军和张军协商共同对芯愿景有限增资，并确定各自持股比例分别为：丁柯持有42.00%股权、蒋卫军持有33.00%股权、张军持有25.00%股权。

本次增资时，蒋卫军担任法定代表人、执行董事和控股股东的芯诺诚，因未按时进行企业年检，被工商主管部门吊销营业执照，且未满三年。出于谨慎性考虑，蒋卫军未以自身名义参与本次增资。经协商，蒋卫军委托丁柯代为持有其股权。

②本次股权代持的形成过程

2006年4月，芯愿景有限增加注册资本184.00万元。新增注册资本中，股东蒋卫军委托股东丁柯持有58.22万元出资额，占总股本24.88%，本次增资完成后，股权结构及实际股权代持情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例（%）	实际股权持有情况
1	丁柯	156.50	66.88	丁柯持有42.00%股权
2	蒋卫军	19.00	8.12	蒋卫军持有33.00%股权
3	张军	58.50	25.00	张军持有25.00%股权
合计		234.00	100.00	-

③本次股权代持的解除过程

2008年5月26日，经股东会审议通过，丁柯将持有的芯愿景有限的24.88%股权转让予蒋卫军。由于本次股权转让实质为芯愿景2006年4月增资时的股权代持还原，本次股权转让交易中，蒋卫军未实际支付股权转让价款。

2008年6月11日，丁柯和蒋卫军就上述股权转让事宜签署了《出资转让协议书》，股权转让相关情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让股权比例	转让原因
1	丁柯	蒋卫军	58.22	24.88%	解除代持

2008年6月11日，芯愿景有限完成本次股权转让的工商变更手续，并领取了注册号为110108003791306的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，芯愿景有限2006年4月增资的股权代持情况已完成解除，具体的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例（%）
1	丁柯	98.28	42.00

2	蒋卫军	77.22	33.00
3	张军	58.50	25.00
合计		234.00	100.00

(3) 2012 年 6 月，第三次股权代持产生及解除情况

①本次股权代持产生的背景

2012 年 6 月，因业务发展需要，丁柯、蒋卫军和张军协商共同对芯愿景有限增资，并确定各自持股比例分别为：丁柯持有 42.00%股权、蒋卫军持有 33.00%股权、张军持有 25.00%股权。

2012 年 6 月，丁柯计划出国定居。本次增资时，丁柯经咨询了解到，新增境内重大投资可能对其出国定居审查造成不利影响。出于个人原因考虑，经协商，丁柯委托蒋卫军代为持有 338.00 万元出资额，委托张军代为持有 250.00 万元出资额。

②本次股权代持的形成过程

2012 年 6 月，芯愿景有限增加注册资本 1400 万元。新增注册资本中，股东丁柯委托股东蒋卫军持有 338 万元出资额，占总股本 11.27%，股东丁柯委托股东张军持有 250 万元出资额，占总股本 8.33%。本次增资完成后，股权结构及实际股权代持情况如下：

本次增资完成后，芯愿景有限的股东及股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例（%）	实际股权持有情况
1	丁柯	672.00	22.40	丁柯持有 42.00%股权
2	蒋卫军	1,328.00	44.27	蒋卫军持有 33.00%股权
3	张军	1,000.00	33.33	张军持有 25.00%股权
合计		3,000.000	100.00	-

③本次股权代持的解除过程

2017 年 6 月 25 日，经股东会审议通过，蒋卫军及张军将其持有的芯愿景有限的部分股权转让予丁柯及丁仲，由于本次蒋卫军及张军对丁柯的股权受让实质为芯愿景 2012 年 6 月增资时的股权代持还原，本次股权转让交易中，丁柯未实际支付股权转让价款。

2017 年 7 月 4 日，丁柯、蒋卫军、张军及丁仲分别就上述股权转让事宜签署了《出资转让协议书》，本次股权代持的解除过程包括股权代持还原和股权转让，具体情况如下：

A、股权代持还原

本次股权代持解除过程中，蒋卫军、张军分别向丁柯还原部分代持股权，具体情况如下：

单位：万元

还原方	被代持方	还原金额	还原代持股权比例 (%)	剩余代持金额	剩余代持股权比例 (%)
蒋卫军	丁柯	319.90	10.66	18.10	0.60
张军	丁柯	238.60	7.95	11.40	0.38
合计		558.50	18.61	29.50	0.98

B、股权转让

经芯愿景有限股东之间协商，对其各自的持股比例进行了变动，并加入新股东丁仲。因此，本次股权代持解除过程中，丁柯向张军转让 0.38%股权，即张军名义持有的尚未还原至丁柯 0.38%代持股权转为自身持有；丁柯、蒋卫军分别向丁仲转让 0.60%股权和 2.55%股权，即蒋卫军将名义持有的尚未还原至丁柯 0.60%代持股权代丁柯转让予丁仲持有，并将其持有的 2.55%自有股权转让予丁仲持有，交易价格为 1.00 元/元出资额，股权转让情况如下：

股东名称	实际股权比例 (%)	本次股权变动比例 (%)	股权变动安排	最终股权比例 (%)
丁柯	42.00	-0.98	0.38%被代持股权由张军保留 0.60%被代持股权由蒋卫军转让予丁仲	41.02
蒋卫军	33.00	-2.55	2.55%自有股权转让予丁仲	30.45
张军	25.00	+0.38	保留为丁柯代持的 0.38%股权	25.38
丁仲	-	+3.15	受让蒋卫军自有 2.55%股权和蒋卫军代持丁柯的 0.60%股权	3.15
合计	100.00	0.00	-	100.00

本次股权转让完成后，芯愿景有限 2012 年 6 月增资的股权代持情况已完成解除，解除后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例 (%)
1	丁柯	1,230.50	41.02
2	蒋卫军	913.70	30.45
3	张军	761.40	25.38
4	丁仲	94.40	3.15
合计		3,000.00	100.00

(4) 公司股东关于公司历史上股权代持及解除事宜的确认和承诺

芯愿景有限历史上存在的股权代持系经公司当时股东合意一致且认可；股东及代持各方均为公司现有实际控制人，相互之间不存在争议与纠纷；该等股权代持情形已经消除并进行了工商变更登记，未影响公司股权清晰与实际控制权稳定。同时，丁柯、蒋卫军、张军及丁仲承诺，公司历史上曾经存在委托持股情况，该等委托代持关系已全部终止，且进行了还原，股权代持的形成及规范过

程不存在潜在问题和风险隐患；若将来出现任何纠纷或潜在纠纷，由其协调解决并承担公司因此受到的全部经济损失。

综上，公司历史上股权代持情形未影响芯愿景有限的股权清晰与稳定，且已经解除并还原，相关股东之间不存在争议及纠纷，不构成公司本次挂牌的实质性法律障碍。

2、非货币出资、出资程序瑕疵及置换：

（1）非货币出资具体情况

芯愿景有限在设立、增资时涉及非专利技术出资，情况如下：

单位：万元

序号	出资时间	出资时的非专利技术	作价出资金额	评估情况	是否办理财产转移手续
1	2002年4月，芯愿景有限设立	芯片图像处理系统 Filmlogic1.0	40.00	由全体股东出具出资确认书确认价值，未评估。	已办理
2	2006年4月，芯愿景有限第一次增资	集成电路芯片层次化整理技术	94.00	中科华会计师事务所有限公司出具“中科华（2006）评报字第015号”《关于丁柯、张军拟投资北京芯愿景软件技术有限公司涉及非专利技术—〈集成电路芯片层次化整理技术〉的资产评估报告书》，以2006年3月31日为评估基准日，“集成电路芯片层次化整理技术”的评估值取整为94万元。根据《高新技术成果说明书及确认书》，丁柯对该项技术拥有的权益为69.56万元，张军对该项技术拥有的权益为24.44万元。	已办理
3	2008年8月，芯愿景有限第二次增资	集成电路仿真调试技术	90.00	北京市洪州资产评估有限责任公司出具“洪州评报字（2008）第2-070号”《评估报告》，以2008年6月20日为评估基准日，“集成电路仿真调试技术”的评估总值为90.00万元，其中，丁柯持有的权益为64.24万元，蒋卫军持有的权益为3.20万元，张军持有的权益为22.56万元。	已办理
4	2008年10月，芯愿景有限第三次增资	电子显微镜的图像采集和处理技术	90.00	北京市洪州资产评估有限责任公司出具“洪州评报字（2008）第2-075号”《评估报告》，以2008年10月5日为评估基准日，“电子显微镜的图像采集和处理技术”的评估总值为90.00万元；其中，丁柯持有的权益为37.80万元，蒋卫军持有的权益为29.70万元，张军持有的权益	已办理

				为 22.50 万元。	
5	2008 年 12 月，芯愿景有限第四次增资	芯片图像自动算法技术	90.00	北京市洪州资产评估有限责任公司出具“洪州评报字（2008）第 2-110 号”《评估报告》，以 2008 年 12 月 8 日为评估基准日，“芯片图像自动算法技术”的评估总值为 90.00 万元；其中，丁柯持有的权益为 37.80 万元，蒋卫军持有的权益为 29.70 万元，张军持有的权益为 22.50 万元。	已办理
6	2009 年 7 月，芯愿景有限第五次增资	超大规模图像数据管理技术	90.00	北京市洪州资产评估有限责任公司出具“洪州评报字（2009）第 2-032 号”《评估报告》，以 2009 年 6 月 18 日为评估基准日，“超大规模图像数据管理技术”的评估总值为 90.00 万元；其中，丁柯持有的权益为 37.80 万元，蒋卫军持有的权益为 29.70 万元，张军持有的权益为 22.50 万元。	已办理

2002 年芯愿景有限设立时，存在非专利技术出资比例超过了芯愿景有限注册资本的 20%，以及非专利技术出资未履行评估程序的情形。

根据当时有效的《公司法》（1999 年修正）第二十四条“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”之规定，芯愿景有限设立时的非专利技术出资占注册资本的比例超过前述《公司法》的规定。

根据当时有效的《国务院关于〈北京市新技术产业开发试验区暂行条例〉的批复》（国函[1988]74 号）及《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》第十七条规定“北京市人民政府可以根据本条例制定实施办法和单行规定”，国务院已授权北京市人民政府为北京市新技术产业开发试验区（即中关村科技园区）相关事项制定实施办法和单行规定；根据当时有效的《中关村科技园区条例》第十一条“以高新技术成果作价出资占企业注册资本的比例，可以由出资各方协商约定……”以及《中关村科技园区企业登记注册管理办法》第二条“凡中关村科技园区内的企业登记注册，均适用本办法”、第十三条第一款“以高新技术成果出资设立公司和股份合作企业的，对其高新技术成果出资所占注册资本（金）和股权的比例不作限制，由出资人在企业章程中约定”等规定，在中关村科技园区内以高新技术成果出资设立的公司，其高新技术成果出资所占注册资本（金）和股权的比例不受限制。

芯愿景有限设立时，注册地址位于中关村科技园区，其非专利技术的出资比例适用当时有效的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》《中关村科技园区条例》《中关村科技园区企业登记注册管理办法》等法律法规；同时，芯愿景有限设立时，依法办理了设立登记手续，取得北京市工商局核发的《企业法人营业执照》。因此，本次非专利技术出资占注册资本的比例符合相关法律法规的规定。

此外，芯愿景有限设立时，用于出资的非专利技术未进行资产评估，不符合当时有效的《公司法》（1999年修正）第二十四条规定“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价……”。因此，芯愿景有限设立时的非专利技术出资程序存在瑕疵。

除上述情况外，公司历史沿革中的其他的非专利技术出资均履行了评估作价手续，非专利技术出资的比例均符合相关法规的规定，且已依法办理非专利技术财产权的转移手续。

（2）2018年7月，公司股东对历史非专利技术出资的纠正及置换

芯愿景有限设立时，丁柯、蒋卫军及张军用于出资的非专利技术未履行资产评估程序，不符合当时有效的《公司法》（1999年修正）规定，存在出资程序瑕疵。同时，公司历史上用于增资的非专利技术为丁柯、蒋卫军和张军在持有芯愿景有限股权期间获得的研发成果，该等研发在一定程度利用了公司物质条件；但公司能够提供的物质条件主要为办公场所及计算机相关设备，并非不可替代的特定物。经协商，上述股东同意该等非专利技术的权属归于芯愿景有限。

为更好的保护公司及新老股东的利益，芯愿景有限于2018年6月29日召开股东会，全体股东一致同意由丁柯、蒋卫军及张军以等额现金置换芯愿景有限设立及后续增资时股东投入的非专利技术出资（其中丁柯207.48万元、蒋卫军163.02万元、张军123.50万元），相关非专利技术出资变更为现金出资，变更后各股东的出资额及股权比例不变。

2018年7月13日，芯愿景有限就上述以现金方式等额置换非专利技术出资事宜履行工商备案手续。

2018年8月，丁柯、蒋卫军及张军分别以银行转账的方式向芯愿景有限缴纳上述用于置换的资金，共计494.00万元。

2018年8月24日，天职国际会计师事务所出具编号为“13RAE号”《验资报告》。经审验，截至2018年8月14日，芯愿景有限已收到全体股东缴纳的置换注册资本合计494.00万元；截至2018年8月14日，芯愿景有限置换后的累计注册资本为3,000.00万元，实收资本为3,000.00万元。

2020年1月20日，北京市海淀区市场监督管理局出具编号为“京海市监信字[2020]103号”《证明》，确认公司自2017年1月1日至该证明出具之日，没有违反市场监督管理部门相关法律、法

规受到该局行政处罚的案件记录。

同时，芯愿景股东丁柯、蒋卫军及张军承诺，如因其在公司历史上非专利技术出资事宜导致公司被相关主管部门处罚，将无条件全额承担该等处罚，不使公司利益受到损害。

综上，丁柯、蒋卫军及张军已通过现金方式等额置换公司历史上非专利技术出资，并办理完成工商变更登记手续，不存在权属纠纷。截至本公开转让说明书签署之日，公司注册资本充足、真实，不存在出资不实情形，不存在被处罚的风险。

3、国有股权情况

截至本公开转让说明书签署之日，深创投持有公司 75.60 万股（占公司总股本的 1.2074%）。根据深创投出具的说明，深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令 第 36 号）第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为‘CS’，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的对象，确认深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。

同时，根据《深圳市国资委授权放权清单（2020 年版）》，“市属国有创业投资企业所持创业企业股权不纳入企业国有资产产权登记范围”，深创投作为深圳市属国有创投企业，按照深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的相关规定，无需就投资入股公司事宜履行国有资产评估、备案、批复等手续，无需依据《挂牌指引 1 号》取得国有股权设置批复文件。

五、报告期内的重大资产重组情况

☐适用 ☒不适用

其他事项披露

☐适用 ☒不适用

六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况

（一）公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业

☒适用 ☐不适用

1. 天津芯愿景软件有限公司

成立时间	2010 年 7 月 16 日
住所	天津经济技术开发区信环西路 20 号愿景大厦 A1-101
注册资本	3,000.00 万元
实缴资本	3,000.00 万元
主要业务	集成电路分析和设计
与公司业务	与公司主营业务一致

的关系	
股东构成及持股比例	芯愿景持股 100.00%

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	
总资产	4,165.56	
净资产	3,436.32	
项目	2024 年度	
营业收入	2,337.44	
净利润	250.05	
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（经天职国际会计师事务所审计）	

2. 太原芯愿景微电子技术有限公司

成立时间	2020 年 8 月 26 日
住所	山西综改示范区学府园区长治西巷 9 号电子商务产业园二期一层 7 号房间
注册资本	500.00 万元
实缴资本	500.00 万元
主要业务	集成电路分析和设计
与公司业务的关系	与公司主营业务一致
股东构成及持股比例	芯愿景持股 100.00%

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	
总资产	3,236.38	
净资产	2,607.55	
项目	2024 年度	
营业收入	3,478.71	
净利润	501.80	
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（经天职国际会计师事务所审计）	

3. 北京方芯半导体有限公司

成立时间	2022 年 5 月 18 日
住所	北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 1 层 101
注册资本	1,000.00 万元
实缴资本	1,000.00 万元
主要业务	芯片销售
与公司业务的关系	与公司主营业务一致
股东构成及持股比例	芯愿景持股 100.00%

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	
总资产	1,138.91	
净资产	1,086.36	
项目	2024 年度	
营业收入	792.86	
净利润	-3.82	
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（经天职国际会计师事务所审计）	

其他情况

☒适用 ☐不适用

截至本公开转让说明书签署之日，芯愿景拥有 1 家分公司，具体情况如下：

公司名称	北京芯愿景软件技术股份有限公司保定分公司
统一社会信用代码	91130605687031080L
成立日期	2008 年 12 月 30 日
负责人	丁柯
注册地址及主要生产 经营地	保定市向阳北大街 2628 号云中心智慧产业园 2#-1 号楼 102 室
经营范围	软件服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

（二） 参股企业

☐适用 ☒不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始 时间	任期结 束时间	国家 或地区	境外 居留权	性别	出生 年月	学历	职称
1	丁柯	董事长、 首席科学家	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	男	1975 年 2 月	博士	-
2	蒋卫 军	董事、副 总经理	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	男	1975 年 3 月	硕士	-
3	张军	董事、总 经理	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	男	1974 年 12 月	硕士	-
4	丁仲	董事、研 发总监	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	男	1979 年 6 月	硕士	-
5	魏峻	独立董	2022 年	2025 年	中国	无	男	1970	博士	研究

		事	10 月 12 日	10 月 11 日				年 10 月		员
6	李晓辉	独立董事	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	女	1974 年 4 月	博士	副教授
7	范宏伟	独立董事	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	男	1972 年 6 月	大专	中级会计师
8	郭静	监事会主席、太原芯愿景监事、方芯半导体监事	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	女	1980 年 11 月	大专	-
9	张金正	监事、保定分公司总经理、太原芯愿景总经理	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	男	1982 年 10 月	本科	-
10	熊伟	监事、天津芯愿景副总经理	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	男	1983 年 9 月	本科	-
11	石子信	副总经理	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	男	1986 年 3 月	本科	-
12	王艳红	财务总监、董事会秘书	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	中国	无	女	1983 年 3 月	硕士	-

续:

序号	姓名	职业（创业）经历
1	丁柯	职业经历参见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”之“1、控股股东”。
2	蒋卫军	职业经历参见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”之“1、控股股东”。
3	张军	职业经历参见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”之“1、控股股东”。
4	丁仲	职业经历参见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”之“1、控股股东”。
5	魏峻	1999 年 10 月至今，历任中国科学院软件研究所助理研究员、副研究员、研究员。2000 年 9 月至 2001 年 11 月，任香港科技大学访问学者。2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。
6	李晓辉	1996 年 7 月至 1998 年 12 月，任太原钢铁公司职员；1999 年 1 月至 2000 年 8 月，任北京动力源科技股份有限公司职员；2006 年 4 月至今，历任北京科技大学经济管理学院工商管理系教师、副教授；2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。
7	范宏伟	2012 年 12 月至 2019 年 12 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高

		级经理；2020年1月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019年10月至今，担任公司独立董事。
8	郭静	2002年5月至今，历任公司销售部助理、销售部副经理、监事会主席、太原芯愿景监事。
9	张金正	2006年5月至今，历任公司设计部经理助理、经理、保定分公司总经理、太原芯愿景总经理，公司监事。 张金正是基于 EDA 软件的应用级开发、纳米级工艺定制版图设计等核心技术的最主要贡献者。张金正拥有十余年从事超大规模集成电路分析项目的技术研发和管理工作经验，发展了基于 EDA 软件的应用级开发技术，设计并建立了应用程序的统一框架及运行平台；任职期间，张金正主持完成了一大批高性能 CPU、FPGA 等芯片分析项目。
10	熊伟	2005年11月至2013年4月，历任芯愿景有限设计部工程师、设计部经理；2013年4月至2019年9月，任天津芯愿景设计部经理；2019年10月至今，任公司监事、天津芯愿景副总经理。 熊伟是面向工业物联网的传感和控制器 IP、高适应性通用基础 IP 等核心技术的最主要贡献者。熊伟曾参与公司多项新业务的开发工作，精通数模混合电路设计技术，是公司多项专利权的发明人之一。熊伟负责组建天津芯愿景的设计团队，创建了集成电路兼容产品开发平台及集成电路兼容 IP 开发平台。
11	石子信	2008年7月至2019年9月，历任芯愿景有限设计部工程师、客户经理、销售部副经理、销售部经理、销售总监；2019年10月至今，任公司副总经理、销售总监。
12	王艳红	2009年7月至2010年6月，任北京宇信易诚科技有限公司业务分析员；2010年7月至2011年12月，任北京兴华会计师事务所有限责任公司审计助理；2012年1月至2017年6月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2017年7月至2018年5月，任北京荣大科技有限公司财务总监；2018年5月至2019年9月，任芯愿景有限财务总监；2019年10月至今，任公司财务总监、董事会秘书。

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总计（万元）	89,872.38	82,675.69
股东权益合计（万元）	73,184.09	66,429.02
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	73,184.09	66,429.02
每股净资产（元）	11.69	10.48
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	11.69	10.48
资产负债率	18.57%	19.65%
流动比率（倍）	3.08	2.34
速动比率（倍）	2.53	1.87
项目	2024年度	2023年度
营业收入（万元）	23,737.49	21,492.38
净利润（万元）	10,144.23	7,667.28
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	10,144.23	7,667.28
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9,699.08	7,128.29
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9,699.08	7,128.29
毛利率	71.35%	71.66%

加权净资产收益率	14.24%	12.06%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	13.61%	11.21%
基本每股收益（元/股）	1.60	1.21
稀释每股收益（元/股）	1.60	1.21
应收账款周转率（次）	2.99	2.12
存货周转率（次）	0.90	1.06
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,043.63	13,096.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.44	2.07
研发投入金额（万元）	5,545.75	5,357.02
研发投入占营业收入比例	23.36%	24.93%

注：计算公式

- 1、每股净资产=期末净资产/期末普通股份总数
- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末普通股份总数
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
- 4、流动比率=流动资产/流动负债
- 5、速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债
- 6、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 7、加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
- 8、基本每股收益
基本每股收益= $P0 \div S$
 $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润孰低值；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
- 9、稀释每股收益
稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润孰低值，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
- 10、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 11、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 12、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动现金流量净额/期末普通股份总数
- 13、研发投入占营业收入比例=研发投入/营业收入

九、报告期内公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

十、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称	平安证券
法定代表人	何之江
住所	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系电话	95511-8
传真	0755-82400862
项目负责人	郭鑫
项目组成员	方健铭、何国威、朱重光、董伟丽、程小轩、洪志谦

（二）律师事务所

机构名称	北京植德律师事务所
律师事务所负责人	龙海涛
住所	北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层
联系电话	010-56500900
传真	010-56500900
经办律师	郑超、黄彦宇

（三）会计师事务所

机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	邱靖之
住所	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
联系电话	010-88827799
传真	010-88827799
经办注册会计师	袁刚、闫丽娜

（四）资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
法定代表人	徐伟建
住所	北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢楼三层 305-306
联系电话	010-52596085
传真	010-88019300
经办注册评估师	王爱萍（已离职）、胡启中（已离职）

（五）证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058

传真	010-50939716
----	--------------

（六） 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	周贵华
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

（七） 做市商

☐适用 ☒不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务、产品或服务

（一） 主营业务

主营业务-IC 分析业务	公司依托自主 EDA 软件和自有工艺分析研究实验室，以各类集成电路产品为主要分析对象，提供检测分析、电路分析等技术服务，并在产品开发、科学研究等领域形成了丰富的分析解决方案库。
主营业务-知识产权和资讯业务	该业务包括知识产权服务、图像资讯、产品资讯。 • 知识产权服务是指 IC 知识产权工程师在分析成果的基础上，依托知识产权检索引擎等工具，提供专利侵权/无效分析、布图设计侵权鉴定、专利运营、专利产品映射（PPM）和现有技术查询等技术服务。 • 图像资讯是指利用实验室设备对 IC 产品进行拆解去层，凭借公司自研 EDA 软件完成显微图像的采集和处理，并向客户交付 IC 产品的显微图像数据。 • 产品资讯是指针对通用类的资讯需求，对具有代表性的芯片和电子产品进行分析，得到芯片及电子产品的竞争力分析、概要资讯、显微图像资讯、电路分析数据等，集合形成公司的集成电路大数据平台数据库，并向客户提供相关数据及报告。
主营业务-IC 设计业务	公司基于自身芯片设计能力、半导体 IP 储备与丰富的项目服务经验，向客户提供定制服务以及自有芯片产品。该业务包括设计服务、IP 授权、自有芯片销售、量产服务。
主营业务-EDA 软件授权业务	公司 EDA 软件定位于集成电路分析和集成电路设计领域，是各类业务开展中的基础性技术工具，亦可直接授权客户使用。

公司的主营业务是依托自主开发的电子设计自动化（EDA）软件，开展集成电路分析业务、知识产权和资讯业务以及集成电路设计业务。

设立至今，公司形成了集成电路分析、知识产权和资讯、集成电路设计以及 EDA 软件授权四大业务板块。公司深耕集成电路分析及设计领域多年，技术服务覆盖范围广泛全面，成果应用于集成电路、分立器件、光器件、传感器等各类半导体器件，客户类型覆盖 IC 设计企业、科研院所、集成器件制造商、电子产品系统厂商、司法鉴定机构及律师事务所等全产业链客户群体，相关应用领域涉及工业、消费电子、计算机及通信等。

公司通过自主研发的 EDA 软件体系、精准可靠的分析技术、丰富多元的项目经验、深度积累的优质客户资源，在细分领域建立了显著品牌优势。同时，公司不断打造研发体系、提升科研实力。具体而言，公司持续升级优化工艺分析研究实验平台及各类分析技术，提升 IC 设计及验证水平，丰富自主 IP 产品线，并创新开发核心 EDA 软件，持续保持相关技术的先进性、高兼容性及服务的高品质。未来，公司将持续强化竞争优势、扩展相关核心技术的应用领域。

（二） 主要产品或服务

1、集成电路分析业务（IC 分析业务）

公司是行业内知名的集成电路分析服务厂商，主要服务于半导体客户的研发环节。芯愿景依托自有工艺分析研究实验室和自主 EDA 软件，向客户提供检测分析、电路分析服务等技术服务，在产品开发、科学研究、司法鉴定等领域形成了丰富的分析解决方案库。公司 IC 分析业务目前已累计服务全球客户近 3,000 家，公司客户覆盖国内外知名的科研院所和 IC 设计厂商，如航天科技、中国电科、中国电子等集团的下属科研院所，得到了诸多业内知名机构认可。

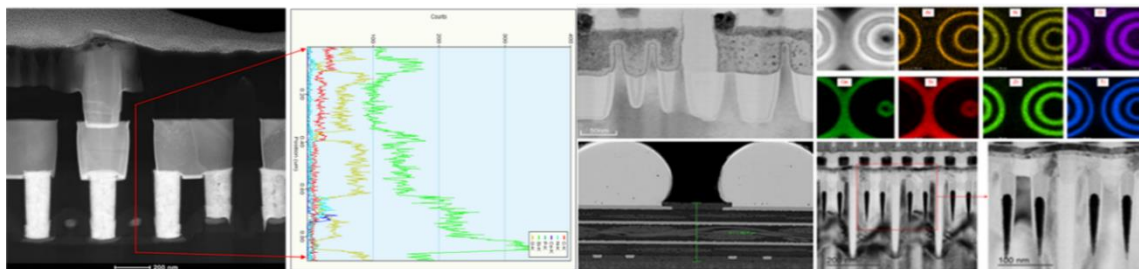
IC 分析业务主要是指对 IC 产品进行拆卸、测绘、分析等，是 IC 领域内了解新技术、设计思路、发现设计缺陷和改进现有技术的重要手段，有利于明确技术探索方向，降低新技术研发试错风险，提升产品性能指标及良品率，在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。公司技术能力覆盖的分析对象工艺难度大、类型丰富、应用范围广。具体而言，目前已具备 3 纳米先进制程的分析能力、单个项目最大规模达 100 亿个晶体管、最大金属层数达 20 层；产品工艺类型包含 CMOS、BiCMOS、Bipolar、BCD 等；产品衬底材料包含体硅（Bulk Silicon）、SiC、GaAs、InP、SiGe、SOI 等；产品应用领域包含 CPU、MCU、FPGA、DSP、RF、ADC、DAC、PM、Image Sensor 等。公司自主研发的 EDA 软件是公司分析业务的核心支撑，随着服务工艺及技术工具的提升完善，软件工具的应用领域持续扩展。

公司的集成电路分析业务包含检测分析服务和电路分析服务，相关服务内容及分析成果案例如下：

（1）检测分析

公司构建了完备的集成电路分析实验室平台，平台由软硬件系统分析实验室、电学特性测试实验室、制造工艺分析实验室、芯片解剖分析实验室和显微拍照实验室等组成。实验室配置了先进的芯片解剖设备、检测分析设备和图像采集设备，可以完成 3 纳米以上各种类型芯片的检测分析。

检测分析是指化学及材料专业工程师利用光学/SEM/TEM/FIB 显微镜、离子刻蚀机、X 射线机等，对集成电路及电子产品进行无损检测分析、电性检测分析、物性检测分析、材料分析、平面分析、纵向结构分析等，综合运用电子、结构、材料、理化等多方面技术完成各类型检测分析项目。该类业务可帮助企业了解 IC 产品的内部结构、成分及电学特性，可作为产品失效分析（Failure Analysis）的重要检测手段，亦可帮助客户理解 IC 产品的制造工艺和设计特点。公司提供的检测分析，一般根据项目需求主要向客户交付纵切图/电性检测分析/EDX 能谱分析等成果，相关交付成果示意如下：



实际应用案例一：IC 厂商改进制造工艺技术，提高产品良率

A 为国内某新建存储类 IC 厂商。为了快速提升技术、完善工艺，A 希望分析国外先进产品，研究其中的制造工艺信息，以提升和改进自身工艺水平。A 从公开渠道购买国外先进产品，委托公司进行工艺指标分析。

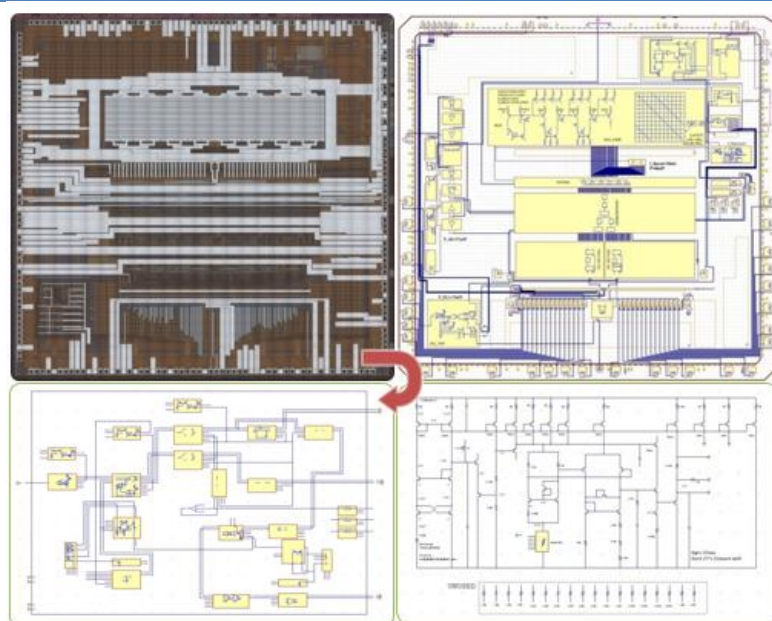
公司运用封装解剖、层次去除、纵切分析和成分测试等手段，融合 IC 工艺处理、显微图像自动采集及处理等核心技术，可获得产品的工艺细节指标；分析后可得到：①封装技术指标（封装类型、尺寸、管脚数量、焊球结构、基板电路等）；②工艺技术指标（制造工艺类型、特征工艺尺寸、介质层材质、金属层数、各互连线层 Pitch 值等）；③器件技术指标（晶体管结构、Polycide 或 Salicide 结构、特殊器件结构、衬底隔离方式等）；④其他信息（IP 模块布局、I/O 分布、ESD 保护电路等）。最终，公司形成分析报告并提供给 A。通过这种产品分析手段，A 可将国外产品指标与自有产品进行对比，并针对性地进行独创性再设计，改进工艺缺陷，从而快速提高产品良率。

（2）电路分析

微电子工程师利用显微镜采集得到的 IC 图像数据，依托 IC 分析、验证软件，通过引线及通孔识别、单元搜索和提取等自动化分析技术，结合工程师的芯片设计经验和电学知识，绘制反映 IC 原始设计思路的电路网表；经进一步整理分析，可得到易于理解、反映原始设计思想及技巧的层次化电路图。

上述流程中，公司自主研发的 EDA 软件起到核心作用。具体而言，显微图像采集和处理系统（Filmshop System）、显微图像实时处理系统（Panovas Pro System）可自动完成 IC 工艺分析业务的重要工序，如显微图像自动采集、海量图像自动拼接对准、并在处理完成后自动生成图像数据库等；集成电路分析再设计系统（ChipLogic Family）、集成电路分析验证系统（Hierux System）和高性能图像自动算法系统（Catalysis Series）可自动开展网表提取、标注图形自动转换为单层次电路图、电路整理，并支持 4 亿门级电路自动提取和 2,000 万门级电路自动整理能力。

公司提供的电路分析服务，根据项目需求向客户交付 IC 电路网表、层次化电路图等技术成果。相关成果（芯片照片/电路网表/层次化电路图）示意如下：



实际应用案例二：IC 设计企业突破关键技术瓶颈

B 是国产 MCU 领域市场领导者之一，与国外先进产品相比，B 的产品在接口电路性能指标方面存在技术瓶颈；B 希望进一步提升产品性能，缩小与国外最尖端产品间的技术差距。作为行业资深企业，B 熟知同行间的产品相互分析学习是集成电路等行业内惯例，能够促进市场竞争和提升产品力。因此，B 从公开市场购买最先进芯片产品，并委托公司对其接口电路进行电路分析。

公司对样品 IC 进行逐层解剖和内部显微全景图像拍照；综合运用 IC 图像自动识别、高精度网表提取、IC 功能分析等核心技术，参照图像背景进行电路网表提取、功能和结构分析；并进行关键技术分析（关键模块的布局布线、电源和地线布局、ESD 设计特点、低功耗技术等），还原样品接口电路的内部结构和工作原理。最终公司将包含分析结果和优化设计思路的分析报告提供给 B，协助其实现产品改良升级。

B 结合自身产品的特点和国内应用场景的特点，对 MCU 接口进行了创新性设计。在不改变制造工艺的前提下，通过增加动态 N 阱偏置结构，解决了接口电压较高情况下的漏电问题，最终使产品耐压性能优于国外同类产品，延长产品使用寿命。

2、知识产权和资讯业务

知识产权和资讯业务包括知识产权服务、产品资讯和图像资讯。相关情况如下：

（1）知识产权服务

知识产权服务是指 IC 知识产权工程师利用电路分析成果，依托知识产权检索引擎等工具，提供专利侵权/无效分析、版图设计侵权鉴定、专利运营（布局/估值/交易/授权）、专利产品映射（PPM）和现有技术查询等技术服务。相关手段包括：专利权利要求及保护范围研究、专利保护范围与电路分析成果比对、版图设计相似度鉴定、专利分类及策略研究等。此外，在分析服务过程中，公司将

项目案例中的共性图像或电路数据、设计技术等进行整合管理，形成了芯片专利数据库；该等技术储备有力支撑了技术查询、专利估值等重要分析工序。

实际应用案三：IC 厂商委托工艺专利侵权取证

C 怀疑另一家 IC 厂商 D 可能侵犯其芯片焊盘结构的一个发明专利。C 从公开市场渠道取得 D 的 IC 产品，并将经公证后的样品交予公司进行分析鉴定。

一般而言，工艺专利的侵权取证须以 IC 工艺分析成果为基础。公司知识产权分析工程师研读 C 的专利文件，根据专利权利要求及保护范围，确定取证方式、样品中拟分析的目标区域及其特征要点，即疑似侵权的焊盘结构的顶层金属和次顶层金属需要满足特定的连接结构，并要求焊盘下的次顶层金属具有缝隙结构。

根据以上特征，公司开展具体侵权分析和取证工作。首先，公司通过采集芯片所有焊盘的顶层和次顶层显微图像，观察分析后确定侵权分析区域。其次，在相关区域的平面高倍率图像和特定位置的 TEM 纵切图像基础上，对特定层次进行 EDX 成分分析，获得焊盘的平面及纵向结构。再次，将前述分析结果与专利权利要求特征要点逐一比对，形成检测分析结果；若比对结果一致，根据专利侵权认定的全覆盖原理，可得出目标芯片是否侵犯焊盘专利权的结论。最终，公司运用电路图版面优化等核心技术，制作侵权分析报告并进行交付。C 可将该报告作为专利侵权的技术证据，进行权利维护。

（2）图像资讯

图像资讯是指利用实验室设备对 IC 产品进行拆解去层，凭借公司自研 EDA 软件完成显微图像的采集和处理，并向客户交付 IC 产品的显微图像数据。该类业务可以帮助客户针对具体工艺层次，理解 IC 制造工艺和设计特点。上述过程中，公司自主研发的 EDA 软件完成图像处理和采集的核心工序，包括显微图像自动采集、海量图像自动拼接对准等，并在处理完成后自动生成图像数据库。

实际应用案例四：

客户 G 从事高速数据转换器集成电路的研发，对某款国外新推出的数据转换器产品感兴趣。通过该产品的数据说明书（datasheet）了解到的资讯非常有限，不能满足客户 G 对该产品的竞争力进行全面评估。客户 G 通过公开市场采购了若干芯片样片，委托公司开展图像资讯采集服务。具体要求包括：获取该芯片各个工艺层次的结构信息、了解该芯片是否存在特殊制造工艺结构、获取该芯片各层次的高分辨率图像信息。公司将这些图像资讯采集并处理后，交付给客户 G。从而，客户 G 能够更全面、更深入地了解该数据转换器产品的技术特点和竞争力水平。

（3）产品资讯

针对通用类的资讯需求，对具有代表性的芯片和电子产品进行分析，得到芯片及电子产品的竞争力分析、概要资讯、显微图像资讯、电路分析数据等，集合形成公司的集成电路大数据平台数据

库，并向客户提供相关数据及报告。

实际应用案例五：

客户 X 是从事近场通信类（NFC）芯片研发的集成电路设计企业。X 通过公司的集成电路大数据平台 IPBrain（微信公众号、网站）上了解到平台中包含若干款国外先进 NFC 芯片的技术分析报告，在与公司销售人员联系咨询报告的详细内容及报价后，X 最终采购了 IPBrain 平台中某款分析报告。X 通过该分析报告，进一步了解了自身产品与国外先进产品之间的竞争力差异，并在研发下一代 NFC 芯片中采用更多的前瞻性技术。

3、集成电路设计业务（IC 设计业务）

公司依托自主 EDA 软件和 IP 产品，提供集成电路设计服务、量产服务、IP 授权等业务，并销售自有芯片产品。公司在微控制器、电源管理、汽车电子、工业和自动化控制、数字信号处理、安防监控、物联网等领域形成了众多解决方案。相关设计具备高兼容性、低功耗、安全防护、静电防护（ESD）等特点，相关产品的流片经验丰富、产品良率较高，成品过程标准规范。

（1）设计服务

集成电路设计服务主要面向后端设计服务、设计验证服务、整包设计服务等需求。

其中，后端设计服务和设计验证服务主要运用公司自主研发的 EDA 软件体系，结合客户对工艺规则、性能指标、兼容性等方面提出的要求进行版图设计。上述流程中，公司自主研发的 EDA 软件体系起到核心作用，具体而言，凭借集成电路设计优化系统（Bool Smart System）、定制集成电路智能设计系统（Design Smart System）、版图实时验证系统（Veri Smart System）等，可完成定制电路图设计、数字逻辑优化、定制版图设计、数字电路布线优化以及版图实时验证。在该等平台级软件的基础上，公司针对特定领域 IC 设计项目可进行自动化、批量化的软件开发，实现快速定制开发、部署应用、迭代优化，降低设计服务人工成本。

整包设计服务指根据客户在芯片功能、性能、功耗、成本等方面的定制化需求，进行芯片定义与芯片设计，形成版图后由公司或者客户委托晶圆厂、封装测试厂进行晶圆生产和封装测试。在该类业务中，公司综合运用基于 EDA 软件的应用级开发、纳米级工艺定制版图设计、基于 FPGA 的 IP 和集成电路产品验证、高适应性通用基础 IP 等自主研发形成的核心技术，进行电路和版图的设计和验证。

实际应用案例七：IC 设计企业产品可靠性加固

H 拟将一款消费类芯片拓展到汽车电子领域，需要对该产品按照车规要求进行可靠性加固，保证其在温/湿度条件较为苛刻或极端的环境中也能保持正常使用。由于不具备汽车电子领域芯片可靠性加固方面的技术和经验，H 委托公司进行产品设计优化。H 将其已量产的消费类芯片电路和版图数据交给公司，公司按客户车规要求，综合运用 IC 安全可信设计、基于 EDA 软件的应用级开发、

基于 FPGA 的 IP 和集成电路产品验证等自主研发形成的核心技术,进行电路和版图的可靠性加固设计和验证,并最终交付设计验证完成的电路、版图和验证过程数据。H 自行完成后续的量产和测试等工作。

(2) IP 授权

IP 授权系,公司根据市场需求及自身技术优势,自主研发了适用于若干领域的 IP;相关技术具备已验证、可复用、特定功能性等特点,有助于提升设计效率;可用于自主设计环节,亦可直接授权客户设计开发使用。同时,公司也为客户提供 IP 定制开发服务。

目前,公司 IP 平台主要包括三大 IP 系列、24 个 IP 产品,已应用于多种 IC 产品的设计服务中,相关情况如下:

IP 系列名称	产品介绍	性能特点
嵌入式安全防护类 IP (SecuraxIP)	针对芯片不同的安全风险点设计了不同的嵌入式安全防护 IP 核,形成了一套灵活的 IP 安全解决方案,可独立使用或嵌入到单/多核架构 MCU/SoC/FPGA 中,适用于物联网、车联网、人工智能、云计算、电子支付等场景的安全应用,可以显著提升系统的安全引导、身份识别、安全信息存储、安全通信等各个领域。	SecuraxIP 可独立使用或嵌入单/多核架构 MCU/SoC/FPGA 中,有效保护 IC 核心模块及数据抵御外部非侵入式攻击(如旁路信号分析、故障注入)、侵入式攻击(如 FIB 修改、微探针窃听)等。
工业物联网与控制类 IP (GeminiIP)	工业物联网与控制类 IP 适用于工厂自动化控制、医疗电子、汽车电子、测量、工业运输等场景。总线协议类、运动控制类和编码器等 IP 能够帮助设计者快速可靠的推出工业产品的解决方案。	GeminiIP 可协助实现主机节点与从机节点的数据通信、自动控制轨迹并驱动电机完成动作、数字/模拟传感信号编解码及抗噪能力提升、支持工业级宽温度测量范围等功能;构成了公司面向工业物联网的传感和控制 IP 等核心技术内容,可帮助设计者快速可靠地实现工业 IC 设计。
通用基础类 IP (TaurusIP)	公司研发了各类数模混合信号 IP 及通用标准接口等基础 IP 库,为设计者提供完善的芯片设计解决方案。	TaurusIP 涵盖数模混合信号、通用标准接口等的基础 IP 库,可覆盖多场景下 MCU 的协议通信、信号传输、时钟管理、功耗性能管理、数模信号处理等需求;同时,面向用户基础需求,可提供不同工艺节点、目标厂商的 IP 授权。该等 IP 构成公司高适应性通用基础 IP 等核心技术内容,可显著降低设计开发过程的周期和成本,有利于提高流片成功率。

(3) 自有芯片销售

凭借基于 EDA 软件的应用级开发、纳米级工艺定制版图设计、基于 FPGA 的 IP 和集成电路产品验证、高适应性通用基础 IP 等自主研发形成的核心技术,公司自主芯片产品由公司自主进行芯片设计与量产。

报告期内,公司自研芯片主要以工业类芯片为主,分为工业总线芯片、数字信号处理器芯片、

以太网物理层芯片等，聚焦工业自动化和智能制造，覆盖工业机器人、运动控制、工业电机控制、电力系统以及网络通信等关键应用领域。产品情况如下：

芯片	应用领域	在应用领域中的作用	产品特点
工业总线芯片	伺服控制与多轴运动系统	负责实现多关节伺服电机的高精度同步控制，确保动作指令的实时性和一致性。例如，在机器人关节控制中，芯片通过分布式时钟同步（精度<1 μs）协调多个轴的联动，避免机械振动和误差累积。	硬件同步机制：内置 64 位分布式时钟，支持微秒级同步精度，确保多轴协同的实时性。低延迟通信：通过 8 个 FMMU（现场总线内存管理单元）直接处理数据映射，减少微控制器负载，通信延迟可控制在纳秒级。接口扩展能力：支持 SPI/QSPI 接口（速率 100MHz），可连接编码器、驱动器等外设，简化伺服系统设计。
	工业 PLC 与分布式 I/O 模块	在 PLC 系统中，作为分布式 I/O 模块的核心器件，传输多通道数据（如温度、压力传感器信号）和指令（如阀门控制），实现中央控制与边缘设备的实时交互。	高集成度设计：集成 8KB 双端口内存（DPRAM）和 8 个同步管理器（SM），支持多任务并行处理，适用于大数据量场景。冗余容错：支持热插拔和端口冗余配置，确保系统在单点故障时仍可连续运行。协议兼容性：内置控制器，支持与第三方设备（如变频器、HMI）无缝集成。
	变频驱动与电机控制	在变频驱动器中解析主站下发的速度指令，实时调节电机扭矩和转速，适用于高动态响应场景（如电梯调速、机床主轴控制）。	硬件加速能力：集成三角函数加速器（TMU）和 14 位 ADC（4MSPS 采样率），优化电机控制算法（如矢量控制）的执行效率。低功耗设计：支持 3.3V/5V 供电灵活配置，适配电池供电的移动设备（如 AGV 小车）。抗干扰性：LVDS 接口降低电磁干扰，确保长距离传输稳定性（最远 100 米）。
	工业通讯网络与拓扑扩展	作为 EtherCAT 交换机或网关的核心组件，支持构建复杂网络拓扑（星型、树型、环形），扩展设备连接数量并优化数据传输路径。	多端口配置：支持 4 个物理通信端口（MII 或 EBUS），可灵活配置为输入/输出，适配不同拓扑需求。协议处理能力：硬件解析 EtherCAT 帧，无需依赖微控制器 IP 堆栈，通信效率提升 10 倍以上。诊断功能：支持电缆开路/短路检测及长度估算，简化现场网络维护。
	机器人控制与协同作业	在人型机器人或多关节机械臂中，协调运动控制与感知系统（如视觉、力觉传感器），实现动态平衡和路径规划。	实时数据融合：通过 Σ - Δ 调制器数字滤波（HPDF）和快速比较器（COMP），实现多传感器数据的高精度同步采集。紧凑封装：QFN64（7×7mm）或 BGA 封装，适应机器人关节模块的空间限制。开发友好性：提供与倍福 TwinCAT 软件兼容的 XML 配置文件，缩短开发周期。
	分布式控制系统（DCS）	在大型产线中，EtherCAT 从站连接 PLC、传感器和执行器，构建分布式实时协同网络，降低主站负载并提升系统可扩展性。	分布式内存映射：通过 8 个 FMMU 单元实现数据分区管理，支持多设备并行访问。低资源占用：无需运行完整 TCP/IP 协议栈，减少处理器开销和功耗。方芯 FCE1100 等芯片实现引脚兼容设计，成本降低 30%以上。

数字信号处理器 (DSP) 芯片	工业电机控制与伺服驱动	作为变频器、伺服驱动器的核心控制器，F28335 通过高精度 PWM 输出(如 18 路 PWM 通道)和实时算法(如矢量控制)，调节电机转速、扭矩及动态响应，适用于数控机床、机械臂等高精度场景	高精度 PWM：支持 150ps 分辨率的 HRPWM（高分辨率脉宽调制），实现微秒级电机控制精度，降低转矩脉动。浮点运算加速：集成 32 位浮点单元（FPU），单精度浮点运算效率达 300MFLOPS，可快速执行电机控制算法（如 FOC 算法）。实时通信接口：内置 CAN 总线、SPI 和 UART 模块，支持与上位机（如 PLC）的实时数据交互。
	新能源逆变器与并网系统	在光伏逆变器、风电变流器中，F28335 负责 MPPT（最大功率点跟踪）算法执行、逆变波形生成及并网控制，提升能源转换效率	高速 ADC 采样：16 通道 12 位 ADC（80ns 转换时间），支持多路电压/电流同步采集，实现精确的功率监测与保护。算法优化能力：通过单周期 32×32 位乘法运算，加速 FFT 变换、谐波分析等复杂运算，优化并网电能质量。低延迟响应：150MHz 主频结合快速中断机制（<100ns 响应时间），确保电网故障时的快速关断保护。
	电力系统与智能电网	用于电能质量监测装置、SVG/SVC（动态无功补偿设备），实现谐波抑制、电压调节及故障录波功能	大容量存储扩展：支持外部存储器接口（EMIF），可连接外部 SRAM/Flash，满足大容量数据缓存需求（如录波数据存储）。多协议通信：集成 CAN 和 EtherCAT（需外接 ESC 芯片），兼容智能电网通信协议（如 IEC61850）。高可靠性设计：-40℃~+85℃工业级温度范围，适应变电站等恶劣环境。
	机器人控制与自动化设备	在多轴机器人、AGV（自动导引车）中协调运动控制与传感器数据融合，实现路径规划和动态平衡	多轴同步控制：通过 6 通道高精度 HRPWM，支持多关节电机的相位同步（误差<1μs）。传感器集成能力：支持 SPI/I2C 接口连接编码器、力觉传感器，实现闭环控制。紧凑系统设计：1.8V 低内核电压与 QFP 封装（176 引脚），适配空间受限的嵌入式设计。
	汽车电子与 ADAS	在电动汽车中用于电池管理系统（BMS）、电机驱动及 ADAS（高级驾驶辅助系统），如电池 SOC 估算、EPS（电动助力转向）控制。	安全冗余机制：双核架构（部分衍生型号）支持功能安全标准（如 ISO26262），确保关键系统可靠性。低功耗优化：动态调节内核电压（1.8V-1.995V），延长车载设备续航。实时数据处理：DMA 控制器直接传输 ADC 数据至内存，减少 CPU 负载（适用于高速 CAN 总线通信）。
以太网物理层 (PHY) 芯片	工业控制与自动化	作为工业 PLC、分布式 I/O 模块的物理层通信核心，通过 RMII/MII 接口连接嵌入式处理器 MAC，实现传感器数据采集、执行器控制指令的实时传输。例如，在产线自动化设备中，协调多节点间的数据同步（如温度传感器与阀门联	抗干扰设计：支持 LVDS 接口降低电磁干扰，确保 100 米电缆传输稳定性（通过集成片上终端电阻实现）。冗余容错：支持热插拔和双 PHY 冗余配置，在单端口故障时可切换至备用链路。实时性优化：通过 MDIO 总线配置寄存器（如速度/双工模式），实现微秒级网络响应，满足 PROFINET/RTT 通信需求。

		动)。	
	嵌入式系统与开发板	在嵌入式开发板（如 ELF1）中作为网络通信模块，通过 RMII 接口与主控芯片（如 ARM Cortex-A 系列）协同工作，支持 TCP/IP 协议栈运行。典型场景包括远程设备调试、OTA 固件升级等。	紧凑集成：采用 24/32 引脚 QFN 封装（最小尺寸 4×4mm），适配空间受限的嵌入式设备。低功耗模式：支持节能以太网（EEE）标准，空闲状态功耗低于 100mW，延长电池供电设备续航。拓扑扩展：通过 MDIO 总线最多挂载 7 个 PHY 芯片（地址 001-111），支持多网口扩展设计。
	网络通信设备	应用于工业交换机、网关设备中，构建星型/树型/环形混合拓扑网络，支持多级级联。例如，在智能电网中作为边缘节点实现数据汇聚。	协议兼容性：硬件解析 IEEE802.3 协议帧，支持 AutoMDI/MDI-X 自动校正线序，无需区分直连/交叉线缆。时钟同步：集成 50MHz RMII 参考时钟输出，减少外部晶振需求，降低 BOM 成本 15%。诊断功能：支持电缆开路/短路检测及长度估算，缩短现场维护时间。
	新能源与电力电子	在光伏逆变器、风电变流器中实现并网通信，传输功率数据及故障告警信号。例如，通过 CAN 总线与上位机联动完成 MPPT 算法参数调整。	宽温支持：工作温度范围 -40℃ 至 +85℃，适配户外恶劣环境。电源集成：内置 1.2V LDO 稳压器，兼容 3.3V/5V 系统供电，简化电源设计。安全隔离：通过集成网络变压器实现 2500Vrms 电气隔离，防止地环路干扰。
	消费电子与物联网	在智能家居网关、IP 摄像头中提供稳定网络连接，支持视频流传输及云端交互。例如，通过 UDP 协议实现安防摄像头实时画面推送	低延迟传输：RMII 接口数据吞吐率达 100Mbps，满足高清视频流传输需求。唤醒功能：支持 LAN 唤醒（WoL），设备待机功耗低于 10mW。易用性优化：提供预配置评估板（如 KSZ8081RND-EVAL），加速原型开发周期。

（4）量产服务

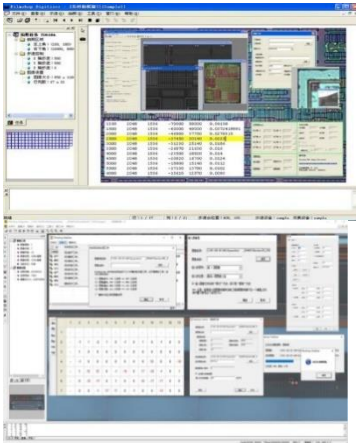
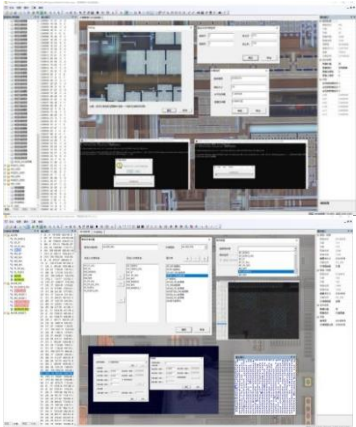
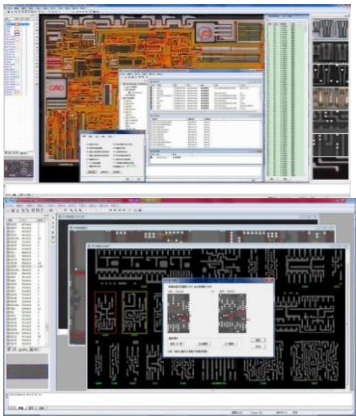
量产服务指公司根据客户的需求，依据公司为客户提供的整包设计服务成果或者客户设计提供的版图或者样片，为其提供量产服务，并向其交付合格的晶圆或者芯片产品。

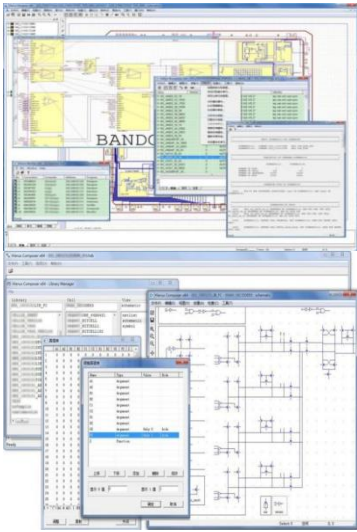
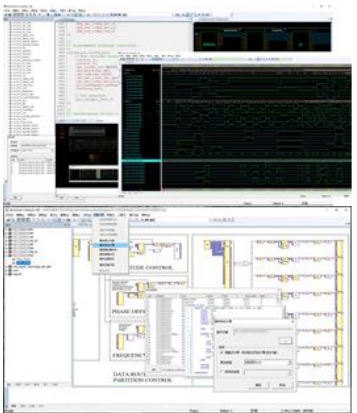
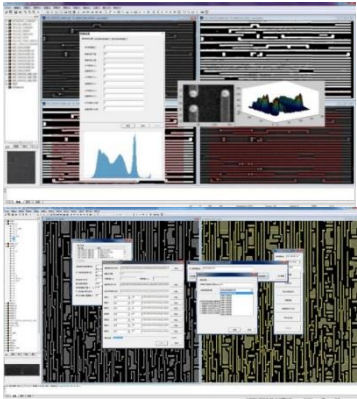
4、电子设计自动化（EDA）软件授权业务

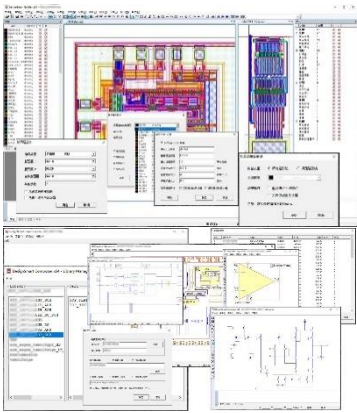
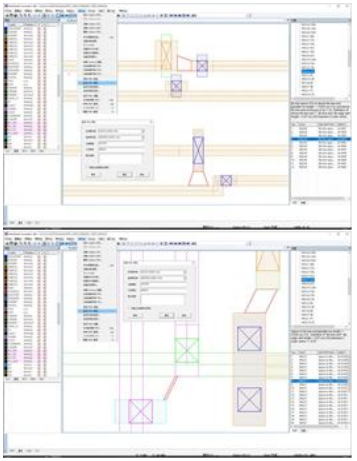
（1）基本情况

公司的主要商业模式为以自有 EDA 软件为核心工具，开展 IC 分析、知识产权和资讯、IC 设计等业务，亦可直接授权客户使用。设立以来，公司将 EDA 软件需求定位于 IC 分析业务、知识产权和资讯业务以及设计业务领域，已逐步形成八大软件产品线、44 个软件产品；该等软件产品具备核心技术引领/实现、执行效率保障/提升等核心作用。各类 EDA 软件产品主要使用 C++ 语言编写，源代码总量已超四百万行，兼容 Windows 和 Linux 操作系统；同时，其二次开发接口可实现设计服务中的“应用级开发”。总体上，公司 EDA 软件功能丰富、覆盖业务全流程，是公司核心技术的重要组成部分。

(2) 主要 EDA 软件系统情况

序号	软件系统名称	功能简介及业务支撑作用	界面示例
1	显微图像采集和处理系统 (Filmshop)	• 主要用于公司 IC 分析业务、知识产权和资讯业务，可自动开展包括显微图像自动采集、问题图像重新采集、图像自动拼接对准、并在处理完成后自动生成图像数据库。 • 作为公司研发的第一代显微图像采集和处理系统，支持光学和电子显微镜的大规模图像采集，及 IC 全景图像的同层无缝拼接和异层精确对准，适用于 4TB 量级图像采集、65 纳米以上工艺、千万门级规模的 IC 图像处理。 • 具体包括：光学图像采集软件 FilmshopDigitizer、SEM 图像采集软件 FilmshopScanner、图像拼接对准软件 FilmshopIntegrator、图像处理软件 FilmshopTools、图像数据库生成器 FilmshopPacker 等。	
2	显微图像实时处理系统 (Panovas Pro)	• 主要用于公司 IC 分析业务、知识产权和资讯业务，面向复杂度更高的芯片，可自动完成包括显微图像自动采集、问题图像重新采集、海量图像自动拼接对准、并在处理完成后自动生成图像数据库。 • 作为公司研发的新一代显微图像处理系统，采用 64 位存储地址空间、虚拟化实时处理技术，适用于 3 纳米以上工艺、4TB 量级规模的 IC 图像处理。 • 具体包括：高性能实时图像器 PanovasProcessor、并发图像处理工具 PanovasTools、高阶图像处理工具 PanovasBooster、海量图像生成器 PanovasPackager 等。	
3	集成电路分析再设计系统 (ChipLogic Family)	• 主要用于公司 IC 分析业务中的网表提取和电路分析工序，适用于层次化结构较简单的芯片，能够自动完成网表提取、单元区定义、数字单元和模拟器件定义、标注图形自动转换为平面电路图；采用集中式数据存储，支持细粒度操作级数据同步及多用户并发处理，适用于超大规模数字电路 IC 项目。 • 具体包括：数据库服务器软件 ChipLogic Datacenter、网表提取软件 ChipLogic Analyzer、布图分析软件 ChipLogic Layeditor、存储分析	

		软件 ChipLogic Decoder、系统管理软件 ChipLogic Manager 等。	
4	集成电路分析验证系统 (Hierux System)	• 主要用于公司 IC 分析业务、知识产权和资讯业务，基于自主 HDB 数据库引擎，适用于复杂层次结构的 SoC 等产品，提供 4 亿门级电路自动提取和 2,000 万门级电路自动整理能力。 • 对于 IC 分析业务，可自动开展网表提取及电路整理；对于知识产权服务，可自动生成布图相似性比较结果、电路图版面优化和报告生成以及结果数据交付等。 • 具体包括：数据同步服务器软件 Hierux Server、网表提取软件 Hierux Extractor、功能分析软件 Hierux Designer、命令执行软件 Hierux Operator、标准单元识别软件 Hierux Recognizer、布图相似性比较软件 Hierux Comparator、专利出版软件 Hierux Publisher、应用程序框架软件 Hierux Ticker、数据交付软件 Hierux Reporter 等。	
5	集成电路设计优化系统 (BoolSmart System)	• 主要用于公司 IC 设计业务。针对数字电路和定制电路设计，提供电路级优化设计能力；采用自主 HDB 数据库引擎，是支撑 IC 设计业务的重要技术工具。 • 具体包括：数据同步服务器软件 BoolSmart Server、数字电路解析软件 BoolSmart Resolver、数字电路布线软件 BoolSmart Innovator、高级智能分析软件 BoolSmart Catalyzer、信号分析优化软件 BoolSmart Inspector、可视化调试软件 BoolSmart Visualizer、命令行执行软件 BoolSmart Translator、服务器管理软件 BoolSmart Monitor 等。	
6	高性能图像自动算法系统 (Catalysis Series)	• 主要用于公司 IC 分析业务，可自动识别出引线/孔/模拟器件/数字单元等电路结构。针对显微图像特点，对模拟和数字电路基本布图结构建模，并利用计算机视觉和深度学习技术，对超大规模数字电路可实现 99% 以上的自动识别率。 • 具体包括：算法授权服务器 Catalysis Server、数字单元搜索算法 Catalysis Search、线网识别算法 Catalysis Extract、引线孔识别算法 Catalysis Contact、算法参数调试平	

		台 Catalysis Platform 等; Katalysis Processor 提供全新的集成式图像识别软件平台。	
7	定制集成电路智能设计系统 (DesignSmart System)	• 主要用于公司 IC 设计业务, 基于自主研发的 HDB 数据库引擎, 提供了定制集成电路的设计环境。该系统提供了全功能的层次化定制电路和版图设计能力, 用于模拟电路、数模混合电路、存储器电路、FPGA 等类型的集成电路的设计和实现, 是支撑定制集成电路设计服务业务的基础性 EDA 工具。 • 具体包括: 电路图设计软件 DesignSmart Composer、版图设计软件 DesignSmart Builder、参数单元开发软件 DesignSmart Engineer 和定制 IP 管理软件 DesignSmart IPmanager 等。	
8	版图实时验证系统 (VeriSmart System)	• 主要用于公司 IC 设计业务。可用于实时版图验证和运算, 适用于先进工艺复杂版图设计规则, 可嵌入到数字电路后端设计软件 BoolSmart Innovator 和定制电路的版图设计软件 DesignSmart Builder 中。提供 16 纳米~180 纳米工艺制程设计规则的验证能力, 可进一步提升设计优化和验证过程中自动化操作水平和品质。同时, 提供了二次开发接口, 可支持应用级程序开发。用于设计服务业务, 通过应用级开发, 针对大型项目可显著提升设计效率。 • 具体包括: 版图实时处理验证引擎 VeriSmart Engine、版图处理界面生成软件 VeriSmart Ticker、应用程序基础框架软件 VeriSmart Foundation 等。	

5、不同业务类型的基本情况

一级分类	二级分类	具体业务实质	目标客户及直接和终端客户群体	合作模式及具体应用场景和用途	业务周期	业务开展方式及服务模式
IC 分析业务	检测分析	利用光学/SEM/TEM/FIB 显微镜、离子刻蚀机、X 射线机等, 对集成电路及电子产品进行无损检测分析、电性检测分析、物性检测分析、材料	IC 设计企业、集成电路器件制造商、电子产品系统厂商、科研院所等	帮助客户了解 IC 产品的内部结构、成分及电学特性, 可作为产品失效分析的重要检测手段, 亦可帮助客户理解	不同项目间业务周期差距较大。影响业务周期的因素包括: 管芯面积、制造工艺、工艺尺	由工艺分析部门执行无损检测分析、电性检测分析、物性检测分析、材料分析、平面分析、纵向结构分析等, 最终获得制

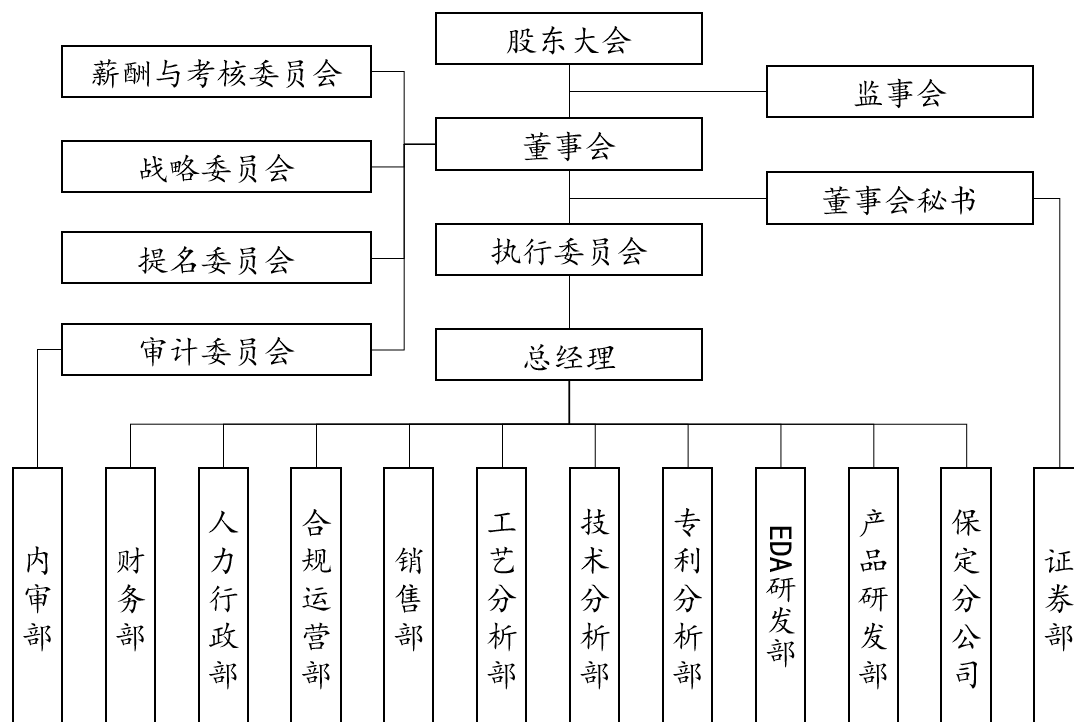
知识产权和资讯业务	电路分析	分析、平面分析、纵向结构分析等，综合运用电子、结构、材料、理化等多方面技术完成各类型检测分析项目		IC 产品的制造工艺和设计特点	寸、金属层数、多晶层数等技术指标，该等指标影响拍照面积（张	成指标、成分指标等数据或信息交付客户。
		利用显微镜采集得到的 IC 图像数据，依托 IC 分析、验证软件，通过引线及通孔识别、单元搜索和提取等自动化分析技术，结合工程师的芯片设计经验和电学知识，绘制反映 IC 原始设计思路的电路网表；经进一步整理分析，可得到易于理解、反映原始设计思想及技巧的层次化电路图	IC 设计企业、集成电路件制造商、电子产品系统厂商、科研院所等	帮助客户了解竞品的设计原理和内部结构，作为研发方向选择的辅助手段	数)、图片拼接、网表提取、电路整理的工作量	首先由工艺分析部门进行显微图像采集和处理，并由技术分析部门在上述图像库等数据的基础上，进行电路网表提取、电路功能分析，最终获得 IC 电路网表、层次化电路图等数据交付客户
	知识产权服务	利用电路分析成果，依托知识产权检索引擎等工具，提供专利侵权/无效分析、布图设计侵权鉴定、专利运营（布局/估值/交易/授权）、专利产品映射（PPM）和现有技术查询等技术服务	IC 设计企业、集成电路件制造商、电子产品系统厂商、科研院所、司法鉴定机构及律师事务所等	专利侵权取证、布图设计侵权取证等		一般由 IC 知识产权工程师利用 IC 分析成果，依托知识产权检索引擎等工具，开展专利侵权分析、集成电路布图设计侵权鉴定、专利产品映射（PPM）和现有技术查询等服务，形成专利分析报告或布图匹配度指标等交付客户
	图像资讯	利用实验室设备对 IC 产品进行拆解去层，凭借公司自研 EDA 软件完成显微图像的采集和处理，并向客户交付 IC 产品的显微图像数据	IC 设计企业、集成电路件制造商、电子产品系统厂商、科研院所等	帮助客户针对具体工艺层次，理解 IC 制造工艺和设计特点		根据客户要求，完成封装解剖、层次去除等步骤后，经 EDA 软件完成显微图像自动采集、海量图像自动拼接对准后，形成显微图像数据库并交付客户
	产品资讯	针对通用类的资讯需求，对具有代表	IC 设计企业、集成电路	帮助客户了解具有代表性的		客户通过集成电路大数据平

		性的芯片和电子产品进行分析,得到芯片及电子产品的竞争力分析、概要资讯、显微图像资讯、电路分析数据等,集合形成公司的集成电路大数据平台数据库,并向客户提供相关数据及报告	件制造商、电子产品系统厂商、科研院所等	竞品的主要情况,了解市场竞争和技术发展情况		台网站和公众号了解公司的数据范围,匹配自身研发和竞品分析需求,向公司采购平台中数据或报告
IC 设计业务	设计服务	主要面向后端设计服务、设计验证服务、整包设计服务等需求。 后端设计服务和设计验证服务主要运用公司自主研发的 EDA 软件体系,结合客户对工艺规则、性能指标、兼容性等方面提出的要求进行版图设计。整包设计服务指根据客户在芯片功能、性能、功耗、成本等方面的定制化需求,进行芯片定义与芯片设计,形成版图后由公司或者客户委托晶圆厂、封装测试厂进行晶圆生产和封装测试	IC 设计企业、科研院所、电子产品系统厂商等	客户提供设计需求,由公司完成集成电路设计工作并交付设计成果	不同项目间业务周期差距较大。影响业务周期的因素包括:客户指定的工艺制程、DRC 规则的复杂程度、电路的复杂程度等	公司根据客户需要完成相关设计服务,并将技术服务成果交付客户
	IP 授权	公司根据市场需求及自身技术优势,自主研发了适用于若干领域的 IP;相关技术具备已验证、可复用、特定功能性等特点,有助于提升设计效率;可用于自主设计环节,亦可直接授权客户设计开发使用。同时,公司也为客户提供 IP 定制开发服务	IC 设计企业、科研院所等	公司自研的 IP 产品匹配客户集成电路研发过程中的需求后,客户向公司采购 IP 产品。同时,公司也为客户提供 IP 定制开发服务	以销售公司自研的 IP 产品为主,业务周期一般较短	公司对外授权 IC 设计数据模块,该等数据已经验证,可直接交付客户或代工厂使用
	自有芯片销售	公司自研芯片主要以工业类芯片为主,分为工业总线	电子产品系统厂商等	系统厂商在整机设计过程中需外购芯片,	由客户采购的产品数量、上游晶	公司在完成自有芯片产品的自主研发后,在

		芯片、数字信号处理器芯片、以太网物理层芯片等		经过比较，向公司购买芯片产品	圆代工、晶圆测试和芯片封装的产能和工期情况决定	获取客户批量订单后，委托晶圆代工厂、封测厂等完成晶圆制造以及封装测试环节后，向客户销售成品芯片
	量产服务	公司根据客户的需求，依据公司为客户提供的整包设计服务成果或者客户设计提供的版图或者样片，为其提供量产服务，并向其交付合格的晶圆或者芯片产品。	IC 设计企业、科研院所、电子产品系统厂商等	公司根据客户的需求，依据公司为客户提供的整包设计服务成果或者客户设计提供的版图或者样片，为其提供量产服务，并向其交付合格的晶圆或者芯片产品		公司在委托晶圆代工厂、封测厂等完成晶圆制造以及封装测试环节后，向客户交付成品芯片。
EDA 软件授权业务	EDA 软件授权	公司的主要商业模式为以自有 EDA 软件为核心工具，开展 IC 分析、知识产权和资讯、IC 设计等业务，亦可直接授权客户使用。	IC 设计企业、科研院所等	有自主开展 IC 分析或设计需求的客户在工作中有使用公司 EDA 软件的需求，向公司购买 EDA 软件	销售公司自主研发的 EDA 产品，业务周期一般较短	一般由销售团队评估客户需求，以软件直接授权或与其他技术服务捆绑销售的方式，将软件及相关授权文件（License）交付客户使用；具体授权方式包括按项目授权及按周期授权等

二、 内部组织结构及业务流程

（一） 内部组织结构



公司各主要职能部门的职责情况如下：

部门名称	主要职责
内审部	对公司及其子公司进行内部审计，完成董事会审计委员会指派的审计项目，监督财务计划及计划执行情况，监督财务制度的执行情况等。
财务部	负责制定公司财务管理制度，组织编制公司财务预算，检查、监督和分析预算执行情况；负责公司会计核算、会计监督；负责建立健全内部控制制度；负责公司筹融资和资金收支管理工作；管理纳税事项等。
人力行政部	负责公司日常行政接待工作；负责草拟公司行政公文；负责公司行政印鉴管理工作；负责办理公司各种业务招待活动；负责公司整体人力资源计划；负责招聘与选拔、员工培训与发展、激励与考核、薪资与福利、员工关系、职业生涯规划等工作。
合规运营部	负责规范的建立与维护；负责员工培训与考核；负责项目安排与调度；负责项目实施质量监督与控制；负责知识产权风险合规审批。
销售部	负责客户开发、维护；负责合同签订、管理、进度跟踪及问题处理；负责售后沟通与账款催收。
EDA研发部	负责公司 EDA 软件产品、专用数据库管理系统、IC 分析和设计相关核心算法、IC 分析和设计的自动化解决方案等研发。
产品研发部	负责 IP 和芯片产品的设计开发工作，并承担相关共性技术的研究开发工作。
工艺分析部	负责产品解剖和去层；并运用刻蚀机与电子显微镜等设备对集成电路进行微处理加工观察；使用本公司图像处理软件对大规模图像进行统一整理和修复进而创建出图像工程数据库。
技术分析部	负责内部电路提取、电路整理分析和版图设计。
专利分析部	负责专利查找、检索；负责专利鉴定、分析；负责专利撰写；负责其他专利服务。
保定分公司	负责承担大型电路分析项目的实施工作；负责承担数字电路为主的集成电路设计服务项目，承担设计服务相关的共性技术研究开发；负责承担集成电路分析项目、设计服务项目相关的应用程序开发。

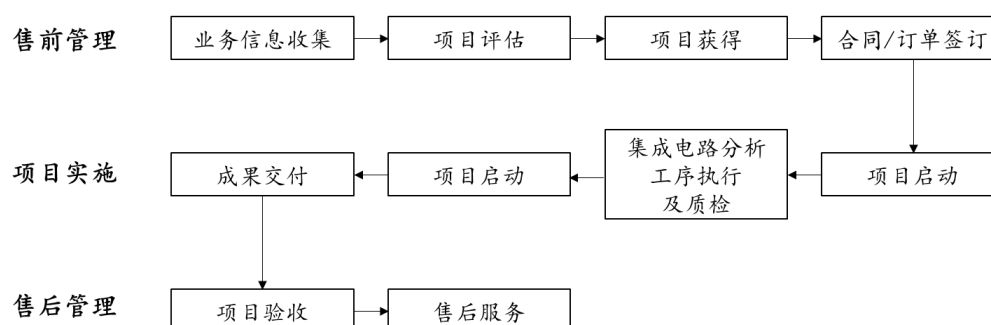
证券部	负责公司股权事务的管理；负责履行投资者关系管理及信息披露工作；负责处理公司董事会日常事务等。
-----	--

（二）主要业务流程

1、流程图

（1）IC 分析业务

IC 分析业务整体业务流程如下：



如上图所示，业务流程分为售前管理、项目实施、售后管理三个阶段，主要包括项目评估、合同/订单签订、工序执行及质检、项目交付及验收等环节。上述业务流程亦适用于知识产权和资讯业务、设计服务等技术服务类业务。

具体情况如下：

业务流程	工作内容
业务信息收集	公司销售人员收集、跟踪客户需求信息；与其达成初步合作意向后，获得拟分析的目标芯片（Sample，样品或样片，即开展分析的第三方目标芯片）、芯片说明书（Datasheet）等资料，并登记管理客户信息。
项目评估	公司销售人员启动项目评估程序，协同业务团队、合规运营部等，共同对目标芯片的封装技术、管芯工艺等进行技术评估，对工作量/工期、实施流程等进行方案评估，形成方案整体的费用评估，并结合客户具体要求，编写项目评估材料。
项目获得	公司销售人员向客户提交项目报价文件，就项目内容、报价、工期、结算等信息进行协商确认，随后签订合同/订单、正式启动项目。
项目执行	项目执行部门根据项目分配结果开展项目执行工作，合规运营部在每个任务完成后进行首次质量检查。各工序执行完毕后，由销售人员对客户信用风险、结算情况进行审查；由合规运营部对分析成果进行内部验收和安全检查，最终达到可交付状态。
项目交付	通过内部验收确认的成果，一般以 FTP 专线发送、存储介质寄送等方式进行交付。
售后管理和服 务	公司专人收集交付完成信息后，及时向销售人员反馈；由销售人员督促、协助客户进行项目验收，形成验收单据；此后项目完成，并转入质保期。在质保期内，公司为客户提供免费的售后服务。

（2）知识产权和资讯业务

知识产权和资讯业务包括知识产权服务、产品资讯、图像资讯。

关于知识产权服务，在项目执行阶段，涉及的芯片解剖、图像处理等工作由工艺分析人员完成，

得到图像数据后涉及的电路整理、版图分析工作由知识产权分析人员完成，并由知识产权分析人员对专利或布图设计权资料进行阅读、研究，并对相应权利要求进行分解，提炼权利要求技术特征。同时，结合目标产品技术特征，进行技术特征要点比对和一致性分析，最终形成分析报告。

关于产品资讯，客户可通过集成电路大数据平台网站和公众号浏览集成电路数据库包含的报告及数据信息介绍，根据自身学习和研究需求，与公司销售部联系。公司销售部根据客户需要的报告内容范围给出报价，就价格进行协商确认，双方签订合同/订单，并向客户交付所需的数据或报告，包括竞争力分析、概要资讯、显微图像资讯、电路分析报告等成果。

关于图像资讯，公司对 IC 产品进行封装解剖、层次去除等步骤后，经 EDA 软件完成显微图像自动采集、海量图像自动拼接对准后，形成显微图像数据库并交付客户。

(3) IC 设计业务

IC 设计业务包括设计服务、IP 授权、自有芯片销售、量产服务。

设计服务包括后端设计服务、设计验证服务以及整包设计服务。关于后端设计服务和设计验证服务，公司完成项目执行后，向客户交付版图数据或仿真验证的过程文件和报告。对于整包设计服务，其业务流程包括：需求信息收集、项目预研及风险评价、项目评估、协议签订、项目分配及执行、知识产权合规等相关内控环节验证、质量控制及内部验收、成果交付等。

关于 IP 授权，业务流程主要包括需求信息收集、授权协议签订、成果交付及售后服务等。

关于自有芯片销售和量产服务，公司在委托晶圆代工厂、封测厂等完成晶圆制造以及封装测试环节后，向客户交付成品芯片。业务流程主要包括项目风险审核、订单签订、委外代工、产品交付及售后服务等。

(4) EDA 软件授权

关于 EDA 软件授权，业务流程主要包括需求信息收集、授权协议签订、成果交付及售后服务等。

2、 外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）具体内容	单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重				是否专门或主要为公司服务	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2024 年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2023 年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
1	上海华虹宏力半导体制造有限公司	无关联关系	晶圆、中测和成测等	361.41	39.42%	426.23	45.12%	否	否
2	苏州高邦半导体科技有限公司	无关联关系	封装等	193.48	21.10%	243.19	25.74%	否	否
3	苏州久元微电子有限公司	无关联关系	晶圆、中测和成测及封装等	56.76	6.19%	32.28	3.42%	否	否
4	北京慧创智芯电子技术有限公司	无关联关系	晶圆等	56.76	6.19%	-	-	否	否
5	广州捷嘉高科技有限公司	无关联关系	晶圆等	51.44	5.61%	72.57	7.68%	否	否
6	无锡华润上华科技有限公司	无关联关系	晶圆等	45.78	4.99%	56.31	5.96%	否	否
7	闵康技术检测（上海）有限公司	无关联关系	外协技术服务	24.68	2.69%	36.13	3.82%	否	否
合计	-	-	-	790.32	86.20%	866.71	91.74%	-	-

注：上述列示报告期各期前五大委外加工厂商

具体情况说明

公司的芯片产品由专业的晶圆厂商、封装测试厂商等完成晶圆加工及测试、芯片封装及测试，属于行业内的常用方式。

3、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	纳米级集成电路工艺处理技术	- 该技术分为横向“层次去除”技术和纵向“纵切分析”技术。技术内涵包括一系列操作方法及流程、控制条件、试剂配方等。 - 具体而言，层次去除技术能够满足3纳米工艺、20层金属布线的IC去层分析处理需求；可完成Si、GaAs、GaN、SiC等多种材质半导体去层分析。纵切分析能够完成定点和非定点的电子显微镜样片制备和分析；可完成各类芯片的结构、成分和晶格取向分析。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
2	显微图像自动采集技术	- 该技术用于显微镜自动采集超大规模集成电路高清图像，相关功能在Filmshop软件中实现。 - 具体而言，公司建立了显微图像自动采集的通用框架，适用于各种常见类型的光学显微镜和电子显微镜，从而降低了对硬件设备的依赖性；同时，建立了大规模显微图像全自动采集能力，单个项目图像规模达到4TB。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
3	超大规模显微图像处理技术	- 该技术针对原始显微图像数据的处理，主要进行纠偏、拼接、对准等步骤后，形成完整的集成电路全景图像，相关功能在Filmshop和PanovasPro软件中实现。 - 具体而言，公司开发了自动化同层图像的拼接算法，可实现4亿门级集成电路图像的无缝衔接，拼接误差控制在1/2最小线宽范围内；开发了4TB量级集成电路图像合成处理技术，能够将1000万张数量级的采集图像文件合成IC全景图像；该技术实现了图像（桶状/枕状/复合）变形纠正、倾角校正及调整，可精确还原IC内部细节特征。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
4	纳米级集成电路图像自动识别技	该技术针对集成电路全景图像，可识别出引线、孔、多晶等	自主研发	已完成阶段性目标，技术已	是

	术	基本版图结构,显著提高了集成电路分析效率和自动化程度,相关功能在 CatalysisSeries 软件中实现。 • 具体而言,该技术建立了引线/孔/多晶等不同版图结构的特征模型,通过模式识别和深度学习算法,能够自动准确的识别出 3 纳米集成电路的基本元素;还可对各种图像缺陷建立纠错模型,快速自动定位高可疑的识别结果,提高识别准确率。该技术有效适用大规模标准数字电路分析工序,人工绘制、线孔查找工作量可显著降低。		在项目中使用	
5	纳米级集成电路高精度网表提取技术	• 该技术可以根据显微图像提取出网表 (Netlist), 获得集成电路内部元件之间的互连关系,相关功能在 ChipLogicFamily 和 HieruxSystem 软件中实现。 • 具体而言,该技术支持 4 亿门级网表的提取,实现了网表到平面电路图的高速转换;公司针对数字电路和模拟电路的特点,建立了 30 余种错误模型,可有效解决网表提取准确性问题。该技术有效适用于含大规模标准单元的电路提取及分析,具体通过 LRC 技术 (自动连线技术), 实现线网和单元的自动连接,避免人工操作的低效易错情形;可进行模块数据间的衔接处理,通过使用多边形相切的划分方式,实现网表自动衔接,提升分析效率;还可通过宏单元制作、引用及复用,实现网表提取的模块复用,大幅缩减项目工作量、避免同一模块不同分析结果等问题,是降低人工工作量及项目成本的有效工具。	自主研发	已完成阶段性目标,技术已在项目中使用	是
6	纳米级集成电路功能分析技术	• 该技术针对数字电路网表进行功能分析,整理成层次清晰、逻辑功能明确的电路结构,相关功能在 HieruxDesigner、BoolSmartResolver 和 BoolSmartCatalyzer 软件中实现。 • 具体而言,该技术可根据网表连接关系自动生成高可读性的数字电路图,最大支持 2,000 万门级的数字电路分析;通过关键信号跟踪,可自动识别寄存器、	自主研发	已完成阶段性目标,技术已在项目中使用	是

		计数器等功能模块。该技术有效适用于电路图化简工序，通过去除逻辑等价电路、缓冲电路，一方面降低电路整理规模及相关工作量，另一方面实现分析成果的清晰易懂，提升整体分析效率、优化技术服务成果；还可通过宏单元制作、引用及复用，实现平面电路整理的模块复用。			
7	面向专利侵权取证的电路图版面优化技术	- 针对专利取证对高品质纸质报告的需求，该技术可自动生成高品质 PDF 格式的专利分析报告，相关功能在 HieruxPublisher 和 HieruxReporter 软件中实现。 - 具体而言，该技术可自动将电路图和符号图无损矢量化为 PDF 文档；提供电路图版面检查，纠正图元重叠和不一致问题；针对专利图示需求，可实现动态简洁化的符号图库；提供信号在层次化电路中的交叉定位、自动生成信号引用表，实现自适应的图元缩放。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
8	集成电路布图设计相似度比较技术	- 该技术用于比较两个布图设计的相似程度，相关功能在 HieruxComparator 软件中实现。 - 具体而言，公司建立了可应用于司法鉴定实践的布图设计一致性比对模型，开发了一致性比对软件。该软件是高效的布图结构计算引擎，已成为业界布图设计侵权鉴定的标准工具。其集成了 IC 专利匹配查询技术，具备精准解析和机器学习能力，显著提升分析效率及效果。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
9	基于 EDA 软件的应用级开发技术	- 该技术针对项目特点，可进行自动化、批量化的软件开发，实现快速定制开发、部署应用、迭代优化，降低设计服务人工成本，相关功能在 HieruxTicker 软件中实现。 - 具体而言，该技术建立了可复用的二次开发标准程序库，实现了通用图形界面框架，定义了界面描述语言；同时实现了应用程序在 HieruxSystem 中嵌入或者后台批处理运行。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
10	纳米级工艺定制版图设计技术	该技术针对定制类版图设计需求，通过对设计环境的扩展，可显著提升版图设计效率、规范性和一致性。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是

		• 具体而言，该技术支持 16 纳米级工艺的定制版图设计能力；具备参数化单元和动态复合图形开发能力，具备各种商用参数化单元的开发能力。该技术有效适用于大规模定制版图的绘制，主要通过系统化 API 接口，利用 Tcl 语言进行功能模块开发，提升设计效率和效果。			
11	集成电路安全可信设计技术	• 该技术包含了一系列面向 IC 安全可信设计研发成果的积累，可满足金融、通信、国防等领域的集成电路设计需求。 • 具体而言，该技术通过增加电路级和版图级保护措施，提高了电路破解难度，可有效保护非易失存储器中固件；通过自主设计的安全协处理器和小容量安全存储器，可提高数据总线和固件加密的安全性。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
12	面向工业物联网的传感和控制器 IP 技术	• 该技术主要用于抗电磁干扰的低成本电容式编码器 IC，支持 4 自由度运动控制器。 • 具体而言，该技术提出了调相及调幅相结合的数字式电容极板位置检测方法，显著降低了实现成本和 IC 功耗；可实现线性及 S-曲线的加减速、多轴差值等运动控制技术。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
13	高适应性通用基础 IP 技术	• 该技术针对设计服务共有需求，开发了可复用的一系列基础 IP，包括标准接口、输入/出单元、数模转换器、电压调整模块等；可用于“一站式 IC 定制”解决方案，显著降低研发周期及成本，提高流片成功率；相关功能在 TauruxIP 系列产品中实现。 • 具体而言，该技术支持 USB2.0FullSpeed 技术规范，具备可自校准的逐次逼近型 12 位模拟数字转换器，以及宽温度测量范围（-40~125°C）模数转换器，可耐受 1.5/3.3/5V 电压，具备漏电补偿的 GPIO 和 ESD 模块。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
14	基于 FPGA 的 IP 和集成电路产品验证技术	• 该技术通过建立 FPGA 验证平台，降低 IP 和 IC 产品的设计验证难度，加快产品开发进度。 • 具体而言，该技术在对外模拟 IP 功能、性能分析的基础上，采用外部模拟 IC 来替换模拟 IP，	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是

		并在 FPGA 中实现补偿和转换接口；可构建数模混合集成电路的通用 FPGA 验证平台，提高验证平台的可复用性。			
15	4TB 级专用数据库引擎技术（HDB）	• 该技术是 ChipLogicFamily、HieruxSystem、BoolSmartSystem、DesignSmartSystem 等产品系列的底层数据库管理引擎，支持 IC 分析及设计的各种工作流程。 • 具体而言，该技术实现了“数据库-单元库-单元-视图”四级通用数据模型；最大支持 4TB 量级的图像数据；支持图像/电路图/符号图/版图/标注视图/物理视图等多种数据类型；对各种类型的设计数据提供统一的访问接口；支持 C/C++、Python 和 Tcl 语言的程序接口；支持快速基于位置的图元访问接口，可以 O（logn）的计算复杂度提取某一个矩形区域的指定类型图元。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
16	数字单元功能识别和验证技术	• 该技术提供了数字单元结构图形到晶体管级电路图的自动转换，并进一步通过电路结构分析自动判断其逻辑功能。相关功能在 Recognizer 软件中实现。 • 具体而言，该技术通过有源区/多晶硅/金属布线等结构图形，自动构造出 MOS 晶体管级电路图；通过自动分析 MOS 晶体管的互联模式，自动判断其逻辑功能。对已有的两个数字单元，还可以验证其功能一致性。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
17	设计数据交换技术	• 该技术实现了 HDB 专用数据库与标准格式之间的数据交换；相关功能在 DesignSmartSystem 和 BoolSmartSystem 软件中实现。 • 具体而言，该技术支持 OpenAccess、Verilog、EDIF200、GDSII、SPICE、CDL、LEF、DEF 等多种数据格式；可实现不同数据之间命名空间的自动转换，兼容国外主流 EDA 软件。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
18	全定制版图编辑器技术	• 该技术可实现层次化版图设计环境，相关功能在 DesignSmartBuilder 软件中实现。 • 具体而言，该技术可支持最小工艺节点 16 纳米；单元可最多	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是

		包含 10 亿个图元。通过图元索引，可快速显示超大版图。			
19	参数化版图单元技术	- 该技术通过利用 HDB 数据库的 API 函数，通过二次程序开发的方式实现参数化版图单元；通过设置不同的单元参数，软件即可生成无设计规则（DRC）错误的版图单元。相关功能在 DesignSmartBuilder 和 DesignSmartEngine 软件中实现。 - 具体而言，相对其他参数化单元技术，该技术支持可视化编辑，显著提高参数修改效率；可提供动态复合图形，通过在主图形上附加参数实现轻量级复杂版图结构。该技术（HCELL 单元技术）通过标准的定义及参数化，并根据参数批量生成单元，可显著提升单元绘制的工作效率。提供参数化单元的集成开发环境，支持多种商用参数化单元。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
20	数字电路布线优化技术	- 该技术针对数字电路版图，保持电路网表连接关系不变的情况下，实现布线优化；相关功能在 BoolSmartInnovator 软件中实现。 - 具体而言，通过嵌入版图验证引擎（VeriSmartEngine），可实现自动化的设计规则（DRC）错误修复；提供批处理、交互式布线优化算法，可实现局部的点对点之间的布线优化；对大规模数字电路的时钟树和关键信号进行跟踪分析，有效提升时序性能。该技术有效适用于复杂工艺的设计工序，可显著提升版图规则检查效率，节省设计时间。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
21	面向版图验证的多边形处理引擎技术	- 该技术针对版图的设计规则验证需求，提供高效实时的宽度、间距等检查功能；相关功能在 DesignSmartSystem、BoolSmartSystem 和 VeriSmartSystem 软件中实现。 - 具体而言，该技术支持多边形的与/或/非等布尔运算，及扩边/缩边运算，计算复杂度达到 $O(n \log n)$；支持 16 纳米级先进工艺的特殊设计规则；提供 C/C++、Python 及 Tcl 编程接口。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是

22	可编程 Verilog 语法分析引擎技术	• 针对 IEEE1364-2005 标准，通过建立内存语法树的方式，实现通用化语法分析能力，实现 Verilog 语法分析器模块。 • 支持二次应用开发；可应用于行为级和结构级数字电路的优化处理。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
23	数字电路快捷仿真器技术	• 针对局部电路，提供交互式的快捷仿真验证功能。 • 基于图表格式的仿真向量的可视化编辑；相关功能在 BoolSmartVisualizer、BoolSmartObserver 中实现。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
24	硬件描述语言（HDL）的可视化技术	• 根据 HDL 描述的数字电路，自动生成层次化的电路图，并提供电路图编辑能力。 • HDL 代码修改后，通过增量同步技术，最大程度地继承原电路图中的布局、标注等信息，帮助工程师优化数字电路；相关功能在 BoolSmartVisualizer 中实现。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在项目中使用	是
25	实时以太网 IP	自主开发 EtherCAT IP，支持 TCP/IP 和 UDP/IP 等标准协议，可以实现跨平台通信，支持与 PC、云端系统和其他基于 IP 的设备交互；该 IP 具备高实时性，支持微秒级的通信周期，适用于高精度控制场景，通过 EtherCAT 的帧优化技术，实现高效的数据传输，减少通信延迟；该 IP 支持网络冗余配置，提高系统的可靠性和容错能力，同时提供强大的错误检测和诊断功能，便于快速定位和解决问题；该 IP 支持使用标准以太网硬件，降低了设备成本，支持灵活的拓扑结构和高效传输，减少了布线需求，进一步降低了部署成本。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在产品中使用	是
26	100Mbps LVDS 物理层 IP	针对实时以太网进行了优化，支持高达 100Mbps 的传输速率，数据传输延迟极低，通常在纳秒级别，能够满足工业自动化中对实时性和高带宽的需求；使用低压差分信号，功耗较低，适合长时间运行的工业环境，同时，进一步优化了信号传输的稳定性和抗干扰能力；支持线型、星型和树型多种拓扑结构，适应不同的工业应用场景，支持热插拔功能，设备可以在运行状态下添加或移除，无需重启系统；支持冗	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在产品中使用	是

		余设计和强大的错误检测功能，确保系统稳定运行。			
27	ADC 电容阵列自校准设计技术	该技术的主要特点是电容 ADC 校准过程从最低有效位（LSB）开始逐步校准至最高有效位（MSB）。每个电容由固定值的基础电容和可调节的附加电容并联组成，校准过程中通过比较器输出判断电容失配，并调整附加电容值以优化线性度。校准模式与正常转换模式分离，校准后电容值最小化，提升转换速率和功耗效率。校准过程无需额外输入信号，复杂度低，适用于高精度电容阵列型 SARADC。该技术包括一系列的设计流程、设计方法和设计约束等。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在产品中使用	是
28	高精度 PWM 设计技术	该技术主要通过“微步进”的方式对传统 PWM 发生器的一个粗略系统时钟以固定的时间步长精度进行细分，使得 PWM 模块能够精细地定位输出的波形边沿位置。并且该技术能根据温度、电压和过程工艺变化对“微步进精度进行校准。该技术包括一系列的设计流程、设计方法和设计约束等。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在产品中使用	是
29	芯片安全功能架构设计	该技术分为加密算法，加密协议集成，在常规芯片中集成高级加密算法例如 RSAEEOO, AES, Hash 等可以有效防护通讯数据被恶意获取，显著提升芯片的安全等级，全芯片高熵值真随机数电路的植入，确保数据的随机性，通讯过程不能被分析，记录。密钥，用户参数，用户配置，用片程序的安全存储以及控制访问权限的设置，保证用户数据不被泄露，芯片抗侧信道攻击设计，防止芯片被攻击。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在产品中使用	是
30	32 位浮点数字硬件加速器设计技术	基于该技术设计的加速器可以与主 CPU 并行执行实时控制算法，有效地使计算性能加倍。该技术包括一系列的设计流程、设计方法和设计约束等。	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在产品中使用	是
31	三角函数硬件加速器设计技术	基于该技术设计的三角函数硬件加速器可以高效执行控制系统应用中常见的三角和算术运算。它还还为 IEEE-754 单精度浮点运算提供硬件支持，这些运算	自主研发	已完成阶段性目标，技术已在产品中使用	是

		加快了三角数学函数的运算。该技术包括一系列的设计流程、设计方法和设计约束等。			
--	--	--	--	--	--

其他事项披露

☐适用 ☒不适用

（二）主要无形资产

1、域名

☒适用 ☐不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	cellix.com.cn	cellix.com.cn	京 ICP 备 06056325 号-1	2021 年 2 月 2 日	-
2	cellixsoft.com	cellixsoft.com	京 ICP 备 06056325 号-1	2021 年 2 月 2 日	-
3	cellixsoft.com.cn	cellixsoft.com.cn	京 ICP 备 06056325 号-1	2021 年 2 月 2 日	-
4	ipbrain.com.cn	ipbrain.com.cn	京 ICP 备 06056325 号-2	2021 年 6 月 25 日	-
5	funcience.com	funcience.com	京 ICP 备 2022028176 号-1	2022 年 9 月 29 日	-

2、土地使用权

☒适用 ☐不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	津(2023)开发区不动产权第0528511号	工业用地	天津芯愿景	12,586.4	天津市开发区信环西路20号	2015.12.20-2061.5.26	出让	否	工业用地	-

3、软件产品

☒适用 ☐不适用

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
1	集成电路数据服务器软件 ChipLogic Datacenter[简称: ChipLogic Datacenter]V1.0	2002SR2911	-	50 年	受让取得	芯愿景
2	集成电路网表提取系统软件 ChipLogic Analyzer[简称: ChipLogic Analyzer]V1.0	2002SR2912	-	50 年	受让取得	芯愿景
3	图像采集处理系统 Filmshop[简称: Filmshop]V4.0	2003SR12508	2003 年 10 月 15 日	50 年	原始取得	芯愿景
4	集成电路自动化分析再设计系统 ChipLogic Family V4.0[简称: ChipLogic Family]	2003SR12509	2003 年 10 月 15 日	50 年	原始取得	芯愿景

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
5	集成电路分析验证系统 V1.0[简称: Hierux System]	2006SRBJ1143	2006 年 4 月 17 日	50 年	原始取得	芯愿景
6	集成电路芯片电路编辑器软件[简称: Hierux Composer]V1.0	2009SR020724	2007 年 3 月 16 日	50 年	原始取得	芯愿景
7	集成电路芯片电路分析器软件[简称: Hierux Designer]V1.0	2009SR020727	2007 年 12 月 10 日	50 年	原始取得	芯愿景
8	集成电路芯片仿真调试器软件[简称: Hierux Simulator]V1.0	2009SR020732	2007 年 12 月 20 日	50 年	原始取得	芯愿景
9	电子显微镜图像采集软件[简称: Filmshop Scanner]V1.0	2009SR020737	2007 年 12 月 20 日	50 年	原始取得	芯愿景
10	集成电路分析算法软件[简称: Catalysis Series]V1.0	2009SR020721	2008 年 2 月 20 日	50 年	原始取得	芯愿景
11	集成电路版图编辑器软件[简称: Hierux Builder]V1.0	2011SR082748	2010 年 10 月 20 日	50 年	原始取得	芯愿景
12	集成电路数据浏览器软件[简称: Hierux Reporter]V1.0	2011SR082811	2010 年 10 月 20 日	50 年	原始取得	芯愿景
13	集成电路图像浏览器软件[简称: Hierux Browser]V1.0	2011SR082904	2010 年 10 月 20 日	50 年	原始取得	芯愿景
14	ROM 码点提取软件[简称: Memoreader]V1.0	2011SR011891	2010 年 10 月 25 日	50 年	原始取得	芯愿景
15	电子显微镜纵向工艺分析软件[简称: CrossSectionAnalyzer]V1.0	2011SR012027	2010 年 10 月 25 日	50 年	原始取得	芯愿景
16	电子显微镜表面工艺分析软件[简称: SurfaceAnalyzer]V1.0	2011SR012211	2010 年 11 月 2 日	50 年	原始取得	芯愿景
17	芯愿景信息管理系统 DS 子系统[简称: CIMS-DS]1.0	2014SR183660	2012 年 4 月 5 日	50 年	原始取得	芯愿景
18	芯愿景信息管理系统 AS 子系统[简称: CIMS-AS]1.0	2014SR183680	2012 年 4 月 5 日	50 年	原始取得	芯愿景
19	图像处理工具包系统[简称: Filmshop Tools]2.0	2014SR183061	2012 年 4 月 15 日	50 年	原始取得	芯愿景
20	集成电路工程创建系统[简称: Panovas Packager]1.0	2014SR181254	2013 年 2 月 6 日	50 年	原始取得	芯愿景
21	集成电路图像处理软件[简称: Panovas Pro]1.0	2014SR183237	2013 年 2 月 6 日	50 年	原始取得	芯愿景
22	光学图像采集软件[简称: Filmshop Digitizer]1.0	2014SR183136	2013 年 12 月 7 日	50 年	原始取得	芯愿景
23	集成电路 PDF 报告生成软件[简称: Hierux Publisher]1.0	2014SR183051	2014 年 4 月 15 日	50 年	原始取得	芯愿景
24	集成电路单元自动识别软件[简称: Hierux Recognizer]1.0	2014SR183202	2014 年 4 月 20 日	50 年	原始取得	芯愿景
25	集成电路网表编辑软件[简称: Hierux Extractor]1.0	2014SR183300	2014 年 4 月 20 日	50 年	原始取得	芯愿景
26	集成电路应用程序框架软件[简称: Hierux Ticker]V4.0	2020SR0322038	2015 年 8 月 20 日	50 年	原始取得	芯愿景
27	ICIntelligence 集成电路智能分析系统[简称: ICIntelligence System]V1.0	2017SR248400	2017 年 2 月 17 日	50 年	原始取得	芯愿景

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
28	ICIntelligence 集成电路分析器软件[简称: ICIntelligence Analyzer]V2.0	2017SR248594	2017年2月17日	50年	原始取得	芯愿景
29	ICIntelligence 集成电路浏览器软件[简称: ICIntelligence Reader]V2.0	2017SR248620	2017年2月17日	50年	原始取得	芯愿景
30	ICIntelligence 数据服务器软件[简称: ICIntelligence Server]V1.0	2017SR248953	2017年2月17日	50年	原始取得	芯愿景
31	版图一致性验证工具软件[简称: LayoutMatcher]V1.0	2018SR376430	2018年3月15日	50年	原始取得	芯愿景
32	IPsense 系统[简称: IPsense]V1.0	2018SR418465	2018年4月4日	50年	原始取得	芯愿景
33	芯愿景信息管理系统EN子系统[简称: CIMS-EN]V1.0	2018SR418470	2018年4月20日	50年	原始取得	芯愿景
34	数字电路分析简化工具软件[简称: BoolSmart Catalyzer]V1.0	2018SR418539	2018年4月20日	50年	原始取得	芯愿景
35	模拟版图规则检查软件[简称: Analog LRC]V1.0	2018SR418548	2018年4月20日	50年	原始取得	芯愿景
36	版图一致性比对工具软件[简称: LayoutVerifier]V1.0	2018SR638272	2018年6月8日	50年	原始取得	芯愿景
37	有源金属屏蔽层布线软件[简称: AndromexShielder]V1.3	2018SR744733	2018年7月27日	50年	原始取得	芯愿景
38	纳米级集成电路布线软件[简称: BoolSmart Innovator]V1.0	2019SR1131933	2019年6月20日	50年	原始取得	芯愿景
39	安全加密协处理器系统[简称: SX570]V1.0	2020SR0411167	2019年6月30日	50年	原始取得	芯愿景
40	存储和总线加密器系统[简称: SX206]V1.0	2020SR0413832	2019年6月30日	50年	原始取得	芯愿景
41	高安全性保护系统[简称: SX530]V1.0	2020SR0414127	2019年6月30日	50年	原始取得	芯愿景
42	PCI-Express 接口控制器 IP 核软件[简称: PCIExpress Controller]V1.0	2022SR0547064	2019年6月30日	50年	原始取得	芯愿景
43	集成电路自动布线算法引擎软件[简称: Innova Router]V1.0	2020SR0039952	2019年8月20日	50年	原始取得	芯愿景
44	集成电路实时规则检查引擎软件[简称: Innova Checker]V1.0	2020SR0071516	2019年8月20日	50年	原始取得	芯愿景
45	数字集成电路解析软件[简称: BoolSmart Resolver]V3.0	2020SR0322042	2019年10月6日	50年	原始取得	芯愿景
46	集成电路设计优化系统[简称: BoolSmart System]V3.0	2020SR0322099	2019年10月6日	50年	原始取得	芯愿景
47	数据同步服务器软件[简称: BoolSmart Server]V3.0	2020SR0369376	2019年10月6日	50年	原始取得	芯愿景
48	数字电路设计增强软件[简称: BoolSmart Inspector]V1.0	2020SR0322091	2019年10月15日	50年	原始取得	芯愿景
49	数字电路时钟树优化软件[简称: BoolSmart Clocker]V1.0	2020SR0322095	2019年10月15日	50年	原始取得	芯愿景

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
50	版图一致性分析工具软件[简称: LayoutPatcher]V1.0	2021SR0112294	2020年9月30日	50年	原始取得	芯愿景
51	数字电路可视化调试软件[简称: BoolSmart Visualizer]V1.0	2021SR0372568	2020年12月10日	50年	原始取得	芯愿景
52	版图设计软件[简称: DesignSmart Builder]V1.0	2021SR0372569	2020年12月10日	50年	原始取得	芯愿景
53	电路图设计软件[简称: DesignSmart Composer]V1.0	2021SR0424760	2020年12月10日	50年	原始取得	芯愿景
54	应用程序界面生成软件[简称: VeriSmart Ticker]V1.0	2021SR0815187	2021年4月16日	50年	原始取得	芯愿景
55	版图实时处理验证引擎软件[简称: VeriSmart Engine]V1.0	2021SR0815253	2021年4月21日	50年	原始取得	芯愿景
56	应用程序基础框架软件[简称: VeriSmart Foundation]V1.0	2021SR1960608	2021年7月13日	50年	原始取得	芯愿景
57	IP 大数据平台设计系统[简称: IPBrain Design System]V1.0	2021SR1560213	2021年8月31日	50年	原始取得	芯愿景
58	参数单元开发软件[简称: DesignSmart Engineer]V1.0	2022SR1049490	2022年2月23日	50年	原始取得	芯愿景
59	通用图形交互界面框架软件[简称: Hierux Quotation]V1.0	2022SR1425995	2022年3月21日	50年	原始取得	芯愿景
60	集成图像识别软件[简称: Katalysis Processor]V1.0	2022SR1425994	2022年6月10日	50年	原始取得	芯愿景
61	模拟电路提取软件[简称: Hierux Analoger]V1.0	2022SR1425972	2022年7月11日	50年	原始取得	芯愿景
62	模拟电路分析软件[简称: Hierux Arranger]V1.0	2022SR1490083	2022年8月3日	50年	原始取得	芯愿景
63	虚拟参数化单元接口软件[简称: VCL API]V1.0	2023SR0622603	2023年1月12日	50年	原始取得	芯愿景
64	集成电路 IP 模块分析工具软件[简称: IPDetector]V1.0	2023SR0622604	2023年2月28日	50年	原始取得	芯愿景
65	数据浏览软件[简称: DesignSmart Explorer lnx64]V8.0	2024SR0665251	2023年3月17日	50年	原始取得	芯愿景
66	参数化版图单元框架软件[简称: VCL Foundation]V1.0	2023SR0622605	2023年4月4日	50年	原始取得	芯愿景
67	数字电路可视化调试软件[简称: Boolsmart Visualizer lnx64]V8.0	2024SR0727837	2023年6月12日	50年	原始取得	芯愿景
68	逻辑功能验证器软件[简称: Hierux Verifier]V8.0	2024SR0726440	2023年8月8日	50年	原始取得	芯愿景
69	波形分析软件[简称: Boolsmart Observer lnx64]V8.0	2024SR1043629	2024年4月19日	50年	原始取得	芯愿景
70	数字电路仿真调试软件[简称: Boolsmart Debugger lnx64]V1.0	2025SR0525271	2025年3月26日	50年	原始取得	芯愿景
71	数字电路自动布局布线软件[简称: ICDigitalGenerator]V1.0	2012SR017773	2011年4月20日	50年	原始取得	天津芯愿景
72	模拟电路自动布局布线软件[简称: ICAnalogGenerator]V1.0	2012SR018387	2011年4月20日	50年	原始取得	天津芯愿景

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
73	集成电路线路阅读器软件[简称: ICCircuitViewer]V1.0	2012SR017775	2011年10月16日	50年	原始取得	天津芯愿景
74	集成电路版图阅读器软件[简称: ICLayoutViewer]V1.0	2012SR017772	2011年10月20日	50年	原始取得	天津芯愿景
75	集成电路设计阅读器软件[简称: ICDesignViewer]V1.0	2012SR017774	2011年10月20日	50年	原始取得	天津芯愿景
76	海量集成电路图像采集和处理系统[简称: PANOVA]V1.0	2014SR004271	2012年12月10日	50年	原始取得	天津芯愿景
77	纳米级集成电路分析 EDA 系统[简称: ICWORKS]V1.0	2014SR003893	2012年12月18日	50年	原始取得	天津芯愿景
78	企业财务销售信息管理系统[简称: EASIMS]V1.0	2015SR235072	2015年9月30日	50年	原始取得	天津芯愿景
79	企业工程信息管理系统[简称: EEIMS]V1.0	2015SR235709	2015年9月30日	50年	原始取得	天津芯愿景
80	IP 数据管理软件[简称: IpPocket Manager]V1.0	2021SR1208391	2021年5月18日	50年	原始取得	天津芯愿景
81	解析脚本生成对话框软件[简称: IpPocket CommonDialog]V1.0	2021SR1205175	2021年5月20日	50年	原始取得	天津芯愿景
82	基于 SiliconSmart 修改 liberty 文件的脚本软件[简称: IpPocket LibertyAPI]V1.0	2021SR1762000	2021年9月24日	50年	原始取得	天津芯愿景
83	数字图形规则检查工具软件[简称: Digital LRC]V1.0	2022SR0494765	2022年2月22日	50年	原始取得	太原芯愿景
84	模拟器件参数工具软件[简称: ATACparameter]V1.0	2022SR1426111	2022年2月22日	50年	原始取得	太原芯愿景
85	电路图端口处理软件[简称: SCport]V1.0	2022SR1426112	2022年2月22日	50年	原始取得	太原芯愿景
86	版图等宽线处理软件[简称: Ltpath]V1.0	2022SR1490084	2022年2月22日	50年	原始取得	太原芯愿景
87	版图接触孔处理软件[简称: LTvia]V1.0	2022SR1490085	2022年2月22日	50年	原始取得	太原芯愿景
88	版图线孔处理软件[简称: LTpath&via]V1.0	2022SR1490086	2022年2月22日	50年	原始取得	太原芯愿景
89	版图标号文本工具软件[简称: LTtext]V1.0	2022SR1490087	2022年2月22日	50年	原始取得	太原芯愿景

4、账面无形资产情况

√适用 □不适用

序号	无形资产类别	原始金额（万元）	账面价值（万元）	使用情况	取得方式
1	土地使用权	583.38	425.87	正在使用中	购入
2	办公软件	20.50	1.16	正在使用中	购入
3	非专利技术	181.50	-	正在使用中	购入
4	专利技术	19.43	9.65	正在使用中	购入

序号	无形资产类别	原始金额（万元）	账面价值（万元）	使用情况	取得方式
	合计	804.81	436.68	-	-

5、其他事项披露

√适用 □不适用

截至公开转让说明书签署日，公司已取得的集成电路布图设计专有权如下：

序号	布图设计名称	登记号	权利人	申请日	取得方式
1	CX19SA	BS.085006521	芯愿景	2008-12-05	原始取得
2	安全非易失小容量存储器 SIP1040	BS.175527857	芯愿景	2017-06-08	原始取得
3	数模混合 C1406101	BS.175536317	芯愿景	2017-11-02	原始取得
4	数模混合 C1504201	BS.175536325	芯愿景	2017-11-02	原始取得
5	数模混合 C1611170	BS.175536333	芯愿景	2017-11-02	原始取得
6	数模混合 C1611230	BS.17553635X	芯愿景	2017-11-02	原始取得
7	OSC_8M_HJ11 可精确修调至 8MHz 的振荡器	BS.185557244	芯愿景	2018-06-15	原始取得
8	P_GPIO_LH_HL_FT_HJ11	BS.185557287	芯愿景	2018-06-15	原始取得
9	OSC_40K_HJ11（40KHz 振荡器）	BS.185557252	芯愿景	2018-06-15	原始取得
10	P_GPIO_LH_HL_HJ11	BS.185557295	芯愿景	2018-06-15	原始取得
11	EM645_HJ35 高性能 4 轴运动控制协处理器	BS.185557236	芯愿景	2018-06-15	原始取得
12	P_V33_HJ11	BS.185557309	芯愿景	2018-06-15	原始取得
13	P_ESD_FT_GLOBAL_HJ11	BS.185557260	芯愿景	2018-06-15	原始取得
14	ADC_12B_MUX19_HJ11 可自校准模拟数字转换器	BS.185557228	芯愿景	2018-06-15	原始取得
15	P_GPIO_LH_HL_32K_HJ11	BS.185557279	芯愿景	2018-06-15	原始取得
16	REGULATOR_SENSE_DRV_HJ11	BS.185557481	芯愿景	2018-06-20	原始取得
17	USB_PHY_HJ11	BS.185557503	芯愿景	2018-06-20	原始取得
18	XTAL_32K_HJ11	BS.185557538	芯愿景	2018-06-20	原始取得
19	XTAL_4_16M_HJ11	BS.18555752X	芯愿景	2018-06-20	原始取得
20	POWER_DET_V33_HJ11	BS.185557457	芯愿景	2018-06-20	原始取得
21	PLL_HJ11	BS.185557449	芯愿景	2018-06-20	原始取得

22	POWER_SWITCH_HJ11	BS.185557473	芯愿景	2018-06-20	原始取得
23	TEMP_SENSOR_1C_HJ11	BS.18555749X	芯愿景	2018-06-20	原始取得
24	DAC_12B（高精度数模转换器）	BS.205530214	芯愿景	2020-05-12	原始取得
25	ETX100（以太网总线模块）	BS.205530249	芯愿景	2020-05-12	原始取得
26	DAC_12B_407（高精度数模转换器）	BS.205530222	芯愿景	2020-05-12	原始取得
27	DAC_12B_103（高精度数模转换器）	BS.205543332	芯愿景	2020-06-16	原始取得
28	PLL_103（倍频锁相环）	BS.205543537	芯愿景	2020-06-16	原始取得
29	POR_PDR_REFCOARSE（电源复位信号和基准电压产生模块）	BS.205543545	芯愿景	2020-06-16	原始取得
30	OSC_65K_4M（65kHz~4MHz 阻容振荡器）	BS.20554343X	芯愿景	2020-06-16	原始取得
31	CLOCK_DET（时钟频率检测电路）	BS.205543294	芯愿景	2020-06-16	原始取得
32	REGULATOR_SENSE_DRV_GCAP（电压调整器驱动电路）	BS.20554360X	芯愿景	2020-06-16	原始取得
33	OSC_8M（8MHz 阻容振荡器）	BS.205543340	芯愿景	2020-06-16	原始取得
34	OSC_40K（40kHz 阻容振荡器）	BS.205543405	芯愿景	2020-06-16	原始取得
35	PLL（倍频锁相环）	BS.205543510	芯愿景	2020-06-16	原始取得
36	RANDOM_PULSE_GEN_X3（随机方波生成模块）	BS.205543685	芯愿景	2020-06-16	原始取得
37	TEST_GATING_BUF（门控电路）	BS.205543626	芯愿景	2020-06-16	原始取得
38	TEST_GATING（门控电路）	BS.205543618	芯愿景	2020-06-16	原始取得
39	REGULATOR_SENSE_DRV（电压调整器驱动电路）	BS.205543588	芯愿景	2020-06-16	原始取得
40	OSC_37K（37kHz 阻容振荡器）	BS.205543367	芯愿景	2020-06-16	原始取得
41	DAC_12B（高精度数模转换器）	BS.205543324	芯愿景	2020-06-16	原始取得
42	REG_VBKPCORE_VCORE_v2（电压调整器）	BS.205543499	芯愿景	2020-06-16	原始取得
43	POWER_DET_COMPX2（电源控制电路和比较器模块）	BS.20554357X	芯愿景	2020-06-16	原始取得
44	OSC_16M（16MHz 阻容振荡器）	BS.205543359	芯愿景	2020-06-16	原始取得
45	PG_HEAD_FLS（电源开关电路）	BS.205543502	芯愿景	2020-06-16	原始取得
46	POWER_DET_V33（复位和电源控制电路）	BS.205543693	芯愿景	2020-06-16	原始取得
47	POWER_DET_407（复位和电源控制电路）	BS.205543561	芯愿景	2020-06-16	原始取得
48	PGA_AMP（高性能自归零可编程仪表放大器）	BS.205590233	芯愿景	2020-10-26	原始取得

49	GAIN_DAC (增益精调数模转换器)	BS.205590217	芯愿景	2020-10-26	原始取得
50	CNC117 (4mA~20mA 线性电流环)	BS.205590195	芯愿景	2020-10-26	原始取得
51	CEX200 (工业以太网协议处理器)	BS.205602002	芯愿景	2020-11-16	原始取得
52	XTAL_32K_072 (32k 频率晶体振荡器)	BS.215622324	芯愿景	2021-09-23	原始取得
53	OSC_48M (48MHz 阻容振荡器)	BS.215624661	芯愿景	2021-09-26	原始取得
54	OSC_8M_051 (8MHz 阻容振荡器)	BS.215624424	芯愿景	2021-09-26	原始取得
55	OSC_8M_103_V3 (8MHz 阻容振荡器)	BS.215624513	芯愿景	2021-09-26	原始取得
56	P_INPUT_FT (耐 5V 的信号输入端口电路)	BS.21562498X	芯愿景	2021-09-26	原始取得
57	PAD_VDDA (模拟电源端口静电泄放电路)	BS.215624475	芯愿景	2021-09-26	原始取得
58	PAD_GPI_E33_FT_ANF_HH (带滤波模块的耐 5V 高压端口高压内核通用输入电路)	BS.215624300	芯愿景	2021-09-26	原始取得
59	P_ESD_FT_GLOBAL (全局耐 5V 静电泄放电路)	BS.215624777	芯愿景	2021-09-26	原始取得
60	USB_PHY_RO8_VX1P7 (通用串行接口物理层)	BS.215624866	芯愿景	2021-09-26	原始取得
61	P_GPIO_LH_HL (低压端口与高压内核的通用输入输出端口)	BS.215624874	芯愿景	2021-09-26	原始取得
62	XTAL_4_16M_V2 (4~16M 频率晶体振荡器)	BS.215624882	芯愿景	2021-09-26	原始取得
63	PAD_GPIO_E33_TTA_TSC_HH_V2 (高压端口高压内核带触控模块的通用输入输出电路_V2)	BS.215624459	芯愿景	2021-09-26	原始取得
64	P_NRST (重置信号触发电路)	BS.215624998	芯愿景	2021-09-26	原始取得
65	P_GPIO_LH_HL_32K_V2 (晶振专用高低电平转换输入输出端口电路)	BS.215624939	芯愿景	2021-09-26	原始取得
66	ADC (模数转换电路)	BS.21562436X	芯愿景	2021-09-26	原始取得
67	TEMP_SENSOR (温度传感器)	BS.215624653	芯愿景	2021-09-26	原始取得
68	XTAL_4_32M_V2 (4~32M 频率晶体振荡器)	BS.215624912	芯愿景	2021-09-26	原始取得
69	P_V33 (3.3V 电源端口电路)	BS.215625005	芯愿景	2021-09-26	原始取得
70	P_V33_V2 (3.3V 电源端口电路_V2)	BS.215625013	芯愿景	2021-09-26	原始取得
71	P_GPIO_LH_HL_32K (晶振专用高低电平转换输入输出端口电路)	BS.215624904	芯愿景	2021-09-26	原始取得
72	P_E33_ESD_FT_GLOBAL (全局耐 5V 静电泄放电路)	BS.21562467X	芯愿景	2021-09-26	原始取得
73	PAD_GPIO_E33_FT_FMP_ANFP_TSC_V2 (带滤波模块加速输出模块触控模块耐 5V 通用输入输出电路_V2)	BS.215624416	芯愿景	2021-09-26	原始取得

74	PAD_GPIO_E33_FTA_ANF_TSC_V2(带滤波模块触控模块耐 5V 通用输入输出电路_V2)	BS.215624351	芯愿景	2021-09-26	原始取得
75	CLOCK_DET(时钟频率检测电路)	BS.215624386	芯愿景	2021-09-26	原始取得
76	REGULATOR_SENSE_DRV_091(电压调整器驱动电路)	BS.215624564	芯愿景	2021-09-26	原始取得
77	OSC_14M_051(14MHz 阻容振荡器)	BS.215624602	芯愿景	2021-09-26	原始取得
78	POWER_DET_V33_072(复位和电源控制电路)	BS.215624505	芯愿景	2021-09-26	原始取得
79	PAD_GPI_E33_FT_ANFX2(带滤波模块的耐 5V 通用输入电路 X2)	BS.215624343	芯愿景	2021-09-26	原始取得
80	USB_INT_PULLUP(串行接口上拉电阻电路)	BS.21562484X	芯愿景	2021-09-26	原始取得
81	P_GPIO_HH_HH(高压端口与高压内核的通用输入输出端口)	BS.215624785	芯愿景	2021-09-26	原始取得
82	TEMP_SENSOR_V2_ST(温度传感器)	BS.215624599	芯愿景	2021-09-26	原始取得
83	POWER_SWITCH_072_V2(电源电压转换电路_V2)	BS.215624521	芯愿景	2021-09-26	原始取得
84	POWER_SWITCH_V2(电源电压转换电路_V2)	BS.215624548	芯愿景	2021-09-26	原始取得
85	PAD_GPIO_E33_FTA_TSC_MV_HXB_V2(带滤波模块触控模块信号选择模块中压耐 5V 通用输入输出电路_V2)	BS.215624378	芯愿景	2021-09-26	原始取得
86	OSC_14M(14MHz 阻容振荡器)	BS.21562453X	芯愿景	2021-09-26	原始取得
87	USB_BCD(串行接口电源检测电路)	BS.215624688	芯愿景	2021-09-26	原始取得
88	GP_COMPX2_091(比较器模块)	BS.215624408	芯愿景	2021-09-26	原始取得
89	P_GPIOAP_LH_HL(带滤波功能的高低电平转换通用输入输出端口电路)	BS.215624963	芯愿景	2021-09-26	原始取得
90	PAD_GPIO_E33_TCA_HH_ILK_V2(带泄漏补偿模块高压端口与高压内核的通用输入输出端口_V2)	BS.215624394	芯愿景	2021-09-26	原始取得
91	P_GPIO_LH_HL_FT_I2C(带 I2C 功能的高低电平转换通用输入输出端口电路)	BS.215624947	芯愿景	2021-09-26	原始取得
92	OSC_8M_072(8MHz 阻容振荡器)	BS.215624432	芯愿景	2021-09-26	原始取得
93	PLL_F4(倍频锁相环)	BS.225524856	芯愿景	2022-03-08	原始取得
94	P407_IO_FT_ANF(带信号滤波功能的耐 5V 通用输入输出端口电路)	BS.225524805	芯愿景	2022-03-08	原始取得
95	IODRV_COMPENSATION(通用输入输出接口输出速率补偿模块)	BS.225524767	芯愿景	2022-03-08	原始取得
96	OSC_32K(32kHz 阻容振荡器)	BS.225524783	芯愿景	2022-03-08	原始取得
97	P407_IO_FT_ASX3(带三个模拟开关的耐 5V 通用输入输出端口电路)	BS.225524821	芯愿景	2022-03-08	原始取得

98	POWER_SWITCH（电源电压转换电路）	BS.225524899	芯愿景	2022-03-08	原始取得
99	USB2_OTG_VBUS_VDET（通用串行接口主从机判断及会话检测模块）	BS.225524929	芯愿景	2022-03-08	原始取得
100	ADC_12B_MUX18（模数转化电路）	BS.225527103	芯愿景	2022-03-14	原始取得
101	P_NRST（重置信号触发电路）	BS.225527146	芯愿景	2022-03-14	原始取得
102	USB2_PHY_TRS_FS_LS_FT_LL（全速低速通用串行接口物理层）	BS.225527235	芯愿景	2022-03-14	原始取得
103	P407_GESD_GS_VBKP_LL（备用电源静电泄放端口电路）	BS.225527162	芯愿景	2022-03-14	原始取得
104	USB2_PHY_TRS_FT（全速通用串行接口物理层）	BS.225527243	芯愿景	2022-03-14	原始取得
105	XTAL_32K_103（32kHz 频率晶体振荡器）	BS.225527251	芯愿景	2022-03-14	原始取得
106	P_GPIOA_V2（通用输入输出端口电路）	BS.225527138	芯愿景	2022-03-14	原始取得
107	P407_NRST（重置信号触发电路）	BS.225527189	芯愿景	2022-03-14	原始取得
108	POWER_SWITCH_103（电源电压转换电路）	BS.225527200	芯愿景	2022-03-14	原始取得
109	P_GPIO_FT_ANF（有滤波功能的耐 5V 通用输入输出端口电路）	BS.225527111	芯愿景	2022-03-14	原始取得
110	P_V33（3.3V 电源端口电路）	BS.225527154	芯愿景	2022-03-14	原始取得
111	P407_VS_L（低压电源静电泄放端口电路）	BS.225527219	芯愿景	2022-03-14	原始取得
112	P_GPIO_HH（耐 5V 高压电平通用输入输出端口）	BS.22552712X	芯愿景	2022-03-14	原始取得
113	P407_VBAT_CLAMP_GESD（带钳位的备用电源静电泄放端口电路）	BS.225527197	芯愿景	2022-03-14	原始取得
114	P407_IO_FT_HH_ASX3（带三个模拟开关的耐 5V 高电平转换通用输入输出端口电路）	BS.225527170	芯愿景	2022-03-14	原始取得
115	TEMP_SENSOR_IPTAT（温度传感器）	BS.225527227	芯愿景	2022-03-14	原始取得
116	协处理器	BS.235519782	芯愿景	2023-03-30	原始取得
117	PH303_GPFATIO（带有 gpio 和 fast 模式的输入输出电路）	BS.235531790	芯愿景	2023-05-08	原始取得
118	PH303_VSS_GESDDET（VSS 输入和 GESD 检测电路）	BS.235531960	芯愿景	2023-05-08	原始取得
119	PLL（锁相环）	BS.235532061	芯愿景	2023-05-08	原始取得
120	PH303_IO_MODE_CTRL（提供 IO 所需要的使能和隔离信号的电路）	BS.23553191X	芯愿景	2023-05-08	原始取得
121	PH303_FASTIO_ASX2（带有 2 个模拟开关的高速输入输出电路）	BS.235531782	芯愿景	2023-05-08	原始取得
122	PCM_TEST（测试电路）	BS.235532053	芯愿景	2023-05-08	原始取得

123	PH303_GPIO_HD_ASX1 (带有 High_Drive 和 1 个模拟开关的通用输入输出电路)	BS.235531871	芯愿景	2023-05-08	原始取得
124	OSC_8M (8MHz 阻容振荡器)	BS.235532037	芯愿景	2023-05-08	原始取得
125	PH303_ESDFILL_DIS-CHRGCELL_2 (ESD 泄放电路)	BS.235531758	芯愿景	2023-05-08	原始取得
126	RANDOM_PULSE_GEN_X3 (随机方波生成模块)	BS.235532088	芯愿景	2023-05-08	原始取得
127	XTAL_4_40M (4~40M 频率晶体振荡器)	BS.23553210X	芯愿景	2023-05-08	原始取得
128	PH303_GSA (模拟地端口静电泻放电路)	BS.235531898	芯愿景	2023-05-08	原始取得
129	PH303_DISCHRG_CTRL (VDDdischarge 信号生成电路)	BS.235531731	芯愿景	2023-05-08	原始取得
130	PH303_GPIO_ASX2 (带有 2 个模拟开关的输入输出电路)	BS.235531855	芯愿景	2023-05-08	原始取得
131	OSC_48M (48MHz 阻容振荡器)	BS.235532045	芯愿景	2023-05-08	原始取得
132	PH303_GPIO_HD (带有 High_Drive 功能的通用输入输出电路)	BS.235531863	芯愿景	2023-05-08	原始取得
133	PH303_FASTIO_ASX1 (带有 1 个模拟开关的高速输入输出电路)	BS.235531774	芯愿景	2023-05-08	原始取得
134	PH303_FASTIO (高速输入输出电路)	BS.235531766	芯愿景	2023-05-08	原始取得
135	PH303_VDD_DISCHRG_CTRL (VDD 输入包含 VDDdischarge 信号生成电路)	BS.235531928	芯愿景	2023-05-08	原始取得
136	PH303_ESDFILL_DIS-CHRGCELL_1 (ESD 泄放电路)	BS.23553174X	芯愿景	2023-05-08	原始取得
137	PH303_GPIO_ANF_ODM_ASX1 (带有滤波与 Open_Drain 功能和 1 个模拟开关的通用 GPIO 电路)	BS.235531820	芯愿景	2023-05-08	原始取得
138	PH303_VSA (模拟电源端口)	BS.235531944	芯愿景	2023-05-08	原始取得
139	CMP_DAC_8B (高精度数模转换器)	BS.235532002	芯愿景	2023-05-08	原始取得
140	ADC_12B (模数转换电路)	BS.235531995	芯愿景	2023-05-08	原始取得
141	PH303_GPIO_ANF_ODM (带有滤波与 Open_Drain 功能的通用 GPIO 电路)	BS.235531812	芯愿景	2023-05-08	原始取得
142	PH303_GPIO_HD_ASX2 (带有 High_Drive 和 2 个模拟开关的通用输入输出电路)	BS.23553188X	芯愿景	2023-05-08	原始取得
143	PH303_CORNER (ESD 泄放电路)	BS.235531693	芯愿景	2023-05-08	原始取得
144	VPP_SWITCH (模拟开关)	BS.235532096	芯愿景	2023-05-08	原始取得
145	PH303_GPIO (通用输入输出电路)	BS.235531804	芯愿景	2023-05-08	原始取得
146	PH303_VREFL (模拟地输入用于 VREF)	BS.235531936	芯愿景	2023-05-08	原始取得
147	PMC_OSC_128K (电源管理控制和 128KHz 阻容振荡器)	BS.23553207X	芯愿景	2023-05-08	原始取得

148	PH303_GPIO_ASX1 (带有 1 个模拟开关的输入输出电路)	BS.235608068	芯愿景	2023-12-18	原始取得
149	OSC_48M (输出频率为 48MHz 的振荡器)	BS.215671422	太原芯愿景	2021-12-09	原始取得
150	OSC_16M_407 (输出频率为 16MHz 的振荡器)	BS.215671414	太原芯愿景	2021-12-09	原始取得
151	CXSUA (工业控制电路)	BS.215671406	太原芯愿景	2021-12-09	原始取得
152	TEMP_SENSOR (温度传感器)	BS.225565552	太原芯愿景	2022-06-17	原始取得
153	ADC_12B_MUX18 (精度可调的模数转换器)	BS.225565544	太原芯愿景	2022-06-17	原始取得
154	OSC_48M_SAMS90 (输出频率为 48MHz 的振荡器)	BS.225576058	太原芯愿景	2022-07-13	原始取得
155	ADC_12B_MUX18_SAMS90 (精度可调的模数转换器)	BS.225576031	太原芯愿景	2022-07-13	原始取得
156	ADC_12B_MUX18_UMC55 (可自校准模拟数字转换器 ADC)	BS.225595079	太原芯愿景	2022-09-06	原始取得
157	PLL (锁相环 PLL)	BS.225595109	太原芯愿景	2022-09-06	原始取得
158	OSC_48M_UMC110 (输出频率为 48MHz 的振荡器)	BS.225595095	太原芯愿景	2022-09-06	原始取得
159	ADC (12 位流水线型模数转换器)	BS.225595052	太原芯愿景	2022-09-06	原始取得
160	ADC (用于温度传感的 TempADC)	BS.225595060	太原芯愿景	2022-09-06	原始取得
161	DAC (4-bit 电流型 DAC)	BS.225595087	太原芯愿景	2022-09-06	原始取得
162	非线性调整模块	BS.225595591	太原芯愿景	2022-09-07	原始取得
163	AMP (高增益放大器)	BS.225595575	太原芯愿景	2022-09-07	原始取得
164	ADC (12 位的模数转换器)	BS.225595559	太原芯愿景	2022-09-07	原始取得
165	ADC (转换速率可编程的 8 位的 ADC)	BS.225595567	太原芯愿景	2022-09-07	原始取得
166	电压基准模块	BS.225596601	太原芯愿景	2022-09-13	原始取得
167	电源监视器	BS.225596628	太原芯愿景	2022-09-13	原始取得
168	DAC (12 位的数模转换器)	BS.225596598	太原芯愿景	2022-09-13	原始取得
169	桥式功率驱动电路	BS.225600048	太原芯愿景	2022-09-23	原始取得
170	输出电压可变的 REGULATOR	BS.225600056	太原芯愿景	2022-09-23	原始取得
171	电流驱动双极型振荡器	BS.22560003 X	太原芯愿景	2022-09-23	原始取得
172	超低值电压比较器	BS.225600021	太原芯愿景	2022-09-23	原始取得

173	CMPSS（高精度比较器）	BS.245567593	太原芯 愿景	2024-09 -03	原始取得
174	VREF_GEN（线性稳压源）	BS.245567526	太原芯 愿景	2024-09 -03	原始取得
175	AMP（运算放大器）	BS.245567615	太原芯 愿景	2024-09 -03	原始取得
176	FCE1100	BS.225629453	方芯半 导体	2022-12 -21	原始取得
177	FCE1200	BS.225629461	方芯半 导体	2022-12 -21	原始取得
178	REG_SWITCH_X2（内部电源驱动开关 管）	BS.235600121	方芯半 导体	2023-11 -27	原始取得
179	IP_RST_CTRL（复位控制电路）	BS.235600113	方芯半 导体	2023-11 -27	原始取得
180	IP_LDO（内部电源产生电路）	BS.235600172	方芯半 导体	2023-11 -27	原始取得
181	LDOX2_IB_GEN（内部电源产生电路）	BS.23560013 X	方芯半 导体	2023-11 -27	原始取得
182	EBUS_RX（总线接收端电路）	BS.235600067	方芯半 导体	2023-11 -27	原始取得
183	REG_SWITCH_50TO33（内部电源驱动 开关管）	BS.235600156	方芯半 导体	2023-11 -27	原始取得
184	REG_SWITCH_25TO18（内部电源驱动 开关管）	BS.235600148	方芯半 导体	2023-11 -27	原始取得
185	EBUS_TX（总线发送端电路）	BS.235600091	方芯半 导体	2023-11 -27	原始取得
186	ADC（12 位流水线型模数转换器）	BS.245500235	方芯半 导体	2024-01 -02	原始取得
187	DSP	BS.245500243	方芯半 导体	2024-01 -02	原始取得
188	PWM	BS.245500294	方芯半 导体	2024-01 -02	原始取得
189	上电复位 POR	BS.245500308	方芯半 导体	2024-01 -02	原始取得
190	IO 布局	BS.24550026 X	方芯半 导体	2024-01 -02	原始取得
191	PLL（锁相环 PLL）	BS.245500286	方芯半 导体	2024-01 -02	原始取得
192	ETH_PHY_PWRDET_PLL（电源检测及 锁相环电路）	BS.245542760	方芯半 导体	2024-06 -18	原始取得
193	ETH_PHY_100X_ANA（通信收发电路）	BS.245542752	方芯半 导体	2024-06 -18	原始取得
194	ET9254_TOP（集成以太网 2/3 端口从控 制器）	BS.245542744	方芯半 导体	2024-06 -18	原始取得

（三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	高新技术企业	GS202411000021	芯愿景	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	2024 年 10 月 29 日	2024 年 10 月 29 日-2027 年 10 月 29 日
2	北京市“专精特新”中小企业	2023ZJTX1762	芯愿景	北京市经济和信息化局	2023 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 -2026 年 12 月
3	北京市知识产权试点单位	-	芯愿景	北京市知识产权局	2023 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 -2026 年 12 月
4	质量管理体系认证（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015）	02622Q31131R1M	芯愿景	北京天一正认证中心有限公司	2022 年 9 月 22 日	2022 年 9 月 22 日-2025 年 9 月 4 日
5	辐射安全许可证	京环辐证[F0854]	芯愿景	北京市海淀区生态环境局	2025 年 1 月 16 日	2025 年 1 月 16 日-2030 年 1 月 15 日
6	对外贸易经营者备案登记表	02138479	芯愿景	对外贸易经营者备案登记（北京海淀）	2020 年 3 月 4 日	-
7	高新技术企业	GR202314001361	太原芯愿景	山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局	2023 年 12 月 8 日	2023 年 12 月 8 日-2026 年 12 月 8 日
8	山西省专精特新中小企业	-	太原芯愿景	山西省小企业发展促进局	2023 年 7 月 1 日	2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（四） 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（万元）	累计折旧（万元）	账面净值（万元）	成新率
房屋及建筑物	5,246.94	2,791.98	2,454.96	46.79%
机器设备	6,565.46	4,975.01	1,590.45	24.22%

运输工具	439.44	281.84	157.61	35.87%
电子设备及其他	1,065.47	814.81	250.66	23.53%
合计	13,317.31	8,863.63	4,453.68	33.44%

2、主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值 (万元)	累计折旧 (万元)	资产净值 (万元)	成新率	是否 闲置
场发射扫描电镜	5	2,306.02	1,555.24	750.78	32.56%	否
场发射透射电镜	1	575.22	218.58	356.64	62.00%	否
高密度等离子刻蚀机系统	5	371.76	259.02	112.75	30.33%	否
截面抛光仪	1	60.18	12.39	47.79	79.42%	否
集成电路测试机	1	74.16	36.40	37.76	50.92%	否
聚焦离子束显微镜	2	469.83	446.34	23.49	5.00%	否
离子研磨仪	1	60.18	39.06	21.11	35.08%	否
合计	-	3,917.35	2,567.03	1,350.31	34.47%	-

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积 (平米)	产权证取得日期	用途
1	京（2020）海不动 产权第 0032251 号	北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 1 层 101	623.29	2020 年 9 月 3 日	创意工坊
2	京（2020）海不动 产权第 0032256 号	北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 1 层 102	635.98	2020 年 9 月 3 日	创意工坊
3	京（2020）海不动 产权第 0032247 号	北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 2 层 201	605.21	2020 年 9 月 3 日	创意工坊
4	京（2020）海不动 产权第 0032229 号	北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 2 层 202	605.21	2020 年 9 月 3 日	创意工坊
5	津（2023）开发区 不动产权第 0528511 号	天津市开发区信环西路 20 号	12,586.4	2015 年 12 月 20 日	工业用地

4、租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁 用途
芯愿景	保定广联数字新媒体有 限公司	保定市向阳北大街 2628 号云中心智慧产业园 2#-1 号楼 2-4 层；2#-1 号楼 1 层 101、102、104、 105；（赠送负一层 B101、	3,023	2024.12.1-2029.11.30	办公 场地

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁用途
		B102、B104、B105)			
方芯半导体	深圳市易安联物业投资发展有限公司	新安街道47区自由路98号愉盛综合大厦4栋第7层715	76	2024.3.27-2025.3.31	办公场地
太原芯愿景	山西万立科技有限公司	山西综改示范区太原学府园区龙兴街9号万立科技大厦1幢4层1-14号房间、21层1-4、12-14房间、2幢1层7、9号房间	3,548.99	2024.10.24-2024.12.31	办公场地
新创愿景	芯愿景	北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201	5.00	2019.08.01-2029.07.31	办公场地
同创愿景	芯愿景	北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201	5.00	2024.01.01-2033.12.31	办公场地
天津新业船务工程有限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路20号愿景大厦B1-208房屋	219.80	2020.1.1-2024.12.31	办公场地
天津天佑物业管理有限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路20号楼顶场地	10.00	2020.5.1-2025.4.30	机房及建杆塔、安装天线、避雷针等
天津海铁隆鑫国际货运代理有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区县信环西路20号愿景大厦B-3层305	290.00	2020.8.10-2025.8.9	办公场地
天津三九泛华国际货运有限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路20号愿景大厦B1-503房屋	271.20	2021.6.1-2026.5.31	办公场地
天津义联新国际物流有限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路20号愿景大厦B1-101房屋	980.00	2021.9.9-2026.9.8	办公场地
米沃(天津)商务秘书有限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路20号愿景大厦B1-203房屋	110.00	2022.3.1-2025.2.28	办公场地
天津帝垚物流有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区信环西路20号愿景大厦A1-610	430.00	2022.7.1-2027.6.30	办公场地
天津自贸试验区隆辉物流有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区信环西路20号愿景大厦A1-620	213.00	2022.7.1-2027.6.30	办公场地
瀚辰海洋科技(天津)有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区信环西路20号愿景大厦B1-303	330.00	2022.11.16-2025.11.15	办公场地
瀚辰能源有	天津芯愿景	天津市经济技术开发区	1,486.70	2022.11.16-2025.11.15	办公

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁用途
限公司		信环西路 20 号愿景大厦 B1-301、B1-401、 B1-406、B1-408			场地
天津精采潜 龙科技有限 公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A1-308	585.33	2023.4.8-2028.4.7	办公 场地
海南俊博鑫 物流有限公 司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A1-603	155.00	2023.5.11-2026.5.10	办公 场地
北京海龙国 际运输代理 有限公司天 津分公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 B1-108	330.00	2023.8.1-2026.7.31	办公 场地
天津弘璟国 际贸易有限 公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A1-402	115.00	2023.9.1-2026.8.31	办公 场地
天津市德富 亚科技有限 公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 B1-302	133.00	2023.12.1-2026.11.30	办公 场地
天津艾意达 科技有限公 司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A1-601	135.00	2024.1.20-2025.1.19	办公 场地
华宸（天津） 商业管理有 限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-210 房屋	208.00	2024.2.1-2025.1.31	办公 场地
八爪章鱼云 计算（上海） 有限公司天 津分公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-309 房屋	136.00	2024.3.15-2025.3.14	办公 场地
天津百瑞达 物流有限公 司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-209 房屋	178.00	2024.5.1-2025.4.30	办公 场地
天津万普拉 斯模具科技 有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 B1-306	62.00	2024.5.1-2025.4.30	办公 场地
天津正津睿 瞻传媒有限 公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 B1-308	225.00	2024.5.1-2025.1.31	办公 场地
中荣海物流 （天津）有 限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A1-501	745.00	2024.5.1-2027.4.30	办公 场地
天津贝斯德 海洋工程技 术有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A2-516	230.00	2024.5.1-2029.4.30	办公 场地
天津中源船 务有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A2-618	660.00	2024.5.1-2029.4.30	办公 场地
闫振国	天津芯愿景	天津市经济技术开发区	415.00	2024.5.1-2029.4.30	办公

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁用途
		信环西路 20 号愿景大厦 A2-608			场地
梓辰领航 (天津) 科 技有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A2-517	400.00	2024.5.1-2029.4.30	办公 场地
天津凯晟国 际货运代理 有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 B1-506	163.00	2024.6.8-2025.6.7	办公 场地
泰沅科技 (天津) 有 限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-207 房屋	116.00	2024.7.1-2025.6.30	办公 场地
天津江海联 供应链有限 公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 B1-501	402.00	2024.7.1-2027.6.30	办公 场地
颂禾装饰设 计(天津) 有限公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A2-101	880.00	2024.7.1-2027.9.30	办公 场地
天津众赢海 洋科技有限 公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 A1-602 房屋	150.00	2024.7.15-2025.7.14	办公 场地
天津瑞高供 应链有限公 司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A2-609	220.00	2024.7.15-2029.7.14	办公 场地
天津冰河世 纪科技有限 公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A2-505	125.00	2024.7.16-2026.7.15	办公 场地
天津合顺工 程咨询有限 公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 B1-307	206.50	2024.8.1-2025.7.31	办公 场地
天津经济技 术开发区海 华贸易有限 公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-310 房屋	120.00	2024.8.1-2025.7.31	办公 场地
天津聚云物 联科技有限 公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A1-105	30.00	2024.9.18-2025.9.17	办公 场地
天津物源国 际贸易有限 公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-304 房屋	175.00	2024.9.19-2025.9.18	办公 场地
天津济通船 务代理有限 公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 A1-307 房屋	200.00	2024.11.1-2025.10.31	办公 场地
天津开发区 艾托工贸发 展有限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-502 房屋	133.00	2024.11.1-2025.10.31	办公 场地
天津庆洋船 务代理有限 公司	天津芯愿景	天津市经济技术开发区 信环西路 20 号愿景大厦 A1-306	230.00	2024.11.1-2025.10.31	办公 场地

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁用途
天津鹏翔华夏科技有限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-206 房屋	120.00	2024.12.1-2025.11.30	办公场地
唐晓	天津芯愿景	天津市经济技术开发区信环西路 20 号愿景大厦 A1-405	80.00	2024.12.10-2025.4.9	办公场地
唐晓	天津芯愿景	天津市经济技术开发区信环西路 20 号愿景大厦 A1-403	400.00	2024.12.10-2029.12.9	办公场地
天津箱满满集装箱有限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 A1-301	135.00	2024.09.01-2025.02.28	办公场地
天津箱满满集装箱有限公司	天津芯愿景	天津开发区信环西路 20 号愿景大厦 A1-401	135.00	2024.07.01-2024.12.31	办公场地

注：上表系公司截至 2024 年 12 月 31 日的租赁情况

5、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（六）公司员工及核心技术（业务）人员情况

1、员工情况

（1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	9	1.17%
41-50 岁	27	3.50%
31-40 岁	171	22.18%
21-30 岁	564	73.15%
21 岁以下	0	0.00%
合计	771	100.00%

（2）按照学历划分

学历	人数	占比
博士	1	0.13%
硕士	19	2.46%
本科	548	71.08%
专科及以下	203	26.33%
合计	771	100.00%

（3）按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理人员	21	2.72%
生产人员	563	73.02%
销售人员	21	2.72%
研发人员	166	21.53%
合计	771	100.00%

(4) 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

2、核心技术（业务）人员情况

☒适用 ☐不适用

(1) 核心技术（业务）人员基本情况

序号	姓名	年龄	现任职务及任期	主要业务经历及职务	国家或地区	学历	职称或专业资质
1	丁柯	50	董事长、首席科学家、核心技术人员	1997年7月毕业于中国科学技术大学计算机科学技术系，取得计算机软件专业学士学位；2002年7月毕业于中国科学院软件研究所，取得计算机软件与理论专业博士学位。2002年9月至2019年9月，历任芯愿景有限执行董事、总经理、董事长；2019年10月至今，任公司董事长、首席科学家。	中国	博士	-
2	蒋卫军	50	董事、副总经理、核心技术人员	1997年7月毕业于中国科学技术大学计算机科学技术系，取得计算机软件专业学士学位；2000年7月毕业于中国科学院自动化研究所，取得模式识别与智能控制专业的硕士学位。2002年4月至2019年9月，历任芯愿景有限总经理、副总经理、董事；2019年10月至今，任公司董事、副总经理。	中国	硕士	-
3	张军	50	董事、总经理、核心技术人员	1997年7月毕业于北京科技大学冶金工程专业，取得工学学士学位，2013年7月取得北京科技大学高级工商管理硕士学位。	中国	硕士	-

				2002 年 4 月至 2019 年 9 月, 历任芯愿景有限监事、副总经理、董事、总经理; 2019 年 10 月至今, 任公司董事、总经理。			
4	丁仲	45	董事、研发总监、核心技术人员	2001 年 7 月毕业于西北工业大学计算机科学与工程系, 取得工学学士学位; 2004 年 7 月毕业于中国科学院软件研究所, 取得计算机应用技术专业的硕士学位。2004 年 8 月至 2006 年 1 月, 就职于北京新浪互联信息服务有限公司; 2006 年 2 月至 2008 年 6 月, 就职于美国 CA Technologies 公司中国研发中心; 2008 年 6 月至 2019 年 9 月, 历任公司研发部经理、研发总监、监事。	中国	硕士	-
5	张金正	42	监事、核心技术人员、保定分公司总经理、太原芯愿景总经理	2005 年毕业于桂林电子工业学院通信与电子信息工程专业, 取得工学学士学位。2006 年 5 月至今, 历任公司设计部经理助理、经理、保定分公司总经理、太原芯愿景总经理, 公司监事。	中国	本科	-
6	熊伟	41	监事、核心技术人员、天津芯愿景副总经理	2005 年毕业于北京化工大学电子信息工程专业, 取得工学学士学位。2005 年 11 月至 2013 年 4 月, 历任芯愿景有限设计部工程师、设计部经理; 2013 年 4 月至 2019 年 9 月, 任天津芯愿景设计部经理; 2019 年 10 月至今, 任公司监事、天津芯愿景副总经理。	中国	本科	-
7	李洋	38	核心技术人员、保定分公司副总经理	2008 年 6 月毕业于东南大学电子科学与技术专业, 获工学学士学位。2008 年 6 月至 2019 年 9 月, 历任保定分公司经理、IC 研发部副经理、IC 研发部经理、保定分公司副总经理; 2019 年 10 月至今, 任保定分公司 IC 研发部经理、保定分公司副总经理。	中国	本科	-

与公司业务相关研究成果

√适用 □不适用

序号	姓名	与公司业务相关的研究成果
1	丁柯	丁柯与蒋卫军、张军共同创立芯愿景有限，并长期从事集成电路分析技术、集成电路安全可信技术、集成电路 EDA 技术的前沿技术研究；丁柯规划建立了芯愿景的完整技术研发及业务体系，是公司总体技术路线的制定者。丁柯是 4TB 级专用数据库引擎、设计数据交换、数字单元功能识别和验证、全定制版图编辑器、参数化版图单元等公司核心技术的最主要贡献者。丁柯在集成电路分析领域拥有近 20 年的研究开发经验，是公司多项专利权的发明人之一；同时，丁柯作为课题负责人承担了“核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品”国家科技重大专项课题（编号：2009ZX01021-002）的研究工作，该课题已顺利结题验收。
2	蒋卫军	蒋卫军与丁柯、张军共同创立芯愿景有限，长期从事集成电路图像自动化处理技术的研究开发，是公司 IC 分析业务总体技术规范的制定者。蒋卫军是显微图像自动采集、超大规模显微图像处理、纳米级集成电路图像自动识别、纳米级集成电路高精度网表提取等公司核心技术的最主要贡献者。蒋卫军是模式识别和图像处理方面的资深专家，主导制订了纳米级 IC 电路分析服务的总体技术流程和技术规范；同时，蒋卫军领导团队承担了“版图一致性验证技术研究”“基于机器学习的集成电路硬件木马 XXXX 技术”等多个大型科研项目的研发工作。
3	张军	张军与丁柯、蒋卫军共同创立芯愿景有限，长期致力于集成电路工艺分析技术、硬件安全技术、知识产权分析鉴定等研究方向，是公司集成电路知识产权分析鉴定业务的奠基人，工艺实验室的创始人。同时，张军长期负责公司各类业务的拓展和推广，为公司发展壮大做出了重要贡献。张军是纳米级集成电路工艺处理、面向专利侵权取证的电路图版面优化、集成电路布图设计相似度比较等公司核心技术的最主要贡献者。张军是公司集成电路知识产权保护方面的资深专家，也是公司专利权的发明人之一；张军多次受邀在中国专利信息年会、ICCAD、中国 IC 领袖峰会等会议上做专题报告，并在《中国知识产权》《电子应用技术》等期刊上发表多篇论文。
4	丁仲	丁仲是纳米级集成电路功能分析、集成电路安全可信设计、数字电路布线优化、面向版图验证的多边形处理引擎等公司核心技术的最主要贡献者。丁仲擅长大型软件工程和系统架构设计，并对集成电路 EDA 技术、集成电路分析技术有深入研究，为公司多项专利权的发明人之一。丁仲提出了公司 EDA 产品研发平台化策略，实现了各 EDA 产品线之间数据互操作。另外，丁仲将高性能分布式计算技术和机器学习技术引入公司 EDA 产品中，提升了数据自动化处理的效率和品质。
5	张金正	张金正是基于 EDA 软件的应用级开发、纳米级工艺定制版图设计等核心技术的最主要贡献者。张金正拥有十余年从事超大规模集成电路分析项目的技术研发和管理工作经验，发展了基于 EDA 软件的应用级开发技术，设计并建立了应用程序的统一框架及运行平台；任职期间，张金正主持完成了一大批高性能 CPU、FPGA 等芯片分析项目。
6	熊伟	熊伟是面向工业物联网的传感和控制器 IP、高适应性通用基础 IP 等核心技术的最主要贡献者。熊伟曾参与公司多项新业务的开发工作，精通数模混合电路设计技术，是公司多项专利权的发明人之一。2013 年，熊伟负责组建天津芯愿景的设计团队，创建了集成电路兼容产品开发平台，并基于该平台研发包括数字电源芯片、运动控制协处理器芯片、低功耗无线接收芯片等多个产品系列。2016 年，熊伟领导研发了电容编码器相关技术，申请多项发明专利。2018 年，熊伟负责创建集成电路兼容 IP 开发平台，并基于

		该平台研发工业以太网现场总线的从机协议处理 IP 等产品。
7	李洋	李洋是基于 FPGA 的 IP 和集成电路产品验证等核心技术的最主要贡献者。入司以来, 李洋一直负责开展芯片产品设计开发工作, 建立了产品的可靠性验证规范, 以及设计工作的标准流程。在保定分公司工作期间, 李洋组建了集成电路设计服务研发团队, 研发完成了高精度低功耗计量 MCU 芯片、16 位实时控制 MCU 芯片、高频远距读写器芯片、嵌入式实时定点低功耗 DSP 芯片、低频近距电子标签芯片、工控电机驱动芯片等集成电路设计服务项目。

(2) 核心技术(业务)人员变动情况

☐适用 ☒不适用

(3) 核心技术(业务)人员持股情况

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	持股数量(股)	直接持股比例	间接持股比例
丁柯	董事长、首席科学家、核心技术人员	24,744,236	38.6614%	0.8588%
蒋卫军	董事、副总经理、核心技术人员	18,373,675	28.7078%	0.6377%
张军	董事、总经理、核心技术人员	15,311,068	23.9226%	0.5314%
丁仲	董事、研发总监、核心技术人员	1,898,298	2.9660%	0.0659%
张金正	监事、核心技术人员、保定分公司总经理、太原芯愿景总经理	180,000	-	0.2875%
熊伟	监事、核心技术人员、天津芯愿景副总经理	180,000	-	0.2875%
李洋	核心技术人员、保定分公司副总经理	98,361	-	0.1571%
合计		60,785,638	94.2578%	2.8257%

(4) 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	是	报告期内, 公司存在的劳务外包情形主要为保洁、保安服务, 不属于公司关键性岗位, 具有合规性。
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

☐适用 ☒不适用

四、 公司主营业务相关的情况

（一） 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：万元

产品或业务	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	23,153.21	97.54%	21,008.01	97.75%
IC 分析业务	12,840.01	54.09%	11,482.94	53.43%
检测分析	165.37	0.70%	353.88	1.65%
电路分析	12,674.64	53.40%	11,129.06	51.78%
知识产权和资讯业务	5,383.17	22.68%	4,838.50	22.51%
知识产权服务	1,025.27	4.32%	829.82	3.86%
图像资讯	3,273.84	13.79%	3,521.51	16.38%
产品资讯	1,084.05	4.57%	487.17	2.27%
IC 设计业务	4,828.62	20.34%	4,483.20	20.86%
设计服务	2,825.64	11.90%	2,344.69	10.91%
IP 授权	798.11	3.36%	693.40	3.23%
自有芯片销售	820.26	3.46%	660.09	3.07%
量产服务	384.60	1.62%	785.03	3.65%
EDA 软件授权	101.42	0.43%	203.37	0.95%
其他业务收入	584.27	2.46%	484.36	2.25%
合计	23,737.49	100.00%	21,492.38	100.00%

2、 其他情况

☐适用 ☒不适用

（二） 产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司服务的主要客户包括 IC 设计企业、集成器件制造商、电子产品系统厂商、科研院所、司法鉴定机构及律师事务所等。报告期内公司前五名客户情况如下：

1、 报告期内前五名客户情况

序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额（万元）	占比
2024 年度					
1	中国航天科技集团有限公司	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务	6,248.27	26.32%
2	中国电子科技集团有限公司	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务	1,245.80	5.25%
3	纳思达股份有限公司	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务	1,082.50	4.56%
4	电子产品系统厂商客户 D1	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务	830.92	3.50%
5	Intellectual Property Research Group	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务	647.37	2.73%
合计		-	-	10,054.86	42.36%
2023 年度					
1	中国电子科技集团有限公司	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务	1,956.71	9.10%
2	中国航天科技集团有限公司	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务	1,421.54	6.61%
3	IC 设计企业客户 F1	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务	1,000.61	4.66%
4	中国电子信息产业集团有限公司	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务	976.82	4.54%
5	电子产品系统厂商客户 D1	否	IC 分析业务、知识产权和资讯业务	971.60	4.52%
合计		-	-	6,327.28	29.44%

注：中国航天科技集团有限公司主要包括航天科技下属单位 B1、航天科技下属单位 B2 等；中国电子科技集团有限公司主要包括中国电科下属单位 A2、中国电科下属单位 A1 及中国电科下属单位 A6 等；纳思达股份有限公司主要包括纳思达股份有限公司、珠海极海半导体有限公司、极海微电子股份有限公司等；电子产品系统厂商客户 D1 主要包括电子产品系统厂商客户 D1、IC 设计企业客户 D2、IC 设计企业客户 D3 等；中国电子信息产业集团有限公司主要包括中国电子下属单位 C1 等；

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、 客户集中度较高

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况

公司主要供应商包括实验设备厂商、晶圆加工厂、IC 封测厂及其他 IC 技术商等。报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额（万元）	占比
2024 年度					
1	上海华虹宏力半导体制造有限公司	否	IC 代工及其他技术服务等	361.41	12.28%
2	苏州高邦半导体科技有限公司	否	IC 代工及其他技术服务等	193.48	6.58%
3	深圳市中声文科技有限公司	否	成品芯片	163.94	5.57%
4	天津泰达电力有限公司	否	办公场所使用及维护等	154.44	5.25%
5	天津市恩来泰商贸有限公司	否	办公场所使用及维护等	147.01	5.00%
合计		-	-	1,020.28	34.67%
2023 年度					
1	深圳锦弦科技有限公司	否	成品芯片	551.02	15.44%
2	上海华虹宏力半导体制造有限公司	否	IC 代工及其他技术服务等	426.23	11.94%
3	山西万立科技有限公司	否	办公场所使用及维护等	257.77	7.22%
4	苏州高邦半导体科技有限公司	否	IC 代工等	243.19	6.82%
5	卡尔蔡司（上海）管理有限公司	否	实验设备及用品等	240.80	6.75%
合计		-	-	1,719.01	48.17%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、 供应商集中度较高

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（四） 主要供应商与主要客户重合的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司存在客户和供应商重叠，且与公司的销售、采购金额均大于 20 万元的交易情况如下：

公司名称	交易类型	主要交易内容	2024 年度		2023 年度		交易原因
			金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	
Materials Analysis Technology Inc.	销售	IC 分析、知识产权和资讯	175.82	0.76	200.08	0.95	公司向闾康（Materials Analysis Technology Inc.）和其子公司闾康技术检测（上海）有限公司的销售为 IC 分析业务和知识产权和资讯业务。同时，公司向闾康技术检测（上海）有限公司采购 FA 失效分析、SIMS（材料分析）等检测分析服务。闾康主营业务为基于其实验室设备，结合顾问与咨询的功能，提供各种试片制备服务。在集成电路分析检测领域中，其在实验室设备完备性及检测能力方面具有优势。但当其在存在电路分析需求时，则需要委托芯愿景等在电路分析领域具有优势的企业完成。
	采购	外协技术服务	24.68	1.21	36.13	1.01	

报告期内，公司存在部分客户与供应商重叠的情形，该等少量的重叠情况具有商业合理性。

（五） 收付款方式

1、 现金或个人卡收款

☐适用 ☒不适用

2、 现金付款或个人卡付款

☐适用 ☒不适用

五、经营合规情况

（一）环保情况

事项	是或否或不适用
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	不适用
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

1、公司不属于重污染行业

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。据生态环境部发布的《环境保护综合名录（2021 年版）》，公司主营业务及主要产品不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》认定的“高污染、高环境风险”产品名录所列产品；其所属行业亦不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》认定的“高污染、高环境风险”行业。根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150 号），公司主营业务及产品不属于重污染行业。

公司在运营过程中产生的污染物较少，主要为 IC 工艺分析环节产生的废弃、废水、固体废物、废水等，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求，同时制定并遵守《实验室日常管理规定》《实验室辐射安全管理规定》《危险化学品突发事件应急预案》等多项内部制度，根据实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行状况良好，处理能力均满足排放量的要求，使得生产经营过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪声得到了合理有效控制。

2、公司建设项目的环评批复与验收

序号	项目名称	建设单位主体	环评批复文号/环境影响评价登记表备案号	验收情况
1	工艺分析研究实验室建设项目	芯愿景	海环审字 20190059 号	已验收
2	工艺分析研究实验室改扩建项目	芯愿景	海环审字 20220046 号	已验收
3	使用射线装置项目	芯愿景	202011010800000029	无需验收

3、环保合法合规情形公司在生产经营中遵守国家环保法律法规，报告期内不存在环保重大违法违规行为，未受到环保部门相关处罚。

（二）安全生产情况

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	否
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

公司为集成电路设计业中的技术服务类企业，安全生产风险较低。公司制定并严格执行《安全生产管理制度》《实验室安全管理规定》《实验室辐射安全管理规定》《实验室危险废物应急预案》等管理制度或措施，对工艺分析实验中的安全隐患（主要包括化学试剂腐蚀、气体泄漏、辐射泄漏、危废泄漏等）进行严格监控，定期开展员工教育活动，坚决杜绝安全生产事故发生。

报告期内，公司不存在由于安全生产事故被相关主管部门处罚的情形。

（三）质量管理情况

事项	是或否或不适用
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量管理违规事项	否

具体情况披露：

1、公司通过质量体系认证情况

公司通过的质量体系认证情况详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质”。

2、质量监督违规事项

报告期内，公司未发生质量监督违规事件，不存在被市场监督管理部门行政处罚或被列为经营异常名录和严重违法失信企业名录的情况。

（四）高耗能、高排放情况

事项	是或否或不适用
公司处于（募集资金投向）火电、石化、化工、钢铁、建材、有色金属行业	否

具体情况披露：

公司不处于火电、石化、化工、钢铁、建材、有色金属行业。

（五）其他经营合规情况

☐适用 ☒不适用

六、商业模式

（一）盈利模式

在 IC 分析业务开展中，公司与客户签订技术服务协议，约定为其提供 IC 样品的分析服务；在项目执行中，客户通常分阶段付款，并最终一次性对项目进行验收确认。

知识产权和资讯业务的盈利模式与 IC 分析业务基本一致。公司与客户签订技术服务协议，约定向其交付知识产权技术服务成果、集成电路大数据平台的资讯数据或芯片图像数据等；在项目执行中，客户根据合同约定付款，并最终一次性对项目进行验收确认。

在 IC 设计业务开展中，对于设计服务，公司与客户签订技术服务协议，约定为其提供 IC 设计服务，在项目执行中，客户通常分阶段付款，并最终一次性对项目进行验收确认；对于 IP 授权，公司与客户签订授权协议，公司交付成果后，客户一次性对成果进行验收确认；对于自有芯片销售，客户根据需要向公司采购公司自主研发的芯片产品，并根据到货情况完成签收确认；对于量产服务，客户设定生产规模，并根据到货情况完成签收确认。

关于 EDA 软件授权，公司与客户签订授权协议，约定固定期限内，客户可使用相关软件及内嵌的技术模块；在项目执行中，客户一次性对成果进行验收确认。

（二）采购模式

公司主营业务涉及的采购主要包括：实验设备、集成电路代工服务、其他技术服务等。

1、实验设备采购

公司依据经营计划及项目需求，采购集成电路刻蚀设备、电子及光学显微镜、精研一体机、X 射线检测设备等实验器材，主要用于 IC 分析业务以及知识产权和资讯业务。相关设备主要为牛津、卡尔蔡司等知名品牌，一般通过其在国内的分支机构或进口代理商进行采购；采购价格以询价方式确定。

2、集成电路代工服务采购

公司根据研发项目需求及客户合同需求，采购晶圆代加工、封装和测试服务，主要用于集成电路试生产、量产服务以及自研芯片销售。一般而言，在产品评估阶段，公司根据集成电路类型及技术参数、封装类型及材料等，确定备选外协厂商；项目风险审核通过后，公司获得各厂商报价、产能排期信息；最终综合考虑各家工艺节点稳定性、交付周期、产品市场价格及成本因素等，选定合格外协厂商。公司设立生产管理岗，负责代工服务的采购及流程管理；同时，进行合格供应商名单的动态管理。

3、其他技术服务采购

公司根据项目的特定需求，采购 EMMI 失效分析、FIB 电路修补等技术服务，用于 IC 分析业务及产品研发项目中。在项目执行中，公司集中对上述服务进行采购询价、确定技术服务商。相关服务主要依赖显微镜等高技术设备，市场竞争较为充分。

（三）服务模式

报告期内，公司业务类型主要包括 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务、EDA 软件授权业务四大板块，其服务模式如下：

1、IC 分析业务

IC 分析业务包括检测分析服务和电路分析服务。对于电路分析服务，首先由工艺分析部门进行显微图像采集和处理，并由技术分析部门在上述图像库等数据的基础上，进行电路网表提取、电路功能分析，最终获得 IC 电路网表、层次化电路图数据交付客户；对于检测分析服务，由工艺分析部门执行无损检测分析、电性检测分析、物性检测分析、材料分析、平面分析、纵向结构分析等，最终获得制成指标、成分指标等数据或信息交付客户。

2、知识产权和资讯业务

知识产权和资讯业务包括知识产权服务、产品资讯和图像资讯。关于知识产权服务，一般由 IC 知识产权工程师利用 IC 分析成果，依托知识产权检索引擎等工具，开展专利侵权分析、集成电路布图设计侵权鉴定、专利产品映射（PPM）和现有技术查询等服务，形成专利分析报告或布图匹配度指标等交付客户；关于图像资讯，公司根据客户要求，完成封装解剖、层次去除等步骤后，经 EDA 软件完成显微图像自动采集、海量图像自动拼接对准后，形成显微图像数据库并交付客户；关于产品资讯，主要为公司基于市场信息，选取具有代表性或关注度的芯片类型及型号进行分析，得到竞争力分析、概要资讯、显微图像资讯、电路分析数据等，并形成集成电路大数据平台。客户通过集成电路大数据平台网站和公众号了解公司的数据范围，匹配自身研发和竞品分析需求，向公司采购平台中数据或报告。

3、IC 设计业务

关于设计服务，公司根据客户需要完成相关设计服务，并将技术服务成果交付客户；关于 IP 授权，主要系公司对外授权 IC 设计数据模块，该等数据已经验证，可直接交付客户或代工厂使用；关于自有芯片销售，为公司在完成自有芯片产品的自主研发后，在获取客户批量订单后，委托晶圆代工厂、封测厂等完成晶圆制造以及封装测试环节后，向客户销售成品芯片；关于量产服务，公司根据客户的需求，依据公司为客户提供的整包设计服务成果或者客户设计提供的版图或者样片，为其提供量产服务，并向其交付合格的晶圆或者芯片产品。

4、EDA 软件授权业务

在 EDA 软件授权业务开展中，一般由销售团队评估客户需求，以软件直接授权或与其他技术服务捆绑销售的方式，将软件及相关授权文件（License）交付客户使用；具体授权方式包括按项目授权及按周期授权等。

（四）营销模式

公司设立销售部，负责市场推广及营销工作。同时，制定了《销售管理制度》《销售管理规范》等，针对重点下游领域或行业，进行精细化的客户管理和开发，响应其售前/后需求、保持紧密协作。公司各类解决方案主要面向 IC 设计企业、集成器件制造商、电子产品系统厂商、科研院所、司法鉴定机构以及律师事务所等终端用户。通常情况下，公司通过半导体产业相关技术研讨会/论坛/展会/杂志，以及战略客户长期合作、潜在客户拜访宣传等多种渠道收集需求信息、树立业内品牌。

七、创新特征

（一）创新特征概况

√适用 □不适用

设立至今，芯愿景面向 IC 设计企业、集成器件制造商、电子产品系统厂商、科研院所、司法鉴定机构及律师事务所等客户群体，在工业、消费电子、计算机及通信等领域，针对各类半导体器件从事 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务，以及多种 EDA 软件的授权业务。公司先后获批“国家高新技术企业”“北京市企业技术中心”“北京市专精特新中小企业”“北京市知识产权试点单位”等资质和平台，并获得北京市科技进步二等奖。

芯愿景自主研发了八大软件产品线、40 余款软件产品，覆盖了集成电路检测和失效分析、电路分析、知识产权分析、数字电路设计、模拟电路设计和设计验证等环节。累计发放授权认证超过 40,000 个，EDA 软件用户群包括国内外芯片设计公司、研究所、高校和知识产权服务机构等。

在 IC 分析业务领域，芯愿景依托自有工艺分析实验室和自主 EDA 软件的集成电路分析服务，在产品开发、科学研究、司法鉴定等领域形成了丰富的解决方案库。目前可以分析的最先进制程已达到 3 纳米，单个项目最大规模超 100 亿个晶体管，最大金属层数达到 20 层。产品工艺类型包括 CMOS、BiCMOS、Bipolar、BCD 等；产品衬底材料包括体硅、SiC、GaAs、InP、SiGe、SOI 等；产品应用领域包括 CPU、MCU、RF、FPGA、ADC、DAC、PM、Image Sensor、DRAM、Flash 等。芯愿景为半数以上的全球半导体领导厂商提供过知识产权分析鉴定服务，技术能力和专业水平得到了客户、法院、知识产权鉴定机构和律师事务所的广泛认可。

在 IC 设计业务领域，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得 194 项布图设计专有权。依托 IC 设计的核心技术，形成具有技术独创性的设计成果，满足客户的进步性需求。在此基础上，公司针对微控制器、电源管理、汽车电子、工控、数字信号处理等多个领域，形成 ASIC/SoC “一站式定制”服务能力。同时，公司建立了自有芯片产品品牌 Funcience，专注于工业机器人、运动控制、工业自动化和通信等领域的芯片设计与研发。此外，公司还开发了嵌入式安全防护类、工业物联网与控制类、通用基础类 IP 等二十余款 IP 产品，具备高可控性及高兼容性，其功能及应用领域将持续扩展。

（二）知识产权取得情况

1、专利

√适用 □不适用

序号	项目	数量（项）	继受取得数量（项）
1	公司已取得的专利	41	6
2	其中：发明专利	37	5
3	实用新型专利	4	1
4	外观设计专利	-	-
5	公司正在申请的专利	13	-

2、著作权

√适用 □不适用

序号	项目	数量（项）
1	公司已取得的著作权	89

3、商标权

√适用 □不适用

序号	项目	数量（项）
1	公司已取得的商标权	64

（三）报告期内研发情况

1、基本情况

√适用 □不适用

1、研发方向

公司结合行业、技术的发展方向，以客户需求为导向开展研发工作。

目前，公司的研发方向包括：第一，通过优化 EDA 软件及工艺分析实验平台，实现 IC 分析、设计的方法及工艺升级；第二，针对市场对集成电路资讯的需求，建设完善 IPBrain 集成电路大数据平台，提升对相关市场的服务及渗透能力；第三，顺应 IC 产业发展趋势，探索产品定制化解决方案开发；第四，根据半导体产品共性需求，研究关键 IP 的设计方法、扩充 IP 技术平台。目前，公司开展的主要研发方向包括 IC 分析工艺研究及 EDA 软件产品开发、IC 设计等。

2、研发组织情况

公司设立首席科学家，发挥其在研发方向协同、重大技术路线和方案决策等方面的核心作用；设立研发总监，负责研发计划起草、研发项目审批及管理；组建以核心技术人员、研发团队带头人

及项目负责人为基础的研发团队，落实研发计划及技术创新方案。针对具体研发工作，公司实施“研发课题制”管理，由北京总部、保定分公司及天津子公司的研发团队进行专业/职能分工，协同工艺/技术/专利分析等业务团队共同完成。

公司制定了《研发管理制度》《应用软件研发管理办法》《芯片产品研发管理办法》《IP 产品研发管理办法》《研发环境安全管理规定》等研发相关的内部控制制度，并严格、有效执行；同时，公司与相关研发人员签署《员工保密协议》《竞业禁止协议》等，防范技术失密风险。

3、技术创新机制及安排

（1）市场导向的研发机制

公司的研发方向、技术路线，坚持以市场及客户需求为导向，不断与最先进半导体制造工艺、最前沿半导体产品保持同步发展。在具体项目的前期评估、论证中，公司进行较为全面、深入的市场调研，充分收集客户需求、吸收同行业观点，在多层级审核、交叉论证的基础上，确定项目执行计划。此外，公司积极探索行业发展变化情况，自主开发产业前沿技术，保持核心技术的前瞻性、先导性，保障服务整体的竞争力。

（2）系统规范的项目管理

公司实施研发“项目制”管理，并以北京总部、保定分公司、天津子公司、太原子公司的研发团队主导，协同业务团队，进行项目分配、任务分解、跨专业协作，共同执行研发项目。同时，公司建立健全《应用软件研发管理办法》《芯片产品研发管理办法》等研发项目管理制度，对每个项目的研发流程、岗位分工、执行质量、风险防控等进行制度化管理。系统规范的研发项目管理，保障了公司研发工作整体有序、高效的推进。

（3）科学高效的团队建设

公司重视技术研发团队建设，针对不同岗位分工要求，建立人才培养及引进机制。具体而言，公司组建 EDA、IC 工艺、IC 设计等研发团队，分别培养并引进计算机软件、化学与材料、微电子等专业人才，形成部门统筹管理、分工职责明晰的团队组织机制。此外，公司定期举行技术培训、外部研讨交流等活动，在研发团队内部形成知识共享氛围，保持对前沿技术的敏感度。

（4）合理有效的团队激励

公司制定了《薪酬管理制度》《分析项目奖金管理办法》《产品研发奖金管理办法》《专利申请奖励办法》等，对研发团队绩效考核、岗位晋升、创新激励进行明确约定。具体而言，公司将技术创新成果作为绩效考核的重要指标，鼓励员工在研发项目实施中，进行技术钻研及成果转化。同时，公司设立员工持股平台、授予相关核心技术人员一定的股权份额。这实现了其与公司长期发展利益的绑定，增强了归属感和责任担当。上述安排有效调动、激发了研发团队整体的积极性和创新能力，使得技术创新持续涌现。

2、 报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元

研发项目	研发模式	2024 年度	2023 年度
先进集成电路大数据平台技术研究	自主研发	1,196.03	1.39
高性能数字信号处理 SOC 的 IP 研发	自主研发	1,180.23	
通用参数化版图单元设计 EDA 软件研发	自主研发	822.91	713.63
工业控制系统芯片产品设计	自主研发	469.80	170.37
面向集成电路智能分析的 EDA 系统研发(二期)	自主研发	466.50	
数字 IP 调试及验证 EDA 技术	自主研发	316.92	
面向应用处理器的专利数据库研究	自主研发	253.24	1,594.68
高端数字 IP 研发	自主研发	160.44	249.30
通用及车载 SOC 通用 IP 研发	自主研发	117.66	200.25
数据收发类相关 IP 研究与开发	自主研发	108.39	71.98
先进芯片电路数据库研究开发	自主研发	88.07	20.97
安全加密类相关 IP 研究与开发	自主研发	79.97	70.45
传感器芯片产品设计与验证	自主研发	78.71	21.11
先进处理器芯片工艺分析技术研究	自主研发	77.22	
智能高精度微型压力采集系统芯片技术研究	自主研发	69.29	210.18
DSP 核心技术和 IP 产品研发	自主研发	28.28	
工业总线及以太网 IP 及芯片产品研发	自主研发	22.48	
数字电路后端时序验证和优化 EDA 技术研究	自主研发	9.00	457.07
工业服务器高速总线 IP 研发	自主研发	0.55	1,044.06
亿门级数字电路架构分析与逻辑还原 EDA 技术研究	自主研发	0.05	279.95

面向集成电路智能分析的 EDA 系统研发	自主研发		133.76
电源驱动 IP 研发	自主研发		55.97
通用数模/模数转化类 IP 研发	自主研发		37.86
高速接口协议 IP 研发	自主研发		20.54
芯片自主可控度评估技术基础研究	自主研发		3.50
合计	-	5,545.75	5,357.02
其中：资本化金额	-	-	-
当期研发投入占营业收入的比重	-	23.36%	24.93%

3、 合作研发及外包研发情况

☐适用 ☒不适用

（四） 与创新特征相关的认定情况

☒适用 ☐不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
“科技型中小企业”认定	☐ 是
“技术先进型服务企业”认定	☐ 是
其他与创新特征相关的认定情况	-
详细情况	1、2024 年 10 月公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年； 2、2023 年 12 月公司由北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期 3 年； 3、2024 年 12 月公司由北京市知识产权局认定为北京市知识产权局试点单位。

八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

（一） 公司所处（细分）行业的基本情况

1、 所处（细分）行业及其确定依据

公司的主营业务是依托自主开发的电子设计自动化（EDA）软件，开展集成电路分析业务、知识产权和资讯业务以及集成电路设计业务。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“集成电路设计”（I6520）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引（2023 年修订）》，公司所属行业为“集成电路设计”（I6520）。

2、 所处（细分）行业主管单位和监管体制

序号	（细分）行业主管单位	监管内容
1	工信部	工业和信息化部主要职责是拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划；制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。
2	中国半导体行业协会	中国半导体行业协会主要负责贯彻落实政府产业政策，主要职责为落实产业及市场的调查、统计、研究和预测，对会员企业提供引导、咨询服务；贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议，并代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。
3	中国软件行业协会	中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、行业协调；为会员企业提供公共服务、行业自律管理；受工信部委托对各地软件企业认定机构的工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性。

3、 主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

（1） 主要法律法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	产业结构调整指导目录（2024 年本）	国家发展改革委令 7 号	国家发改委	2023 年	集成电路设计，集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产（含掩模版、8 英寸及以上硅片生产），集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产，和球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SIP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试，集成电路装备及关键零部件制造。
2	“十四五” 国家信息化规划	-	中央网络安全和信息化委员会	2021 年	加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、

					微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。加强人工智能、量子信息、集成电路、空天信息、类脑计算、神经芯片等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。
3	“十四五”数字经济发展规划	国发[2021]29号	国务院	2022 年	瞄准集成电路、大数据、人工智能等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力。提升产业链关键环节竞争力，完善集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。
4	“十四五”国家知识产权保护和运用规划	国发[2021]20号	国务院	2021 年	健全高质量创造支持政策，加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件等领域自主知识产权创造和储备。健全知识产权法律法规，完善集成电路版图设计法规。
5	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	-	全国人民代表大会	2021 年	加强关键数字技术创新应用，聚焦高端芯片、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发。推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人等产业创新发展。
6	中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议	-	中共中央	2020 年	强化国家战略科技力量，瞄准人工智能、集成电路、脑科学等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。制定实施战略性科学计划和科学工程，推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。
7	新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策	国发（2020）8 号	国务院	2020 年	明确集成电路产业在信息产业中的核心地位，从财税、投融资、研究开发、进出口、知识产权、市场应用等八个方面大力支持集成电路产业发展。对集成电路生产企业或项目最高按照十年免征所得税。

8	关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见	发改高技[2020]1409号	发改委、科技部、工业和信息化部、财政部	2020 年	加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。
9	战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）	-	国家发改委	2017 年	明确集成电路等电子核心产业地位，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业重点产品和服务。明确了“集成电路芯片设计及服务”与“集成电路芯片产品”均属于电子核心基础产业，属于战略性新兴产业重点产品和服务，符合国家支持方向。
10	关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知	发改高技[2016]1056号	国家发改委、工信部、财政部、商务部、国税总局	2016 年	重点集成电路设计领域包含 IP 及设计服务、工业芯片、物联网和信息安全芯片等。
11	国家创新驱动发展战略纲要	-	国务院	2016 年	加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障。攻克高端通用芯片、集成电路装备等方面的关键核心技术，形成若干战略性技术和战略性产品，培育新兴产业。
12	关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知	国 发〔2016〕43 号	国务院	2016 年	将集成电路装备等列为国家科技重大专项，发展关键核心技术，着力解决制约经济社会发展的重大科技问题。
13	国家集成电路产业发展推进纲要	-	国务院	2014 年	着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展。近期聚焦移动智能终端和网络通信领域，开发量大面广的移动智能终端芯片、数字电视芯片、网络通信芯片、智能穿戴设备芯片及操作系统，提升信息技术产业整体竞争力。

（2）对公司经营发展的影响

公司处于集成电路产业链芯片设计环节中的芯片设计服务细分领域，集成电路产业作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业，是现代信息产业的基础和核心产业之一，是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。

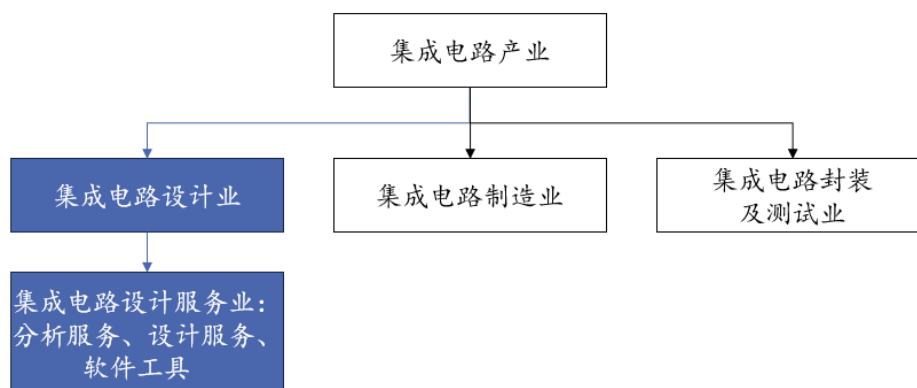
近年来，国内社会各界对集成电路发展的重视程度不断提升。近年来，国家相关部门针对集成电路行业出台多项支持性文件，进一步为国内集成电路行业发展及上下游产业生态的构建起到了促进作用，为公司持续稳定的经营发展提供了良好引导作用和外部政策环境。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等政策，国家明确了集成电路等电子行业的核心产业地位，大力支持集成电路行业的发展。

综上所述，公司主要产品和业务符合国家相关产业政策和国家经济发展战略的要求。公司所处行业的监管体制、法律法规、行业标准和相关产业政策为发行人提供了良好的经营环境和发展机遇。

4、（细分）行业发展概况和趋势

（1）公司的行业定位

公司的主营业务是依托自主开发的电子设计自动化（EDA）软件，开展集成电路分析业务、知识产权和资讯业务以及集成电路设计业务。属于“半导体产业→集成电路产业→集成电路设计业→集成电路设计上游支撑环节”的细分领域，为 IC 设计行业上游支撑环节。



①集成电路设计行业简介

IC 设计行业处于产业链的上游，负责芯片的开发设计，分析定义各类目标终端设备的性能需求、产品需求，结合晶圆制造技术、封装技术、测试技术等，设计出符合市场需求的芯片产品。

②集成电路上游支撑环节简介

集成电路上游支撑环节即为集成电路设计提供服务的产业，其核心是面向集成电路设计公司与系统厂商等客户的芯片开发需求，通过技术授权、方案设计、流程优化等方式，助力客户高效完成

芯片开发并实现量产。一般而言，IC 设计服务厂商主要涵盖芯片设计服务公司、芯片分析检测服务公司与 EDA 工具供应商等。该等业务的出现，可使得 IC 设计者、系统厂商更好的发挥核心优势，专注提升产品竞争力。集成电路上游支撑环节的主要服务包括：

服务类型	含义
集成电路设计服务	帮助客户完成芯片定制设计、IP 授权、芯片验证以及根据客户需求提供对应产品的芯片量产服务。其中，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等生产环节，集成电路设计服务企业采用委托第三方企业代工的方式完成。
EDA 软件工具授权	提供 EDA 软件工具的授权。EDA 软件作为集成电路领域的上游基础工具，贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节。
集成电路分析检测服务	分类为第三方实验室技术检测服务和集成电路分析服务。 ①第三方实验室技术检测服务是为客户提供第三方技术检测实验，包括失效分析、材料分析和可靠性分析，帮助客户定位缺陷，实现产品质量提升与工艺技术升级。 ②集成电路分析服务主要是指对 IC 产品进行拆卸、测绘、分析等，是 IC 领域内获取新技术、设计思路、发现设计缺陷和改进现有技术的重要技术手段，有利于缩短技术探索周期，降低新技术研发成本和风险，提升产品性能指标及良品率，在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。

③集成电路分析行业简介

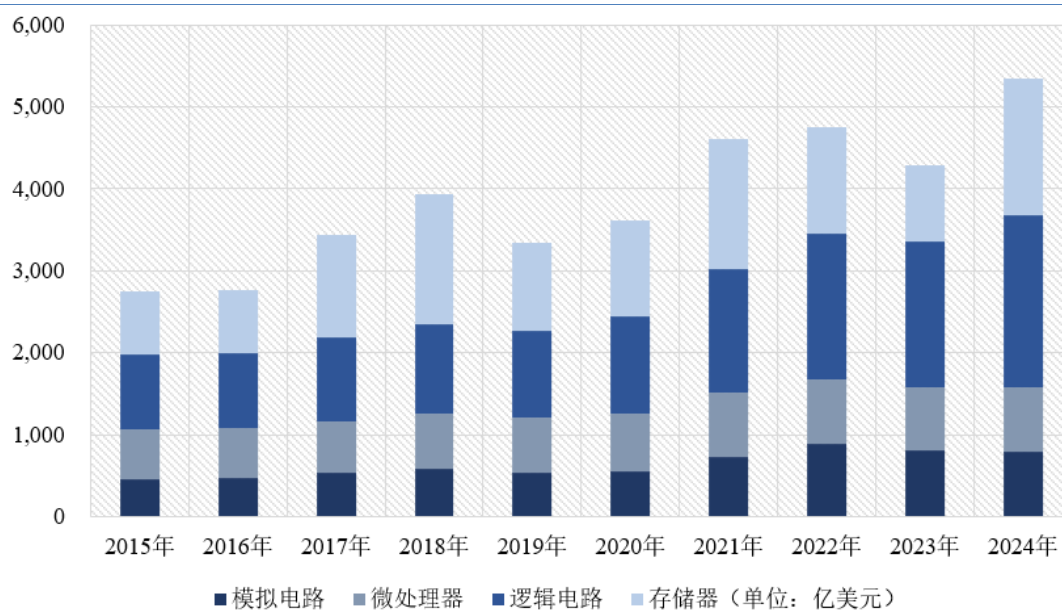
集成电路分析服务主要是指对 IC 产品进行拆卸、测绘、分析等，是 IC 领域内获取新技术、设计思路、发现设计缺陷和改进现有技术的重要手段，有利于缩短技术探索周期，降低新技术研发成本和风险，提升产品性能指标及良品率，在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。随着 IC 产品集成度的提升，IC 分析的工程量陡增，专用于 IC 分析的 EDA 软件愈发成为细分领域内的核心竞争力。

从集成电路分析的产业链结构来看，行业上游主要是提供检测设备、化学试剂及其他耗材的生产制造商等；中游主要是集成电路分析厂商，集成电路分析厂商可分为 IC 分析企业（有实验室）、IC 分析企业（无实验室）、第三方技术检测实验室；下游则是半导体产业链各类型的检测报告使用者，包括芯片设计、晶圆制造及芯片封装、终端设备制造厂商等。

（2）集成电路行业发展概况和趋势

①全球集成电路行业发展概况和趋势

根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）的统计数据显示，2015 年至 2018 年期间，全球集成电路行业呈现快速增长趋势，行业规模由 2,744.84 亿美元增长至 3,932.88 亿美元，年均复合增长率为 12.74%。2019 年，全球集成电路产业总收入为 3,333.54 亿美元，较 2018 年度下降 15.24%。随着 5G 通信、物联网、人工智能等下游应用市场需求的持续增长，2021 年度市场规模快速增长。2022 年以来，受到宏观经济下行压力、下游消费电子行业需求疲软等影响，集成电路行业景气度有所调整，增速放缓。据全球半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2023 年全球集成电路销售额为 4,284.42 亿美元。



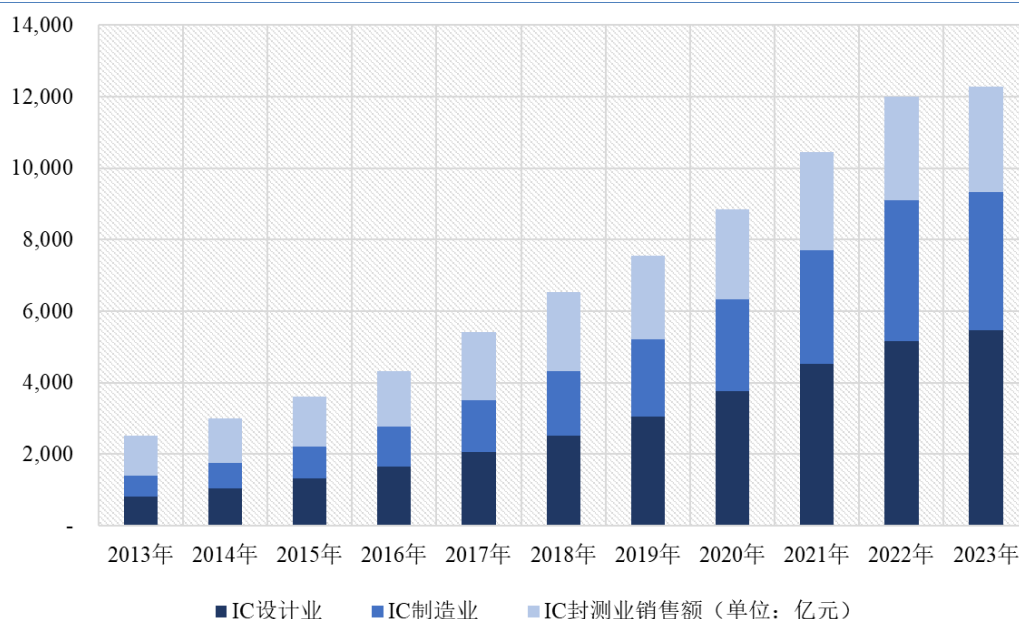
数据来源: WSTS

根据 WSTS 于 2024 年 12 月发布的半导体市场预测, 虽然 2023 年全球半导体市场预计将负增长, 但在存储芯片及逻辑芯片等推动下, 全球半导体市场未来两年将迎来强劲复苏, 2024 年全球半导体市场规模同比增长 19.0%, 有望达到 6,270 亿美元, 2025 年预计同比增长 11.2%, 达到 6,970 亿美元。此外, 根据 ICInsights 预测, 2022 年至 2026 年市场将呈现 6.5% 的年平均增长率。

②中国集成电路行业发展概况和趋势

受相关产业政策支持, 以及下游应用领域需求旺盛等因素的影响, 本世纪以来中国大陆地区集成电路产业实现了跨越式发展, 并快速追赶半导体发达国家和地区的工艺水平。

根据中国半导体行业协会发布的数据, 2019 年至 2022 年期间, 我国集成电路产业销售额逐年提高。2023 年中国集成电路产业销售额达 12,276.9 亿元人民币, 同比增长 2.3%。其中, 设计业销售额为 5,470.7 亿元, 同比增长 6.1%。



(3) 集成电路设计行业发展概况和趋势

集成电路设计主要是根据终端市场需求，设计开发各类 IC 产品，属于典型的技术、资金密集型业务。其在很大程度上决定了终端产品的功能、性能及制造成本等属性，是 IC 产业中对科研实力和技术水平要求较高的环节。目前，IC 设计者普遍采取垂直整合、IDM 和 Fabless 等模式，设计工作相应由终端制造厂商、集成器件制造商及独立的芯片设计商承担。其中，Fabless 模式以其轻资产、定制化等优势，更好的适应了 IC 产业技术迭代加快、产品开发周期缩短等新要求，成为行业主流经营模式。

本世纪以来，我国大陆地区 IC 设计业持续快速发展。根据中国半导体协会（CSIA）及其下设的集成电路设计分会（ICCAD）统计：第一，从市场规模来看，IC 设计业销售规模从 2013 年的 809 亿元提升至 2023 年的 5,471 亿元，年均复合增长率达 21.07%。第二，从产业结构来看，我国大陆地区 IC 设计业占全产业链比重由 2010 年的 32.24% 增长至 2023 年的 44.56%，整体发展速度高于全产业平均水平。第三，从市场格局来看，2024 年 IC 设计企业达 3,626 家，企业数量最近十年的年均复合增长率为 18.20%。2024 年，前十大设计企业的销售总和为 1762.04 亿元，前十大设计企业占全行业市场规模的比例为 27.3%，行业集中度不高。第四，从区域分布来看，我国大陆地区 IC 设计产业稳定分布于长三角、珠三角、北京、成都、西安等地区；2023 年及 2024 年，设计业规模最大的十个城市（包括上海、深圳、北京、杭州、无锡、南京、西安、武汉、武汉、苏州）IC 设计业销售额分别达 5909.1 亿元和 6689.3 亿元，相关城市销售额过亿元的 IC 设计企业数量分别达 625 家和 731 家，占全国整体比重均较高。

(4) 集成电路设计上游支撑环节发展概况和趋势

集成电路设计产业链升级及分工细化催生了集成电路设计上游支撑环节的诞生。随着芯片产业

在制程工艺方面的发展、芯片生命周期的缩短与设计企业数量的增加，芯片设计企业在市场竞争、开发成本、设计难度与流片风险等方面面临的挑战大幅加剧，芯片设计效率与一次流片成功率成为芯片设计公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势的关键因素。上述因素造成 IC 设计业对工作效率和产品定制化水平的要求持续提高、产业分工持续细化，相关上游支撑环节快速发展。其中，公司主营业务涉及的细分领域主要为：集成电路分析服务、集成电路设计服务、EDA 软件工具授权服务。

①集成电路分析行业发展概况和趋势

A.IC 分析产业发展历程

IC 分析产业起源于美国硅谷。上世纪五六十年代，美国中大型半导体公司纷纷设立各自的 IC 分析部门。随着 IC 产品集成度的提升，产业分工持续细化，出现了一些 IC 分析公司。早期的 IC 分析缺少专业自动化工具，以人工为主。随着 IC 产品集成度的提升，IC 分析所需工程量陡增。目前，开展 IC 分析业务需要持续大额的投资，用以配备和升级实验设备、分析工程师以及专用软件工具。然而，IC 设计企业对 IC 分析的需求量相对其业务总量规模较小，建立专业的 IC 分析部门并不经济。因此，专业的 IC 分析公司逐渐在细分领域中建立优势地位。

此后，通过 IC 分析辅助产品开发的思路和技术，愈发受到产业链各环节企业的重视，成为后进者获取技术信息，实现技术赶超的关键方法。此外，IC 分析亦可应用于半导体专利分析等领域，满足了大型半导体公司在技术保护、侵权规避等方面的需求。近年来，一些境外上市公司也建立了专门提供 IC 分析服务的部门或收购了 IC 分析企业；如在伦敦证券交易所上市的 Oakley Capital Investments Limited（股票代码：OCIL）于 2017 年 5 月收购了 IC 分析企业 TechInsights，在中国台湾上柜的宜特科技股份有限公司（股票代码：3289）和闽康科技股份有限公司（股票代码：3587）等。在全球范围内，北美地区仍是目前 IC 分析技术应用最为发达的地区；我国大陆地区的 IC 分析服务产业及技术起步较晚，全球市场占有率目前仍落后于北美的头部集团。

未来，我国 IC 分析技术水平将紧跟 IC 设计和制造工艺整体的发展步伐，持续实现对最前沿、最先进产品技术工艺的还原及分析，协助开发者跟踪技术情报，并进行再创新；同时，IC 分析技术的应用领域也将不断拓展，在知识产权保护、专利运营、系统厂商合格供应商管理等方面发挥更大作用，从而使 IC 全产业链受益。

B.IC 分析业市场发展情况

IC 分析行业的市场参与者主要包括大型 IC 设计企业自行设立的 IC 分析部门或团队、各类专业化的 IC 分析企业、具备部分 IC 分析能力的技术检测企业等。其市场规模与 IC 设计市场规模的发展方向一致。

在半导体行业较为发达的国家或地区，尤其是对于产业后进者，某一 IC 领域发展初期，IC 分析业务的市场发展与 IC 设计相一致，需求整体较为旺盛；待该领域技术较为成熟时或已达到全球

领导地位时，资讯服务和知识产权服务将受到产业链企业更多的重视。在该等发展规律下，国外 IC 分析市场呈现持续稳定增长态势，不同阶段市场需求存在一定结构性变化。

国内半导体产业在本世纪初，基本上还未形成规模化的 IC 分析需求。随着国内电子信息产业的高速发展，尤其是终端系统产品市场需求的持续爆发，全球半导体产业迎来第三次产业转移趋势；在此过程中，市场需求、技术创新、国家政策和资源配置共同作用，为我国 IC 分析产业提供了加速发展的机遇。

2021 年 12 月 16 日，国家知识产权局出具《答复函》（信复字[2021]第 072 号），确认企业以评价、分析、研究、教学等目的把集成电路拍照工作委托给专业的集成电路拍照服务公司，专业集成电路拍照公司承接以上委托任务后，根据设备折旧和人工费等确定照片单价，并按照张数收取拍照费用的行为不违反《集成电路布图设计保护条例》的相关规定。

未来，国内 IC 市场需求的持续旺盛、知识产权保护意识的加强及相关产业配套的成熟，将成为上述市场扩容的关键因素。

②集成电路设计服务行业发展概况和趋势

芯片设计服务公司主要服务于芯片设计与系统厂商等客户，并满足其芯片定制需求。与芯片设计公司相比，芯片设计服务公司亦主要从事芯片设计工作，但芯片设计服务公司较少通过销售自有品牌芯片产品实现收入，而是依托自身芯片设计能力为客户提供定制服务，并最终形成客户品牌产品。

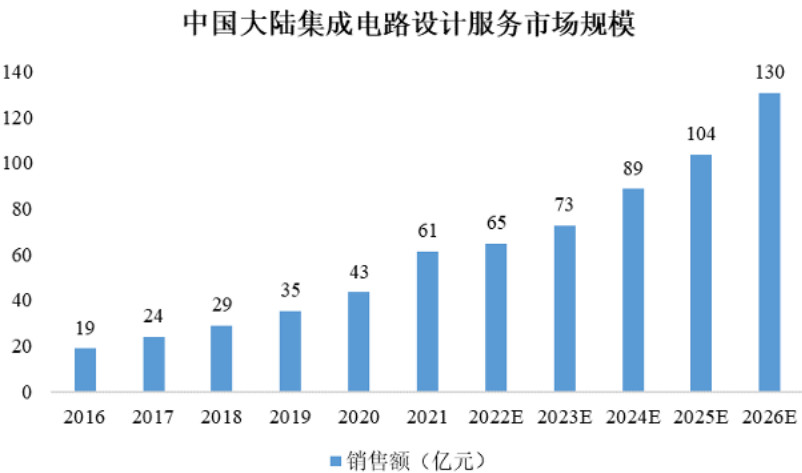
根据中商产业研究院统计，随着全球数据中心、智能物联网设备等领域蓬勃发展的情况下，芯片设计公司、系统厂商等对设计服务的需求有望不断上升。2021 年全球集成电路设计服务市场规模约为 193 亿元，自 2016 年以来的年均复合增长率约为 10.6%。随着设计服务的需求不断增大，预计到 2026 年全球集成电路设计服务市场规模将达到 283 亿元。



数据来源：中商产业研究院

经过多年发展，中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，也是全球最大的集成电路市场。

随着 5G、自动驾驶、数据中心、物联网等下游市场需求的涌现与政府良好的产业政策，中国大陆集成电路设计服务产业发展迅速。2021 年中国大陆集成电路设计服务市场规模约为 61 亿元，自 2016 年以来的年均复合增长率约为 26.8%，增速显著高于全球市场。随着本土芯片设计公司的快速发展与系统厂商芯片定制需求的增长，预计到 2026 年中国大陆集成电路设计服务市场规模将达到 130 亿元。



数据来源：中商产业研究院

③电子设计自动化（EDA）软件行业发展概况和趋势

EDA 是集成电路设计的必备工具，用于辅助设计人员进行电路设计、仿真和验证等工作，贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节。

EDA 软件行业主要受技术驱动，具有较高的技术、人才储备、用户协同、资金规模等壁垒，市场集中度较高。长期以来，中国 EDA 市场由国际 EDA 企业 Cadence、Synopsys、Siemens EDA 三大巨头垄断，根据中商产业研究院统计，前三大企业占比超 70%。

随着半导体产业第三次产业转移的持续深化，我国 EDA 软件市场逐步激活，出现了华大九天、概伦电子、广立微电子等本土厂商；相关厂商在特定领域具备全流程产品，或在局部领域处于技术先进位置。目前，国产 EDA 软件在项目定制化、产品兼容度等方面优势显现。根据中商产业研究院统计，2023 年，中国 EDA 市场规模达到了 120 亿元，约占全球 EDA 市场的 10%。预计 2024 年中国 EDA 市场规模将达到 135.9 亿元。

5、（细分）行业竞争格局

（1）行业竞争格局

①IC 设计业整体竞争格局

IC 设计行业专业性强，细分市场众多，各个细分领域之间存在一定的技术壁垒。受制于研发力量及资本投入规模，中小企业一般选择某一细分市场进行深入的技术开发，通过长期的技术积累形

成技术壁垒和产品优势，在细分领域取得先发优势，占得一定的市场份额；大型传统厂商芯片产品类别众多，研发项目较为分散，但该等企业可以凭借研发力量、资本投入等优势快速积累技术，并依靠其较为成熟的销售体系和客户网络迅速开展产品推广，从而形成大型厂商与中小企业并存的充分竞争格局。

②IC 分析行业竞争格局

IC 分析行业市场参与者主要包括大型 IC 设计企业自行设立的 IC 分析部门或团队、各类专业化的 IC 分析企业、具备部分 IC 分析能力的第三方技术检测实验室等。由于相关 IC 分析成本在 IC 设计的综合成本中占比较低，长期以来市场中未形成具备绝对规模或技术优势的巨头企业，整体市场集中度维持在较低水平。

国外市场在发展初期 IC 分析需求旺盛，成熟期后需求转向资讯服务及知识产权服务等方面；整体上，市场呈现持续稳定增长态势，不同阶段市场需求存在一定结构性变化。其中，专业从事 IC 分析的公司主要为 TechInsights，其为上市公司子公司；整体从业年限长、技术先进、市场份额较高，其他分析类公司与其相比竞争优势较小。其他检测类公司还包括中国台湾上柜公司闼康、中国台湾上柜宜特等；该等公司以技术检测为主业，其中部分公司，如闼康、宜特使用相关实验设备承接部分 IC 分析项目。此外，行业内还存在一些非上市企业，如日本 LTEC 公司、法国 Evans Analytical 等。

国内相关市场及技术发展起步较晚，近二十年经历了快速产业化落地过程。公司是国内 IC 分析市场的重要参与者。此外，还有中国科学院自动化研究所 ASIC 研究中心等规模较小的机构及企业。最早从事商业 IC 分析服务业务的圣景微电子（上海）有限公司已于 2008 年被 TechInsights 收购。其他检测类公司还包括科创板上市公司胜科纳米、苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司等。

随着集成电路产品的设计规模不断增加、工艺制程不断缩小，仅凭人工分析的工作方式难以为继。在此背景下，高效的 IC 分析 EDA 软件是行业持续发展的必要条件。

目前，市场上 IC 分析领域的重大事项包括：2008 年，UBM 公司收购国内较早从事 IC 分析服务的圣景微电子（上海）有限公司，将其并入 TechInsights；2016 年 6 月，TechInsights 与另一家 IC 分析服务提供商 Chipworks 合并；2017 年 5 月，TechInsights 被 Oakley Capital Investments Limited（伦敦交易所上市公司，股票代码：OCIL）收购，OCI 主要投资领域是技术、消费品与教育领域。中国台湾的宜特科技股份有限公司（台湾上柜公司，股票代码：3289）和闼康科技股份有限公司（台湾上柜公司，股票代码：3587）将其业务领域向芯片分析业务拓展。

（2）行业内的主要企业

①行业内主要企业

A.IC 分析检测服务企业

a.TechInsights

TechInsights,Inc., 曾用名 Semiconductor Insights, 成立于 1989 年 6 月, 总部位于加拿大渥太华。2007 年, Semiconductor Insights 被 United Business Media 收购, 成为其 TechInsights 事业部。2008 年, UBM 公司收购国内较早从事逆向工程服务的圣景微电子(上海)有限公司, 将其并入 TechInsights 事业部。2013 年, TechInsights 成为独立公司, 并于 2016 年 6 月与另一家逆向工程服务提供商 Chipworks, Inc. 合并。2017 年, TechInsights 被 Oakley Capital Investments Limited (股票代码: OCIL) 收购, OCI 主要投资领域是技术、消费品与教育领域。目前, 该公司是全球技术咨询及知识产权管理领域的领导者。其主要服务内容包括: 半导体逆向工程、电子系统拆解分析; 市场、产品及技术相关的商业情报报告; 专利及商业秘密侵权分析、在先技术检索、专利申请方向建议、收费专利组合构建管理等。

b.胜科纳米

胜科纳米(苏州)股份有限公司, 是行业内知名的半导体第三方技术检测实验室, 主要服务于半导体客户的研发环节, 可以为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的检测实验。公司深耕半导体技术检测行业多年, 技术检测实验覆盖范围广泛全面, 掌握的技术检测技术应用于集成电路、分立器件、光器件、传感器、显示面板等众多领域, 客户类型覆盖芯片设计、晶圆代工、封装测试、IDM、原材料、设备厂商、模组及终端应用等半导体全产业链。通过精准可靠的检测技术、全面多元的测试项目、高效及时的响应速度、有效完善的研发体系、优质丰富的客户资源以及布局合理的营销服务网络, 公司在半导体检测领域形成了突出的品牌效应, 目前已累计服务全球客户 2,000 余家。

c.宜特

宜特创始于 1994 年, 2004 年于中国台湾上柜。宜特以 IC 线路除错以及芯片线路修改业务起家, 目前主要业务涵盖失效分析、可靠度验证、材料分析、污染物分析等, 协助芯片除错、分析, 巩固质量, 解决客户的痛点, 扮演加速客户产品上市的研发伙伴。2019 年, 宜特向苏州苏试试验集团股份有限公司出售旗下子公司上海宜特, 自出售后, 宜特不再在大陆地区开展半导体检测分析业务, 目前其半导体检测分析主要位于中国台湾地区。

d.闳康

闳康创始于 2002 年, 2009 年于中国台湾上柜。闳康以半导体材料分析见长, 并逐步构建失效分析、可靠度验证实验室。闳康扮演产业界的研发服务中心, 主要业务在于提供 IC 供应链上 IC 设计、制造、封装、测试等各阶段所需的分析服务, 具体业务范围涵盖电子产品设计阶段的快速除错与实体验证, 以及微、纳米产品元件故障区域的精准定位、结构观察、材料成分等各种静态、动态测试分析等, 相关检测分析可应用于半导体相关产业(包括 IC 设计、制造、封装测试)、材料供应商(硅基、晶圆、三五族、玻璃等)、设备商、光通信等产业。目前, 闳康实验室布局在中国台

湾、上海、厦门、苏州、日本等地。

B.IC 设计服务企业

①芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司，成立于 2001 年 8 月，该公司是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、“一站式 IC 定制”服务和半导体 IP 授权的企业。其专注于全球 IC 产业前沿的芯片定制技术和半导体 IP 技术进行持续研发；在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等先进工艺和制程上具有较强的设计能力。该公司拥有多种 IC 定制解决方案、处理器 IP、数模混合 IP 和射频 IP；业务范围覆盖消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等行业领域。

②国芯科技

苏州国芯科技股份有限公司，成立于 2001 年 6 月，是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。

③创耀科技

创耀（苏州）通信科技股份有限公司，成立于 2006 年 8 月，是一家专业的集成电路设计企业，主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务。公司致力于结合市场需求，将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务。

（3）EDA 软件销售企业

①华大九天

北京华大九天科技股份有限公司，成立于 2009 年 5 月，主要从事用于集成电路设计与制造的 EDA 工具软件开发、销售及相关服务业务。该公司主要产品包括模拟电路设计全流程 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统和晶圆制造 EDA 工具等 EDA 工具软件，并围绕相关领域提供技术开发服务。公司产品和服务主要应用于集成电路设计及制造领域。

②概伦电子

上海概伦电子股份有限公司，成立于 2010 年 3 月，是一家具备国际市场竞争力的 EDA 企业，拥有领先的 EDA 关键核心技术，致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值，提供专业

高效的 EDA 流程和工具支撑。公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的 EDA 产品及解决方案，主要产品及服务包括制造类 EDA 工具、设计类 EDA 工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。

③广立微

杭州广立微电子股份有限公司，成立于 2003 年 8 月，是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司提供 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

注：上述同行业企业的财务数据来源于其官方网站、招股说明书、定期报告或交易所公告等公开资料。

2、与同行业可比公司的对比情况

（1）IC 分析行业

上世纪九十年代，大型 IC 设计企业/单位自行设立 IC 分析部门或团队的情况较为普遍。本世纪以来，随着产品工艺制程的特征线宽变小、设计规模剧增，分析业务须在设备和研发上持续投入；内设分析部门的方式已不具备经济性。因此，除部分国家专业科研单位具备一定分析能力外，已不存在 IC 设计企业投建分析业务线的情况。

目前，活跃的市场参与者主要包括：各类专业化的 IC 分析企业、具备部分 IC 分析能力的技术检测企业等。专业化的 IC 分析企业又可细分为有实验室和无实验室两类。具体比较如下：

项目	IC 分析企业（有实验室）	IC 分析企业（无实验室）	第三方技术检测实验室
代表企业	TechInsights、芯愿景、TechPats、LTEC	Taeus、IPRG、ICMasters	胜科纳米、闵康、宜特、埃文斯（EAG）、苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司
业务情况	以 IC 分析为主业	以 IC 分析为主业	以失效分析、检测服务等为主业
应用领域	各领域芯片	各领域芯片	各领域芯片
商业模式特点	针对 IC 分析服务市场，通过建立全流程的解决方案，提供专业服务	依赖有实验室的 IC 分析企业提供的基础 IC 分析服务，针对特定客户需求，形成深入的技术服务能力	由于部分用于技术检测的设备也可用于 IC 分析，通过 IC 分析业务实现了更高的设备利用率
IC 分析设备投入情况	大量投入专用分析设备	无设备投入；将与设备相关的工艺分析部分外包给第三方	大量投资用于主业的检测设备；部分设备可用于 IC 分析业务
IC 分析设备利用率	全部用于 IC 分析服务	-	部分设备在其主业和 IC 分析业务中共用
IC 分析研发	对 IC 分析的核心	无 IC 分析技术的研发	对 IC 分析的研发投入较少

情况	技术进行大量投入				
(2) IC 设计行业					
对于 IC 设计服务板块, 公司相关业务及技术处于发展、演进阶段, 在其专注领域具备一定成本优势。与细分领域内上市公司对比情况如下:					
项目	比较内容	发行人	芯原股份 (688521.SH)	国芯科技 (688262.SH)	创耀科技 (688259.SH)
经营情况	IC 设计业务营业收入	4,000-5,000 万元	23 亿元	4-5 亿元	5-7 亿元
	员工规模	700-800 人	1,800-1,900 人	400-500 人	400-500 人
	主要市场	中国大陆	全球市场	中国大陆	中国大陆
	主要收入来源	设计服务、量产服务、IP 授权、自有芯片销售	半导体 IP 授权业务和一站式芯片定制业务	自主芯片及模组产品、芯片定制服务、IP 授权	通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务
	目标客户	IC 设计企业、科研院所、系统厂商	芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等	IC 设计企业/IDM 企业/系统厂商	系统厂商/IC 设计企业
主要产品与服务	IP 授权领域	嵌入式安全防护类、工业物联网与控制类、通用基础类三大 IP 系列, 24 个产品	拥有图形处理器 IP、神经网络处理器 IP、视频处理器 IP、数字信号处理器 IP、图像信号处理器 IP 和显示处理器 IP 六类处理器 IP, 以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。	围绕自主可控 CPU 技术, 拥有 8 种 40 余款嵌入式 CPU 内核	物理层基带 IP、模拟前端 IP 以及嵌入式软件 IP, 均为宽带电力线载波通信芯片的核心 IP
	自有芯片销售/定制服务领域	微控制器、电源管理、汽车电子、工业和自动化控制、数字信号处理、安防监控、物联网等领域	消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等	基于自主可控的嵌入式 CPU 技术提供的芯片定制服务在国家重大需求与信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信领域具有一定的竞争优势	接入网网络通信芯片、电力线载波通信芯片、新一代短距无线星闪芯片、工业通信芯片等

(二) 公司的市场地位及竞争优势

1、公司的行业地位

IC 产业各领域普遍属于技术、资金密集型行业，项目规模沿摩尔定律持续演进。一般而言，前沿技术的演化多通过开发者的增量研发获得。开发者唯有基于既有技术实现创新开发，方能快速进入更先进领域，解决更高层面的技术问题，并持续保有头部客户资源；无法仅通过短期投入，获得有竞争力的技术成果及优势市场地位。公司先后获批“国家高新技术企业”“北京市企业技术中心”“北京市专精特新中小企业”“北京市知识产权试点单位”等资质和平台，并获得北京市科技进步二等奖。报告期内，公司持续跟踪研究行业最前沿技术，实现了 3 纳米 FinFET 产品的分析，单个项目最大规模达 100 亿个晶体管，最大金属层数达 20 层，相关芯片工艺制程及相应的分析技术已达国际领先水平。

公司是国内知名的 IC 分析服务厂商，围绕 IC 分析服务和设计服务打造核心解决方案体系，累计形成各类解决方案近百个，累计服务客户近 3,000 个，业务覆盖下游工业自动化、医疗器械、汽车电子、航空航天、消费电子、计算机相关、通信及周边等多个应用领域，并实现了技术服务出口。目前，公司培养了成熟的研发、项目实施及技术型销售团队，积累了丰富的客户资源及项目经验，成功打造 IC 产业综合服务平台，具备行业内较为领先的市场地位。

2、公司的竞争优势及劣势

（1）技术及解决方案优势

设立至今，公司围绕 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务，进行技术开发创新，并自主开发支撑性 EDA 软件工具。

在 IC 分析业务领域，公司依托六大工艺分析研究实验室（包括软硬件系统分析实验室、化学特性分析实验室、电学特性分析实验室、制造工艺分析实验室、芯片分析实验室、显微图像采集实验室），实现了 3 纳米 FinFET 产品的分析，单个项目最大规模达 100 亿个晶体管，最大金属层数达 20 层。其中，“纳米级工艺处理”解决方案，可针对 Si、GaAs、GaN、SiC 等多种材质，满足 3 纳米工艺、20 层金属布线的去层处理需求；“显微图像采集及处理”解决方案，可进行 4TB 量级图像自动采集，并在 1/2 最小线宽误差内，实现 4TB 量级图像的无缝衔接，最终形成 IC 全景图像合成；“纳米级图像自动识别”解决方案，可支持 4 亿门级网表提取及纠错，实现网表到平面电路图的快速准确转换；“纳米级电路功能分析”解决方案，可支持 2,000 万门级的数字电路分析，自动识别各类功能模块、生成高可读性数字电路图；“布图设计相似度比较”解决方案，具备精准解析和机器学习能力，可高效实现布图设计一致性比对，完成专利与电路图的匹配。

在 IC 设计业务领域，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得 194 项布图设计专有权。依托 IC 设计的核心技术，形成具有技术独创性的设计成果，满足客户的进步性需求。在此基础上，公司针对微控制器、电源管理、汽车电子、工控、数字信号处理等多个领域，形成 ASIC/SoC “一站式定制”服务能力。同时，公司建立了自有芯片产品品牌 Funcience，专注于工业机器人、运动控制、工业自动化和通信等领域的芯片设计与研发。此外，公司还开发了嵌入式安全防护类、工业物联网与

控制类、通用基础类 IP 等二十余款 IP 产品，具备高可控性及高兼容性，其功能及应用领域将持续扩展。

在 EDA 软件领域，公司跟随产业发展规律、先进技术、前沿产品的演进路径，不断进行软件优化升级；相关软件产品构成公司各类业务的核心技术基础，是实现业务全流程优化管理，保持持续较强盈利能力的重要前提。目前，公司八大 EDA 软件产品系列具备如下优势特点：第一，相关产品的开发和运行，综合了软件工程、数据库、图像处理、IC 设计等多领域的技术知识，研发难度相对较高。第二，相关产品覆盖主营业务全流程，具备各工序/环节所需功能模块，包括不限于图像采集及处理、图像识别、网表提取、电路图编辑及整理、版图编辑及验证等。第三，相关产品内嵌大量自动算法，可大幅提升分析及设计效率；相关算法主要支持图像拼接及对准、单元/线网/通孔的自动搜索及连接、网表提取及电路整理的同构匹配及模块复用、电路图化简、单元批量绘制、版图规则检查等功能。第四，相关产品支持一系列工业标准数据格式（OpenAccess、Verilog、EDIF200、GDSII、SPICE、CDL、LEF、DEF 等），具备与主流 EDA 软件的高兼容性和互操作性。

随着新的研发成果、项目执行经验、工艺技巧及分析结论等不断汇集，公司各类解决方案持续优化、不断完善。这是公司保持核心竞争力最关键因素。

（2）项目管理优势

大规模 IC 分析项目需要进行高复杂度的项目管理工作。上亿门量级的 IC 分析规模，往往需要数十乃至上百名工程师同时开展分析工作；在产品时间周期的约束下，项目管理和执行难度较大。公司创新开发了全流程管理架构，在售前/后、项目实施等方面进行制度化管理。其中，针对项目实施，公司对项目审批、项目流程、质量管理、岗位职责等进行统筹规范，形成了严谨、周密的执行机制，以及“跨部门协作”“工作量动态平衡”“多层级分工”等特色模式。

上述机制设置合理，运行高效。第一，业务流程逐层细分，整个项目任务化、环节化、标准化；各工序设定标准作业规范，执行高效率的“流水化作业”流程，降低对单人操作技能的依赖。第二，项目执行团队与部门条线设置形成错配，降低人力资源因素可能对执行效率的影响，并防范数据失密等风险。第三，施行串行工序、交叉复核、分段检查、质量控制等措施，保障项目执行的高品质。因此，各类科学有效的项目管理模式，是公司提供高效高质服务的重要基础。

（3）客户及品牌优势

自公司设立二十多年来，芯愿景业务主要面向 IC 设计企业、集成器件制造商、系统厂商、科研院所、司法鉴定机构等，期间积累了大量长期的产业合作伙伴和丰富的客户资源。公司重要客户中，包括航天科技下属单位、中国电科下属单位、中国电子下属单位等。一方面，上述机构在各自领域具有技术代表性和先进性，对服务商选择极为慎重、严苛，其与公司的合作情况在业内产生了较强的示范效应；另一方面，经过长期稳定的合作，公司与该等客户间，已形成多种定制化解决方案或技术规范。随着合作默契的达成和累积，公司逐步融入多个战略客户的研发体系之中，不断构

筑客户壁垒。目前，凭借为各类客户提供的数万个 IC 分析服务和设计服务项目，公司已在业内树立了良好的服务口碑和信誉；这为公司开拓新市场、达成新合作建立了优势。

（4）领军团队优势

长期以来，公司管理层以创业团队以及各业务条线技术创新带头人为核心。该等人员在 IC 工艺、技术、知识产权分析及设计服务领域深耕多年，专业积累及技术创新经验丰富，且具备行业发展方面的战略视角，以及对市场变化的敏锐判断。相关人员简历参见本节之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（六）公司员工及核心技术（业务）人员情况”。领军团队长期稳定、优势互补是公司长足发展的必要条件。

2、竞争劣势

（1）融资能力有限、渠道单一

为保证及时响应市场需求变化，增强全业务流程的核心竞争力，公司须持续进行大规模的研发投入。目前，除部分房产外，公司可抵押资产较少；融资渠道以股东投入为主。这在一定程度上制约了公司规模扩张及业务拓展。

（2）部分领域的产品类型、技术水平、市场竞争实力距大型设计服务商仍存在差距

在知识产权和资讯领域，相比同行业的 TechInsights 通过大数据平台向客户提供技术报告、专家评论、市场分析、组件定价、物料清单、路线图等订阅服务业务，公司的产品资讯服务处于发展阶段，规模较小；公司知识产权服务开展时间相对较短，对客户需求理解不够深刻，不能完全满足国际专利分析市场的需求。同时，与全球大型半导体设计公司合作的项目数量和金额相对较小，与同行业公司相比存在一定差距。

在 IC 设计领域，公司近年来取得了一定的突破。但由于整体进入时间较晚（设计服务业务于 2009 年起步、IP 开发团队于 2015 年组建），公司在 IP 数量和产品线类型上相比同行业的芯原股份等存在差距。公司“一站式”定制设计服务的技术能力主要面向成熟制程产品，亦与行业领先企业存在差距。同时，公司自有芯片品牌 Funcience 于 2022 年正式建立，处于丰富和完善产品体系及市场推广阶段。以上情况导致公司需要在该业务领域持续投入，以尽快提升公司的技术水平及市场竞争力。

在 EDA 软件授权领域，公司的 EDA 产品主要集中于集成电路分析领域，用于集成电路设计的 EDA 产品以点工具为主，未形成全流程的解决方案，亦未在特定领域（如平板显示/高端数字 SoC 芯片）形成定制设计能力；且相关产品的技术水平与同行业头部企业（如 Cadence、华大九天等）相比存在差距，仅能满足后端设计和优化的细分业务需求。同时，公司客户主要集中于国内市场，且主要作为提供技术服务的载体或工具，增强客户粘性，直接销售取得的收益较小。

（三）其他情况

☐适用 ☒不适用

九、公司经营目标和计划

（一）经营目标

公司持续研发先进的自主 EDA 软件和 IP 产品，不断提升基于核心技术的服务能力，致力于打造具有国际竞争力的 IC 设计创新平台。

凭借工艺分析实验平台、EDA 软件产品线等软硬件设施，成熟的多领域应用解决方案，以及自主 IP 平台技术储备，公司可帮助客户高效高质地完成 IC 分析、知识产权和资讯、产品设计及量产交付。同时，公司坚持服务工艺、方法及工具的同步创新开发，遵循“技术-平台-解决方案”紧密结合的研发路线，持续加强前瞻性、先导性、可复用技术方案研发；保持 IC 分析业务的领先优势，同时大幅提升设计服务和 EDA 软件业务板块。

未来，公司将实施如下发展规划：首先，将进一步优化 EDA 软件，开发新一代设计数据库引擎、加快自动算法及数据交互技术升级，强化核心竞争优势；其次，针对市场对集成电路资讯的需求，建设完善 IPBrain 集成电路大数据平台，提升对相关市场的服务及渗透能力；再次，开发行业覆盖更广、技术成熟可靠度更高的设计服务解决方案，满足物联网相关高性能 IC 发展需求；最终，针对各类 IC 产品的共性需求，研究关键 IP 的设计方法和技术平台，择机通过投资及并购扩充技术储备，继续扩大市场份额。

（二）公司经营计划

公司将依托自主研发的集成电路 EDA 软件，持续打造具有国际竞争力的集成电路服务和设计厂商。

1、技术研发

公司未来将继续加大基础性、关键性核心技术的研发投入。

公司将针对集成电路工艺迈向 3 纳米、设计规模达到百亿晶体管级的趋势，研发新一代的设计数据库引擎作为未来 EDA 软件的基石；结合深度学习等领域的最新技术发展，加快自动算法的升级改造；研究更高效精确的设计数据交互技术，实现与第三方 EDA 系统的无缝互操作。

公司将针对物联网芯片和高端数字芯片的共性需求，研究工艺可迁移的 IP 产品设计方法和技术平台，建立基于 FPGA 的数模混合电路的验证、评价和调试平台，突破一系列关键 IP 的核心技术，扩充技术储备，形成更完善的 IP 产品组合。

2、市场开拓

公司将加强市场服务能力和推广力度。针对市场对集成电路资讯的需求，建设完善 IPBrain 集成电路大数据平台，进一步提升市场渗透率和服务能力。针对物联网普及化的趋势，以及高性能集成电路发展的需求，公司将提供更加成熟可靠的设计服务解决方案，扩大行业区域覆盖率，并在细分领域形成更强的 IP 产品和设计服务的竞争优势。

3、团队建设

目前，根据持续增长的订单情况，公司建立健全内部组织架构、优化人力资源管理制度，实施核心员工激励计划；并大幅扩充各条线团队规模、加强配套专业培训。上述措施为公司快速发展奠定了团队基础。

未来，公司将进一步扩大和优化团队。针对持续扩大的市场需求，公司将招募更多的技术人员以扩大服务能力；同时加强技术人员培训、选拔更多的各级管理人员，从技术和管理上提升团队能力；提高公司北京、保定、天津、太原等各办公地点的沟通效率。针对越来越大的团队规模，公司将提升人力资源管理能力，强化企业文化建设。对发展急需的人才，公司将探索和建立人才引进机制。公司将继续加大项目奖金、股权激励等措施，提升团队活力和战斗力。

第三节 公司治理

一、 公司股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一） 公司股东会的建立健全及运行情况

公司股东大会/股东会为公司最高权力机构，公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，赋予股东大会/股东会行使决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等决定性权力。同时，上述制度对股东大会/股东会如何运行作出了清晰且具有可操作性的规定。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司历次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署均按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作，股东大会召开及决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及其他法律法规规定行使职权的情况。

（二） 公司董事会的建立健全及运行情况

董事会为公司股东大会/股东会的执行机构，在股东大会/股东会授权下负责公司经营决策及业务发展，制订公司的年度财务预算方案、决算方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，行使法律、法规、规章、公司章程规定的及股东大会/股东会授予的其他职权。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，由董事会过半数董事选举产生。公司依照相关法律、法规及《公司章程》制定了《董事会议事规则》，对董事的任职资格、权利及义务，董事会职权及议事规则作了详细规定，指导董事会规范运行。

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，公司历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作，董事会召开及决议内容合法有效，不存在董事违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

董事会中审计委员会的设置及运行情况

√适用 □不适用

审计委员会设置及运行情况	是/否
审计委员会的职权范围、成员构成符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定	是

审计委员会会议的召开程序、表决方式符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定	是
《公司章程》已载明审计委员会的组成、职权、程序、运行机制及议事规则	是

具体情况

公司董事会下设审计委员会，审计委员会的主要职责为依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。

2022年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举范宏伟、李晓辉、蒋卫军为审计委员会委员，由会计专业的独立董事范宏伟担任召集人。2024年5月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，根据相关规定，董事会审计委员会成员不能由高级管理人员兼任，因此，将本届董事会审计委员会成员由蒋卫军调整为魏峻。

报告期内，审计委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》相关规定履行相关职责。

董事会中其他专门委员会的设置及运行情况

√适用 □不适用

1、战略委员会

公司董事会下设战略委员会，战略委员会的主要职责为对公司长期发展战略规划和重大投资决策等进行研究并提出建议。

2022年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举丁柯、张军、魏峻为战略委员会委员，由董事长丁柯担任召集人。

报告期内，战略委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》相关规定履行相关职责。

2、提名委员会

公司董事会下设提名委员会，提名委员会的主要职责为对公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序、人选提出建议，对董事人选和高级管理人员人选进行审核。

2022年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举魏峻、李晓辉、丁柯为提名委员会委员，由独立董事魏峻担任召集人。

报告期内，提名委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》相关规定履行相关职责。

3、薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会的主要职责为研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。

2022年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举李晓辉、范宏伟、蒋卫军为薪酬与考核委员会委员，由独立董事李晓辉担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行相关职责。

（三）公司监事会的建立健全及运行情况

√适用 □不适用

监事会为公司监督机构，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，行使法律、法规、规章、公司章程及股东大会/股东会授予的其他职权。公司监事会由3名监事组成，其中包括1名公司职工代表监事，该监事由职工代表大会选举产生。公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》《监事会议事规则》，对监事的任职资格、监事会组成、监事会职权及议事规则作了详细规定，指导监事会规范运行。

报告期内，公司监事会共召开了3次会议，公司历次监事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作。

（四）其他需要披露的事项

√适用 □不适用

1、公司内部监督机构调整情况

√适用 □不适用

公司设置了监事会，董事会下设审计委员会，报告期内公司监事会与审计委员会并存，共同发挥内部监管职能。2025年7月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后撤销监事会并修订挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，公司选择在挂牌后在公司董事会中设置审计委员会、不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；审计委员会每六个月至少召开一次会议，审计委员会两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议；审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数

通过；审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人员担任召集人。

鉴于公司挂牌的时间尚不确定，若公司无法在 2026 年 1 月 1 日前完成挂牌，公司拟根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的规定，将于 2026 年 1 月 1 日前按照《公司法》等有关规定完成公司内部监督机构调整，取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司内部监督机构的设置符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定。报告期内实行的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及公司挂牌后适用的《公司章程（草案）》中规定的公司审计委员会的职权范围、召开程序、表决方式、成员任职资格及履职情况等事项均符合有关规定。

2、其他事项

☐适用 ☒不适用

二、表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

三、内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

（一）公司内部管理制度的建立健全情况

事项	是或否
《公司章程》是否符合《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等关于挂牌公司的要求	是
《公司章程》中是否设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，是否对股东权益保护作出明确安排	是

内部管理制度建立健全情况：

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会/股东会、董事会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的公司治理结构，形成了权力机构、执行机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司已形成了符合挂牌公司规范运作要求的、能够保证中小股东充分行使权利的权责明确、运作规范、监督有效的公司治理结构，实现了公司治理架构的合法有效运行，切实保障所有股东的利益。

（二）公司投资者关系管理制度安排

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，公司制定了《公司章程（草案）》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，明确了公司与股东等主体之间的纠纷解决机制，以切实保障投资者和公司的合法权益。公司具有完善的投资者信息沟通渠道，能够及时解决投资者投诉问题。公司将通过信息披露与日常交流，加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同的同时，积极提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司董事会认为，公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。同时，随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

四、公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响

（一）报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况

☐适用 ☒不适用

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

(三) 其他情况

□适用 √不适用

五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况

具体方面	是否完整、独立	具体情况
业务	是	公司具有独立完整的业务体系，独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争或严重影响独立性或显失公平的关联交易。为避免今后可能出现的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及控制的其他企业、控股股东及实际控制人关系密切家庭成员控制的企业已出具相关承诺函，进一步保障了公司的业务独立。
资产	是	公司系由芯愿景有限整体变更设立，拥有独立完整的资产，具备与 IC 分析、知识产权和资讯、IC 设计及 EDA 软件授权有关的业务体系及主要相关资产；公司合法拥有与经营相关的主要设备以及专利权、商标权、非专利技术、软件著作权、集成电路布图设计专有权等所有权。公司目前拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，不存在被实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。
人员	是	公司拥有独立的人事管理制度，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格按照《公司法》《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定产生，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬。公司设立财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬的情况。
财务	是	公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立、规范的会计核算体系及完善的财务管理制度，独立进行财务核算。公司在银行独立开立账户，独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与控股股东、实际控制人的财产完全分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户或混合纳税的情况。
机构	是	公司形成了完善的法人治理结构和规范化运作体系，拥有独立的经营和办公场所。公司已建立了股东大会/股东会、董事会、监事会等法人治理结构；根据日常经营的需要设置相应的职能部门，并制定了完备的内部管理制度。公司各机构、部门均按规定的职责独立运作，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东、实际控制人和其他股东干预公司机构设置和运营的情况。

六、 公司同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☒适用 ☐不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	新创愿景	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	员工持股平台	7.50%
2	同创愿景	一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	实际控制人持股平台	100.00%

（三） 避免潜在同业竞争采取的措施

为避免今后可能发生的同业竞争，维护公司全体股东利益，保证公司长期稳定发展，在遵守有关法律、法规及《公司章程》规定的前提下，公司控股股东、实际控制人丁柯、蒋卫军、张军及丁仲以书面形式出具《关于避免同业竞争的承诺函》。详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

（四） 其他情况

☐适用 ☒不适用

七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况

☐适用 ☒不适用

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，

公司根据《公司法》以及《公司章程》等规定，建立了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》《内部审计制度》《财务管理制度》及《财务工作制度》等公司治理具体制度，有效防范股东及其关联方违规占用公司资金现象的发生。同时，公司控股股东、实际控制人、董监高出具了关于《不存在占用公司资金事项的承诺函》，承诺进一步加强和规范公司的资金管理，维护公司的独立性，避免本人及本人控制或施加重大影响的其他企业与公司及其控股子公司发生除正常业务外的资金往来，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

（四）其他情况

☐适用 ☒不适用

八、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

☒适用 ☐不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
1	丁柯	董事长、首席科学家	实际控制人	24,744,236	38.66%	0.86%
2	蒋卫军	董事、副总经理	实际控制人	18,373,675	28.71%	0.64%
3	张军	董事、总经理	实际控制人	15,311,068	23.92%	0.53%
4	丁仲	董事、研发总监	实际控制人	1,898,298	2.97%	0.07%
5	魏峻	独立董事	独立董事	-	-	-
6	李晓辉	独立董事	独立董事	-	-	-
7	范宏伟	独立董事	独立董事	-	-	-
8	郭静	监事会主席、太原芯愿景监事、方芯半导体监事	监事	-	-	-
9	熊伟	监事、天津芯愿景副总经理	监事	180,000	-	0.29%
10	张金正	监事、保定分公司总经理、太原芯愿景总经理	监事	180,000	-	0.29%
11	石子信	副总经理、销售总监	高级管理人员	180,000	-	0.29%

12	王艳红	董事会秘书、财务总监	高级管理人员	133,770	-	0.21%
----	-----	------------	--------	---------	---	-------

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员中，董事长丁柯与董事丁仲系同胞兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人关系无其他关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺:

√适用 □不适用

在公司任职领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签署了劳动合同或聘任协议，并与公司签署了《保密协议》；核心技术人员均与公司签署了《竞业限制协议》。截至本公开转让说明书签署之日，上述合同、协议均履行正常，不存在违约情形。

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺，详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
丁柯	董事长、首席科学家、核心技术人员	天津芯愿景	执行董事	否	否
丁柯	董事长、首席科学家、核心技术人员	新创愿景	执行事务合伙人	否	否
丁柯	董事长、首席科学家、核心技术人员	同创愿景	执行事务合伙人	否	否
张军	董事、总经理、核心技术人员	天津芯愿景	总经理	否	否
张军	董事、总经理、核心技术人员	太原芯愿景	执行董事	否	否
张军	董事、总经理、核心技术人员	方芯半导体	执行董事、经理	否	否
丁仲	董事、研发总监、核心技术人员	天津芯愿景	监事	否	否
魏峻	独立董事	中国科学院软件研究所	研究员	否	否
魏峻	独立董事	江苏博云科技股份有限公司	独立董事	否	否
李晓辉	独立董事	北京科技大学	副教授	否	否

		经济管理学院			
范宏伟	独立董事	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理	否	否
范宏伟	独立董事	无无明（北京）管理咨询有限公司	执行董事、经理	否	否
范宏伟	独立董事	北京祥瑞康商贸有限公司	监事	否	否
郭静	监事会主席	太原芯愿景	监事	否	否
郭静	监事会主席	方芯半导体	监事	否	否
张金正	监事	太原芯愿景	总经理	否	否

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
丁柯	董事长、首席科学家、核心技术人员	新创愿景	3.08%	员工持股平台	否	否
丁柯	董事长、首席科学家、核心技术人员	同创愿景	41.02%	实控人持股平台	否	否
丁柯	董事长、首席科学家、核心技术人员	北京书同文数字化技术有限公司	1.05%	古籍数字化	否	否
蒋卫军	董事、副总经理、核心技术人员	新创愿景	2.28%	员工持股平台	否	否
蒋卫军	董事、副总经理、核心技术人员	同创愿景	30.46%	实控人持股平台	否	否
蒋卫军	董事、副总经理、核心技术人员	中泰德信（海南）档案管理有限公司	3.00%	档案数据信息管理服务	否	否
张军	董事、总经理、核心技术人员	新创愿景	1.90%	员工持股平台	否	否
张军	董事、总经理、核心技术人员	同创愿景	25.38%	实控人持股平台	否	否
丁仲	董事、研发总监、核心技术人员	新创愿景	0.24%	员工持股平台	否	否
丁仲	董事、研发总监、核心技术人员	同创愿景	3.15%	实控人持股平台	否	否

范宏伟	独立董事	无无明（北京）管理咨询有限公司	50.00%	管理咨询	否	否
熊伟	监事、天津芯愿景副总经理、核心技术人员	新创愿景	18.30%	员工持股平台	否	否
张金正	监事、保定分公司总经理、太原芯愿景总经理、核心技术人员	新创愿景	18.30%	员工持股平台	否	否
石子信	副总经理、销售总监	新创愿景	18.30%	员工持股平台	否	否
王艳红	董事会秘书、财务总监	新创愿景	13.60%	员工持股平台	否	否

（六）董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（七）其他情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

☐适用 ☒不适用

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,924,813.24	126,014,841.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,173,976.92	45,565,097.72
应收账款	45,061,764.38	57,638,101.17
应收款项融资		
预付款项	2,259,723.30	4,979,226.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,470,475.48	2,707,544.07
买入返售金融资产		
存货	82,098,047.72	66,497,205.50
合同资产	126,118.20	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	243,605,315.10	57,080,738.11
其他流动资产	2,083,807.85	14,001.94
流动资产合计	487,804,042.19	360,496,756.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	312,962,037.95	360,062,536.68
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,738,794.06	19,893,809.50
固定资产	44,536,804.95	61,164,027.88
在建工程	693,950.00	1,053,867.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,341,290.21	6,448,335.63
无形资产	4,366,759.90	4,501,874.83
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,156,174.32	5,816,188.10
递延所得税资产	8,123,930.14	7,079,533.62
其他非流动资产		240,000.00
非流动资产合计	410,919,741.53	466,260,173.24
资产总计	898,723,783.72	826,756,929.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	441,493.68	336,905.18
预收款项	1,078,779.32	976,182.20
合同负债	136,876,408.15	134,700,129.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,460,705.34	9,407,270.26
应交税费	5,324,947.87	3,722,533.69
其他应付款	2,135,216.67	899,511.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,743,696.13	3,262,655.61
其他流动负债	1,269,032.82	1,024,279.78
流动负债合计	158,330,279.98	154,329,466.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,336,416.65	2,843,317.38
长期应付款		
预计负债	200,000.00	200,000.00
递延收益	2,016,162.64	5,093,966.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,552,579.29	8,137,284.34
负债合计	166,882,859.27	162,466,751.23
所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,611,670.00	63,367,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,638,723.16	196,774,257.61
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,683,835.00	31,683,835.00
一般风险准备		
未分配利润	473,906,696.29	372,464,415.94
归属于母公司所有者权益合计	731,840,924.45	664,290,178.55
少数股东权益		
所有者权益合计	731,840,924.45	664,290,178.55
负债和所有者权益总计	898,723,783.72	826,756,929.78

2. 合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	237,374,863.51	214,923,771.79
其中：营业收入	237,374,863.51	214,923,771.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,820,480.16	132,315,960.45
其中：营业成本	68,019,069.70	60,913,938.44
利息支出	84,186.34	344,833.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,535,022.54	2,650,519.06
销售费用	5,451,109.21	5,228,639.62
管理费用	10,550,432.12	13,386,339.89
研发费用	55,457,511.88	53,570,216.38
财务费用	-1,192,665.29	-3,433,692.94
其中：利息收入	1,164,411.67	3,799,879.63
利息费用	84,186.34	344,833.00
加：其他收益	5,111,317.47	6,394,926.98
投资收益（损失以“-”号填列）	12,846,078.26	8,012,547.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	-5,165,960.05	-15,704,716.45
资产减值损失	-843,215.72	-1,306,170.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,561.02	-8,542.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,472,042.29	79,995,856.68
加：营业外收入	450,265.64	1,552.83

减：营业外支出	8,549.54	200,014.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,913,758.39	79,797,395.15
减：所得税费用	7,471,478.04	3,124,639.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,442,280.35	76,672,756.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	101,442,280.35	76,672,756.06
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司所有者的净利润	101,442,280.35	76,672,756.06
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,442,280.35	76,672,756.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,442,280.35	76,672,756.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.60	1.21
（二）稀释每股收益	1.60	1.21

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,188,439.65	285,486,709.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	102,989.70	645,655.30
收到其他与经营活动有关的现金	11,578,142.92	7,480,399.93
经营活动现金流入小计	259,869,572.27	293,612,764.26
购买商品、接受劳务支付的现金	13,297,404.02	23,808,939.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	112,177,319.92	105,518,976.50
支付的各项税费	26,429,700.70	19,040,605.22
支付其他与经营活动有关的现金	17,528,871.69	14,280,139.92
经营活动现金流出小计	169,433,296.33	162,648,661.02
经营活动产生的现金流量净额	90,436,275.94	130,964,103.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,470,000.00	242,597,500.00
取得投资收益收到的现金	3,025,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,237,605.00	3,311,097.71
投资活动现金流入小计	154,734,805.00	245,911,597.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,139,585.90	8,471,491.63
投资支付的现金	215,603,000.00	365,976,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,742,585.90	374,447,491.63
投资活动产生的现金流量净额	-66,007,780.90	-128,535,893.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,899,833.58	2,442,156.15
筹资活动现金流出小计	36,899,833.58	32,442,156.15
筹资活动产生的现金流量净额	-36,899,833.58	-32,442,156.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,921.20	-4,148.12
五、现金及现金等价物净增加额	-12,621,259.74	-30,018,094.95
加：期初现金及现金等价物余额	60,910,100.86	90,928,195.81
六、期末现金及现金等价物余额	48,288,841.12	60,910,100.86

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,393,988.48	117,238,350.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,173,976.92	45,565,097.72
应收账款	45,059,398.87	58,534,535.41
应收款项融资		
预付款项	1,579,765.70	4,977,065.66
其他应收款	4,506,263.36	8,821,376.87
存货	90,723,164.30	71,991,239.88
合同资产	126,118.20	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	243,605,315.10	57,080,738.11
其他流动资产	1,595,058.67	
流动资产合计	486,763,049.60	364,208,404.12
非流动资产：		
债权投资	312,962,037.95	360,062,536.68
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,753,645.36	43,623,549.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	92,074.00	101,629.24
固定资产	39,538,306.06	48,241,776.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,130,897.10	3,154,902.52
无形资产	7,642.17	28,575.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	254,544.65	621,383.44
递延所得税资产	6,798,546.76	6,240,462.30
其他非流动资产		240,000.00
非流动资产合计	413,537,694.05	462,314,814.91
资产总计	900,300,743.65	826,523,219.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	26,977,408.60	20,185,941.46
预收款项	2,453.33	19,596.20
合同负债	136,684,932.62	133,976,412.27
应付职工薪酬	5,991,940.77	6,063,273.17
应交税费	4,906,186.36	3,320,075.63
其他应付款	1,295,891.35	354,359.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	977,288.54	1,106,456.28
其他流动负债	1,264,615.12	934,200.13
流动负债合计	178,100,716.69	165,960,314.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,892,431.13	1,763,832.92
长期应付款		
预计负债	200,000.00	200,000.00
递延收益	1,449,730.00	4,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,542,161.13	6,663,832.92
负债合计	183,642,877.82	172,624,147.74
所有者权益：		
股本	62,611,670.00	63,367,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,676,136.20	200,811,670.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,683,835.00	31,683,835.00
一般风险准备		
未分配利润	454,686,224.63	358,035,895.64
所有者权益合计	716,657,865.83	653,899,071.29
负债和所有者权益合计	900,300,743.65	826,523,219.03

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	230,692,372.95	209,222,253.01
减：营业成本	68,121,216.40	62,154,256.18
税金及附加	1,582,257.17	1,497,181.31
销售费用	5,253,038.84	5,212,896.52
管理费用	7,616,665.37	8,967,751.42
研发费用	56,172,739.40	54,371,103.81
财务费用	-1,136,147.82	-3,591,639.71

其中：利息收入	123,219.09	167,720.04
利息费用	1,141,519.21	3,775,539.59
加：其他收益	4,781,508.00	1,030,333.85
投资收益（损失以“-”号填列）	12,846,078.26	8,012,547.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	-5,186,836.33	-15,653,875.91
资产减值损失	-1,108,301.01	-2,382,086.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,561.02	-8,542.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,384,491.49	71,609,080.19
加：营业外收入		
减：营业外支出	8,549.54	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,375,941.95	71,409,080.19
减：所得税费用	7,725,612.96	3,063,018.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,650,328.99	68,346,061.34
（一）持续经营净利润	96,650,328.99	68,346,061.34
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	96,650,328.99	68,346,061.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,314,056.12	279,107,173.48
收到的税费返还	102,989.70	645,655.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,956,855.14	9,399,814.89
经营活动现金流入小计	256,373,900.96	289,152,643.67
购买商品、接受劳务支付的现金	37,738,986.04	45,774,028.74

支付给职工以及为职工支付的现金	72,874,046.56	69,020,916.71
支付的各项税费	21,700,863.15	15,202,431.00
支付其他与经营活动有关的现金	35,857,250.48	46,637,024.87
经营活动现金流出小计	168,171,146.23	176,634,401.32
经营活动产生的现金流量净额	88,202,754.73	112,518,242.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,470,000.00	262,597,500.00
取得投资收益收到的现金	3,025,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,237,605.00	3,311,097.71
投资活动现金流入小计	154,734,805.00	265,911,597.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,766,293.90	5,644,305.56
投资支付的现金	220,603,000.00	365,976,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,369,293.90	371,620,305.56
投资活动产生的现金流量净额	-67,634,488.90	-105,708,707.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,793,938.13	1,294,322.40
筹资活动现金流出小计	35,793,938.13	31,294,322.40
筹资活动产生的现金流量净额	-35,793,938.13	-31,294,322.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,921.20	-4,148.12
五、现金及现金等价物净增加额	-15,375,593.50	-24,488,936.02
加：期初现金及现金等价物余额	52,133,609.86	76,622,545.88
六、期末现金及现金等价物余额	36,758,016.36	52,133,609.86

（三）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司自报告期末起 12 个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1）合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	名称	主营业务	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额（万元）	纳入合并范围的期间	取得方式	合并类型
1	天津芯愿景	集成电路分析和设计	100.00%	100.00%	3,000.00	2023.1.1-2024.12.31	新设	子公司
2	太原芯愿景	集成电路分析和设计	100.00%	100.00%	500.00	2023.1.1-2024.12.31	新设	子公司
3	方芯半导体	芯片销售	100.00%	100.00%	1,000.00	2023.1.1-2024.12.31	新设	子公司

纳入合并报表企业的其他股东为公司股东或在公司任职

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

（2） 民办非企业法人

□适用 √不适用

（3） 合并范围变更情况

□适用 √不适用

二、 审计意见及关键审计事项

1. 财务报表审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具无保留的审计意见	是

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了北京芯愿景软件技术股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了芯愿景 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度、2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

2. 关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中如何应对
2023 年度、2024 年度主营业务收入分别为 21,008.01 万元、23,153.21 万元，收入的真实性以及是否在恰当的财务报表期间确认可能存在	审计过程中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行的审计程序主要包括： 1、了解芯愿景销售与收款的内部控制，执行内

潜在错报，同时对芯愿景的净利润产生重大影响，因此天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将收入的确认确定为关键审计事项。	部控制测试并评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性； 2、了解同行业上市公司收入确认政策，与管理层讨论业务特点及检查相关合同，对与芯愿景收入确认有关的重大风险及确认时点进行分析评估，进而评估收入确认会计政策的适当性和合理性； 3、对收入执行实质性查验及分析程序：抽取大额项目收入确认单据；检查业务回款情况；按业务类别和客户分析年度毛利率变动情况； 4、向主要客户函证交易金额，并与账面记录进行核对，确认销售金额的真实性、准确性； 5、对重大客户进行背景调查及现场走访，检查相关业务的真实性及交易合理性； 6、针对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止测试，以评估营业收入是否在恰当的期间确认。
--	--

三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额 200 万元以上（含）的款项
重要的应收款项实际核销	单项核销金额 200 万元以上（含）的款项
重要的预付款项	单项账龄超过 1 年且金额超过 200 万元（含）以上
重要的在建工程	单项工程项目预算金额超过 300 万元（含）以上
重要的应付账款	单项账龄超过 1 年且金额超过 200 万元（含）以上
重要的合同负债	单项账龄超过 1 年且金额超过 300 万元（含）以上

四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求。 2、会计期间和经营周期
--

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

5、重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额 200 万元以上（含）的款项
重要的应收款项实际核销	单项核销金额 200 万元以上（含）的款项
重要的预付款项	单项账龄超过 1 年且金额超过 200 万元（含）以上
重要的在建工程	单项工程项目预算金额超过 300 万元（含）以上
重要的应付账款	单项账龄超过 1 年且金额超过 200 万元（含）以上
重要的合同负债	单项账龄超过 1 年且金额超过 300 万元（含）以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期

的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

11、应收票据

（1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（2）本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	组合依据及计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，公司参考历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构，公司参考历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

(1) 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(2) 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

本公司参考历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。依据风险特征确定组合如下：

项目	计提方法
组合 1：信用风险组合	参考历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分账龄确认预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合 2：合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款项。
坏账准备的计提方法	将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为信用减值损失，计入当期损益。

13、其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见本章节 15、金融工具）进行处理。

14、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、发出商品、库存商品、委托加工物资、合同履约成本。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

（3）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述存货跌价准备计提原则，公司合同履约成本可变现净值的具体确定依据及存货跌价准备的具体计提方法为：

合同履约成本可变现净值以合同金额为基础。按照合同对应项目的期末总成本除以已发生工时计算出单位成本，用生产部门评估的预计总工时减去已发生工时计算出预计发生工时，以此计算出至完工时将要发生的成本。以合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、费用和相关税费后的金额确定可变现净值。按照合同履约成本大于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

15、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司

承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，

直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（4）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（6）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

17、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联

营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、投资性房地产

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

19、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、办公软件、非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
办公软件	3
非专利技术	5
土地使用权	50
专利技术	5-20

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复

核。

(3) 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

(4) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

①研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出,包括职工薪酬、折旧摊销费、房租费用、材料费、办公费用及其他等。

②研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

24、职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形

式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（3）设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定

价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认

的金额。

27、收入

（1）收入的确认

本公司主营业务收入包括 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务、EDA 软件授权业务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

①本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

A、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

B、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

C、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

②对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

A、本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

B、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

C、本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

D、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

E、客户已接受该商品。

F、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

（1）IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务中的设计服务和 IP 授权

按验收确认收入。按照合同约定的要求交付服务成果，并经客户验收后一次性确认收入。

（2）IC 设计业务中的自有芯片销售和量产服务

按照合同约定生产芯片产品，通过物流或快递交付给客户，经客户签收后确认收入。

（3）EDA 软件授权业务

根据合同约定交付软件，并经客户验收合格后一次性确认收入。

（3）收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

①可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

28、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

29、政府补助

（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（4）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（5）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

①财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司选择按照下列方法进行会计处理: 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: ①企业合并; ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

①判断依据

短期租赁, 是指在租赁期开始日, 租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁, 是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时, 应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估, 不应考虑资产已被使用的年限。

②会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁, 选择不确认使用权资产和租赁负债, 将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额, 在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

①融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

②经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

(1) 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司已提前执行，该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

(2) 本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。该项会计政策变更对报告期财务报表无重大影响。

(3) 本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。根据规定，公司将保证类质保费用计入营业成本，并进行追溯调整。该项会计政策变更对报告期财务报表的影响列示如下：

单位：万元					
期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2024 年度	解释 18 号	营业成本	6,783.45	18.46	6,801.91
2024 年度	解释 18 号	销售费用	563.57	-18.46	545.11
2023 年度	解释 18 号	营业成本	6,025.22	66.18	6,091.39
2023 年度	解释 18 号	销售费用	589.04	-66.18	522.86

2. 会计估计变更

□适用 √不适用

（三） 前期会计差错更正

□适用 √不适用

五、 适用主要税收政策

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	按提供劳务、服务的金额计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13.00%、6.00%、5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%、20.00%
城市维护建设税	按应缴流转税税额计缴	7.00%、5.00%
教育费附加及地方教育费附加	按应缴流转税税额计缴	5.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.20%、12.00%

2、 税收优惠政策

（1） 增值税

本公司符合《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定的软件产品，享受增值税即征即退的政策。

（2） 企业所得税

2021 年 10 月 25 日，本公司通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111000827），有效期为三年。减按 15%的税率计提、缴纳企业所得税。

2024 年 10 月 29 日，本公司通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202411000021），有效期为三年。减按 15%的税率计提、缴纳企业所得税。

2023 年 12 月 8 日，本公司子公司太原芯愿景微电子有限公司通过山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局高新技术企业审核，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR20231400136），有效期为三年。减按 15%的税率计提、缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

根据财政部、税务总局发布的《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 10 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控的需要，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

子公司天津芯愿景软件有限公司、太原芯愿景微电子技术有限公司和北京方芯半导体有限公司为小微企业，享受以上小微企业所得税税收优惠政策。

3、其他事项

☐适用 ☒不适用

六、经营成果分析

（一）报告期内经营情况概述

1. 报告期内公司经营成果如下：

项目	2024 年度	2023 年度
营业收入（万元）	23,737.49	21,492.38
综合毛利率	71.35%	71.66%
营业利润（万元）	10,847.20	7,999.59
净利润（万元）	10,144.23	7,667.28
加权平均净资产收益率	14.24%	12.06%
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9,699.08	7,128.29

2. 经营成果概述

(1) 营业收入

报告期内，公司营业收入分别为 21,492.38 万元和 23,737.49 万元，2024 年度营业收入较 2023 年度有所上涨。营业收入具体情况详见本节“六、经营成果分析”之“(二) 营业收入分析”。

(2) 毛利率分析

报告期内，公司毛利率分别为 71.66%和 71.35%，毛利率维持在较高水平。具体情况详见本节“六、经营成果分析”之“(四) 毛利率分析”。

(3) 净利润分析

报告期内，公司净利润分别为 7,667.28 万元和 10,144.23 万元，2024 年净利润较 2023 年上涨 2,476.95 万元，主要系销售收入增加以及信用减值损失减少等原因导致。与销售毛利相关的销售收入变动原因分析详见本节“六、经营成果分析”之“(二) 营业收入分析”和“(四) 毛利率分析”，与信用减值损失变动原因分析详见本节“六、经营成果分析”之“(六) 影响经营成果的其他主要项目”。

(二) 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

公司各类收入确认的具体方法为：

(1) IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务中的设计服务和 IP 授权

按验收确认收入。按照合同约定的要求交付服务成果，并经客户验收后一次性确认收入。

(2) IC 设计业务中的自有芯片销售和量产服务

按照合同约定生产芯片产品，通过物流或快递交付给客户，经客户签收后确认收入。

(3) EDA 软件授权业务

根据合同约定交付软件，并经客户验收合格后一次性确认收入。

2. 营业收入的主要构成

(1) 按产品（服务）类别分类

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	23,153.21	97.54%	21,008.01	97.75%
IC 分析业务	12,840.01	54.09%	11,482.94	53.43%

检测分析	165.37	0.70%	353.88	1.65%
电路分析	12,674.64	53.40%	11,129.06	51.78%
知识产权和资讯业务	5,383.17	22.68%	4,838.50	22.51%
知识产权服务	1,025.27	4.32%	829.82	3.86%
图像资讯	3,273.84	13.79%	3,521.51	16.38%
产品资讯	1,084.05	4.57%	487.17	2.27%
IC 设计业务	4,828.62	20.34%	4,483.20	20.86%
设计服务	2,825.64	11.90%	2,344.69	10.91%
IP 授权	798.11	3.36%	693.40	3.23%
自有芯片销售	820.26	3.46%	660.09	3.07%
量产服务	384.60	1.62%	785.03	3.65%
EDA 软件授权	101.42	0.43%	203.37	0.95%
其他业务收入	584.27	2.46%	484.36	2.25%
合计	23,737.49	100.00%	21,492.38	100.00%
原因分析	参见下文			

报告期内，公司营业收入分别为 21,492.38 万元和 23,737.49 万元，呈上升趋势。报告期内，公司主营业务收入占比超过 97%，主营业务突出。其他业务收入主要系房屋出租收入，金额及占比均较小。

公司主营业务为 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务及 EDA 软件授权业务。相关业务收入分析具体如下：

①IC 分析业务

报告期内，公司主营业务收入主要来源于 IC 分析业务。目前，公司 IC 分析业务中已形成检测分析、电路分析业务两大解决方案体系；一般结合客户具体需求，优化组合相关解决方案、交付 IC 分析数据。IC 分析业务占营业收入的比例分别为 53.43%和 54.09%，占比较高，且收入金额呈现增长趋势，增长率为 11.82%，主要系公司紧跟行业发展趋势，相关服务较好地满足了市场需求所致。

②知识产权和资讯业务

公司知识产权和资讯业务包括知识产权服务、图像资讯和产品资讯。报告期内，公司知识产权和资讯业务收入分别为 4,838.50 万元和 5,383.17 万元，呈增长趋势，最近一年增长率为 11.26%，收入规模增长率与公司整体业务发展情况一致，占营业收入的比例分别为 22.51%和 22.68%，占比相对稳定。

③IC 设计业务

报告期内，IC 设计业务收入金额分别为 4,483.20 万元和 4,828.62 万元，占营业收入的比例分别为 20.86%和 20.34%，占比较为稳定。目前，公司的 IC 设计业务已形成设计服务、量产服务、IP 授权和自有芯片销售四大解决方案，公司结合客户具体需求，提供 IC 设计数据（IP 数据/版图等）或产品（晶圆/芯片等）。

④EDA 软件授权

报告期内，EDA 软件授权业务占公司营业收入的比例分别为 0.95%和 0.43%，占比较低。

公司授权客户使用的 EDA 软件产品均系自主开发获得，是公司提供技术服务的重要工具，与技术服务过程及成果高度绑定。该类业务收入规模及占比较小且存在一定的波动。

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
境内销售收入	22,449.63	94.57%	20,408.21	94.96%
其中：华南区域	5,573.80	23.48%	5,138.32	23.91%
华北区域	7,887.08	33.23%	3,995.86	18.59%
华东区域	5,557.21	23.41%	6,382.42	29.70%
西南区域	1,865.42	7.86%	2,896.38	13.48%
其他境内区域	1,566.11	6.60%	1,995.23	9.28%
境外销售收入	1,287.86	5.43%	1,084.17	5.04%
合计	23,737.49	100.00%	21,492.38	100.00%
原因分析	公司凭借业内领先的技术和良好的口碑，获得了境内外客户的广泛认可。报告期内，公司来自境外的销售收入占比分别为 5.04%和 5.43%，主要集中在北美和东亚等 IC 产业发达地区。报告期内，公司境内收入主要来源于珠三角、京津冀、长三角等 IC 产业集中度较高的区域，与我国产业区域分布特征基本相符。			

报告期内，公司境外业务开展情况如下：

①主要进口国和地区情况、主要客户情况、与公司是否签订框架协议及相关协议的主要条款内容、境外销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式、信用政策

公司来自境外的销售收入占比分别为 5.04%和 5.43%，主要集中在北美和东亚等 IC 产业发达地区，包括加拿大、韩国、中国台湾、美国等。报告期内，公司境外客户主要为 Intellectual Property Research Group、闵康（Materials Analysis Technology Inc.）、ICmasters Ltd.等。客户根据需求向公司下达采购订单。订单获取的方式为商业谈判。公司产品的境外销售价格定价原则与境内销售无异，综合考虑成本、利润率、客户采购量、市场价格以及汇率等因素确定。公司与主要外销客户的结算方式均为银行转账，信用政策与境内客户基本一致。

②境外销售毛利率与境内销售毛利率的差异

报告期内，公司主营业务境内销售毛利率为 71.92%和 72.33%，境外销售毛利率为 83.72%和 78.81%。2023 年度境外销售毛利率较高系销售业务类别结构差异所致。

③汇率波动对公司业绩的影响

报告期内，汇兑损益金额分别为 0.41 万元和-13.05 万元，金额较小，汇率波动对公司的影响总体较小。

④出口退税等税收优惠的具体情况，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响

报告期内，公司主要向该等客户提供 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、EDA 软件授权业务等技术服务，不享受出口退税等税收优惠。公司对单一国家产品外销占主营业务收入比例相对较小，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力不存在重大不利影响。

⑤主要境外客户与公司及其关联方是否存在关联方关系及资金往来

报告期内，主要境外客户与公司及其关联方不存在关联方关系，除正常的贸易结算款项外，无其他非业务关系的资金往来。

（3）按生产方式分类

☐适用 ☒不适用

（4）按销售方式分类

☐适用 ☒不适用

（5）其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 公司收入冲回情况

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（三）营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司与主要客户以项目制开展业务、签订合作协议，并以此进行收入成本核算。报告期内，公司主营业务成本主要由人工费用、IC 代工费用和其他费用构成。其中，人工费用主要为 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务中的设计服务和 IP 授权的人工薪酬；IC 代工费用主要为 IC 设计业务中的自有芯片销售和量产服务所采购的晶圆流片、封装、测试等代工费用；其他费用主要包括 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务中的设计服务和 IP 授权项目中所分摊的房租、设备折旧费、外协技术服务费、办公费等。

（1）IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务中的设计服务和 IP 授权

公司 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务中的设计服务和 IP 授权项目成本主要包括人工成本、折旧费、委外测试费用和其他费用等。具体成本的归集、分摊及核算方法如下：

①人工成本：为参与生产项目人员的工资、社保和公积金等。直接参与项目的人工成本根据参与项目工时/工作量占比分摊至对应项目，生产部门管理岗等非直接参与项目人工成本根据其所在部门执行的各项目工时/工作量占比分摊至各项目。

②折旧费：为生产部门所承担的资产折旧费用。先按照设备使用部门归集，生产部门折旧费用再根据执行的各项目工时/工作量占比分摊至各项目。

③委外测试费用：为项目委托外部机构执行部分任务的支出，直接归集至对应项目。

④其他费用：包括房租物业费、水电费、办公费等无法直接对应到具体项目的支出。先按照一定标准（如人数、办公面积等）在各个部门归集，生产部门其他费用再根据各项目耗用的工时/工作量占比分摊至具体项目。

⑤工时/工作量分摊方法适用范围：工艺分析部执行去层拍照流程，单个工程师每天工作涉及项目数量较多，每个项目的处理时间较短。例如：一个普通封装去除的时间为 5 分钟，一名工程师一天内可能处理几十个普通封装去除。由于这种多项目、短工序的工作特点，工程师按工时填报费时费力，且准确度低，按照工时分摊不能很好体现各项目真实的成本。因此，工艺分析部制定了《工艺分析部工作量填写规范》。工程师每日填报其完成各项目工序对应的工作量，成本根据工作量分摊。

除工艺分析部外，其他部门均按照工时填报并分摊成本。

项目服务成本根据上述标准分摊至各项目，通过会计科目“存货—未完工项目”进行核算。项目成果交付客户并验收通过后，项目达到收入确认条件，同时将对应的“存货—未完工项目”结转至“主营业务成本”。

（2）IC 设计业务中的自有芯片销售和量产服务

公司自有芯片销售和量产服务采用 Fabless 经营模式，成本主要为 IC 代工费用，主要包括晶圆流片、封装、测试等代工费用，公司按照实际发生的委外成本核算。

（3）EDA 软件

EDA 软件均系公司自主研发产品，前期投入均在研发当期进行费用化处理，故 EDA 软件业务收入对应成本为零。

2. 成本构成分析

（1）按照产品（服务）分类构成：

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	6,323.06	92.96%	5,771.84	94.75%
IC 分析业务	3,426.18	50.37%	2,928.97	48.08%
检测分析	49.33	0.73%	91.55	1.50%
电路分析	3,376.86	49.65%	2,837.41	46.58%
知识产权和资讯业务	1,227.90	18.05%	1,202.78	19.75%
知识产权服务	226.03	3.32%	140.92	2.31%
图像资讯	949.12	13.95%	1,046.22	17.18%
产品资讯	52.75	0.78%	15.64	0.26%
IC 设计业务	1,668.98	24.54%	1,640.09	26.92%
设计服务	1,070.69	15.74%	554.00	9.09%
IP 授权	1.16	0.02%	78.67	1.29%
自有芯片销售	371.99	5.47%	334.60	5.49%
量产服务	225.14	3.31%	672.81	11.05%
EDA 软件授权	-	-	-	-
其他业务成本	478.85	7.04%	319.56	5.25%
合计	6,801.91	100.00%	6,091.39	100.00%
原因分析	报告期内，公司营业成本主要为主营业务成本，各期占比均超过 90%，与主营业务收入占比情况相匹配。除此之外，其他业务成本为房屋出租相关的折旧费用、维护费用等，与其他业务收入相匹配。 报告期内，公司主营业务成本主要由 IC 分析业务成本、知识产权和资讯业务成本、IC 设计业务成本等构成，上述成本合计占营业成本的比例分别为 94.75%和 92.96%。IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务中的设计服务和 IP 授权、EDA 软件授权的成本主要为项目人工成本及相关费用。IC 设计业务的自有芯片销售和量产服务成本主要为 IC 代工费用等。			

(2) 按成本性质分类构成:

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	6,323.06	92.96%	5,771.84	94.75%
人工费用	4,533.75	66.65%	3,510.53	57.63%
IC 代工费用	597.13	8.78%	1,007.41	16.54%
其他	1,192.17	17.53%	1,253.90	20.58%
其他业务成本	478.85	7.04%	319.56	5.25%
合计	6,801.91	100.00%	6,091.39	100.00%
原因分析	公司作为 IC 分析及 IC 设计服务提供商，自身不开展生产和制造活动。			

	报告期内，公司主营业务成本主要由人工费用、IC 代工费用和其他费用构成。其中，人工费用主要为 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务中的设计服务和 IP 授权的人工薪酬；IC 代工费用主要为 IC 设计业务中的自有芯片销售和量产服务所采购的晶圆流片、封装、测试等代工费用；其他费用主要包括 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务中的设计服务和 IP 授权项目中所分摊的房租、设备折旧费、外协技术服务费、办公费等。 报告期内，公司营业成本中人工费用占比分别为 57.63%和 66.65%，2023 年人工费用占比低于 2024 年主要系当年部分客户委托公司采购芯片进行图像资讯业务，材料费用直接记入项目成本，导致当年其他费用占比较高。 报告期内，公司营业成本中 IC 代工费用占比下降，分别为 16.54%和 8.78%，主要因量产服务收入占比下降所致，二者波动趋势基本一致。
--	---

（3）其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（四）毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

项目	2024 年度		2023 年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
主营业务	97.54%	72.69%	97.75%	72.53%
IC 分析业务	54.09%	73.32%	53.43%	74.49%
检测分析	0.70%	70.17%	1.65%	74.13%
电路分析	53.40%	73.36%	51.78%	74.50%
知识产权和资讯业务	22.68%	77.19%	22.51%	75.14%
知识产权服务	4.32%	77.95%	3.86%	83.02%
图像资讯	13.79%	71.01%	16.38%	70.29%
产品资讯	4.57%	95.13%	2.27%	96.79%
IC 设计业务	20.34%	65.44%	20.86%	63.42%
设计服务	11.90%	62.11%	10.91%	76.37%
IP 授权	3.36%	99.86%	3.23%	88.65%
自有芯片销售	3.46%	54.65%	3.07%	49.31%
量产服务	1.62%	41.46%	3.65%	14.29%

EDA 软件授权	0.43%	100.00%	0.95%	100.00%
其他业务	2.46%	18.04%	2.25%	34.03%
合计	100.00%	71.35%	100.00%	71.66%
原因分析	参见下文			

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 72.53%和 72.69%，整体较为稳定。各业务类型的毛利率分析如下：

（1）IC 分析业务

报告期内，公司 IC 分析业务毛利率分别为 74.49%和 73.32%，其中各类细分业务的毛利率也存在一定的波动，主要原因包括：

第一，集成电路行业技术更新换代速度较快，项目技术不断提升。由于客户订单受其进度计划安排和预算等多方面因素的影响，其技术难度升级的周期存在一定的长短变化。如订单技术难度升级，公司现有的技术能力亦须同步提升，以持续提供最优化的解决方案；该等情形短期内会造成该订单的执行工作量增加、工期延长。由于项目技术难度、历史技术经验以及软件自动化应用程度的不同，项目实际执行工时会与预估工时（公司进行报价的重要参考）存在偏差。这使得项目之间毛利率存在一定差异。

第二，不同项目的执行人员对业务技术的熟练程度有所区别，这亦使得项目之间毛利率存在一定差异。

报告期内，公司 IC 分析业务毛利率较高且较为稳定，主要原因如下：

①IC 分析行业技术创新及迭代壁垒较高

IC 分析行业具有技术创新及迭代壁垒。由于集成电路设计和制造技术的高度发展，面对超大规模的晶体管数量和复杂的制造工艺，仅有 EDA 软件能够完成海量芯片图像的自动采集、自动对准、自动拼接，并基于芯片图像数据库进行标准单元、布线、通孔的自动标注，电路网表提取，电路功能分析等一系列复杂功能。上述分析流程环节众多，且集成电路产品类型众多，不同器件类型、工艺类型、半导体材料、功能类型、应用领域的产品适用不同的解决方案，导致 IC 分析厂商需要以大量项目经验积累为基础，开发全流程的 IC 分析 EDA 软件体系，才能形成竞争优势。

市场的后进者，即使通过高额投入建立相关技术能力，也因缺乏不同产品的分析经验和 IC 分析 EDA 开发的长期积累，在软件能力、分析范围、技术工艺等方面存在劣势。目前，产业链专业化细分、高效分工已成为业内共识及市场的现实需要，具备经济性，助推了高端市场竞争格局的固化。

公司自主开发了行业领先的全流程 IC 分析 EDA 软件体系，并在 20 余年的项目经验积累和技术人才培养的过程中不断升级迭代，构筑了技术壁垒，形成了显著的先发优势。

②自主研发的全流程 IC 分析 EDA 软件体系形成公司的核心竞争力

自主研发的 EDA 软件为公司开展业务的核心工具，公司的 EDA 软件综合了软件工程、数据库、图像处理、IC 设计等多领域的技术知识，主要使用 C++ 语言编写，源代码总量已超四百万行，并随着公司项目执行经验的积累而不断迭代升级。公司 EDA 软件具备核心技术引领/实现、执行效率保障/提升等核心作用，内嵌自动算法支撑 IC 分析全业务流程的开展，包括图像自动拼接及对准、单元/线网/通孔的自动搜索及连接、网表提取及电路整理的同构匹配及模块复用、电路图化简等功能。

公司自 2002 年开始从事 IC 分析 EDA 软件的自主研发，细分领域发展至今，行业内具有自研 IC 分析 EDA 软件体系的厂商数量仍极少。基于自主研发的全流程 EDA 软件体系，公司在市场竞争中保持优势，市场占有率高。

③公司是 IC 分析领域的领先企业，拥有完善且先进的核心技术体系

公司 IC 分析相关的核心技术处于行业领先水平，且持续通过自主研发带动该领域产业技术的整体提升。公司核心技术可划分为 EDA 软件技术和工艺分析实验室技术。对于 EDA 软件技术，产品内嵌大量自动算法实现分析效率的大幅提升。其中，“显微图像采集及处理”解决方案，可进行 4TB 量级图像自动采集，并在 1/2 最小线宽误差内，实现 4TB 量级图像的无缝衔接，最终形成 IC 全景图像合成；“纳米级图像自动识别”解决方案，可支持 4 亿门级网表提取及纠错，实现网表到平面电路图的快速准确转换；“纳米级电路功能分析”解决方案，可支持 2,000 万门级的数字电路分析，自动识别各类功能模块、生成高可读性数字电路图；对于工艺分析实验室技术，公司依托六大工艺分析研究实验室，实现了最小 3 纳米 FinFET 产品的分析，单个项目最大规模达 100 亿个晶体管，最大金属层数达 20 层。由于具备完善的核心技术体系和领先的分析能力，公司 IC 分析业务具有较强的议价能力。

④丰富的项目经验积累和稳定的客户关系

公司在 IC 分析领域深耕二十余年，积累了丰富的项目经验并与客户建立了稳定的合作关系。

公司多年来累计执行项目超过 40,000 个，累计服务客户超过 3,000 家，对 EDA 软件开发形成了有力的支撑，技术能力覆盖的分析对象工艺难度大、类型丰富、应用范围广，形成了上百种技术解决方案，实现面对各类集成电路产品的全面覆盖，形成了有效的经验壁垒，例如产品工艺类型包括 CMOS、BiCMOS、Bipolar、BCD 等，产品衬底材料包括体硅、SiC、GaAs、InP、SiGe、SOI 等，产品应用领域包括 CPU、MCU、RF、FPGA、ADC、DAC、PM、Image Sensor、DRAM、Flash 等。

公司主要客户包括航天科技下属单位、中国电科下属单位、中国电子下属单位等。上述机构在各自领域具有技术代表性和先进性，对服务商选择慎重且严苛，其与公司的合作情况在业内产生了较强的示范效应；同时，经过长期稳定的合作，公司与该等客户间已形成多种定制化解决方案或技术规范。随着合作默契的达成和累积，公司逐步融入多个战略客户的研发体系之中，不断构筑客户壁垒，树立了公司良好的服务口碑和信誉。

⑤服务客户研发的关键环节，服务质量是客户的首要考量

IC 分析业务主要服务于半导体客户的研发环节。IC 行业属于资金密集型行业，研发投入较高，IC 分析支出占其研发总体预算的比例较低，同时由于 IC 分析成果能够辅助客户决定研发方向并降低试错风险，客户在选择 IC 分析服务商时，往往优先考量服务质量和及时交付能力。

公司在服务质量和及时交付能力方面均有显著优势。在面对超大规模复杂集成电路分析需求时，公司核心技术的优势突出，能够在相对较短的时间内以极高准确率完成分析工作。同时，公司在项目管理上创新开发了全流程管理架构，可实现数十乃至上百名工程师同时执行单个分析项目，形成“跨部门协作”“工作量动态平衡”“多层级分工”等特色模式。因此，客户对公司服务的支付意愿亦较强。

由上述内容可见，IC 分析业务的技术壁垒和客户要求较高，公司作为行业先入者和领先厂商在核心技术、项目经验和客户积累方面具有显著优势，毛利率较高具有合理性。

（2）知识产权和资讯业务

报告期内，公司知识产权和资讯业务毛利率分别为 75.14%和 77.19%，整体相对稳定。

对于产品资讯，该业务开展基于公司自主研发形成的集成电路大数据平台数据库，因此毛利率相对较高；对于图像资讯，因不同项目的技术难度、历史技术经验、实际执行情况不同，导致项目实际执行工时/工作量与预估存在偏差，导致项目之间毛利率存在一定差异；对于知识产权服务，其与国际 IC 知识产权诉讼及纠纷事件存在关联。公司执行该类项目的侧重点是寻找到样片对于标的 IC 的侵权点，故在项目执行过程中，项目周期、执行难度等均存在一定偶然性，实际所需工时可能与评估报价时预计的工时存在差异。这使得该类项目之间的毛利率存在一定差异。

（3）IC 设计业务

报告期内，公司 IC 设计业务毛利率分别为 63.42%和 65.44%，整体较为稳定。对于 IC 设计业务内部不同业务毛利率分析如下：

①设计服务

报告期内，公司设计服务毛利率分别为 76.37%和 62.11%，2024 年设计服务的毛利率有所下降，原因系 2024 年度部分项目毛利率较低，2024 年首次接触同类设计需求的项目数量较 2023 年有所增长，因此部分项目执行过程中的实际人员投入超过预期，导致部分项目的毛利率较低。

②IP 授权

公司授权客户使用的 IP 均为自主开发，绝大部分前期投入均在研发当期进行费用化处理，故该类业务毛利率接近 100%。2023 年 IP 授权毛利率相对较低主要系当年为客户开发 IP 核发生较多定制化开发成本所致。

③自有芯片销售

报告期内，公司自有芯片销售毛利率分别为 49.31%和 54.65%，变动的原因系各年之间销售的产品型号不同，且公司产品销售价格随市场供需情况和商业谈判情况亦有一定程度的波动。

④量产服务

报告期内，公司量产服务毛利率分别为 14.29%和 41.46%，呈现出一定的波动，基于生产成本以及销售价格的谈判情况，该业务类型下不同型号的产品毛利率存在较大差异，导致总体毛利率存在差异。

（4）EDA 软件授权

公司向客户授权使用的 EDA 软件系公司自主开发获得，绝大部分前期投入均在研发当期记入研发费用，故该业务毛利率较高，接近或达到 100.00%。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司业务主要分为 IC 分析业务、知识产权和资讯业务、IC 设计业务以及 EDA 软件授权。目前国内尚无与公司在业务模式及产品种类上完全可比的上市公司，因此就公司各类业务分别选取模式具有一定可比性的上市公司或其某一业务板块进行对比分析。选取的同行业可比公司具体如下：

产品和服务类型	可比公司
IC 分析业务	TechInsights、胜科纳米、宜特、闾康
知识产权和资讯业务	TechInsights
IC 设计业务	芯原股份、国芯科技、创耀科技
EDA 软件授权	华大九天、概伦电子、广立微

公司与同行业可比公司综合毛利率对比情况如下：

公司	2024 年度	2023 年度
申请挂牌公司	71.35%	71.66%
胜科纳米（688757.SH）	46.81%	54.23%
宜特（3289.TW0）	27.99%	26.70%
闾康（3587.TW0）	24.28%	35.29%
芯原股份（688521.SH）	39.70%	44.61%
国芯科技（688262.SH）	24.06%	21.33%
创耀科技（688259.SH）	27.24%	31.60%
华大九天（301269.SZ）	93.21%	93.70%
概伦电子（688206.SH）	86.09%	82.40%
广立微（301095.SZ）	61.57%	59.97%

可比公司平均	47.88%	49.98%
原因分析	原因分析请见下文	

由上表可见，公司毛利率处于可比公司的区间范围内。总体而言，低于以 EDA 软件授权为主业的可比公司，高于与 IC 分析业务和 IC 设计业务为主业的可比公司。由于各可比公司的业务内容等方面存在差异，因此公司将分业务类别进行比较。

公司各业务板块与相关可比公司毛利率对比情况及各类业务毛利率均高于可比公司同类业务毛利率的原因具体如下：

（1）IC 分析业务

公司 IC 分析业务的业务模式与 TechInsights 一致，由于无法获取其财务数据，故无法进行对比。公司的其他同行业可比公司胜科纳米、宜特、闳康所属的细分领域为第三方实验室技术检测服务，即为客户提供第三方技术检测实验，包括失效分析、材料分析和可靠性分析，帮助客户定位缺陷，实现产品质量提升与工艺技术升级。而公司和 TechInsights 所属的细分领域为集成电路分析服务，主要是指对 IC 产品进行拆卸、测绘、分析等，是 IC 领域内获取新技术、设计思路、发现设计缺陷和改进现有技术的重要技术手段。

第三方实验室技术检测服务的核心技术主要为检测工艺技术，即依托实验室设备，研发定制检测方案技术、样品制备技术、上机观测技术、设备治具加工改造技术等。而公司集成电路分析服务的除工艺处理技术外，主要集中于 EDA 软件技术，凭借自研的全流程 EDA 软件体系，公司可实现自动化的集成电路显微图像采集、对准、拼接，电路标准单眼、金属层布线、金属层间瞳孔的自动提取，电路网表的提取和电路功能的分析等一系列功能。

IC 分析行业具有技术创新及迭代壁垒，且市场具有全流程 IC 分析服务能力的供应商相对较少。公司 IC 分析领域的核心技术已经达到产业头部水平，具有全流程的 IC 分析能力，技术水平得到诸多业内知名机构认可，具有较强的议价能力。基于上述原因，公司 IC 分析业务的毛利率较同行业可比公司相对较高。

（2）知识产权和资讯业务

公司知识产权和资讯业务的可比公司 TechInsights 为境外上市公司子公司，由于无法获取其财务数据，故未对知识产权和资讯业务进行对比分析。

报告期内，公司毛利率较高的原因系，该等业务均依托自有的工艺分析研究实验室和自主的体系化 EDA 软件开展，其中公司自主研发的 EDA 软件是该业务的核心支撑。对于知识产权服务，EDA 软件能够完成布图相似性的比较、电路图版面优化和报告生成等一系列功能。对于产品资讯，该业务开展基于公司自主研发形成的集成电路大数据平台数据库，因此毛利率较高。对于图像资讯，EDA 软件能够自动化完成显微图像采集、拼接、对准等多项工序，效率得到显著提升。与 IC 分析

业务的情况相类似，市场具有相同全流程 EDA 软件体系的供应商相对较少，因此公司知识产权和资讯业务毛利率较高。

(3) IC 设计业务

公司 IC 设计服务业务可以细分为 4 个二级子业务，分别为设计服务、量产服务、IP 授权、自有芯片销售。上述 4 个二级子业务之间存在差异，因此单独进行比较。

具体情况如下：

①设计服务

项目	业务类型	2024 年度	2023 年度
芯原股份 (688521. SH)	芯片设计定制-设计业务	12.87%	14.36%
国芯科技 (688262. SH)	芯片设计定制-设计服务	32.04%	25.90%
创耀科技 (688259. SH)	芯片版图设计服务及其他技术服务	21.28%	20.44%
可比公司平均值		22.06%	20.23%
芯愿景	IC 设计服务	62.11%	76.37%

报告期内，公司 IC 设计服务毛利率高于同行业可比公司，主要有以下几方面原因：

A、客户类型及具体业务内容

公司设计服务业务主要客户包括航天科技、中国电科、中国电子等的下属科研院所及子公司，其与公司合作的领域，对委外设计芯片的性能、稳定性、可靠性等指标高于一般的消费级产品，同时，该等客户对产品自主、安全、可控的要求较高，因此，相应的 IC 设计难度较高。通用 EDA 工具对这些细分需求的支持不足。公司通过应用级开发模式，将 EDA 功能分布在基础层、中间层和应用层三个层级中，最大限度地满足了这些 EDA 细分需求，同时又保持了 EDA 软件架构稳定性，提升了 EDA 迭代速度和研发效率。同时，公司研发了一系列产品级和组件级 IP，在设计服务中重复使用，提升了设计效率，降低了设计成本。

公司与可比公司面对的下游客户领域存在差异。国芯科技的产品主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信领域；创耀科技主要服务于通信行业客户；芯原股份的产品主要应用于消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等领域。

B、技术能力

与其他 IC 设计服务提供商不同，公司拥有自主研发的 EDA 软件体系，研发了多项创新性 EDA 技术。公司组建 EDA 研发部，相关技术团队持续研发，并根据特定领域项目的具体需求进行增量开发，形成一系列适用于上述领域要求的应用级模块，使得 EDA 软件在对兼容性、稳定性、可靠性有较高要求的领域的智能化及功能水平不断增强，形成了比较优势，提高了设计效率和质量，降

低了人工成本，最终降低了项目综合成本。具体而言，除提供基础运算的引擎和平台级软件外，公司在软件开发的过程中，形成了具有高复用性、高灵活性的应用层、中间层软件。其中，应用层软件包括 GRC、ARC、LRC、CDS 等，满足随时变化的应用需求；中间层软件包括 VeriSmartFoundation（HxFoundation）基础框架软件、VeriSmartExtension（VsExtension）扩展框架软件、BoolSmartOrganization（BsOrganization）整理框架软件等，提供已验证的支撑函数和功能。基于 EDA 软件的应用级开发技术能够有效降低项目执行过程中的人工成本，提高了设计服务业务的利润水平。

C、具体定价情况

在定价模式方面，公司 IC 设计服务业以评估工时为定价依据，评估人员根据设计需求，考虑工作内容的复杂程度，对人员水平的要求，根据公司单位人·月平均可以完成的工作内容，评估出预计需要的工时，按照成本加成的方式进行定价。公司凭借自主研发的 EDA 软件体系和产业头部的 IC 分析能力开展业务，形成了较强的技术壁垒，在销售时具有较强的议价能力。

由上述内容可见，公司的设计服务业务与可比公司在业务模式、客户类型及具体业务内容、技术能力和成本结构以及具体定价情况等方面存在较为明显的差异，因此毛利率存在差异具有合理性。

②IP 授权

项目	业务类型	2024 年度	2023 年度
芯原股份 (688521. SH)	知识产权授权使用费收入	89.71%	87.42%
国芯科技 (688262. SH)	IP 授权	100.00%	100.00%
可比公司平均值		94.86%	93.71%
芯愿景	IP 授权	99.86%	88.65%

报告期内，公司与同行业可比公司该业务的毛利率均较高，原因系 IP 授权的主要盈利模式为，向客户授权公司研发活动形成的货架化设计数据，相关研发支出计入损益，在该模式下，IP 授权业务毛利率为 100%。除货架化 IP 外，公司和芯原股份亦从事定制化 IP 开发业务，故部分业务存在人工成本。

③自有芯片销售

项目	业务类型	2024 年度	2023 年度
创耀科技 (688259. SH)	通信芯片与解决方案业务	29.11%	34.00%
国芯科技 (688262. SH)	自主芯片及模组产品	29.35%	30.34%
可比公司平均值		29.23%	32.17%
芯愿景	自有芯片销售	54.65%	49.31%

如上表所示，2023 年度，公司自有芯片销售毛利率与同行业可比公司无明显差异。报告期内，

公司自有芯片销售主要系工业控制领域芯片的生产销售，在所涉及领域内，公司具有较多的技术积累，且该领域的 IC 产品具备专用性强、更新换代较慢、单款产品市场容量较小，而毛利率相对较高等特征。

④量产服务

项目	业务类型	2024 年度	2023 年度
芯原股份 (688521. SH)	芯片设计定制-量产业务	19.30%	27.43%
国芯科技 (688262. SH)	芯片设计定制-量产服务	20.02%	10.07%
可比公司平均值		19.66%	18.75%
芯愿景	量产服务	41.46%	14.29%

如上表所示，公司量产服务的毛利率与同行业可比公司存在一定差异。公司对于量产服务客户及相关项目采取主动选择的方式，优选长期合作的客户继续保持合作，侧重于毛利率水平较高且自身技术积累较多的工控领域 IC 的项目，该等单品市场容量较小，实现了与同行业头部企业的差异化竞争及定位。芯原股份与其部分主要客户合作时间较长，相关产品成熟度较高，收入规模较高，但毛利率较低。与该等主要客户的合作对其量产业务整体毛利率存在一定程度影响。

(4) EDA 软件授权

项目	业务类型	2024 年度	2023 年度
华大九天 (301269. SZ)	EDA 软件销售	100.00%	100.00%
概伦电子 (688206. SH)	集成电路设计类 EDA 软件	100.00%	100.00%
广立微 (301095. SZ)	软件开发及授权	85.96%	94.87%
可比公司平均值		95.32%	98.29%
芯愿景	EDA 软件授权	100.00%	100.00%

报告期各期，公司及同行业可比公司毛利率较高，主要系 EDA 软件授权业务的主要业务模式为向客户授权长期自主开发形成的货架 EDA 软件，前期投入均在研发当期进行费用化处理，故毛利率为 100%。广立微存在部分定制化开发业务，故毛利率低于 100%。

3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(五) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2024 年度	2023 年度
营业收入（万元）	23,737.49	21,492.38
销售费用（万元）	545.11	522.86
管理费用（万元）	1,055.04	1,338.63
研发费用（万元）	5,545.75	5,357.02
财务费用（万元）	-119.27	-343.37
期间费用总计（万元）	7,026.64	6,875.15
销售费用占营业收入的比重	2.30%	2.43%
管理费用占营业收入的比重	4.44%	6.23%
研发费用占营业收入的比重	23.36%	24.93%
财务费用占营业收入的比重	-0.50%	-1.60%
期间费用占营业收入的比重总计	29.60%	31.99%
原因分析	报告期内，公司期间费用总额分别为 6,875.15 万元和 7,026.64 万元，占当期营业收入的比重分别为 31.99%和 29.60%。2024 年公司的收入较 2023 年增加 10.45%，管理费用金额及占比有所下降，研发费用金额略有增长，导致期间费用整体有所增加，以上因素共同使得 2024 年期间费用率略有下降。	

2. 期间费用主要明细项目

（1）销售费用

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	425.17	414.61
宣传推广费	39.41	11.64
售前服务费	30.77	49.29
交通费	18.11	15.37
通讯费	16.67	16.26
办公费	4.87	2.63
业务招待费	3.92	8.97
水电气费	3.38	4.07
其他	2.81	0.03
合计	545.11	522.86
原因分析	报告期内，公司销售费用分别为 522.86 万元和	

	545.11 万元，较为稳定。销售费用主要由职工薪酬、宣传推广费和售前服务费等构成。其中，售前服务费主要是公司为承接项目而发生的前期评估人工费用等内容。 报告期内，公司销售费用占当期营业收入的比例分别为 2.43%和 2.30%，占比较为稳定。
--	--

（2）管理费用

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	425.57	537.26
折旧摊销费	208.14	262.36
残疾人就业保障金	111.20	95.38
办公费	70.36	151.78
股份支付	65.76	65.76
中介服务费	44.55	66.11
房租物业费	38.84	48.06
装修改造费	36.58	21.00
业务招待费	22.80	36.04
交通费	12.05	22.15
其他	19.19	32.76
合计	1,055.04	1,338.63
原因分析	报告期内，公司管理费用分别为 1,338.63 万元和 1,055.04 万元，主要由职工薪酬、折旧摊销费、残疾人就业保障金、办公费和股份支付等构成。2024 年公司管理费用的减少主要是由于职工薪酬、办公费以及折旧摊销费减少所致，其中职工薪酬减少主要原因系 2023 年公司员工入职培训、内部技术培训相对较多，不参与具体项目的人工计入管理费用；办公费减少主要原因系 2023 年支付公司周年庆典徽章费用 50.96 万元、网站设计费 18.87 万元等；折旧摊销费减少主要系天津芯愿景自用房产转为投资性房地产，折旧费用由管理费用调整至其他业务成本核算。 报告期内，公司管理费用率分别为 6.23%和	

	4.44%，随着管理费用金额的下降，营业收入增加，管理费用占收入的比例也呈下降趋势。
--	--

（3） 研发费用

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	4,557.64	4,364.81
折旧摊销费	440.57	466.26
材料费	293.43	295.22
水电气费	76.54	55.77
办公费	56.43	54.67
房租费	14.11	18.67
测试分析设计费	5.03	48.20
交通费	16.40	20.48
其他	85.60	32.95
合计	5,545.75	5,357.02
原因分析	公司研发费用主要由职工薪酬、折旧摊销费、材料费及水电气费等构成。报告期各期，公司研发费用分别为 5,357.02 万元和 5,545.75 万元，占当期营业收入的比例分别为 24.93%和 23.36%，研发费用金额逐年增长，研发费用占当期营业收入的比例相对稳定，公司报告期内不存在研发费用资本化的情况。	

（4） 财务费用

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
利息支出	8.42	34.48
减：利息收入	116.44	379.99
银行手续费	1.80	1.72
汇兑损益	-13.05	0.41
其他		-0.00011
合计	-119.27	-343.37
原因分析	报告期内，公司财务费用总额分别为-343.37 万元和-119.27 万元。报告期内，公司财务费用主要为利息收入、利息支出和汇兑损益等；利息收入主要系公司银行存款产生的利息；利息支出系租赁办公场所产生的未确认融资费用。总体而言，公司财务费用整体规模较小，且为收益的增加项，对公司经营活动产生积极	

	的影响。
--	------

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（六）影响经营成果的其他主要项目

1. 其他收益

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
政府补助	466.85	533.10
个税手续费返还	28.07	2.87
增值税即征即退	10.30	64.57
企业招用脱贫人口税费减免	5.92	
增值税加计抵减		38.96
合计	511.13	639.49

具体情况披露

报告期内，其他收益主要包括政府补助、增值税即征即退、增值税加计抵减及个税手续费返还等内容，金额分别为 639.49 万元和 511.13 万元。政府补助明细参见本节“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他主要项目”之“5.报告期内政府补助明细表”。

2. 投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
债权投资持有期间取得的利息收入	1,284.61	801.25
合计	1,284.61	801.25

具体情况披露：

报告期内，公司投资收益金额分别为 801.25 万元和 1,284.61 万元，主要为银行定期存款持有期间所产生的收益。2024 年投资收益金额增加的原因是 2024 持有的定期存款较 2023 年有一定程度增长所致。

3. 其他利润表科目

☒适用 ☐不适用

单位：万元

信用减值损失科目		
项目	2024 年度	2023 年度
应收账款坏账损失	472.38	-1,429.46
应收票据坏账损失	-991.66	-125.02
其他应收款坏账损失	2.68	-15.98
合计	-516.60	-1,570.47

具体情况披露

报告期内，公司的信用减值损失金额分别为-1,570.47 万元和-516.60 万元，主要为公司应收账款、应收商业承兑汇票等坏账准备变动所致。2024 年应收账款坏账损失为正，主要系公司当年收回前期计提坏账准备的应收账款，转回较多的信用减值损失所致。

报告期内，公司已按照企业会计准则及公司会计政策足额计提了各项资产的信用减值损失。

单位：万元

资产减值损失科目		
项目	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-83.13	-130.62
合同资产减值损失	-1.19	
合计	-84.32	-130.62

具体情况披露

报告期内，公司的信用减值损失金额分别为-130.62 万元和-84.32 万元，均为存货跌价损失和合同资产减值损失。

报告期内，公司已按照企业会计准则及公司会计政策足额计提了各项资产的资产减值损失。

单位：万元

营业外收入科目		
项目	2024 年度	2023 年度
政府补助	45.00	
非流动资产处置利得		
其他	0.03	0.16
合计	45.03	0.16

具体情况披露

报告期内，公司的营业外收入金额分别为 0.16 万元和 45.03 万元，主要系政府补助收入。政府补助明细参见本节“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他主要项目”之“5.报告期

内政府补助明细表”。

单位：万元

营业外支出科目		
项目	2024 年度	2023 年度
赔偿金、违约金及罚款支出	0.85	20.00
合计	0.85	20.00

具体情况披露

报告期内，公司的营业外支出主要为赔偿金、违约金及罚款支出，金额较小，对公司经营业绩影响较小。

2023 年度营业外支出主要为客户北京和芯智能信息科技有限公司终止合同，公司根据合同约定预计将产生损失 20 万元。

单位：万元

所得税费用科目		
项目	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	851.59	633.68
递延所得税费用	-104.44	-321.22
合计	747.15	312.46

具体情况披露

报告期内，公司所得税费用主要由当期所得税费用和递延所得税费用构成，公司当期所得税费用的增减变动与公司当期实现利润变动情况相匹配。

4. 非经常性损益情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3.06	-0.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	511.85	533.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10.20
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.83	-19.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5.92	38.96
减：所得税影响数	68.73	22.57
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	445.15	538.98

5. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目	2024 年度	2023 年度	与资产相关/ 与收益相关	经常性/非经常性损益	备注
第 125 批通用参数化版图项目	400.00		与收益相关	非经常性	
专精特新企业奖励	35.00		与收益相关	非经常性	
高精尖产业发展资金	30.00		与收益相关	非经常性	
专家公寓补贴	15.42	16.24	与收益相关	非经常性	
集成电路设计外包服务	10.75	301.52	与资产相关、	非经常性	

基地项目			与收益相关		
高新技术企业奖励	10.00		与收益相关	非经常性	
稳岗补贴、一次性就业补贴	5.68	9.98	与收益相关	非经常性	
高新技术企业筑基扩容	5.00		与收益相关	非经常性	
房租补贴		205.36	与收益相关	非经常性	
合计	511.85	533.10			

七、 资产质量分析

（一） 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	4,892.48	10.03%	12,601.48	34.96%
应收票据	6,217.40	12.75%	4,556.51	12.64%
应收账款	4,506.18	9.24%	5,763.81	15.99%
预付款项	225.97	0.46%	497.92	1.38%
其他应收款	147.05	0.30%	270.75	0.75%
存货	8,209.80	16.83%	6,649.72	18.45%
合同资产	12.61	0.03%	0.00	0.00%
一年内到期的非流动资产	24,360.53	49.94%	5,708.07	15.83%
其他流动资产	208.38	0.43%	1.40	0.00%
合计	48,780.40	100.00%	36,049.68	100.00%
构成分析	公司的流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货和一年内到期的非流动资产等构成，报告期各期末上述资产占流动资产的比例分别为 97.86%和 98.78%。具体科目分析参见本节各流动资产科目分析。			

1、 货币资金

√适用 □不适用

（1） 期末货币资金情况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	7.96	6.36
银行存款	4,820.93	12,567.05
其他货币资金	63.60	28.08
合计	4,892.48	12,601.48

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

公司的货币资金主要为银行存款。2024 年末，公司银行存款较 2023 年末减少 7,746.12 万元，主要系公司利用闲置资金购买银行定期存款以获取稳定的收益所致。

(2) 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他	63.60	28.08
合计	63.60	28.08

报告期内，公司其他货币资金主要为未办理结汇的外币收款，金额分别为 28.08 万元和 63.60 万元，金额较小。

(3) 其他情况

□适用 √不适用

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	140.41	74.18
商业承兑汇票	6,076.99	4,482.33
合计	6,217.40	4,556.51

(2) 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

□适用 √不适用

(5) 其他事项

☐适用 ☒不适用

4、 应收账款

☒适用 ☐不适用

(1) 应收账款按种类披露

☒适用 ☐不适用

单位：万元

种类	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	67.49	0.95%	67.49	100.00%	-
按组合计提坏账准备	7,006.75	99.05%	2,500.57	35.69%	4,506.18
合计	7,074.24	100.00%	2,568.06	36.30%	4,506.18

续：

种类	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	50.28	0.57%	50.28	100.00%	-
按组合计提坏账准备	8,753.97	99.43%	2,990.16	34.16%	5,763.81
合计	8,804.25	100.00%	3,040.44	34.53%	5,763.81

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

☒适用 ☐不适用

单位：万元

2024 年 12 月 31 日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	华秩微电子（上海）有限公司	27.12	27.12	100.00%	预计无法收回
2	深圳市致宸信息科技有限公司	15.58	15.58	100.00%	预计无法收回
3	临海市国晶智芯科技有限公司	7.63	7.63	100.00%	预计无法收回
4	中国电科下属单位 A8	3.60	3.60	100.00%	预计无法收回
5	成都方程式电子有限公司	2.75	2.75	100.00%	预计无法收回
6	其他	10.83	10.83	100.00%	预计无法收回
合计	-	67.49	67.49	100.00%	-

☒适用 ☐不适用

单位：万元

2023 年 12 月 31 日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	华秩微电子（上海）有限公司	27.12	27.12	100.00%	预计无法收回

2	深圳市致宸信息科技有限公司	15.58	15.58	100.00%	预计无法收回
3	成都方程式电子有限公司	2.75	2.75	100.00%	预计无法收回
4	绍兴芯谷科技有限公司	2.73	2.73	100.00%	预计无法收回
5	无锡恒宇微电子科技有限公司	1.05	1.05	100.00%	预计无法收回
6	其他	1.06	1.06	100.00%	预计无法收回
合计	-	50.28	50.28	100.00%	-

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	账龄组合				
账龄	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	4,021.65	57.40%	345.79	8.60%	3,675.86
1-2 年(含 2 年)	313.55	4.48%	75.28	24.01%	238.27
2-3 年(含 3 年)	1,013.42	14.46%	582.21	57.45%	431.21
3 年以上	1,658.12	23.66%	1,497.28	90.30%	160.84
合计	7,006.75	100.00%	2,500.57	35.69%	4,506.18

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	3,166.76	36.18%	341.69	10.79%	2,825.07
1-2 年(含 2 年)	3,254.11	37.17%	823.29	25.30%	2,430.82
2-3 年(含 3 年)	1,105.50	12.63%	671.48	60.74%	434.02
3 年以上	1,227.60	14.02%	1,153.70	93.98%	73.90
合计	8,753.97	100.00%	2,990.16	34.16%	5,763.81

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2024 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（万元）	账龄	占应收账款总额的比例
航天科技下属单位 B1	非关联方	3,021.25	1 年以内(含 1 年)、 1-2 年（含 2 年）、	42.71%

			2-3 年（含 3 年）、 3 年以上	
中国电科下属单位 A1	非关联方	1,237.77	1 年以内（含 1 年）、 1-2 年（含 2 年）、 2-3 年（含 3 年）、 3 年以上	17.50%
中国电科下属单位 A2	非关联方	724.01	1 年以内（含 1 年）、 1-2 年（含 2 年）、 2-3 年（含 3 年）、 3 年以上	10.23%
中国电子下属单位 C1	非关联方	278.48	1 年以内（含 1 年）、 1-2 年（含 2 年）	3.94%
院校 M1	非关联方	179.40	1 年以内（含 1 年）	2.54%
合计	-	5,440.90	-	76.91%

续：

单位名称	2023 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（万元）	账龄	占应收账款总额的比例
中国电科下属单位 A1	非关联方	2,002.58	1 年以内（含 1 年）、1-2 年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上	22.75%
航天科技下属单位 B1	非关联方	2,001.93	1 年以内（含 1 年）、1-2 年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上	22.74%
航天科技下属单位 B2	非关联方	1,424.47	1 年以内（含 1 年）、1-2 年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上	16.18%
中国电科下属单位 A2	非关联方	893.75	1 年以内（含 1 年）、1-2 年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上	10.15%
中国电子下属单位 C1	非关联方	559.76	1 年以内（含 1 年）、1-2 年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）	6.36%
合计	-	6,882.48	-	78.17%

（4） 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 5,763.81 万元和 4,506.18 万元，2024 年末应收账款余额较上年末减少 21.82%，主要系部分主要客户 2024 年的回款金额高于 2023 年所致。
--

② 公司期末余额合理性分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 5,763.81 万元和 4,506.18 万元，占当期营业收入的比例分别为 26.82%和 18.98%。其中，2023 末应收账款占比较高，主要系公司主要客户因自身生产经营计划和资金使用规划导致回款周期较长；2024 年公司主要客户回款情况有所改善，使得应收账款占比有所下降。

(5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

报告期内，公司应收账款坏账计提政策包括按单项计提坏账准备及按信用风险特征组合计提坏账准备，其中按单项计提坏账准备的计提比例均为 100%，与同行业可比公司不存在差异。

报告期内，公司应收账款按信用风险特征组合坏账计提政策与同行业可比公司对比情况如下：

可比公司	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上
胜科纳米 (688757. SH)	5.00%	10.00%	50.00%	100.00%
宜特 (3289. TW0)	以应收账款逾期天数订定预期信用损失率，基于不同客户的不同信用期，平均授信期为 30-150 天			
闳康 (3587. TW0)	以应收账款逾期天数订定预期信用损失率，基于不同客户的不同信用期，平均授信期为 30-120 天			
芯原股份 (688521. SH)	公司对客户进行内部风险等级评估，并结合客户所在地区将其分为 8 种风险等级，包括中国大陆大客户（R1）、美国大客户（R2）、中国台湾大客户（R3）、欧洲大客户（R4）、东亚大客户（R5）、所有中小客户（R6）、集团内关联方（R7）及高风险客户（R8）确定各评级应收账款的预期损失率。本集团基于减值矩阵确认应收账款的预期信用损失准备			
国芯科技 (688262. SH)	6 个月以内： 1.00%；6-12 个月： 5.00%	10.00%	30.00%	3 至 4 年：50.00%；4 至 5 年：70.00%；5 年以上： 100.00%
创耀科技 (688259. SH)	5.00%	10.00%	50.00%	-
华大九天 (301269. SZ)	5.00%	10.00%	50.00%	-
概伦电子 (688206. SH)	0-3 个月：1.00%； 4-12 个月：5.00%	20.00%	50.00%	-
广立微 (301095. SZ)	6 个月以内： 1.00%；6-12 个月： 5.00%	10.00%	-	-
公司（2024 年）	8.60%	24.01%	57.45%	90.30%
公司（2023 年）	10.79%	25.30%	60.74%	93.98%

由上表可见，公司 3 年以内的坏账计提比例均高于同行业可比公司；3 年以上计提比例总体略低于胜科纳米和国芯科技。

与胜科纳米和国芯科技相比，公司长账龄应收账款坏账准备计提比例相对较低，主要是公司应收账款账龄较长的客户多数为科研院所类客户，其应收账款账龄较长主要受其单位预算执行及付款

特点影响，此类客户信用等级较高，坏账发生损失的风险较小。因此，公司与可比公司坏账准备计提比例差异具有合理性，公司应收账款坏账准备计提政策不存在显著差异，坏账准备计提充分。

报告期各期末，公司与上述可比公司按信用风险特征组合的实际坏账计提比例如下：

可比公司	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
胜科纳米（688757.SH）	5.72%	5.62%
宜特（3289.TW0）	0.99%	1.14%
闽康（3587.TW0）	3.01%	4.42%
芯原股份（688521.SH）	6.95%	6.36%
国芯科技（688262.SH）	15.21%	17.85%
创耀科技（688259.SH）	5.48%	5.33%
华大九天（301269.SZ）	5.32%	5.20%
概伦电子（688206.SH）	4.28%	3.71%
广立微（301095.SZ）	3.30%	1.37%
公司	35.69%	34.16%

由上表内容可见，公司总体的实际坏账计提比例高于可比公司总体的实际坏账计提比例。经与同行业可比公司比较，公司坏账准备计提充分。

（6） 应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

（7） 其他事项

☐适用 ☒不适用

5、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

6、 预付款项

☒适用 ☐不适用

（1） 预付款项按账龄列示

单位：万元

账龄	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	213.68	94.56%	485.57	97.52%
1-2 年 (含 1 年)	-	-	-	-

2-3 年 (含 2 年)	-	-	0.06	0.01%
3 年以上	12.29	5.44%	12.29	2.47%
合计	225.97	100.00%	497.92	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2024 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额（万元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
华虹半导体（无锡）有限公司	非关联方	67.36	29.81%	1 年以内	预付 IC 代工款
上海华虹宏力半导体制造有限公司	非关联方	22.74	10.06%	1 年以内	预付 IC 代工款
北京中经世纪科技园管理股份公司	非关联方	17.33	7.67%	1 年以内	预付水电物业费等
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	16.51	7.31%	1 年以内	预付中介服务费
盛帆半导体（苏州）有限公司	非关联方	15.16	6.71%	1 年以内	预付 IC 代工款
合计	-	139.11	61.56%	-	-

续：

2023 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额（万元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
上海华虹宏力半导体制造有限公司	非关联方	273.51	54.93%	1 年以内	预付 IC 代工款
苏州高邦半导体科技有限公司	非关联方	67.04	13.46%	1 年以内	预付 IC 代工款
广州捷嘉高科技有限公司	非关联方	58.13	11.67%	1 年以内	预付 IC 代工款
北京中经世纪科技园管理股份公司	非关联方	17.33	3.48%	1 年以内	预付水电物业费等
天津泰达电力有限公司	非关联方	15.00	3.01%	1 年以内	预付水电物业费等
合计	-	431.02	86.55%	-	-

(3) 最近一期期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

(4) 其他事项

□适用 √不适用

7、其他应收款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他应收款	147.05	270.75
应收利息		
应收股利		
合计	147.05	270.75

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：万元

坏账准备	2024 年 12 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	185.42	38.38					185.42	38.38
合计	185.42	38.38					185.42	38.38

续：

坏账准备	2023 年 12 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	311.82	41.06					311.82	41.06
合计	311.82	41.06					311.82	41.06

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	账龄组合				
账龄	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	60.03	32.37%	3.00	5.00%	57.02
1-2 年 (含 2 年)	48.95	26.40%	4.90	10.00%	44.06
2-3 年 (含 3 年)	65.66	35.41%	19.70	30.00%	45.96
3 年以上	10.78	5.81%	10.78	100.00%	
合计	185.42	100.00%	38.38	20.70%	147.05

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	184.46	59.16%	9.22	5.00%	175.24
1-2 年 (含 2 年)	71.39	22.90%	7.14	10.00%	64.25
2-3 年 (含 3 年)	44.66	14.32%	13.40	30.00%	31.26
3 年以上	11.30	3.62%	11.30	100.00%	
合计	311.82	100.00%	41.06	13.17%	270.75

②按款项性质列示的其他应收款

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	19.85	1.09	18.76
押金保证金	82.66	22.56	60.10
代扣代缴社保	7.06	0.35	6.70
代收代付款	6.39	2.24	4.15
其他	69.47	12.13	57.34
合计	185.42	38.38	147.05

续：

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	116.15	5.83	110.31

押金保证金	122.57	27.89	94.68
代扣代缴社保	6.56	0.35	6.21
代收代付款	7.83	2.20	5.62
其他	58.71	4.78	53.93
合计	311.82	41.06	270.75

③本报告期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

④其他应收款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	2024 年 12 月 31 日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（万元）	账龄	
员工宿舍款	非关联方	其他	58.11	1 年以内、1-2 年、2-3 年	31.34%
郑州大学	非关联方	押金保证金	31.70	1-2 年、2-3 年	17.10%
山西万立科技有限公司	非关联方	押金保证金	25.36	1 年以内、2-3 年	13.67%
北京市保障性住房建设投资有限公司	非关联方	押金保证金	9.21	1 年以内、2-3 年、3 年以上	4.97%
保定广联数字新媒体有限公司	非关联方	押金保证金	9.00	1-2 年	4.85%
合计	-	-	133.38	-	71.93%

续：

单位名称	2023 年 12 月 31 日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（万元）	账龄	
山西转型综合改革示范区管理委员会	非关联方	往来款	94.58	1 年以内	30.33%
郑州大学	非关联方	押金保证金	75.95	1 年以内、1-2 年、2-3 年	24.36%
员工宿舍款	非关联方	其他	48.78	1 年以内、1-2 年	15.64%
山西万立科技有限公司	非关联方	押金保证金	22.13	1-2 年	7.10%
保定广联数字新媒体有限公司	非关联方	押金保证金	9.00	1 年以内	2.89%
合计	-	-	250.44	-	80.32%

⑤其他应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

⑥其他事项

☐适用 ☒不适用

(2) 应收利息情况

☐适用 ☒不适用

(3) 应收股利情况

☐适用 ☒不适用

8、 存货

☒适用 ☐不适用

(1) 存货分类

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	365.03	5.04	359.98
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	75.31		75.31
委托加工物资	149.48		149.48
合同履约成本	7,771.28	146.24	7,625.03
合计	8,361.09	151.29	8,209.80

续：

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	50.17		50.17
库存商品	235.51		235.51
委托加工物资	118.02		118.02
合同履约成本	6,394.13	148.11	6,246.02
合计	6,797.83	148.11	6,649.72

(2) 存货项目分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 6,649.72 万元和 8,209.80 万元，占流动资产的比例分别为 18.45%和 16.83%。基于公司业务模式和特点，公司存货以合同履约成本为主，报告期各期末占比均超过 90%，占比相对稳定。报告期内，公司新增订单规模呈上升趋势，且大中型项目一般工期较长，需要跨年度完成，从而导致报告期各期末未完工项目存货金额增加。

发出商品主要系未进行封装的晶圆、已测试或未完成测试的成品芯片；公司部分量产服务项目由客户自行完成晶圆加工及芯片封装环节，客户将封装完的芯片发送至公司进行测试，测试完成后公司将测试通过的芯片发送至客户，客户确认收货。

库存商品主要是未形成销售的晶圆和芯片。公司根据客户需求或自身对市场需求的预估进行委外生产。生产后的晶圆封装成芯片或进行部分封装，剩余未封装的以晶圆形式存在。后续客户再订购时可直接销售给客户。

委托加工物资是需要由封装厂进行封装或测试厂进行测试的晶圆或芯片。

公司合同履约成本为未完工项目的人工成本、折旧摊销费及测试分析费等。公司与客户合作的项目均为完工后经验收一次性确认收入，不存在采用完工百分比法确认收入的情形，成本核算以实际发生成本确认。

9、合同资产

√适用 □不适用

(1) 合同资产分类

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未到期的质保金	13.80	1.19	12.61
合计	13.80	1.19	12.61

续：

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未到期的质保金			
合计			

(2) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2024 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
未到期的质保金		1.19				1.19

合计		1.19				1.19
----	--	------	--	--	--	------

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2023 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
未到期的质保金						
合计						

（3）其他情况披露

☐适用 ☒不适用

10、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

11、 一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

（1） 一年内到期的非流动资产余额表

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的债权投资	24,360.53	5,708.07
合计	24,360.53	5,708.07

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产主要为一年内到期的债权投资。债权投资情况详见本节“七、资产质量分析（二）非流动资产结构及变化分析之 1、债权投资”

（2）其他情况

☐适用 ☒不适用

12、 其他主要流动资产

☒适用 ☐不适用

（1） 其他主要流动资产余额表

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预缴企业所得税	207.30	0.98
其他	1.08	0.42
合计	208.38	1.40

（2）其他情况

☐适用 ☒不适用

（二）非流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
债权投资	31,296.20	76.16%	36,006.25	77.22%
投资性房地产	2,473.88	6.02%	1,989.38	4.27%
固定资产	4,453.68	10.84%	6,116.40	13.12%
在建工程	69.40	0.17%	105.39	0.23%
使用权资产	834.13	2.03%	644.83	1.38%
无形资产	436.68	1.06%	450.19	0.97%
长期待摊费用	715.62	1.74%	581.62	1.25%
递延所得税资产	812.39	1.98%	707.95	1.52%
其他非流动资产			24.00	0.05%
合计	41,091.97	100.00%	46,626.02	100.00%
构成分析	公司的非流动资产主要由债权投资、投资性房地产、固定资产等构成，报告期各期末上述资产合计占非流动资产的比例分别为 94.61%和 93.02%。			

1、 债权投资

√适用 □不适用

（1） 债权投资情况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
定期存款	31,296.20		31,296.20
合计	31,296.20		31,296.20

续：

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
定期存款	36,006.25		36,006.25
合计	36,006.25		36,006.25

（2） 最近一期末重要的债权投资情况

单位：万元

债权项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
定期存款	10,000.00	3.25%	3.25%	2026 年 4 月 7 日
定期存款	4,000.00	1.70%	1.70%	2026 年 9 月 27 日

定期存款	2,600.00	1.90%	1.90%	2026 年 4 月 23 日
定期存款	2,500.00	1.90%	1.90%	2026 年 1 月 12 日
定期存款	2,000.00	1.70%	1.70%	2026 年 8 月 21 日
定期存款	1,480.00	1.95%	1.95%	2026 年 8 月 16 日
定期存款	1,200.00	1.90%	1.90%	2026 年 4 月 29 日
定期存款	1,100.00	2.40%	2.40%	2027 年 8 月 21 日
定期存款	1,000.00	1.90%	1.90%	2026 年 3 月 13 日
定期存款	1,000.00	3.10%	3.10%	2026 年 8 月 2 日
定期存款	1,000.00	3.10%	3.10%	2026 年 7 月 5 日
定期存款	900.00	2.40%	2.40%	2027 年 9 月 9 日
定期存款	600.00	1.90%	1.90%	2026 年 6 月 21 日
定期存款	530.00	2.15%	2.15%	2026 年 8 月 6 日
定期存款	300.00	1.90%	1.90%	2026 年 7 月 19 日
定期存款	200.00	2.15%	2.15%	2026 年 7 月 12 日
定期存款	50.30	1.95%	1.95%	2026 年 9 月 9 日
合计	30,460.30	-	-	-

(3) 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

2、其他债权投资

☐适用 ☒不适用

3、其他权益工具投资

☐适用 ☒不适用

4、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

5、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

6、固定资产

☒适用 ☐不适用

(1) 固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	14,329.12	233.56	1,245.36	13,317.31
房屋及建筑物	6,418.93		1,171.99	5,246.94
机器设备	6,536.38	42.21	13.13	6,565.46

运输工具	362.34	128.98	51.89	439.44
电子设备及其他	1,011.47	62.37	8.36	1,065.47
二、累计折旧合计:	8,212.72	1,235.57	584.65	8,863.63
房屋及建筑物	3,015.94	290.98	514.94	2,791.98
机器设备	4,235.41	752.08	12.47	4,975.01
运输工具	317.62	13.51	49.29	281.84
电子设备及其他	643.75	179.00	7.94	814.81
三、固定资产账面净值合计	6,116.40	818.21	2,480.93	4,453.68
房屋及建筑物	3,402.99	514.94	1,462.97	2,454.96
机器设备	2,300.97	54.69	765.21	1,590.45
运输工具	44.73	178.27	65.39	157.61
电子设备及其他	367.72	70.31	187.37	250.66
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	6,116.40	818.21	2,480.93	4,453.68
房屋及建筑物	3,402.99	514.94	1,462.97	2,454.96
机器设备	2,300.97	54.69	765.21	1,590.45
运输工具	44.73	178.27	65.39	157.61
电子设备及其他	367.72	70.31	187.37	250.67

续:

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	14,776.53	581.13	1,028.54	14,329.12
房屋及建筑物	7,424.87		1,005.94	6,418.93
机器设备	6,183.46	352.92		6,536.38
运输工具	349.56	35.38	22.60	362.34
电子设备及其他	818.64	192.83		1,011.47
二、累计折旧合计:	7,284.39	1,344.00	415.67	8,212.72
房屋及建筑物	3,069.40	340.74	394.20	3,015.94
机器设备	3,445.86	789.55		4,235.41
运输工具	332.09	7.00	21.47	317.62
电子设备及其他	437.04	206.71		643.75
三、固定资产账面净值合计	7,492.14	996.80	2,372.54	6,116.40
房屋及建筑物	4,355.46	394.20	1,346.67	3,402.99
机器设备	2,737.60	352.92	789.55	2,300.97
运输工具	17.48	56.85	29.60	44.73
电子设备及其他	381.60	192.83	206.71	367.72
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	7,492.14	996.80	2,372.54	6,116.40

房屋及建筑物	4,355.46	394.20	1,346.67	3,402.99
机器设备	2,737.60	352.92	789.55	2,300.97
运输工具	17.48	56.85	29.60	44.73
电子设备及其他	381.60	192.83	206.71	367.72

(2) 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

7、使用权资产

☒适用 ☐不适用

(1) 使用权资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	1,264.01	626.49	624.02	1,266.48
房屋及建筑物	1,264.01	626.49	624.02	1,266.48
二、累计折旧合计：	619.18	317.43	504.26	432.35
房屋及建筑物	619.18	317.43	504.26	432.35
三、使用权资产账面净值合计	644.83	309.06	119.76	834.13
房屋及建筑物	644.83	309.06	119.76	834.13
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	644.83	1,130.74	941.45	834.13
房屋及建筑物	644.83	1,130.74	941.45	834.13

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	1,259.91	4.10		1,264.01
房屋及建筑物	1,259.91	4.10		1,264.01
二、累计折旧合计：	302.44	316.74		619.18
房屋及建筑物	302.44	316.74		619.18
三、使用权资产账面净值合计	957.48	4.10	316.74	644.83
房屋及建筑物	957.48	4.10	316.74	644.83
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	957.48	4.10	316.74	644.83
房屋及建筑物	957.48	4.10	316.74	644.83

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

8、 在建工程

☒适用 ☐不适用

(1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
天津房屋七期装修工程		69.40						自筹	69.40
天津房屋六期装修工程	105.39	195.82		301.21				自筹	
合计	105.39	265.22		301.21			-	-	69.40

续：

项目名称	2023 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
天津房屋六期装修工程		105.39							105.39
合计		105.39					-	-	105.39

(2) 在建工程减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 其他事项

☐适用 ☒不适用

9、 无形资产

☒适用 ☐不适用

(1) 无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	803.87	0.94		804.81
土地使用权	583.38			583.38
办公软件	19.56	0.94		20.50
非专利技术	181.50			181.50
专利技术	19.43			19.43
二、累计摊销合计	353.68	14.45		368.14
土地使用权	145.85	11.67		157.51
办公软件	19.06	0.29		19.34
非专利技术	181.50			181.50
专利技术	7.28	2.50		9.78
三、无形资产账面净值合计	450.19	0.94	14.45	436.68
土地使用权	437.54		11.67	425.87
办公软件	0.50	0.94	0.29	1.16
非专利技术				
专利技术	12.15		2.50	9.65
四、减值准备合计				
土地使用权				
办公软件				
非专利技术				
专利技术				
五、无形资产账面价值合计	450.19	0.94	14.45	436.68
土地使用权	437.54		11.67	425.87
办公软件	0.50	0.94	0.29	1.16
非专利技术				
专利技术	12.15		2.50	9.65

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	793.25	10.62		803.87
土地使用权	583.38			583.38
办公软件	18.94	0.62		19.56
非专利技术	181.50			181.50
专利技术	9.43	10.00		19.43
二、累计摊销合计	337.19	16.49		353.68
土地使用权	134.18	11.67		145.85
办公软件	16.32	2.73		19.06
非专利技术	181.50			181.50
专利技术	5.19	2.09		7.28
三、无形资产账面净值合计	456.06	10.62	16.49	450.19
土地使用权	449.20		11.67	437.54
办公软件	2.61	0.62	2.73	0.50
非专利技术				
专利技术	4.25	10.00	2.09	12.15
四、减值准备合计				

土地使用权				
办公软件				
非专利技术				
专利技术				
五、无形资产账面价值合计	456.06	10.62	16.49	450.19
土地使用权	449.20		11.67	437.54
办公软件	2.61	0.62	2.73	0.50
非专利技术				
专利技术	4.25	10.00	2.09	12.15

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

10、 生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

11、 资产减值准备

☒适用 ☐不适用

(1) 资产减值准备变动表

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2024 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
存货跌价损失	148.11	83.13		79.95		151.29
合同资产减值损失		1.19				1.19
合计	148.11	84.32		79.95		152.48

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2023 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
存货跌价损失	17.49	130.62				148.11
合同资产减值损失						
合计	17.49	130.62				148.11

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

12、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

(1) 长期待摊费用变动表

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2024 年 12 月 31 日
			摊销	其他减少	
装修工程	581.62	301.21	167.21		715.62
合计	581.62	301.21	167.21		715.62

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2023 年 12 月 31 日
			摊销	其他减少	
装修工程	706.05	35.98	160.41		581.62
合计	706.05	35.98	160.41		581.62

（2）其他情况

☐适用 ☒不适用

13、递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

（1）递延所得税资产余额

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,778.31	715.68
内部交易未实现利润	978.01	146.70
递延收益	201.62	24.58
租赁负债	855.13	96.17
预计负债	20.00	3.00
与递延所得税负债的抵销金额		-173.73
合计	6,833.07	812.39

续：

项目	2023 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,257.35	637.32
内部交易未实现利润	657.86	98.68
递延收益	509.40	72.47
租赁负债	624.30	65.02
预计负债	20.00	3.00
与递延所得税负债的抵销金额		-168.54
合计	6,068.90	707.95

（2）其他情况

☒适用 ☐不适用

①未经抵销的递延所得税负债

单位：万元				
项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产 折旧费用	834.13	93.02	596.31	61.36
固定资产加 计扣除	548.90	80.71	734.68	107.18
合计	1,383.03	173.73	1,330.99	168.54

②以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：万元				
项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 末余额	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 末余额
递延所得税 资产	173.73	812.39	168.54	707.95
递延所得税 负债	173.73		168.54	

14、其他主要非流动资产

√适用 □不适用

(1) 其他主要非流动资产余额表

单位：万元		
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预付设备款		24.00
合计		24.00

(2) 其他情况

√适用 □不适用

2024 年投资性房地产变动明细：				
单位：万元				
项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	3,339.56	1,171.99		4,511.55
房屋及建筑物	3,339.56	1,171.99		4,511.55
二、累计折旧合计：	1,350.18	687.49		2,037.67
房屋及建筑物	1,350.18	687.49		2,037.67
三、账面净值合计	1,989.38	484.50		2,473.88
房屋及建筑物	1,989.38	484.50		2,473.88

四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、账面价值合计	1,989.38	484.50		2,473.88
房屋及建筑物	1,989.38	484.50		2,473.88

2023 年投资性房地产变动明细：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	2,333.62	1,005.94		3,339.56
房屋及建筑物	2,333.62	1,005.94		3,339.56
二、累计折旧合计：	833.18	516.99		1,350.18
房屋及建筑物	833.18	516.99		1,350.18
三、账面净值合计	1,500.44	488.94		1,989.38
房屋及建筑物	1,500.44	488.94		1,989.38
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、账面价值合计	1,500.44	488.94		1,989.38
房屋及建筑物	1,500.44	488.94		1,989.38

（三） 资产周转能力分析

1、 会计数据及财务指标

项目	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	2.99	2.12
存货周转率（次/年）	0.90	1.06
总资产周转率（次/年）	0.28	0.27

2、 波动原因分析

（1）应收账款周转率 报告期内，公司应收账款周转率有所上升，主要系部分主要客户 2024 年的回款情况良好导致 2024 年末应收账款余额下降所致。 （2）存货周转率 报告期内，公司存货周转率基本保持稳定，略有下降，主要系随着半导体行业的逐渐复苏，公司大中型项目订单数量有所增加，大中型项目一般工期较长，需要跨年度完成，公司存货余额的增
--

长速度高于成本结转的速度，因此公司存货周转率有所下降。

(3) 总资产周转率

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.27、0.28，基本保持稳定。

八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析

(一) 流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
应付账款	44.15	0.28%	33.69	0.22%
预收款项	107.88	0.68%	97.62	0.63%
合同负债	13,687.64	86.45%	13,470.01	87.28%
应付职工薪酬	946.07	5.98%	940.73	6.10%
应交税费	532.49	3.36%	372.25	2.41%
其他应付款	213.52	1.35%	89.95	0.58%
一年内到期的非流动负债	174.37	1.10%	326.27	2.11%
其他流动负债	126.90	0.80%	102.43	0.66%
合计	15,833.03	100.00%	15,432.95	100.00%
构成分析	报告期各期末，公司流动负债总额分别为 15,432.95 万元和 15,833.03 万元，公司流动负债金额较为稳定。公司流动负债主要由合同负债、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款等构成，报告期各期末合计占比均在 90% 以上。			

1、 短期借款

□适用 √不适用

2、 应付票据

□适用 √不适用

3、 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：万元

账龄	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	39.64	89.77%	21.45	63.66%
1-2 年(含 2 年)	2.89	6.55%	6.12	18.16%
2-3 年(含 3 年)	0.25	0.56%	3.52	10.46%
3 年以上	1.38	3.12%	2.60	7.72%
合计	44.15	100.00%	33.69	100.00%

(2) 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2024 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(万元)	账龄	占应付账款总额的比例
天津钜泰消防设备安装工程有限公司	非关联方	办公场所使用及维护采购款	18.95	1 年以内(含 1 年)	42.91%
北京华迈创达科技有限公司	非关联方	其他技术服务采购款	11.00	1 年以内(含 1 年)、1-2 年(含 2 年)、2-3 年(含 3 年)	24.91%
阅康技术检测(上海)有限公司	非关联方	其他技术服务采购款	7.80	1 年以内(含 1 年)	17.66%
深圳市福田区新融跃电子商行	非关联方	实验设备及用品采购款	2.28	1 年以内(含 1 年)	5.16%
广东鑫业智能标签有限公司	非关联方	IC 代工采购款	1.85	1 年以内(含 1 年)	4.19%
合计	-	-	41.88	-	94.84%

续:

2023 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(万元)	账龄	占应付账款总额的比例
捷欧路(北京)科贸有限公司	非关联方	实验设备及用品采购款	6.80	1 年以内(含 1 年)	20.18%
天津汉拿弗斯特商贸有限公司	非关联方	办公场所使用及维护采购款	5.30	1-2 年(含 2 年)	15.73%
阅康技术检测(上海)有限公司	非关联方	其他技术服务采购款	4.19	1 年以内(含 1 年)	12.44%
苏州久元微电子有限公司	非关联方	IC 代工采购款	4.07	1 年以内(含 1 年)	12.09%
南京泛铨电子科技有限公司	非关联方	其他技术服务采购款	3.01	2-3 年(含 3 年)	8.94%
合计	-	-	23.37	-	69.38%

(3) 其他情况

□适用 √不适用

4、预收款项

√适用 □不适用

(1) 预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：万元

账龄	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含 1 年)	107.88	100.00%	97.62	100.00%
合计	107.88	100.00%	97.62	100.00%

(2) 预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2024 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（万元）	账龄	占预收款项总额的比例
天津义联新国际物流有限公司	非关联方	房租及物业费 等	9.97	1 年以内（含 1 年）	9.24%
瀚辰能源有限公司	非关联方	房租及物业费 等	9.83	1 年以内（含 1 年）	9.12%
北京海龙国际运输代理有限公司天津分公司	非关联方	房租及物业费 等	9.67	1 年以内（含 1 年）	8.97%
天津精采潜龙科技有限公司	非关联方	房租及物业费 等	7.99	1 年以内（含 1 年）	7.40%
天津物源国际贸易有限公司	非关联方	房租及物业费 等	7.37	1 年以内（含 1 年）	6.84%
合计	-	-	44.83	-	41.56%

续：

2023 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（万元）	账龄	占预收款项总额的比例
天津义联新国际物流有限公司	非关联方	房租及物业费 等	10.12	1 年以内（含 1 年）	10.36%
瀚辰能源有限公司	非关联方	房租及物业费 等	9.83	1 年以内（含 1 年）	10.07%
北京海龙国际运输代理有限公司天津分公司	非关联方	房租及物业费 等	9.67	1 年以内（含 1 年）	9.91%

天津精采潜龙科技有限公司	非关联方	房租及物业费 等	7.99	1 年以内（含 1 年）	8.18%
天津物源国际贸易有限公司	非关联方	房租及物业费 等	7.37	1 年以内（含 1 年）	7.55%
合计	-	-	44.98	-	46.08%

（3）最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

☐适用 ☒不适用

（4）其他情况

☐适用 ☒不适用

5、合同负债

☒适用 ☐不适用

（1）合同负债余额表

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预收项目款	13,687.64	13,470.01
合计	13,687.64	13,470.01

（2）其他情况披露

☐适用 ☒不适用

6、其他应付款

☒适用 ☐不适用

（1）其他应付款情况

1) 其他应付款账龄情况

单位：万元

账龄	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内 （含 1 年）	155.05	72.61%	27.28	30.33%
1-2 年 （含 2 年）	15.86	7.43%	17.05	18.95%
2-3 年 （含 3 年）	15.67	7.34%	2.90	3.22%
3 年以上	26.94	12.62%	42.72	47.49%
合计	213.52	100.00%	89.95	100.00%

2) 按款项性质分类情况:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
代收代付款	96.28	45.09%		
押金保证金	92.58	43.36%	77.83	86.53%
代扣代缴社保	9.77	4.57%	9.50	10.56%
其他	14.89	6.98%	2.62	2.91%
合计	213.52	100.00%	89.95	100.00%

3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2024 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (万元)	账龄	占其他应付款总额的比例
天津义联新国际物流有限公司	非关联方	押金保证金	8.00	3 年以上	3.75%
宋凤	非关联方	代收代付款	6.60	1 年以内(含 1 年)	3.09%
中荣海物流(天津)有限公司	非关联方	押金保证金	4.00	1 年以内(含 1 年)、2-3 年(含 3 年)	1.87%
天津精采潜龙科技有限公司	非关联方	押金保证金	4.00	2-3 年(含 3 年)、3 年以上	1.87%
瀚辰能源有限公司	非关联方	押金保证金	4.00	2-3 年(含 3 年)	1.87%
合计	-	-	26.60	-	12.46%

续:

2023 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (万元)	账龄	占其他应付款总额的比例
北京赢家伟业国际商务服务有限公司	非关联方	押金及保证金	14.41	3 年以上	16.02%
天津义联新国际物流有限公司	非关联方	押金	8.00	3 年以上	8.89%
天津精采潜龙科技有限公司	非关联方	押金	4.00	1-2 年(含 2 年)、3 年以上	4.45%
瀚辰能源有限公司	非关联方	押金	4.00	1-2 年(含 2 年)	4.45%
天津帝壹物流有限公司	非关联方	押金	3.00	1-2 年(含 2 年)	3.34%
合计	-	-	33.41	-	37.14%

(2) 应付利息情况

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他情况

☐适用 ☒不适用

7、应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

(1) 应付职工薪酬变动表

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	916.99	10,483.40	10,478.44	921.96
二、离职后福利-设定提存计划	23.73	766.23	765.85	24.11
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	940.73	11,249.63	11,244.29	946.07

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	800.36	9,963.99	9,847.35	916.99
二、离职后福利-设定提存计划	19.10	707.68	703.05	23.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	819.46	10,671.67	10,550.40	940.73

(2) 短期薪酬

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	902.56	9,610.56	9,605.83	907.30
2、职工福利费		97.18	97.18	
3、社会保险费	14.43	467.39	467.16	14.66
其中：医疗保险费	14.15	443.12	442.89	14.37
工伤保险费	0.29	24.27	24.26	0.29
生育保险费				

4、住房公积金		308.28	308.28	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	916.99	10,483.40	10,478.44	921.96

续:

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	788.74	9,117.60	9,003.78	902.56
2、职工福利费		136.78	136.78	
3、社会保险费	11.63	428.61	425.80	14.43
其中: 医疗保险费	11.39	411.59	408.83	14.15
工伤保险费	0.23	17.02	16.96	0.29
生育保险费				
4、住房公积金		281.00	281.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	800.36	9,963.99	9,847.35	916.99

8、 应交税费

√适用 □不适用

单位: 万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
增值税	452.90	164.29
消费税		
企业所得税		159.67
个人所得税	26.83	24.82
城市维护建设税	25.49	11.34
教育费附加	24.52	10.307258
其他	2.76	1.829609
合计	532.49	372.25

9、 其他主要流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他主要流动负债余额表

单位: 万元

一年内到期的非流动负债		
项目	2024年12月31日	2023年12月31日

1 年内到期的租赁负债	174.37	326.27
合计	174.37	326.27

单位：万元

其他流动负债		
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待转销项税	126.90	102.43
合计	126.90	102.43

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 非流动负债结构及变化分析

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
租赁负债	633.64	74.09%	284.33	34.94%
预计负债	20.00	2.34%	20.00	2.46%
递延收益	201.62	23.57%	509.40	62.60%
合计	855.26	100.00%	813.73	100.00%
构成分析	报告期各期末，公司非流动负债分别为 813.73 万元和 855.26 万元，主要由租赁负债、递延收益和预计负债等构成。2024 年末非流动负债较 2023 末有一定上升主要系公司递延收益在 2024 年摊销结转较大金额到当期损益和公司办公场所出租方签订新的租赁合同导致 2024 年末租赁负债上升的共同影响。			

(三) 偿债能力与流动性分析

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产负债率	18.57%	19.65%
流动比率（倍）	3.08	2.34
速动比率（倍）	2.53	1.87
利息支出(万元)	8.42	34.48
利息保障倍数（倍）	1,294.72	232.41

1、波动原因分析

长期偿债能力方面，报告期各期末，公司资产负债率分别为 19.65%和 18.57%，公司负债主要为合同负债、应付职工薪酬和应交税费等。报告期内公司资产负债率较低，财务结构较为稳健。

短期偿债能力方面，报告期各期末，公司流动比率分别为 2.34 和 3.08，速动比率分别为 1.87 和 2.53，短期偿债能力良好。公司流动资产以货币资金、应收票据、应收账款、存货和一年内到期的非流动资产为主，流动负债以合同负债、应付职工薪酬及应交税费为主，在生产经营规模扩大和经营积累增多的同时，公司前期购买的大额银行定期存款于 2024 年重分类为一年内到期的非流动资产，故 2024 年流动比率和速动比率整体呈上升趋势。

报告期内，公司不存在银行借款，利息支出主要是执行新租赁准则等事项计提利息所致。报告期内，公司利息支出分别 34.48 万元和 8.42 万元，金额较小；利息保障倍数分别为 232.41 倍和 1,294.72 倍，利息保障倍数较高，整体偿债能力较强。

（四） 现金流量分析

1、 会计数据及财务指标

项目	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,043.63	13,096.41
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-6,600.78	-12,853.59
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-3,689.98	-3,244.22
现金及现金等价物净增加额（万元）	-1,262.13	-3,001.81

2、 现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13,096.41 万元和 9,043.63 万元，2024 年经营活动现金流量净额较 2023 年减少约 4,052.78 万元，主要系公司部分主要客户于 2024 年以较高比例商业承兑汇票回款，且票据尚未到期承兑。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,853.59 万元和-6,600.78 万元，主要来源于购买大额银行定期存款及购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。2023 年及 2024 年，公司购买的大额银行定期存款分别为 36,597.60 万元和 21,560.30 万元，公司赎回到期的大额银行定期存款的金额分别为 24,259.75 万元和 15,047.00 万元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-3,244.22 万元和-3,689.98 万元。2023 年公司筹资活动现金流净流出，主要原因系公司派发 2022 年度现金分红 3,000.00 万元。2024 年公司筹资活动现金流净流出，主要为公司花费 3,454.91 万元回购盈富泰克所持公司股份所致。

（五） 持续经营能力分析

公司报告期内实现营业收入 21,492.38 万元和 23,737.49 万元，其中主营业务收入占比分别为 97.75%和 97.54%，公司营业收入稳定，主营业务突出。

截至本公开转让说明书签署之日，公司经营正常，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形，也不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，具有持续经营能力。

（六） 其他分析

☐适用 ☒不适用

九、 关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方信息

事项	是或否
是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公众公司信息披露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方	是

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
丁柯	共同控股股东、实际控制人	38.6614%	0.8588%
蒋卫军		28.7078%	0.6377%
张军		23.9226%	0.5314%
丁仲		2.9660%	0.0659%

2. 关联法人及其他机构

☒适用 ☐不适用

关联方名称	与公司关系
天津芯愿景	公司全资子公司
太原芯愿景	公司全资子公司
方芯半导体	公司全资子公司
新创愿景	公司实际控制人丁柯持有新创愿景 3.08%合伙份额并担任执行事务合伙人，公司实际控制人蒋卫军、张军及丁仲分别持有新创愿景 2.28%、1.90%、0.24%的合伙份额
同创愿景	公司实际控制人丁柯持有同创愿景 41.02%合伙份额并担任执行事务合伙人，公司实际控制人蒋卫军、张军及丁仲分别持有同创愿景 30.46%、25.38%、3.15%的合伙份额
无无明（北京）管理咨询有限公司	公司独立董事范宏伟控制的企业
泓泽嘉业（北京）科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的

	企业
北京祥瑞康商贸有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业
苏州科仪通生物科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业
北京鼎业天成投资管理有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业
北京社文科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业
北京社文知识产权管理有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业
北京天策天成品牌管理有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业
广西社文科技发展有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业
北京市鼎业律师事务所	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员担任负责人的事务所
希莱乐检（郑州）生物科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业
北京优合恺恩家具有限公司	公司实际控制人张军关系密切家庭成员担任执行董事兼经理的企业
上海周圆股权投资基金管理有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员担任董事的企业（已于 2024 年 3 月 12 日吊销）
北京今米房科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员担任董事的企业（已于 2013 年 10 月吊销）
北京富仕兰德科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业（已于 2003 年 10 月吊销）

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
丁柯	董事长、首席科学家
蒋卫军	董事、副总经理
张军	董事、总经理
丁仲	董事、研发总监
魏峻	独立董事
李晓辉	独立董事
范宏伟	独立董事
郭静	监事会主席
张金正	监事
熊伟	监事
石子信	副总经理
王艳红	财务总监、董事会秘书

（二） 报告期内关联方变化情况

1. 关联自然人变化情况

☐适用 ☒不适用

2. 关联法人变化情况

☒适用 ☐不适用

关联方名称	与公司关系	资产、人员去向
北京庭成商贸有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业	已于 2024 年 4 月 3 日注销
贵阳社文知识产权代理有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业	已于 2024 年 4 月 3 日注销
苏州易检唯康医疗技术合伙企业（有限合伙）	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业	已于 2024 年 3 月 20 日注销
北京文宣商贸有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业	已于 2024 年 3 月 4 日注销
郑州讯得生物科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业	已于 2024 年 2 月 27 日注销
保定社文软件科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业	已于 2023 年 5 月 15 日注销
长春国科华仪科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业	已于 2023 年 3 月 20 日注销
北京国科华仪科技有限公司	公司独立董事范宏伟关系密切家庭成员控制的企业	2022 年 12 月 3 日后不再控制

（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

☒适用 ☐不适用

（1）采购商品/服务

☐适用 ☒不适用

（2）销售商品/服务

☐适用 ☒不适用

（3）关联方租赁情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
新创愿景	承租房屋建筑物	0.42	0.42
同创愿景	承租房屋建筑物	0.42	
合计	-	0.84	0.42
关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司向新创愿景及同创愿景租出房屋建筑物用于注册使用，上述房屋租金标准根据市场价格确定。		

(4) 关联担保

☐适用 ☒不适用

(5) 其他事项

☐适用 ☒不适用

2. 偶发性关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(2) 应收关联方款项

☐适用 ☒不适用

(3) 应付关联方款项

☐适用 ☒不适用

(4) 其他事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬及以权益结算的股份支付费用情况如下：

单位：万元

关联交易性质	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	407.47	391.83
关键管理人员以权益结算的股份支付确认的费用金额	48.70	48.70
合计	456.16	440.53

注：除此之外，部分关键管理人员关系密切的家庭成员报告期内存在在公司任职的情形，各期薪酬总额分别为 0.00 万元及 3.73 万元，上述人员均已于 2025 年 4 月离职；报告期内，部分关键管理人员关系密切的家庭成员存在在公司实习的情形，各期薪酬总额分别为 0.00 万元及 1.07 万元。

4. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

为规范公司的关联交易行为，保护公司及投资者的合法利益，公司制定了《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等制度，对关联交易的决策权限、程序等进行了规定。公司严格遵守以上制度，确保关联交易的公允性以及重大事项决策程序的合法合规性，有效地防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，切实保障了公司和股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司将始终以股东利益最大化为原则，规范和减少关联交易。对于不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》和《独立董事工作制度》等制度的规定，保证关联交易的公平、公正、公允；并对关联交易予以充分、及时披露，避免关联交易损害公司及股东利益。

同时，为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员出具了关于《减少和规范关联交易的承诺》，具体详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

十、重要事项

（一）提请投资者关注的资产负债表日后事项

1、审计截止日期后 6 个月的主要经营情况及重要财务信息

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》之“1-21 财务报告审计截止日后的信息披露”的规定，申请挂牌公司财务报告审计截止日至公开转让说明书签署日超过 7 个月的，应补充披露期后 6 个月的主要经营情况及重要财务信息。

公司财务报告审计截止日为 2024 年 12 月 31 日，至本次公开转让说明书签署日超过 7 个月。截止日后 6 个月，公司经营情况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化、公司主要经营模式、销售模式等未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员未发生重大变更，主要销售及采购情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。具体情况如下列示（特别说明，以下财务数据未经会计师事务所审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺）：

（1）订单获取情况

2025 年 1-6 月，公司新签订单金额 8,339.55 万元（不含税，下同）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在手订单金额为 35,654.62 万元。公司在手订单和新签订单充足且正常履行，业绩情况良好

（2）主要原材料（或服务）的采购规模

2025 年 1-6 月，公司原材料（或服务）采购金额为 1,689.37 万元（不含税）。公司主要供应

商相对稳定，公司原材料（或服务）采购具有持续性、稳定性。

（3）主要产品（或服务）的销售规模

2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 11,641.22 万元，较 2024 年 1-6 月增长 33.94%，主要系 IC 设计业务中的 IP 授权收入和设计服务收入同比大幅增加所致。

（4）关联交易情况

报告期后 6 个月内，公司未出现新增关联交易的情况，均为前期关联交易的延伸，主要包括向关键管理人员支付薪酬及计提股份支付费用以及向新创愿景及同创愿景出租房屋建筑物用于注册使用，房屋租金标准根据市场价格确定，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年 1-6 月
新创愿景	房屋建筑物租赁	0.21
同创愿景	房屋建筑物租赁	0.21
合计	-	0.42

（5）重要研发项目进展

报告期后 6 个月内，公司主要研发项目均按计划正常开展，未发生重要研发项目暂停、终止等异常情形。

（6）重要资产及董监高变动情况

报告期后 6 个月内，公司的重要资产及董监高未发生变动。

报告期后，公司拟根据挂牌后的内部监督机构设置的调整计划或根据《公司法》等有关规定，取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。除上述情况外，公司的董事、监事及高管未发生其他变动或调整计划。

（7）对外担保

报告期后 6 个月内，公司未发生对外担保。

（8）债权融资及对外投资情况

报告期后 6 个月内，公司无新增借款及对外投资情况。

（9）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月 /2025.06.30	2024 年 1-6 月/ 2024.12.31	变动比例
营业收入	11,641.22	8,691.47	33.94%
净利润	6,131.47	2,489.12	146.33%

扣除非经常性损益后的净利润	6,096.99	2,437.63	150.12%
研发投入	2,987.81	2,598.74	14.97%
所有者权益	79,348.44	73,184.09	8.42%
经营活动产生的现金流量净额	9,156.74	5,853.40	56.43%

纳入非经常性损益的主要项目和金额如下：

单位：万元

非经常性损益明细	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	变动比例
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.21	-0.63	-132.99%
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	29.87	59.04	-49.41%
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.85	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7.69	-0.85	-999.53%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减：所得税影响金额	4.13	6.06	-31.85%
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	34.48	51.49	-33.04%

2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 11,641.22 万元，较 2024 年 1-6 月增长 33.94%，主要系 IC 设计业务中的 IP 授权收入和设计服务收入大幅增加所致。

2025 年 1-6 月，公司净利润为 6,131.47 万元，较 2024 年 1-6 月增长 146.33%，主要原因为收入大幅增加、毛利率提升以及发生较大金额的应收票据到期导致应收票据信用减值损失金额大幅下降。

2025 年 1-6 月，公司经营性现金流量净额为 9,156.74 万元，较 2024 年 1-6 月增长 56.43%，主要原因系 2025 年 1-6 月公司持有的较大金额应收承兑票据到期。

综上所述，公司财务报告审计截止日后 6 个月内，公司经营状况、主营业务、经营模式、税收政策、行业市场环境、采购及销售规模未发生重大变化，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变更，不存在重大不利变动，亦未发生其他重大事项。

公司审计截止日后经营状况未出现重大不利变化，公司符合挂牌条件。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（万元）	进展情况	对公司业务的影响
-			
合计		-	-

2、其他或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，本公司无应披露的其他或有事项。

（三）提请投资者关注的担保事项

截至本公开转让说明书签署之日，本公司无提请投资者关注的担保事项。

（四）提请投资者关注的其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，本公司无请投资者关注的其他重要事项。

十一、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会/股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会/股东会决议，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会/股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会/股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会/股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以采用现金或股票形式分配股利。

（二）报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（万元）	是否发放	是否符合《公司	是否超额分
------	--------	--------	------	---------	-------

				法》等相关规定	配股利
2023年4月23日	2022年度	3,000.00	是	是	否

（三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司章程》（草案）规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司可以采取现金、送股、转增股本或法律、法规、规范性文件规定的其他方式分配利润。

（四）其他情况

无。

十二、财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司申报财务报表按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，不存在重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	是
公司不存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	是
公司不存在通过第三方获取或为第三方提供无真实交易背景的贷款（转贷）	是
公司不存在个人卡收付款	是
公司不存在现金坐支	是
公司不存在开具无真实交易背景票据融资	是
公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用	是
公司不存在其他财务内控不规范事项	是

公司不存在第三方回款	否
------------	---

具体情况说明

√适用 □不适用

存在第三方回款的情况

报告期内，存在部分公司客户委托他人代为付款的情况，该等第三方回款情况具体如下：

单位：万元

类别	2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比
客户关联方或客户经办人代付	7.38	0.03%	14.34	0.07%
合计	7.38	0.03%	14.34	0.07%

注：占比为占当期营业收入的比例。

报告期内，公司第三方回款金额占当期营业收入的比例分别为 0.07%和 0.03%，占比较低，且呈下降趋势。通过第三方回款主要系客户通过其关联方或内部经办人代为支付款项，具有真实的交易背景和合理性，不存在异常情况。

第五节 挂牌同时定向发行

☐适用 ☒不适用

第六节 附表

一、 公司主要的知识产权

(一) 专利

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	201110234347.9	一种数字电路网表数据的处理方法	发明专利	2014 年 6 月 25 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
2	201721579964.1	一种防破解电路模块	实用新型	2018 年 6 月 1 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
3	201821354551.8	一种安全芯片	实用新型	2019 年 5 月 10 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
4	201821354552.2	一种增加集成电路逆向工程难度的芯片	实用新型	2019 年 8 月 2 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
5	201210512490.4	版图验证规则中金属层的测试向量针对不同工艺的可复用生成方法	发明专利	2020 年 4 月 14 日	芯愿景	芯愿景	继受取得	-
6	201610530462.3	一种电路图布局的方法、装置及电子设备	发明专利	2020 年 5 月 19 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
7	202110555290.6	一种芯片及电子设备	发明专利	2021 年 7 月 23 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
8	202110450941.5	目标对象定位方法、装置、电子设备和存储介质	发明专利	2021 年 8 月 10 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
9	202110427937.7	芯片、处理器驱动方法及电子设备	发明专利	2021 年 9 月 14 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
10	202110658341.8	类总线分组的确定方法、装置、设备及介质	发明专利	2021 年 9 月 28 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
11	202110765167.7	简化电路图生成的方法、装置、设备及存储介质	发明专利	2021 年 11 月 9 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
12	202110971710.9	存储装置和数据读取方法	发明专利	2021 年 11 月 9 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
13	202110492659.3	电路分析方法、装置、设备及存储介质	发明专利	2021 年 11 月 30 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
14	202111046662.9	一种芯片及其制备方法、电子设备	发明专利	2022 年 1 月 4 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-

		备						
15	202110934179.8	门级电路的RTL代码生成方法、装置和电子设备	发明专利	2022年2月18日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
16	202111472553.3	刻蚀设备及刻蚀方法	发明专利	2022年3月11日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
17	202210051897.5	集成电路版图显示方法、装置、电子设备、介质和产品	发明专利	2022年4月29日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
18	202210200891.X	存储装置和数据读取方法	发明专利	2022年5月27日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
19	202210413409.0	仿真结果的验证方法、装置、设备及计算机存储介质	发明专利	2022年7月26日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
20	202110397331.3	一种漏电补偿电路	发明专利	2022年11月1日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
21	202210559836.X	基本单元库简化方法及装置	发明专利	2023年1月10日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
22	202111351811.2	集成电路版图设计方法、装置及设备	发明专利	2023年2月28日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
23	202310029733.7	版图层分组方法、装置、电子设备及非易失性存储介质	发明专利	2023年5月9日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
24	201910112408.0	一种可视化版图编辑方法	发明专利	2023年5月23日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
25	202310342067.2	一种集成电路版图的生成方法及装置	发明专利	2023年7月25日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
26	202310184452.9	一种版图设计校验结果的显示方法及装置	发明专利	2023年7月28日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
27	202310515852.3	电路仿真展示方法及装置	发明专利	2023年10月13日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
28	202310245203.6	一种数模电路仿真方法、装置、设备及计算机存储介质	发明专利	2023年10月13日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
29	202310515975.7	模拟电路的建模方法、装置及电子设备	发明专利	2023年11月28日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
30	202311451333.1	一种版图布局的生成方法及系统	发明专利	2024年1月30日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
31	202311320393.X	集成电路分析方法和装置	发明专利	2024年2月9日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
32	202311710750.3	器件提取方法、装置、设备和介	发明专利	2024年3月19日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-

		质						
33	202410436967.8	一种版图图形比较方法及装置、版图图形比较替换方法	发明专利	2024 年 6 月 14 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
34	201710616273.2	一种防破解芯片的设计方法及防破解芯片	发明专利	2024 年 9 月 20 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
35	201810958914.7	一种增加集成电路逆向工程难度的方法及芯片	发明专利	2024 年 9 月 24 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
36	202411586090.7	一种集成电路版图相似度分析方法及系统	发明专利	2025 年 2 月 28 日	芯愿景	芯愿景	原始取得	-
37	201621114163.3	一种使用电容编码原理检测位置的伺服电机	实用新型	2017 年 4 月 12 日	天津芯愿景	天津芯愿景	继受取得	-
38	201610866929.1	一种获取电容编码器绝对位置的方法及电容编码器	发明专利	2019 年 1 月 25 日	天津芯愿景	天津芯愿景	继受取得	-
39	201610829189.4	一种提高电容编码器测量密度的方法及电容编码器	发明专利	2019 年 5 月 3 日	天津芯愿景	天津芯愿景	继受取得	-
40	201610990510.7	一种伺服电机位置检测的方法及电路	发明专利	2019 年 9 月 6 日	天津芯愿景	天津芯愿景	继受取得	-
41	201911342594.3	一种柔性复合薄膜纳米发电机及其制备方法	发明专利	2022 年 12 月 27 日	太原芯愿景	太原芯愿景	继受取得	-

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	201910112437.7	一种动态复合图形	发明专利	2019 年 6 月 7 日	实质审查	-
2	202110194975.2	一种高 ESD 等级的集成电路	发明专利	2021 年 5 月 11 日	实质审查	-
3	202010262823.7	一种模块化设计输入输出单元版图的方法及单元	发明专利	2021 年 11 月 30 日	实质审查	-
4	202110998640.6	只读存储器、编码阵列生成方法、芯片及存储介质	发明专利	2021 年 12 月 17 日	实质审查	-

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
5	202111382304.5	电路生成方法、装置、设备及介质	发明专利	2021 年 12 月 21 日	实质审查	-
6	202211270524.3	数字电路分析、电路图显示方法、装置、设备及介质	发明专利	2022 年 11 月 15 日	实质审查	-
7	202310234962.2	一种电路展示方法、装置及设备	发明专利	2023 年 4 月 21 日	实质审查	-
8	202310397139.3	模拟电路数字化建模的方法、装置、设备、介质和产品	发明专利	2023 年 5 月 16 日	实质审查	-
9	202310130830.5	集成电路版图图形绘制方法、装置、设备以及介质	发明专利	2023 年 8 月 22 日	实质审查	-
10	202311713457.2	器件的提取方法、装置、设备和介质	发明专利	2024 年 4 月 12 日	实质审查	-
11	202410591798.5	一种静电保护电路及芯片	发明专利	2024 年 7 月 26 日	实质审查	-
12	202411194635.X	一种基于标尺工具的波形图标注方法及系统	发明专利	2024 年 9 月 27 日	实质审查	-
13	202510358924.7	一种版图图形提取方法及装置	发明专利	2025 年 4 月 25 日	实质审查	-

（二） 著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	集成电路数据服务器软件 ChipLogic Datacenter[简称：ChipLogic Datacenter]V1.0	2002SR2911	-	受让取得	芯愿景	-
2	集成电路网表提取系统软件 ChipLogic Analyzer[简称：ChipLogic Analyzer]V1.0	2002SR2912	-	受让取得	芯愿景	-
3	图像采集处理系统 Filmshop[简称：Filmshop]V4.0	2003SR12508	2003 年 10 月 15 日	原始取得	芯愿景	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
4	集成电路自动化分析再设计系统 ChipLogic Family V4.0[简称: ChipLogic Family]	2003SR12509	2003年10月15日	原始取得	芯愿景	-
5	集成电路分析验证系统 V1.0[简称: Hierux System]	2006SRBJ1143	2006年4月17日	原始取得	芯愿景	-
6	集成电路芯片电路编辑器软件[简称: Hierux Composer]V1.0	2009SR020724	2007年3月16日	原始取得	芯愿景	-
7	集成电路芯片电路分析器软件[简称: Hierux Designer]V1.0	2009SR020727	2007年12月10日	原始取得	芯愿景	-
8	集成电路芯片仿真调试器软件[简称: Hierux Simulator]V1.0	2009SR020732	2007年12月20日	原始取得	芯愿景	-
9	电子显微镜图像采集软件[简称: Filmshop Scanner]V1.0	2009SR020737	2007年12月20日	原始取得	芯愿景	-
10	集成电路分析算法软件[简称: Catalysis Series]V1.0	2009SR020721	2008年2月20日	原始取得	芯愿景	-
11	集成电路版图编辑器软件[简称: Hierux Builder]V1.0	2011SR082748	2010年10月20日	原始取得	芯愿景	-
12	集成电路数据浏览器软件[简称: Hierux Reporter]V1.0	2011SR082811	2010年10月20日	原始取得	芯愿景	-
13	集成电路图像浏览器软件[简称: Hierux Browser]V1.0	2011SR082904	2010年10月20日	原始取得	芯愿景	-
14	ROM 码点提取软件[简称: Memoreader]V1.0	2011SR011891	2010年10月25日	原始取得	芯愿景	-
15	电子显微镜纵向工艺分析软件[简称: CrossSectionAnalyzer]V1.0	2011SR012027	2010年10月25日	原始取得	芯愿景	-
16	电子显微镜表面工艺分析软件[简称: SurfaceAnalyzer]V1.0	2011SR012211	2010年11月2日	原始取得	芯愿景	-
17	芯愿景信息管理系统 DS 子系统[简称: CIMS-DS]1.0	2014SR183660	2012年4月5日	原始取得	芯愿景	-
18	芯愿景信息管理系统 AS 子系统[简称: CIMS-AS]1.0	2014SR183680	2012年4月5日	原始取得	芯愿景	-
19	图像处理工具包系统[简称: Filmshop Tools]2.0	2014SR183061	2012年4月15日	原始取得	芯愿景	-
20	集成电路工程创建系统[简称: Panovas Packager]1.0	2014SR181254	2013年2月6日	原始取得	芯愿景	-
21	集成电路图像处理软件[简称: Panovas Pro]1.0	2014SR183237	2013年2月6日	原始取得	芯愿景	-
22	光学图像采集软件[简称: Filmshop Digitizer]1.0	2014SR183136	2013年12月7日	原始取得	芯愿景	-
23	集成电路 PDF 报告生成软件[简称: Hierux Publisher]1.0	2014SR183051	2014年4月15日	原始取得	芯愿景	-
24	集成电路单元自动识别软件[简称: Hierux	2014SR183202	2014年4月20日	原始取得	芯愿景	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	Recognizer]1.0					
25	集成电路网表编辑软件[简称: Hierux Extractor]1.0	2014SR183300	2014年4月20日	原始取得	芯愿景	-
26	集成电路应用程序框架软件[简称: Hierux Ticker]V4.0	2020SR0322038	2015年8月20日	原始取得	芯愿景	-
27	ICIntelligence 集成电路智能分析系统[简称: ICIntelligence System]V1.0	2017SR248400	2017年2月17日	原始取得	芯愿景	-
28	ICIntelligence 集成电路分析器软件[简称: ICIntelligence Analyzer]V2.0	2017SR248594	2017年2月17日	原始取得	芯愿景	-
29	ICIntelligence 集成电路浏览器软件[简称: ICIntelligence Reader]V2.0	2017SR248620	2017年2月17日	原始取得	芯愿景	-
30	ICIntelligence 数据服务器软件[简称: ICIntelligence Server]V1.0	2017SR248953	2017年2月17日	原始取得	芯愿景	-
31	版图一致性验证工具软件[简称: LayoutMatcher]V1.0	2018SR376430	2018年3月15日	原始取得	芯愿景	-
32	IPsense 系统[简称: IPsense]V1.0	2018SR418465	2018年4月4日	原始取得	芯愿景	-
33	芯愿景信息管理系统 EN 子系统[简称: CIMS-EN]V1.0	2018SR418470	2018年4月20日	原始取得	芯愿景	-
34	数字电路分析简化工具软件[简称: BoolSmart Catalyzer]V1.0	2018SR418539	2018年4月20日	原始取得	芯愿景	-
35	模拟版图规则检查软件[简称: Analog LRC]V1.0	2018SR418548	2018年4月20日	原始取得	芯愿景	-
36	版图一致性比对工具软件[简称: LayoutVerifier]V1.0	2018SR638272	2018年6月8日	原始取得	芯愿景	-
37	有源金属屏蔽层布线软件[简称: AndromexShielder]V1.3	2018SR744733	2018年7月27日	原始取得	芯愿景	-
38	纳米级集成电路布线软件[简称: BoolSmart Innovator]V1.0	2019SR1131933	2019年6月20日	原始取得	芯愿景	-
39	安全加密协处理器系统[简称: SX570]V1.0	2020SR0411167	2019年6月30日	原始取得	芯愿景	-
40	存储和总线加密器系统[简称: SX206]V1.0	2020SR0413832	2019年6月30日	原始取得	芯愿景	-
41	高安全性保护系统[简称: SX530]V1.0	2020SR0414127	2019年6月30日	原始取得	芯愿景	-
42	PCI-Express 接口控制器 IP 核软件[简称: PCIExpress Controller]V1.0	2022SR0547064	2019年6月30日	原始取得	芯愿景	-
43	集成电路自动布线算法引擎软件[简称: Innova Router]V1.0	2020SR0039952	2019年8月20日	原始取得	芯愿景	-
44	集成电路实时规则检查引擎软件[简称: Innova	2020SR0071516	2019年8月20日	原始取得	芯愿景	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	Checker]V1.0					
45	数字集成电路解析软件[简称: BoolSmart Resolver]V3.0	2020SR0322042	2019年10月6日	原始取得	芯愿景	-
46	集成电路设计优化系统[简称: BoolSmart System]V3.0	2020SR0322099	2019年10月6日	原始取得	芯愿景	-
47	数据同步服务器软件[简称: BoolSmart Server]V3.0	2020SR0369376	2019年10月6日	原始取得	芯愿景	-
48	数字电路设计增强软件[简称: BoolSmart Inspector]V1.0	2020SR0322091	2019年10月15日	原始取得	芯愿景	-
49	数字电路时钟树优化软件[简称: BoolSmart Clocker]V1.0	2020SR0322095	2019年10月15日	原始取得	芯愿景	-
50	版图一致性分析工具软件[简称: LayoutPatcher]V1.0	2021SR0112294	2020年9月30日	原始取得	芯愿景	-
51	数字电路可视化调试软件[简称: BoolSmart Visualizer]V1.0	2021SR0372568	2020年12月10日	原始取得	芯愿景	-
52	版图设计软件[简称: DesignSmart Builder]V1.0	2021SR0372569	2020年12月10日	原始取得	芯愿景	-
53	电路图设计软件[简称: DesignSmart Composer]V1.0	2021SR0424760	2020年12月10日	原始取得	芯愿景	-
54	应用程序界面生成软件[简称: VeriSmart Ticker]V1.0	2021SR0815187	2021年4月16日	原始取得	芯愿景	-
55	版图实时处理验证引擎软件[简称: VeriSmart Engine]V1.0	2021SR0815253	2021年4月21日	原始取得	芯愿景	-
56	应用程序基础框架软件[简称: VeriSmart Foundation]V1.0	2021SR1960608	2021年7月13日	原始取得	芯愿景	-
57	IP大数据平台设计系统[简称: IPBrain Design System]V1.0	2021SR1560213	2021年8月31日	原始取得	芯愿景	-
58	参数单元开发软件[简称: DesignSmart Engineer]V1.0	2022SR1049490	2022年2月23日	原始取得	芯愿景	-
59	通用图形交互界面框架软件[简称: Hierux Quotation]V1.0	2022SR1425995	2022年3月21日	原始取得	芯愿景	-
60	集成图像识别软件[简称: Katalysis Processor]V1.0	2022SR1425994	2022年6月10日	原始取得	芯愿景	-
61	模拟电路提取软件[简称: Hierux Analoger]V1.0	2022SR1425972	2022年7月11日	原始取得	芯愿景	-
62	模拟电路分析软件[简称: Hierux Arranger]V1.0	2022SR1490083	2022年8月3日	原始取得	芯愿景	-
63	虚拟参数化单元接口软件[简称: VCL API]V1.0	2023SR0622603	2023年1月12日	原始取得	芯愿景	-
64	集成电路IP模块分析工具软件[简称: IPDetector]V1.0	2023SR0622604	2023年2月28日	原始取得	芯愿景	-
65	数据浏览软件[简称:]	2024SR0665251	2023年3月	原始取得	芯愿景	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	DesignSmart Explorer lnx64]V8.0		17 日	取得	景	
66	参数化版图单元框架软件[简称：VCL Foundation]V1.0	2023SR0622605	2023 年 4 月 4 日	原始取得	芯愿景	-
67	数字电路可视化调试软件[简称：Boolsmart Visualizer lnx64]V8.0	2024SR0727837	2023 年 6 月 12 日	原始取得	芯愿景	-
68	逻辑功能验证器软件[简称：Hierux Verifier]V8.0	2024SR0726440	2023 年 8 月 8 日	原始取得	芯愿景	-
69	波形分析软件[简称：Boolsmart Observer lnx64]V8.0	2024SR1043629	2024 年 4 月 19 日	原始取得	芯愿景	-
70	数字电路仿真调试软件[简称：Boolsmart Debugger lnx64]V1.0	2025SR0525271	2025 年 3 月 26 日	原始取得	芯愿景	-
71	数字电路自动布局布线软件 [简称：ICDigitalGenerator]V1.0	2012SR017773	2011 年 4 月 20 日	原始取得	天津芯愿景	-
72	模拟电路自动布局布线软件 [简称：ICAnalogGenerator]V1.0	2012SR018387	2011 年 4 月 20 日	原始取得	天津芯愿景	-
73	集成电路线路阅读器软件[简称：ICCircuitViewer]V1.0	2012SR017775	2011 年 10 月 16 日	原始取得	天津芯愿景	-
74	集成电路版图阅读器软件[简称：ICLayoutViewer]V1.0	2012SR017772	2011 年 10 月 20 日	原始取得	天津芯愿景	-
75	集成电路设计阅读器软件[简称：ICDesignViewer]V1.0	2012SR017774	2011 年 10 月 20 日	原始取得	天津芯愿景	-
76	海量集成电路图像采集和处理系统[简称：PANOVAS]V1.0	2014SR004271	2012 年 12 月 10 日	原始取得	天津芯愿景	-
77	纳米级集成电路分析 EDA 系统[简称：ICWORKS]V1.0	2014SR003893	2012 年 12 月 18 日	原始取得	天津芯愿景	-
78	企业财务销售信息管理系统 [简称：EASIMS]V1.0	2015SR235072	2015 年 9 月 30 日	原始取得	天津芯愿景	-
79	企业工程信息管理系统[简称：EEIMS]V1.0	2015SR235709	2015 年 9 月 30 日	原始取得	天津芯愿景	-
80	IP 数据管理软件[简称：IpPocket Manager]V1.0	2021SR1208391	2021 年 5 月 18 日	原始取得	天津芯愿景	-
81	解析脚本生成对话框软件[简称：IpPocket CommonDialog]V1.0	2021SR1205175	2021 年 5 月 20 日	原始取得	天津芯愿景	-
82	基于 SiliconSmart 修改 liberty	2021SR1762000	2021 年 9 月	原始	天津	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	文件的脚本软件[简称: IpPocket LibertyAPI]V1.0		24日	取得	芯愿景	
83	数字图形规则检查工具软件[简称: Digital LRC]V1.0	2022SR0494765	2022年2月22日	原始取得	太原芯愿景	-
84	模拟器件参数工具软件[简称: ATACparameter]V1.0	2022SR1426111	2022年2月22日	原始取得	太原芯愿景	-
85	电路图端口处理软件[简称: SCport]V1.0	2022SR1426112	2022年2月22日	原始取得	太原芯愿景	-
86	版图等宽线处理软件[简称: Ltpath]V1.0	2022SR1490084	2022年2月22日	原始取得	太原芯愿景	-
87	版图接触孔处理软件[简称: LTVia]V1.0	2022SR1490085	2022年2月22日	原始取得	太原芯愿景	-
88	版图线孔处理软件[简称: LTPath&via]V1.0	2022SR1490086	2022年2月22日	原始取得	太原芯愿景	-
89	版图标号文本工具软件[简称: LTtext]V1.0	2022SR1490087	2022年2月22日	原始取得	太原芯愿景	-

注: 第1-2项软件著作权系由自然人开发完成。其中, 第1项软件著作开发完成日期为2002年4月15日; 第2项软件著作开发完成日期为2002年4月20日。

(三) 商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1	芯愿景	芯愿景	12557154	35	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	-
2	Cellixsoft	CELLIXSOFT	12557235	35	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	-
3	FilmShop	FILMSHOP	12557272	35	2025年03月21日至2035年03月20日	原始取得	正常使用	-
4	ChipLogic Family	CHIPLOGIC FAMILY	12557341	35	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
5	Hierux System	HIERUX SYSTEM	12557384	35	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
6	芯愿景	芯愿景	12557524	9	2025年03月21日至2035年03月20日	原始取得	正常使用	
7	Cellix	CELLIX	12557553	9	2025年01月21日至2035年01月20日	原始取得	正常使用	
8	Cellixsoft	CELLIXSOFT	12557984	9	2025年03月28日至2035年03月27日	原始取得	正常使用	
9	FilmShop	FILMSHOP	12558016	9	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
10	ChipLogic Family	CHIPLOGIC FAMILY	12558044	9	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
11	Hierux System	HIERUX SYSTEM	12558057	9	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
12		CELLIX REVEALING TECHNOLOGY	12558096	9	2025年12月14日至2035年12月13日	原始取得	正常使用	
13	芯愿景	芯愿景	12558214	41	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
14	Cellix	CELLIX	12558227	41	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
15	Cellixsoft	CELLIXSOFT	12558230	41	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
16	FilmShop	FILMSHOP	12558253	41	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
17	ChipLogic Family	CHIPLOGIC FAMILY	12558263	41	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
18	Hierux System	HIERUX SYSTEM	12558281	41	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
19		CELLIX REVEALING TECHNOLOGY	12558300	41	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
20	芯愿景	芯愿景	12558339	42	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
21	Cellix	CELLIX	12558354	42	2024年11月21日至2034年11月20日	原始取得	正常使用	撤销/无效宣告申请审查中
22	Cellixsoft	CELLIXSOFT	12558364	42	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
23	FilmShop	FILMSHOP	12558370	42	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
24	ChipLogic Family	CHIPLOGIC FAMILY	12558378	42	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
25	Hierux System	HIERUX SYSTEM	12558388	42	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
26	 CELLIX Revealing Technology	CELLIX REVEALING TECHNOLOGY	12558395	42	2025年03月28日至2035年03月27日	原始取得	正常使用	
27	芯愿景	芯愿景	12558430	45	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
28	Cellix	CELLIX	12558435	45	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
29	Cellixsoft	CELLIXSOFT	12558441	45	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
30	 CELLIX Revealing Technology	CELLIX REVEALING TECHNOLOGY	12563686	45	2024年10月07日至2034年10月06日	原始取得	正常使用	
31	IPsense	IPSENSE	38883660	45	2020年6月28日至2030年6月27日	原始取得	正常使用	
32	IPsense	IPSENSE	38869169	42	2020年6月28日至2030年6月27日	原始取得	正常使用	
33	IPsense	IPSENSE	38886243	9	2020年6月28日至	原始取得	正常使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
					2030年6月27日			
34	Panovas System	PANOVAS SYSTEM	46509546	41	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
35	BoolSmart System	BOOLSMART SYSTEM	46510725	41	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
36	Catalysis Series	CATALYSIS SERIES	46534358	9	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
37	Panovas System	PANOVAS SYSTEM	46534515	42	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
38	Panovas System	PANOVAS SYSTEM	46519562	35	2021年6月28日至2031年6月27日	原始取得	正常使用	
39	BoolSmart System	BOOLSMART SYSTEM	46519577	35	2021年6月28日至2031年6月27日	原始取得	正常使用	
40	Panovas System	PANOVAS SYSTEM	46505795	9	2021年6月28日至2031年6月20日	原始取得	正常使用	
41	Catalysis Series	CATALYSIS SERIES	46509534	41	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
42	芯远景	芯远景	48069007	42	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
43	芯原景	芯原景	48074567	35	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
44	芯远景	芯远景	48052295	9	2021年6月28日至2031年6月27日	原始取得	正常使用	
45	芯远景	芯远景	48067194	41	2021年6月28日至2031年6月27日	原始取得	正常使用	
46	芯原景	芯原景	48073257	42	2021年6月28日至2031年6月27日	原始取得	正常使用	
47	芯原景	芯原景	48073466	9	2021年6月28日至	原始取得	正常使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
					2031年6月27日			
48	芯原景	芯原景	48081209	41	2021年6月28日至2031年6月27日	原始取得	正常使用	
49	BoolSmart System	BOOLSMART SYSTEM	46532949	42	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
50	芯远景	芯远景	48058501	35	2021年6月28日至2031年6月27日	原始取得	正常使用	
51	BoolSmart System	BOOLSMART SYSTEM	46518048	9	2021年6月28日至2031年6月20日	原始取得	正常使用	
52	新愿景	新愿景	48069678	35	2021年6月28日至2031年6月20日	原始取得	正常使用	
53	新愿景	新愿景	48061169	42	2021年6月28日至2031年6月20日	原始取得	正常使用	
54	新愿景	新愿景	48079715	9	2021年6月28日至2031年6月27日	原始取得	正常使用	
55	IPbrain	IPBRAIN	48064343	9	2021年6月28日至2031年6月27日	原始取得	正常使用	
56	新愿景	新愿景	48080309	41	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
57	新远景	新远景	48084101	35	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
58	新远景	新远景	48088553	42	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
59	新远景	新远景	48088867	9	2021年6月28日至2031年6月6日	原始取得	正常使用	
60	Ver i Smart	VERISMART	53456988	42	2021年6月28日至2031年6月13日	原始取得	正常使用	
61	IPBrain	IPBRAIN	52789874	42	2021年6月28日至	原始取得	正常使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
					2031 年 6 月 27 日			
62		CELLIX	68116705A	9	2023 年 6 月 28 日至 2033 年 6 月 13 日	原始取得	正常使用	
63		CELLIX	68116705	9	2023 年 6 月 28 日至 2033 年 6 月 13 日	原始取得	正常使用	
64		CELLIX	66574388	42	2024 年 6 月 28 日至 2034 年 6 月 27 日	原始取得	正常使用	

二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

重大合同是指报告期内公司履行完毕的，或当前正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

具体重大业务合同判断标准为：销售合同统计公司报告期内 500.00 万元以上的销售合同，采购合同统计公司报告期内重要的框架协议。报告期内，公司不存在借款、担保、抵押/质押的业务。具有重大影响的销售合同和采购合同具体明细如下：

（一） 销售合同

序号	合同名称	合同日期	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	《技术服务合同》	2024 年 12 月 26 日	航天科技下属单位 B1	无	样品制备和图像采集、网表提取、电路整理、芯片设计	4,600.00	正在履行
2	《芯片委托技术开发合同》	2020 年 3 月 31 日	中国电子下属单位 C8	无	芯片设计、MPW、Full-Mask、晶圆生产和封装测试	3,310.00	正在履行
3	《芯片委托技术开发合同》	2020 年 3 月 31 日	中国电子下属单位 C8	无	芯片设计、MPW、Full-Mask、晶圆生产和封装测试	3,280.00	正在履行
4	《集成电路技术服务合同》	2021 年 7 月 19 日	中国电科下属单位 A6	无	封装解剖、层次去除、图像采集和处理、网表提取和电路整理及版图设计	1,250.00	正在履行
5	《外包合同（技术类）》	2023 年 4 月 20 日	中国电科下属单位 A1	无	去层拍照、网表提取、电路整理及版图设计	1,198.00	正在履行
6	《技术服务合	2023 年 8 月	中国电子下属单	无	封装解剖、芯片层次	890.00	正在

	同》	2 日	位 C10		去除、图像采集和处理、网表提取、电路整理		履行
7	《32Gbps Serdes Controller IP 核技术开发主合同》	2024 年 11 月 20 日	山东芯慧微电子科技有限公司	无	32Gbps Serdes Controller IP 核部分技术研发工作	698.00	正在履行
8	《集成电路技术服务合同》	2023 年 8 月 8 日	中国电科下属单位 A6	无	封装解剖、层次去除、图像采集和处理、网表提取和电路整理、版图设计及数字单元建库	679.00	正在履行
9	《集成电路设计服务合同》	2023 年 8 月 2 日	中国电子下属单位 C10	无	版图设计	660.00	正在履行
10	《技术服务合同》	2022 年 10 月 8 日	珠海极海半导体有限公司	无	封装解剖、芯片层次去除、图像采集和处理、网表提取、电路整理、数字标准单元区上层引线简易版图	632.00	履行完毕
11	《PCI-EGEN4 接口 IP 核技术开发主合同》	2024 年 11 月 20 日	山东芯慧微电子科技有限公司	无	PCI-EGEN4 接口 IP 核部分技术研发工作	598.00	正在履行
12	《Interlaken IP 核技术开发主合同》	2024 年 11 月 20 日	山东芯慧微电子科技有限公司	无	InterlakenIP 核部分技术研发工作	560.00	正在履行
13	《技术服务协议》	2023 年 9 月 1 日	Intellectual Property ResearchGroup	无	电路专利侵权取证	框架协议	正在履行

（二） 采购合同

序号	合同名称	合同日期	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	《晶圆制造协议》	2016 年 1 月 6 日	上海华虹宏力半导体制造有限公司	无	生产制造晶圆产品	框架协议	正在履行

（三） 借款合同

☐适用 ☒不适用

（四） 担保合同

☐适用 ☒不适用

（五） 抵押/质押合同

☐适用 ☒不适用

（六） 其他情况

☐适用 ☒不适用

三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

☒适用 ☐不适用

承诺主体名称	控股股东、实际控制人：丁柯、蒋卫军、张军、丁仲
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	规范或避免同业竞争的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除公司（包括其控制的企业，下同）外的其他企业、经营实体，目前均未以任何形式从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，亦未直接或间接拥有与公司构成或可能构成竞争的其他企业、经营实体的权益。 2、本人承诺在作为公司控股股东、实际控制人及其一致行动人期间： （1）不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向业务与公司相同、类似或任何方面与公司构成竞争的企业、经营实体提供客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。 （2）如本人及本人控制的其他企业被认定与公司存在同业竞争，本人将或促使本人所控制的其他企业将该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或公司，或终止该企业的经营；如公司有能力、有意向，可以采取优先收购或委托经营的方式将相关竞争企业、经营实体的竞争业务集中到公司经营，以避免同业竞争。如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，如公司有能力、有意向承揽该业务的，尽力将该商业机会让予公司。 （3）如本人及本人控制的企业在承担科研项目过程中形成任何与公司的主营业务相关的科技成果并将其用于商业化的，在同等条件下，公司拥有优先购买权或合作权。 （4）如违反上述承诺的，本人将立即停止与公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本人未履行

	本承诺函所作的承诺而给公司造成的相关损失和后果承担相关赔偿责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	详见本节之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”之“其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺”。

承诺主体名称	控股股东、实际控制人：丁柯、蒋卫军、张军、丁仲
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	减少或规范关联交易的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、本人将诚信和善意履行作为公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的义务，尽量避免和减少与公司（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的除公司以外的其他企业、经营实体将与芯愿景按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序、信息披露义务及回避表决义务，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性。 2、本人保证诚实守信，依法行使股东权利，不滥用控制权，不通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司或其他股东的合法权益；保证不利用控股股东、实际控制人及其一致行动人地位谋取不当利益或谋求与公司达成交易的优先权利，不以任何其他形式损害公司及公司其他股东的合法权益。 3、本人承诺将杜绝本人及本人控制的除公司外的其他企业、经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司的资金、资产的行为。 如因本人或本人控制的企业、经营实体违反上述承诺与保证而导致公司的权益受到损害，本人愿意承担因此给公司造成的相关损失。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	详见本节之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”之“其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺”。

承诺主体名称	全体董事、监事、高级管理人员
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他

承诺事项	减少或规范关联交易的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、本人将诚信和善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与公司（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制或施加重大影响的企业、经营实体将与芯愿景按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序、信息披露义务及回避表决义务，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性。 2、本人保证诚实守信，依法行使董事/监事/高级管理人员权利，不滥用董事/监事/高级管理人员权利，不通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司或其他股东的合法权益；保证不利用董事/监事/高级管理人员地位谋取不当利益或谋求与公司达成交易的优先权利，不以任何其他形式损害公司及公司其他股东的合法权益。 3、本人承诺杜绝本人及本人控制的企业、经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司的资金、资产的行为。 4、本人承诺在任何情况下，不要求芯愿景向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。 如因本人及本人控制或施加重大影响的企业、经营实体违反上述承诺与保证而导致公司的权益受到损害，本人愿意承担因此给公司造成的相关损失。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	详见本节之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”之“其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺”。

承诺主体名称	控股股东、实际控制人、董事：丁柯、蒋卫军、张军、丁仲
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	股份增持或减持的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，本人在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为本人挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前 12 个月以内本人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的限售安排按照前款承诺执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人

	应继续执行股票限售安排。 2、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，本人作为公司董事，应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，本人在就任时确定的担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 若本人未履行上述承诺，本人将根据法律、法规、规章及规范性文件的规定承担相应的法律责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	详见本节之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”之“其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺”。

承诺主体名称	持有公司股份的监事、高级管理人员：张金正、熊伟、石子信、王艳红
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	股份增持或减持的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，本人作为公司监事/高级管理人员，应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，本人在就任时确定的担任公司监事/高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 若本人未履行上述承诺，本人将根据法律、法规、规章及规范性文件的规定承担相应的法律责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	详见本节之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”之“其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺”。

承诺主体名称	同创愿景、新创愿景
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他
承诺事项	股份增持或减持的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，本企业在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除限售，每

	批解除限售的数量均为本企业挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前 12 个月以内本企业直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的限售安排按照前款承诺执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售安排。 若企业未履行上述承诺，企业将根据法律、法规、规章及规范性文件的规定承担相应的法律责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	详见本节之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”之“其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺”。

承诺主体名称	控股股东、实际控制人：丁柯、蒋卫军、张军、丁仲
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	不存在占用公司资金事项的承诺函
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业不存在以任何形式占用公司及其控股子公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司为本人及本人控制或施加重大影响的其他企业提供担保的情况。 2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，维护公司的独立性，避免本人及本人控制或施加重大影响的其他企业与公司及其控股子公司发生除正常业务外的资金往来，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。 如因违反该等声明与承诺而导致公司的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	详见本节之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”之“其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺”。

承诺主体名称	全体董事、监事、高级管理人员
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	不存在占用公司资金事项的承诺函
承诺履行期限类别	长期有效

承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业不存在以任何形式占用公司及其控股子公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司为本人及本人控制或施加重大影响的其他企业提供担保的情况。 2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，维护公司的独立性，避免本人及本人控制或施加重大影响的其他企业与公司及其控股子公司发生除正常业务外的资金往来，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。 本人关系密切的家庭成员及本人与该等人士控制或施加重大影响的企业也应遵守上述声明与承诺。 如因违反该等声明与承诺而导致公司的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	详见本节之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”之“其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺”。

承诺主体名称	申请挂牌公司：芯愿景
承诺主体类型	☒ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，公司将采取以下措施： （1）公司将在股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉； （2）公司有权对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬、津贴（如在公司领薪）等措施，直至相关人员履行承诺； （3）若因公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法向投资者赔偿损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，公司将采取以下措施： （1）公司将及时披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）公司将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监

	管机构及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	见本承诺

承诺主体名称	控股股东、实际控制人：丁柯、蒋卫军、张军、丁仲
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施： （1）本人将在股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉； （2）公司有权在本人未履行该等承诺之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红，直至本人履行相关承诺； （3）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付至公司指定账户； （4）若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施： （1）本人将及时披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）本人将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 上述承诺内容系本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	见本承诺

承诺主体名称	全体董事、监事、高级管理人员
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺

承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施： （1）本人将在公司股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉； （2）公司有权在本人未履行该等承诺之日起 10 个交易日内，停发本人应在公司领取的薪酬、津贴（如在公司领薪）直至本人履行相关承诺； （3）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付至公司指定账户； （4）若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施： （1）本人将及时披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）本人将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 上述承诺内容系本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	见本承诺

承诺主体名称	同创愿景、新创愿景
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他
承诺事项	其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本企业将采取以下措施： （1）本企业将在股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉； （2）公司有权在本企业未履行该等承诺之日起 10 个交易日内，停止对本企业进行现金分红，直至本企业履行相关承诺； （3）如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收

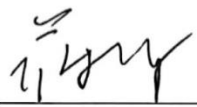
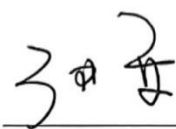
	益归公司所有；本企业在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付至公司指定账户； （4）若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本企业将采取以下措施： （1）本企业将及时披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）本企业将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 上述承诺内容系本企业的真实意思表示，本企业自愿接受监管机构及社会公众的监督，若违反上述承诺，本企业将依法承担相应责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	见本承诺

第七节 有关声明

申请挂牌公司控股股东、实际控制人声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人（签字）：

 _____	 _____	 _____
丁 柯	蒋卫军	张 军
 _____		
丁 仲		

北京芯愿景软件技术股份有限公司

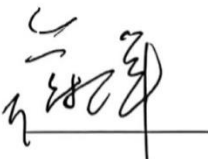
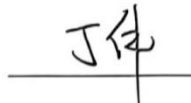
2025 年 8 月 4 日



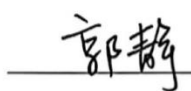
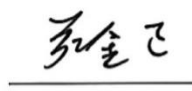
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：

			
丁 柯	蒋卫军	张 军	丁 仲
			
魏 峻	李晓辉	范宏伟	

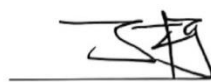
全体监事（签字）：

		
郭 静	张金正	熊 伟

非董事高级管理人员（签字）：

	
石子信	王艳红

法定代表人（签字）：


丁 柯

北京芯愿景软件技术股份有限公司

2015年8月4日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

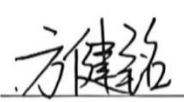
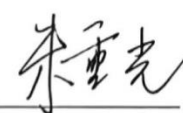
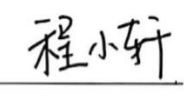
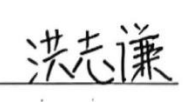
法定代表人或授权代表人(签字):


何之江

项目负责人(签字):


郭鑫

项目小组成员(签字):


方健铭
何国威
朱重光
董伟丽
程小轩
洪志谦

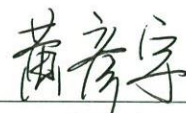
律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《北京芯愿景软件技术股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：



郑超



黄彦宇

负责人：



龙海涛



审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的天职业字[2025]9639号审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的上述报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师(签字+盖章):

中国注册会计师
袁刚
110101500102

袁刚

中国注册会计师
闫丽娜
110101505271

闫丽娜

会计师事务所负责人(签字+盖章):

邱靖之

邱靖之

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



2025年8月4日

评估机构声明

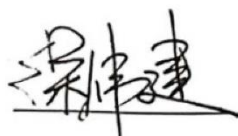
本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师(签字): _____

王爱萍(已离职)

胡启中(已离职)

资产评估机构负责人(签字):



徐伟建

沃克森(北京)国际资产评估有限公司



沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于评估人员离职的说明

本机构于2019年9月24日为北京芯愿景软件技术股份有限公司（原公司名称为“北京芯愿景软件技术有限公司”）出具了“沃克森评报字（2019）1265号”《北京芯愿景软件技术有限公司拟了解股权激励计划公允价值项目涉及北京芯愿景软件技术有限公司全部权益资产评估报告》；2019年9月26日为北京芯愿景软件技术股份有限公司出具了“沃克森评报字（2019）1279号”《北京芯愿景软件技术有限公司拟变更为股份有限公司涉及北京芯愿景软件技术有限公司净资产资产评估报告》。

上述资产评估报告的签字评估师胡启中已于2021年3月离职，王爱萍已于2024年1月离职，上述人员的离职不影响本机构出具的上述报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人（签字）：



徐伟建

沃克森（北京）国际资产评估有限公司



第八节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件
- 六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 七、其他与公开转让有关的重要文件